

证券代码：002049

证券简称：晶源电子

# 唐山晶源裕丰电子股份有限公司

## 非公开发行股份购买资产暨关联交易

### 报告书

上市公司名称：唐山晶源裕丰电子股份有限公司  
股票上市地点：深圳证券交易所  
股票简称：晶源电子  
股票代码：002049

交易对方	住所	通讯地址
同方股份有限公司	北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层	北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层
北京清晶微科技有限公司	北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场A座29层2901室	北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场A座29层2901室
赵维健	北京市海淀区	北京市海淀区知春路27号量子芯座11层
葛元庆	北京市海淀区	北京市海淀区知春路27号量子芯座11层
吴行军	北京市海淀区	北京市海淀区知春路27号量子芯座11层
段立	北京市海淀区	北京市海淀区知春路27号量子芯座11层
孟红霞	北京市海淀区	北京市海淀区知春路27号量子芯座11层
宋翌	北京市海淀区	北京市海淀区知春路27号量子芯座11层
丁义民	北京市海淀区	北京市海淀区知春路27号量子芯座11层
李刚	北京市海淀区	北京市海淀区知春路27号量子芯座11层



二〇一二年三月

## 公司声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会及其它政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

## 修订说明

根据《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（110112号）、《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（110112号）和《关于唐山晶源裕丰电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案反馈意见的函》（上市部函【2011】443号）的要求，本公司对重组报告书进行了补充和完善，补充和完善的主要内容如下：

1、补充说明了交易对方清晶微科技设立的目的以及清晶微科技股东的基本情况。请详见重组报告书“第三节 交易对方的基本情况”之“三、交易对方之二：北京清晶微科技有限公司”之“（五）公司设立的目的”以及之“（六）现有股东的基本情况”。

2、补充说明了陆致成未参股交易对方清晶微科技的原因。请详见重组报告书“第三节 交易对方的基本情况”之“三、交易对方之二：北京清晶微科技有限公司”之“（七）陆致成未参股公司的原因”。

3、补充说明了本次交易相关内幕信息知情人在交易前六个月内买卖同方股份股票的具体情况。请详见重组报告书“第十三节 其他对上市公司的影响”之“五、对相关人员买卖同方股份股票情况的自查”。

4、补充说明了预测标的资产同方微电子金融支付产品的营业收入未来大幅度增加的原因，以及同方微电子在金融支付产品方面相应的研发、管理和销售能力。请详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“三、交易标的评估情况说明”之“（四）收益法评估参数选择”之“2、金融支付产品收入未来增长的原因及合理性”。

5、补充说明了标的资产同方微电子供应商华虹 NEC 与其竞争对手华虹集成电路之间的关系对同方微电子业务的影响。请详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“二、交易标的业务与技术”之“（五）主要产品成本构成情况”之“4、华虹 NEC 和华虹集成电路公司的关联关系”。

6、补充说明了标的资产同方微电子所处集成电路设计行业与晶源电子、同方股份在行业结构方面的关联度，进一步说明了本次交易的目的。请详见重组报

报告书“第一节 本次交易概述”之“二、本次交易的背景和目的”之“(二) 本次交易的目的”。

7、补充说明了本次交易对交易对方同方股份资产负债结构、经营业绩等方面的影响程度。请详见重组报告书“第五节 本次股份发行情况”之“三、本次交易对同方股份的影响”。

8、补充说明了本次交易评估折现率取值的依据和合理性。请详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“三、交易标的评估情况说明”之“(四) 收益法评估参数选择”之“4、折现率的确定”。之“(5) 折现率取值的合理性”。

9、补充说明了标的资产同方微电子采用市场法评估时可比公司选择的依据及合理性。请详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“三、交易标的评估情况说明”之“(二) 市场法评估情况”之“2、可比公司的选择”。

10、补充说明了标的资产同方微电子保持核心技术人员团队稳定的具体措施。。请详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“二、交易标的的业务与技术”之“(三) 主要经营模式”之“1、研发模式”。

11、补充说明了标的资产同方微电子股权存在被代持的过程、被代持股东出资情况以及参与同方微电子利润分配的情况。请详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“一、交易标的概况”之“(十) 股份代持基本情况”。

12、根据相关审计报告，将重组报告中涉及标的资产同方微电子的相关财务会计数据以及相应的数据分析更新至2011年9月30日。请详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”、“第九节 本次交易对上市公司的影响”和“第十节 财务会计信息”等。

13、由于审核期间评估报告过期，根据相关评估报告，将重组报告中涉及标的资产同方微电子的评估情况进行了更新。请详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“三、交易标的评估情况说明”、“第八节 董事会对交易定价依据及公平合理性分析”。

14、补充说明了本次重组完成后上市公司与标的资产之间实现业务整合和协同发展的具体措施。请详见重组报告书“第九节 本次交易对上市公司的影响”之“五、交易完成后，公司资产、业务整合及人员调整计划”。

15、补充说明了标的资产同方微电子 2011 年盈利预测实现情况。请详见重组报告书“第九节 本次交易对上市公司的影响”之“三、交易标的最近三年一期财务状况、盈利能力分析”之“(二) 交易标的的经营成果分析”之“5、2011 年盈利预测实现情况分析”。

16、补充说明了标的资产同方微电子在评估过程中溢余资产的确定方法和确定过程、预测年度付现的次数确定方法和确定过程。请详见重组报告书“第四节 本次交易标的”之“三、交易标的的评估情况说明”之“(四) 收益法评估参数选择”之“5、溢余资产的确定方法和确定过程”和之“6、预测年度付现次数的确定方法和确定过程”。

17、更新披露了标的资产同方微电子主要资产权属情况。请详见重组报告书“第四节 本次交易标的”之“三、交易标的的概况”之“(六) 主要资产及其权属情况”。

## 重大事项提示

### 一、本次交易方案已获中国证监会审批

本公司非公开发行股份购买资产暨关联交易已经获得中国证监会《关于核准唐山晶源裕丰电子股份有限公司向同方股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2012】340号）核准，核准本公司向同方股份有限公司等发行股份购买相关资产。

### 二、本次交易为关联交易且构成重大资产重组

公司本次拟购买的标的资产为交易对方持有的同方微电子 100%的股权。本次交易完成后，同方微电子将成为公司的全资子公司，公司本次发行股份购买标的资产的价格为 149,134.01 万元，占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元人民币，根据中国证监会《重组办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。

本次交易前，交易对方同方股份持有公司 25%的股权，为公司控股股东；交易对方赵维健、段立为公司第四届董事会董事，交易对方吴行军为公司第四届监事会监事，因此，本次交易构成关联交易。

### 三、本次交易标的估值作价

根据具有证券业务资格的中发国际资产评估有限公司出具并经教育部备案的《资产评估报告书》（中发评报字【2010】第 083 号），在评估基准日 2010 年 10 月 31 日，同方微电子净资产账面价值为 50,833.27 万元；采用市场法确定的股东全部权益评估价值为区间值 144,167.48 万元~156,181.15 万元，比股东权益账面价值增值 93,334.22 万元~105,347.88 万元，增值率为 183.61%~207.24%；采用收益法确定的股东全部权益评估价值为 149,134.01 万元，增值额为 98,300.74 万元，增值率为 193.38%。鉴于本次评估目的是转让股东全部权益，运用收益法评估能够真实地反映企业整体资产的价值，本次交易标的的评估价值最终以收益法的评估结果作为评估结论。

截至 2011 年 10 月 31 日，《资产评估报告》（中发评报字【2010】第 083 号）

已过有效期。公司聘请中发评估出具了以 2010 年 12 月 31 日为评估基准日的《资产评估报告》（中发评报字【2011】第 103 号），并经教育部备案。在评估基准日 2010 年 12 月 31 日，同方微电子净资产账面价值为 51,846.14 万元；采用市场法确定的股东全部权益评估价值为区间值 146,594.49 万元~158,810.70 万元，比股东权益账面价值增值 94,748.35 万元~106,964.56 万元，增值率为 182.75%~206.31%；采用收益法确定的股东全部权益评估价值为 151,071.75 万元，增值额为 99,225.61 万元，增值率为 191.38%。本次交易标的的评估价值最终仍以收益法的评估结果作为评估结论。

截至 2011 年 12 月 31 日，《资产评估报告》（中发评报字【2011】第 103 号）已过有效期。公司聘请中发评估出具了以 2011 年 9 月 30 日为评估基准日的《资产评估报告》（中发评报字【2011】第 138 号），并经教育部备案。在评估基准日 2011 年 9 月 30 日，同方微电子净资产账面价值为 58,898.58 万元；采用市场法确定的股东全部权益评估价值为区间值 170,634.80 万元~184,854.36 万元，比股东权益账面价值增值 111,736.22 万元~125,955.79 万元，增值率为 189.71%~213.85%；采用收益法确定的股东全部权益评估价值为 153,412.31 万元，增值额为 94,513.73 万元，增值率为 160.47%。本次交易标的的评估价值最终仍以收益法的评估结果作为评估结论。

经交易双方协商一致，本次交易标的资产的交易价格维持公司第四届董事会第四次会议确定的交易价格不变，仍为 149,134.01 万元。即公司拟向交易对方购买的标的资产的价格仍为 149,134.01 万元，相应的本公司向交易对方发行新增股份数量也保持不变（最终以中国证监会核准的发行数量为准）。

虽然评估机构在评估过程中严格按照评估相关规定，遵循谨慎原则，履行了勤勉、尽职的职责，但仍存在因未来实际情况与评估假设不一致的风险。公司已与交易对方签署了《利润补偿协议》，同方微电子在承诺期间内实际实现的净利润低于承诺净利润的部分，将由交易对方按照其在同方微电子的持股比例以股份回购方式进行补偿。

#### 四、本次交易的盈利预测

本公司和交易标的同方微电子均已编制了 2010 年、2011 年的盈利预测报告，

并经具有证券业务资格的会计师事务所进行了审核。

根据北京兴华会计师事务所出具的《盈利预测审核报告》((2010)京会兴核字第 1-52 号),同方微电子 2011 年度的净利润为 7,246.89 万元。同方微电子 2011 年 1-9 月份已经实现净利润为 7,052.43 万元。

根据北京兴华会计师事务所出具的《备考盈利预测审核报告》((2010)京会兴核字第 1-53 号),本次交易完成后,晶源电子 2011 年全年实现净利润约 10,034.54 万元。按照发行完成后 24,099.43 万股计算,2011 年晶源电子基本每股收益约为 0.42 元/股。目前晶源电子 2010 年归属于母公司的净利润为 3,760.45 万元,基本每股收益为 0.279 元/股,本次交易将有利于提高上市公司盈利能力。

盈利预测的编制主要依据同方微电子、晶源电子实际情况及目前已知的市场资料,尽管遵循了谨慎性原则,但是盈利预测假设前提可能受到宏观经济周期、行业政策、市场供求等各种因素的影响而存在一定的不确定性,提醒投资者关注本次盈利预测的相关假设的不确定性以及由此而引致的交易标的经营业绩下降风险。

## 五、本次交易已经获得的批准

根据《重组办法》的相关规定,本次交易已经获得批准包括:

- 1、公司董事会和股东大会通过本次交易并批准同方股份及其一致行动人免于以要约方式增持上市公司股份;
- 2、交易对方同方股份董事会和股东大会审议批准了本次交易;
- 3、交易对方清晶微科技股东大会审议批准了本次交易;
- 4、教育部对本次评估报告的备案;
- 5、教育部对本次交易的批准。
- 6、中国证监会对本次交易的核准;

## 六、本次交易的利润补偿情况

根据公司与同方股份、清晶微科技、其它八名自然人股东签署的《利润补偿协议》及《利润补偿补充协议》,同方股份、清晶微科技、其它八名自然人股东

承诺：如果本次交易于 2011 年度实施完毕（本次交易实施完毕以本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限公司办理完成证券登记手续为准），2011 年、2012 年、2013 年同方微电子实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于人民币 7,246.57 万元、9,009.69 万元和 10,715.19 万元。若同方微电子 2011 年、2012 年、2013 年实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润低于上述利润预测值，则由同方股份、清晶微科技、其它八名自然人股东负责向公司进行补偿，具体补偿方式为：

同方股份、清晶微科技、其它八名自然人股东在 2011 年、2012 年、2013 年公司年度审计报告出具后 30 个工作日内按照下述公式计算应回购股份数并协助公司通知证券登记结算机构，将应回购股份转移至公司董事会设立的专门账户，进行单独锁定。交易对方自应回购股份转移至公司董事会设立的专门账户后，不再拥有回购股份的表决权且不享有股利分配的权利，该部分被锁定的股份应分配的利润归公司所有。同方股份、清晶微科技、其它八名自然人股东按照其各自在本次交易前持有同方微电子的股权比例分别计算该部分补偿股份。回购股份数计算公式为：

回购股份数量=（截至当期期末对应标的资产累积预测净利润数－截至当期期末对应标的资产累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的对应标的资产预测净利润数总和－已补偿股份数量

如果利润补偿期内公司以转增或送股方式进行分配而导致交易对方持有的公司股份数发生变化，则回购股份的数量应调整为：按上款公式计算的回购股份数×（1+转增或送股比例）。

在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。

在补偿期限届满时，晶源电子将对标的资产进行减值测试，如期末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则交易对方将另行补偿股份。另需补偿的股份数量为：期末减值额/每股发行价格－补偿期限内已补偿股份总数。

公司将在在利润补偿期限届满且确定最后一个会计年度应回购股份数量并

完成锁定手续后，应在两个月内就全部应回购股份的股票回购事宜召开股东大会。若股东大会通过定向回购议案，公司将以总价人民币 1.00 元的价格定向回购上述专户中存放的全部股份，并予以注销；若股东大会未通过上述定向回购议案，则公司应在股东大会决议公告后 10 个交易日内书面通知交易对方，交易对方将在接到通知后的 30 日内将上述存放于公司董事会设立的专门账户中的全部已锁定股份赠送给公司董事会确定的股权登记日在册的除交易对方以外的其他股东，其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除交易对方持有的股份数后公司的股本数量的比例享有获赠股份。

## 七、本次交易的股份锁定情况

资产出让方同方股份承诺：本次交易完成后，同方股份所拥有的晶源电子的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不转让。

资产出让方清晶微科技承诺：本次交易完成后，清晶微科技所拥有的晶源电子的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不转让。

资产出让方赵维健、葛元庆、吴行军、段立、孟红霞、宋翌、丁义民、李刚承诺：本次以资产认购的股份，自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不转让。

## 八、本次交易完成后公司仍然符合上市条件

本次交易完成后，公司股本增加到 24,099.43 万股，社会公众股持股比例超过 25%，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》所规定的上市条件。

## 九、本次交易的其它风险

### 1、新技术研发风险

同方微电子为了保持技术领先优势，必须尽可能准确地预测相关芯片技术的发展方向、技术产业化及市场化的发展趋势，并进行相应的研发投入。同方微电子制定了完善的技术研发管理制度和风险控制流程，所有研发项目都必须经过前期调研和论证，履行严格的决策程序后方可实施。但由于对未来市场的预测存在不确定性，如果同方微电子对相关芯片技术和市场发展趋势判断失误，或新技术产业化存在重大不确定性，将可能让同方微电子面临风险。

## 2、对核心技术人员依赖的风险

同方微电子拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是同方微电子技术持续领先、产品不断创新的主要因素之一。为了吸引和留住核心技术人才，同方微电子制定了行业内具有竞争力的薪酬政策和职业发展规划体系；并通过中高层管理人员和核心技术人员持股，增强相关人员对公司的归属感。随着行业的发展，企业间人才竞争的日趋激烈，人才流动可能增加，同方微电子仍存在核心技术人才流失的风险。

## 3、业务模式风险

同方微电子采用 Fabless 运营模式，有效降低了运营成本，提高了资金使用效益。但由于 Fabless 运营模式中，同方微电子本身不具备芯片制造能力，芯片制造、封装和测试必须依托晶圆代工厂商和封装测试厂商。为保证产品供应环节的稳定性，同方微电子已与多家有实力的晶圆代工厂商和封装测试厂商建立长期稳定的合作关系。但在集成电路生产旺季，可能会存在晶圆代工厂商和封装测试厂商产能饱和，不能保证公司产品及时供应的风险。

## 4、主要客户集中的风险

同方微电子2008年、2009年、2010年、2011年1-9月份向前五名客户销售涉及金额合计分别为37,304.98万元、43,175.04万元、31,821.70万元、24,504.73万元，占同期销售总金额的比例分别为94.04%、95.94%、92.43%、91.42%。同方微电子存在客户相对集中的风险，可能会因为某一单个客户的变动，影响同方微电子的经营业绩。

2008年、2009年、2010年、2011年1-9月份同方微电子向公安部第一研究所的销售占同期销售总金额的比例分别为70.09%、65.99%、41.97%、50.34%，销售的内容为国家二代身份证芯片。销售占比比较高的主要原因在于同方微电子在成立之初就承担了国家第二代居民身份证专用芯片模块开发和生产供应任务，是公安部指定的四家二代身份证芯片供应商之一。公安部每年根据二代身份证换发情况，给四家供应商下达芯片生产指标，由公安部第一研究所负责统一采购。同时，在成立之初，公司的产品线相对单一，二代身份证芯片在销售收入中所占比重比较高。随着第二代居民身份证大规模换证进入尾声，第二代居民身份证芯片

供应进入平稳期，以及公司产品线的丰富，SIM卡业务业务的迅猛发展，同方微电子与公安部第一研究所的销售占比在报告期内持续下降，由70.09%下降到50.34%，未来将持续降低。

## 5、主要供应商集中的风险

同方微电子2008年、2009年、2010年、2011年1-9月份向前五名供应商采购金额合计分别为25,879.54万元、15,613.96万元、21,454.04万元、17,390.91万元，占同期采购总金额的比例分别为98.64%、96.88%、97.40%、94.86%，采购比例比较集中。报告期内，上海华虹NEC电子有限公司是公司最大的供应商，2008年、2009年、2010年、2011年1-9月份同方微电子向上海华虹NEC电子有限公司的采购金额占当期采购总额的比例分别为68.68%、59.35%、63.32%、70.09%。公司对其采购内容为晶圆。上海华虹NEC电子有限公司是全球领先的晶圆代工厂商，双方业已建立起长期稳定的良好合作关系，签署了战略合作协议。相对于其它可供选择的代工厂商，在公司部分的芯片产品中，上海华虹NEC电子有限公司的工艺和技术可更有效提升公司产品的成功率和稳定性。公司与上海华虹NEC电子有限公司的交易价格与业界平均水平相当，价格公允，双方为平等的合作关系，对主要供应商不存在重大依赖。

公司对供应商价格确定有完备、严格的决策程序，以“品质优先”、“货比三家”策略为基础，在保证产品质量的前提下，以“成本导向定价”方法为主。同时考虑，同等质量和价格条件下，交付周期最短者优先；同等上述条件下，技术支持服务较好者优先。

## 6、管理风险

本次交易完成后，公司的资产和业务规模将出现大幅增长。尽管公司已建立规范的管理体系，经营状况良好，但随着公司规模迅速的扩大，技术创新要求将加快，组织结构和管理体系需要向更有效率的方向发展，公司经营决策和风险控制难度将增加。如公司的组织管理体系和人力资源不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，公司的生产经营和业绩提升将受到一定影响。

## 7、大股东控制风险

目前公司的控股股东同方股份持有公司25%的股份，本次重组完成后，预计

同方股份持有的公司股份比例将增加至 51.83%，处于绝对控股地位。同方股份可能通过公司董事会或通过行使股东表决权等方式对公司的人事、经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司其他股东的利益。

同方股份承诺，保证在本次重组完成后，将按照中国证监会规范性文件的要求，做到与晶源电子在资产、业务、机构、人员、财务方面完全分开，切实保障晶源电子在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立运作。

## **8、股市风险**

股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩，还受到宏观经济周期、利率、资金供求关系等因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。因此，股票交易是一种风险较大的投资活动，投资者对此应有充分准备。公司本次交易需要有关部门审批，且审批时间存在不确定性，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

# 目录

公司声明.....	2
修订说明.....	3
重大事项提示.....	6
一、本次交易方案已获中国证监会审批.....	6
二、本次交易为关联交易且构成重大资产重组.....	6
三、本次交易标的估值作价.....	6
四、本次交易的盈利预测.....	7
五、本次交易已经获得的批准.....	8
六、本次交易的利润补偿情况.....	8
七、本次交易的股份锁定情况.....	10
八、本次交易完成后公司仍然符合上市条件.....	10
九、本次交易的其它风险.....	10
释 义.....	19
第一节 本次交易概述.....	22
一、本次交易的背景和目的.....	22
二、本次交易的决策过程.....	25
三、本次交易的主要内容.....	27
第二节 上市公司基本情况.....	30
一、公司概况.....	30
二、公司设立及上市情况.....	30
三、公司历次股本变动情况.....	31
四、公司最近三年重大资产重组情况.....	32
五、公司最近三年控股权变动情况.....	32
六、公司主营业务情况.....	33
七、主要财务数据.....	33

八、公司控股股东及实际控制人概况.....	34
<b>第三节 交易对方的基本情况.....</b>	<b>36</b>
一、交易对方概况.....	36
二、交易对方之一：同方股份有限公司.....	36
三、交易对方之二：北京清晶微科技有限公司.....	44
四、交易对方之三：其它八名自然人股东.....	52
五、交易对方与上市公司的关联关系情况.....	55
六、交易对方最近五年内受到行政处罚的基本情况.....	55
<b>第四节 交易标的基本情况.....</b>	<b>56</b>
一、交易标的概况.....	56
二、交易标的的业务和技术.....	74
三、交易标的的评估情况说明.....	93
四、债权债务转移情况.....	118
五、重大会计政策或会计估计差异情况.....	118
<b>第五节 本次股份发行情况.....</b>	<b>119</b>
一、本次发行股份购买资产的具体方案.....	119
二、本次交易对上市公司的影响.....	120
三、本次交易对同方股份的影响.....	123
<b>第六节 本次交易合同的主要内容.....</b>	<b>125</b>
一、《非公开发行股票购买资产协议》及《非公开发行股票购买资产之补充协议》的主要内容.....	125
二、《利润补偿协议》的主要内容.....	127
三、交易标的的其他股东放弃优先购买权的主要内容.....	128
<b>第七节 本次交易的合规性分析.....</b>	<b>130</b>
一、本次交易符合《重组办法》第十条的规定.....	130
二、本次交易符合《重组办法》第四十二条要求的说明.....	135
<b>第八节 董事会对交易定价依据及公平合理性分析.....</b>	<b>139</b>

一、本次交易定价的依据.....	139
二、标的资产价格公允性分析.....	140
三、董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见.....	142
四、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见.....	143
<b>第九节 本次交易对上市公司的影响.....</b>	<b>144</b>
一、本次交易前上市公司财务状况、经营成果的讨论与分析.....	144
二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析.....	150
三、交易标的最近三年一期财务状况、盈利能力分析.....	167
四、上市公司完成交易后的财务状况、盈利能力及未来盈利趋势分析.....	201
五、交易完成后，公司的资产、业务整合及人员调整计划.....	211
<b>第十节 财务会计信息.....</b>	<b>213</b>
一、交易标的最近三年一期合并财务报表.....	213
二、上市公司最近两年一期备考合并财务报表.....	222
三、标的资产盈利预测审核报告.....	226
四、上市公司备考合并盈利预测审核报告.....	228
<b>第十一节 同业竞争和关联交易.....</b>	<b>230</b>
一、本次交易对同业竞争的影响.....	230
二、本次交易对关联交易的影响.....	233
<b>第十二节 本次交易对公司治理机制的影响.....</b>	<b>239</b>
一、公司拟采取的完善公司治理结构的措施.....	239
二、控股股东对上市公司的承诺.....	240
<b>第十三节 其他对上市公司的影响.....</b>	<b>243</b>
一、资金占用和关联担保.....	243
二、本次交易对上市公司负债结构的影响.....	244
三、连续停牌前公司股票价格的波动情况.....	244

四、对相关人员买卖公司股票情况的自查.....	245
五、对相关人员买卖同方股份股票情况的自查.....	247
六、其他影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息 .....	255
<b>第十四节 风险因素</b> .....	<b>256</b>
一、新技术研发风险.....	256
二、对核心技术人员依赖的风险.....	256
三、业务模式风险.....	256
四、主要客户集中的风险.....	257
五、主要供应商集中的风险.....	257
六、管理风险.....	258
七、大股东控制风险.....	258
八、股市风险.....	258
<b>第十五节 独立董事、财务顾问和法律顾问对本次交易的结论性意见</b> .....	<b>260</b>
一、独立董事意见.....	260
二、律师法律意见.....	261
三、独立财务顾问意见.....	261
<b>第十六节 相关中介机构</b> .....	<b>263</b>
一、独立财务顾问.....	263
二、法律顾问.....	263
三、审计机构.....	263
四、资产评估机构.....	263
<b>第十七节 董事及相关中介机构的声明</b> .....	<b>265</b>
一、公司全体董事声明.....	266
二、同方股份有限公司声明.....	267
三、北京清晶微科技有限公司声明.....	268
四、八位自然人声明.....	269
五、审计机构声明.....	270

六、资产评估机构声明.....	271
七、法律顾问声明.....	272
八、独立财务顾问声明.....	273
<b>第十八节 备查文件</b> .....	<b>274</b>
一、备查文件.....	274
二、备查地点.....	274

## 释 义

1、本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

本公司/公司/上市公司/发行人/晶源电子	指	唐山晶源裕丰电子股份有限公司
交易对方	指	同方股份有限公司、北京清晶微科技有限公司、赵维健、葛元庆、吴行军、段立、孟红霞、宋翌、丁义民、李刚
同方股份	指	同方股份有限公司
一致行动人、清晶微科技	指	北京清晶微科技有限公司
其它八名自然人股东	指	赵维健、葛元庆、吴行军、段立、孟红霞、宋翌、丁义民、李刚
同方微电子	指	北京同方微电子有限公司
晶源科技	指	唐山晶源科技有限公司
教育部	指	中华人民共和国教育部
交易标的、目标资产、标的资产、拟购买资产	指	同方股份有限公司、北京清晶微科技有限公司、其它八名自然人股东合计持有的北京同方微电子有限公司 100%股权
本次交易、本次资产重组、本次重组	指	晶源电子向同方股份有限公司、北京清晶微科技有限公司、其它八名自然人股东非公开发行股份购买其持有的目标资产之交易行为
《非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》、本报告书	指	《唐山晶源裕丰电子股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》
《非公开发行股票购买资产协议》	指	《唐山晶源裕丰电子股份有限公司与同方股份有限公司、北京清晶微科技有限公司之非公开发行股票购买资产协议》和《唐山晶源裕丰电子股份有限公司与赵维健、葛元庆、吴行军、段立、孟红霞、宋翌、丁义民、李刚之非公开发行股票购买资产协议》
《非公开发行股票购买资产之补充协议》	指	《唐山晶源裕丰电子股份有限公司与同方股份有限公司、北京清晶微科技有限公司非公开发行

		股票购买资产之补充协议》和《唐山晶源裕丰电子股份有限公司与赵维健、葛元庆、吴行军、段立、孟红霞、宋翌、丁义民、李刚非公开发行股票购买资产之补充协议》
《利润补偿协议》	指	《唐山晶源裕丰电子股份有限公司非公开发行股票购买资产之利润补偿协议》
《利润补偿补充协议》	指	《唐山晶源裕丰电子股份有限公司非公开发行股票购买资产之利润补偿补充协议》
作价基准日	指	2010年10月31日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
独立财务顾问/西南证券	指	西南证券股份有限公司
法律顾问/中咨律师	指	北京市中咨律师事务所
中发评估	指	中发国际资产评估有限公司
兴华事务所	指	北京兴华会计师事务所有限责任公司
华虹 NEC	指	上海华虹NEC电子有限公司
华虹集成电路公司	指	上海华虹集成电路有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

2、本报告书涉及专业术语释义如下：

集成电路、IC	指	采用半导体制作工艺,在一块较小的单晶硅片上制作许多晶体管及电阻器、电容器等元器件,并按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路
晶圆	指	又称 wafer、圆片,用以制作芯片的圆形硅晶体半导体材料
SIM	指	Subscriber Identity Module的缩写。在卡片内含的芯片上存储了数字移动电话客户的信息、加密的密钥以及用户的电话簿等内容,可供GSM网络客户身份进行鉴别,并对客户通话时的语音信息进行加密
Fabless	指	无晶圆厂的集成电路企业经营模式,采用该模式的厂商仅进行芯

		片的设计、研发、应用和销售，而将晶圆制造、封装和测试外包给专业的晶圆代工、封装和测试厂商
IDM	指	Integrated Device Manufacturer 的缩写，即集成电路整合元件企业运营模式，该类公司采用垂直布局，涵盖集成电路设计、晶圆加工及封装和测试等各业务环节，形成一体化的完整运作模式
掩膜	指	在半导体制造中，许多芯片工艺步骤采用光刻技术，用于这些步骤的图形“底片”称为掩膜。其作用是在芯片上选定的区域中对一个不透明的图形模板掩膜，继而下面的腐蚀或扩散将只影响选定的区域
减薄划片	指	功能测试之后，单颗芯片必须被分离出来。首先用背面磨削技术将晶圆的厚度减薄，再将减薄后的晶圆粘在一个带有金属环或塑料框架的薄膜上，利用划片锯（切割刀）或划线剥离技术将晶片分离成单个芯片
裸片测试	指	是在晶圆从晶圆厂生产出来后，切割减薄之前的检测。其过程一般是将晶圆放在测试平台上，用探针探到芯片中事先确定的检测点，探针上可以通过直流电流和交流信号，可以对其进行各种电气参数检测
封装	指	把晶圆上的芯片电路，用导线及各种连接方式，加工成含外壳和管脚的可使用芯片成品的生产加工过程
摩尔定律	指	摩尔定律是由英特尔创始人之一戈登·摩尔提出来的。指集成电路上可容纳的晶体管数目，约每隔 18 个月会增加一倍，性能也将提升一倍；当价格不变时，每一美元所能买到的电脑性能，将每隔 18 个月翻两倍以上。这一定律揭示了信息技术进步的速度。

本报告中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成的。

## 第一节 本次交易概述

### 一、本次交易的背景和目的

#### (一) 本次交易的背景

信息技术是当今世界经济和社会发展的重要驱动力，以计算机、集成电路和软件、核心电子元器件为代表的信息技术的发展改变了人类的生产、生活和思维方式，极大地促进了人类社会由工业化社会向信息化社会的转变。近些年来我国电子和信息技术产业的整体水平得到了很大的提高，但与发达国家相比还有较大差距，特别是高端通用芯片、基础软件和核心电子器件的研发能力和产业化水平与世界发达国家相比差距更大，还不能满足电子信息产业高速发展的需求。

2006年2月，国务院出台了《中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，纲要确定了包括“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”在内的国家十六个科技重大专项。2009年4月，国务院发布的《电子信息产业调整和振兴规划》明确将片式元器件、高频频率器件列入加快电子元器件产品升级，提升研发生产能力的范围。

晶源电子是国内石英晶体元器件制造的龙头企业，石英晶体元器件作为频率选择与控制及时频基准元器件，在移动通讯、消费类电子产品、汽车电子、无线通讯产品等领域有着非常广泛的应用。2009年6月21日，同方股份向晶源科技（晶源电子原第一大股东）发行1,688万股股份，收购晶源科技持有的晶源电子25%股份，成为晶源电子第一大股东。

同方股份的控股子公司同方微电子主要从事集成电路设计及配套系统的产品开发，其与晶源电子石英晶体振荡器等相关技术关联度较大。同方微电子在集成电路设计方面的核心技术优势和相关经验，可以配合晶源电子开发石英晶体振荡器专用集成电路等高端精密电子元器件产品。

本公司结合自身发展情况和市场环境，经过充分论证，拟收购控股股东同方股份控股的同方微电子。本次交易系同一控制下的企业之间的业务整合，有利于发挥协同作用，优化和完善公司战略布局和产品结构，进一步巩固公司在石英晶

体元器件行业的领先地位。

## （二）本次交易的目的

### 1、产品结构调整是晶源电子持续发展的需要

近年来，随着信息产业及数字技术的飞速发展，石英晶体元器件的应用领域不断拓展，市场需求不断增长，尤其是能够满足小型化、片式化、低噪声、高频率、高精度与高稳定度等要求的高端石英晶体振荡器产品，未来市场仍呈高速增长趋势。这也促使我国石英晶体元器件行业技术向小型化、片式化发展，生产要素向规模企业集中，以适应提升产品档次、增加技术含量所带来的大规模投入的要求。石英晶体元器件是完全竞争性的行业，高端产品由于技术要求高、生产难度大，市场被日本等国外大公司占据。国内厂商由于技术能力所限，研发主要集中在晶片加工工艺等方面，涉及集成电路设计的中高端产品比重非常少，在技术和生产规模上都远落后于国外大厂。国内所需的中高档片式化石英晶体元器件主要依靠进口。

晶源电子目前的产品以谐振器和普通晶振、钟振等常规振荡器为主，多为低端电子元器件产品。在低端产品市场中，由于技术门槛低，生产厂家众多，造成产品竞争激烈和利润率不断下降。近年来，晶源电子一直在不断提升技术工艺能力，开始涉足中高端产品。其产品已经包括了恒温晶振、温补晶振和压控晶振。但是由于缺乏高端产品所需要的控制集成电路设计技术，自身持续发展受到了这一技术瓶颈的严重制约。从近三年来的振荡器业务实际情况也表明，虽然振荡器业务的毛利率较高，但其销售收入和规模一直增长缓慢。

最近两年，随着公司主要产品下游行业如通信设备、家电、计算机等电子整机产品价格的不下降，以及压电石英晶体元器件行业竞争日益激烈，公司主要产品销售价格呈现下降的趋势。2008年度、2009年度公司主要产品价格综合售价分别下降了9.85%、10%。目前，公司要走出困境，保持企业的良性发展，调整产品结构，提高高附加值、高利润率的高端产品的比重是必然途径，是晶源电子持续发展的需要。

### 2、同方微电子与晶源电子的协同效应

目前数字产品大规模使用的小型化 SMD 晶体振荡器（OSC）和卫星精密定

位系统、制导系统等应用的高端温度补偿晶体振荡器（TCVCXO）均是压电晶体技术和集成电路技术两个学科技术组合的模块产品，随着频率器件小型化、多功能、低能耗技术发展方向的要求，更加依赖于专用集成电路（ASIC）的发展。前者得益于大规模集成电路的超小型化而减小产品的体积，提高输出频率；后者则依赖于集成电路技术来提高各项技术指标，以满足更高的系统要求。然而，目前绝大多数晶振所需的集成电路均被日本企业垄断，不仅售价高，而且各种技术指标的配合也存在一定问题。一些高端晶体振荡器所需的集成电路甚至在市场上难以采购，特别需要提出的是应用于高端敏感产品领域 TCVCXO 和专用集成电路（ASIC），进口会受到一些国家禁运限制的。

同方微电子是一家专业的集成电路设计企业，它具有模拟电路设计技术、数字电路设计技术和低功耗设计技术，并能提供系统解决方案。该公司依托清华大学的技术优势，在数字、模拟及数模混合集成电路的设计和产业化方面积累了丰富的经验，先后承担、完成了国家“863”重大科技专项、“核高基”重大专项、工信部电子发展基金、北京市科委、北京市经信委和中关村等多个集成电路项目的产品开发任务，完成了多项智能卡相关产品研发和产业化成果。公司连续五年入围中国半导体行业协会评选的“年度中国十大集成电路设计企业”，曾获得“国家科学技术进步一等奖”，在智能卡芯片相关技术方面居于国内领先和国际先进水平。同方微电子在技术上有能力解决晶源电子振荡器专用集成电路的瓶颈，能够帮助晶源电子将振荡器产品向中高端方向发展，并且将拓展晶源电子振荡器的相关产品，如实时时钟等产品上的研发和发展，从而增强晶源电子的持续发展能力和抵御风险能力，拓展新的业务范围和利润增长点。

本次交易完成后，晶源电子将具有集成电路技术，不仅可以开发出具有自主知识产权的各种高端晶体振荡器产品，同时可以结合微机电系统（MEMS）振荡器、全硅振荡器技术的发展，择机拓展晶源电子产品线。因此，本次重组不仅仅是两家公司的简单相加，而是业务的紧密结合、协同发展，必将创造出更大的经营业绩。

### 3、本次重组是同方股份整体战略的重要布局

同方股份作为多元化的高科技企业，从成立之初就一直坚持高新技术企业孵化器的发展模式，下属业务覆盖众多行业。同方微电子的主营业务是其旗下较为

独立的细分业务，与其它业务基本不发生关联交易。2009年，同方股份以换股收购的方式，收购晶源电子25%的股份，成为公司控股股东，进入了国家大力支持的核心电子元器件产业。同方股份计划通过产业整合，结合同方股份和晶源电子双方的研发实力和技术资源，拓展核心和高端电子器件相关业务，向信息产业的上游进一步扩展并延伸公司的产业链。

本次交易完成后，同方股份实现了对晶源电子的绝对控股，更有利于结合晶源电子和同方微电子的技术优势，实现同方股份做大做强电子元器件产业的战略目标，把晶源电子打造成为一个具有国际竞争力的电子元器件生产企业。

#### 4、有利于提高公司盈利能力

同方微电子2009年度实现净利润10,108.90万元，2010年度实现净利润7,035.96万元。2011年预计可产生净利润7,246.89万元。本次重组完成后，晶源电子2010年全年实现净利润10,943.57万元，2011年全年实现净利润约10,034.54万元。按照发行完成后24,099.43万股计算，2010年、2011年晶源电子基本每股收益为0.45元/股、0.42元/股。目前晶源电子2010年归属于母公司的净利润为3,760.45万元，基本每股收益为0.279元/股，本次交易将有利于提高上市公司盈利能力。

## 二、本次交易的决策过程

### （一）决策程序

1、2010年9月20日，经深圳证券交易所批准，公司股票停牌。

2、2010年11月6日，本公司与交易对方同方股份、清晶微科技、其它八名自然人股东签署了《非公开发行股票购买资产协议》。本公司计划向交易对方非公开发行A股股票，收购其合计持有的同方微电子100%的股权。

3、2010年11月7日，同方股份召开董事会，同意以其持有的同方微电子86%股权认购晶源电子非公开发行的股份。

2010年11月7日，清晶微科技召开股东会，同意将其持有的同方微电子3.92%股权认购晶源电子非公开发行的股份。

4、2010年11月7日，本公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于

晶源电子非公开发行股份购买资产暨关联交易预案的议案》等议案，并于 2010 年 11 月 12 日公告。

5、2011 年 1 月 6 日，本公司与交易对方同方股份、清晶微科技、其它八名自然人股东签署了《非公开发行股票购买资产之补充协议》，以及《利润补偿补充协议》。

6、2011 年 1 月 7 日，同方股份召开董事会，同意本次交易之具体方案。

7、2011 年 1 月 7 日，清晶微科技召开股东会，同意本次交易之具体方案。

8、2011 年 1 月 7 日，本次交易经公司第四届董事会第四次会议审议通过，并于 2011 年 1 月 8 日予以公告。

9、2011 年 1 月 24 日，同方股份召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易方案。

10、2011 年 1 月 24 日，本次交易经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过并于 2011 年 1 月 25 日公告。

11、2011 年 11 月 3 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认中发国际资产评估有限公司更新出具的〈资产评估报告〉的议案》和《关于继续以原交易价格向交易对方发行股份购买其持有的同方微电子 100%股权的议案》。

12、2011 年 11 月 3 日，同方股份、清晶微科技召开董事会，同意以继续以原交易价格向晶源电子出售资产并认购其股份。

## （二）关联方回避表决情况

本次交易前，交易对方同方股份持有公司 25%的股权，为公司控股股东；交易对方赵维健、段立为公司第四届董事会董事，交易对方吴行军为公司第四届监事会监事，因此，本次交易构成关联交易。根据《重组办法》和《上市规则》，公司在召开董事会审议本次交易相关事项时，关联董事已回避表决，相关事项经非关联董事表决通过。公司在召开股东大会审议相关事宜时，关联股东已回避表决，相关事宜经非关联股东表决通过。

本公司独立董事已就本次交易事项发表意见：本次非公开发行股份购买资产

构成关联交易，关联董事在表决过程中依法进行了回避，也没有代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。

### 三、本次交易的主要内容

#### (一) 交易主体

资产出让方：同方股份有限公司、北京清晶微科技有限公司、赵维健、葛元庆、吴行军、段立、孟红霞、宋翌、丁义民、李刚

资产受让方：唐山晶源裕丰电子股份有限公司

#### (二) 交易标的

北京同方微电子有限公司 100%的股权。

#### (三) 交易方案

本公司向交易对方非公开发行股份收购其合计持有的同方微电子 100%的股权。

#### (四) 交易价格及溢价情况

截至 2010 年 10 月 31 日，根据具有证券业务资格的中发评估出具并经教育部备案的《资产评估报告书》（中发评报字【2010】第 083 号）。同方微电子净资产账面价值为 50,833.27 万元，按照收益法评估净资产为 149,134.01 万元，增值率为 193.38%；按照市场法评估净资产为区间值 144,167.48 万元~156,181.15 万元，增值率为 183.61%~207.24%。

截至 2010 年 12 月 31 日，根据具有证券业务资格的中发评估出具并经教育部备案的《资产评估报告书》（中发评报字【2011】第 103 号）。同方微电子净资产账面价值为 51,846.14 万元，按照收益法评估净资产为 151,071.75 万元，增值率 191.38%；按照市场法评估净资产为区间值 146,594.49 万元~158,810.70 万元，增值率为 182.75%~206.31%。

截至 2011 年 9 月 30 日，根据具有证券业务资格的中发评估出具并经教育部备案的《资产评估报告书》（中发评报字【2011】第 138 号）。同方微电子净资产

账面价值为 58,898.58 万元，按照收益法评估净资产为 153,412.31 万元，增值率为 160.47%；按照市场法评估净资产为区间值 170,634.80 万元~184,854.36 万元，增值率为 189.71%~ 213.85%。

经交易双方协商一致，本次交易标的资产的交易价格维持公司第四届董事会第四次会议确定的交易价格不变，以 2010 年 10 月 31 日收益法评估结果 149,134.01 万元为作价依据。

### **（五）本次交易构成关联交易**

本次交易前，交易对方同方股份持有公司 25%的股权，为公司控股股东；交易对方赵维健、段立为公司第四届董事会董事，交易对方吴行军为公司第四届监事会监事，因此，本次交易构成关联交易。

### **（六）本次交易构成重大资产重组**

本次交易标的的交易价格为 149,134.01 万元，占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币，根据中国证监会《重组办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组，需提交中国证监会并购重组委员会审核通过，并获得中国证监会的核准。

### **（七）期间损益的安排**

根据公司与交易对方签署的《非公开发行股票购买资产协议》和《非公开发行股票购买资产之补充协议》，自 2010 年 10 月 31 日至资产交割日期间，如交易标的产生的利润为正数，则该利润所形成的权益归本公司享有；如交易标的产生的利润为负数，由交易对方按照其在同方微电子的持股比例以现金全额补偿给本公司。具体补偿金额以资产交割日为基准日的相关专项审计结果为基础计算。

### **（八）本次交易的董事会、股东大会表决情况**

1、2010 年 11 月 7 日，公司召开了关于本次重大资产重组的首次董事会会议（第四届董事会第二次会议），经全体非关联董事一致同意，会议审议通过了《关于晶源电子非公开发行股份购买资产暨关联交易预案的议案》等议案，并于 2010 年 11 月 12 日公告。

2、2011年1月7日，公司召开了关于本次重大资产重组的二次董事会会议（第四届董事会第四次会议），经全体非关联董事一致同意，会议审议通过了《关于晶源电子非公开发行股份购买资产暨关联交易的议案》等议案，并于2011年1月8日公告。

3、2011年1月24日，公司召开了关于本次重大资产重组的临时股东大会（2011年第一次临时股东大会），会议审议通过了《关于晶源电子非公开发行股份购买资产暨关联交易的议案》等议案，并于2011年1月25日公告。

4、2011年11月3日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于确认中发国际资产评估有限公司更新出具的〈资产评估报告〉的议案》和《关于继续以原交易价格向交易对方发行股份购买其持有的同方微电子100%股权的议案》，并于2011年11月4日公告。

#### **（九）本次交易方案实施已履行的审批程序**

1、2011年12月26日，本公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，获有条件通过。

2、2012年3月14日，中国证监会出具《关于核准唐山晶源裕丰电子股份有限公司向同方股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2012】340号），核准本公司向同方股份有限公司等发行股份购买相关资产。

## 第二节 上市公司基本情况

### 一、公司概况

法定中文名称：唐山晶源裕丰电子股份有限公司

上市证券交易所：深圳证券交易所

证券简称：晶源电子

证券代码：002049

成立日期：1991年9月17日

注册资本：135,000,000元

法定代表人：陆致成

注册地址：河北省玉田县无终西街3129号

办公地址：河北省玉田县无终西街3129号

董事会秘书：杜林虎

联系电话：0315-6198181

传真：0315-6198179

经营范围：压电石英晶体器件的生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

### 二、公司设立及上市情况

公司系2001年8月17日经河北省人民政府以冀股办（2001）88号文批准，由唐山晶源裕丰电子有限公司整体变更而成的股份有限公司。公司于2001年9月17日在河北省工商行政管理局领取了注册号为1300001001989的营业执照，注册资本为5,050万元人民币。其中唐山晶源电子股份有限公司（后更名为“唐山晶源科技有限公司”）持有38,425,450股，占总股本的76.09%，陈继红等18

位自然人持有 12,074,550 股，占总股本的 23.91%。

经中国证监会证监发行字【2005】18 号文批准，晶源电子于 2005 年 5 月 20 日发行人民币普通股（A 股）2,500 万股。经深圳证券交易所深证上【2005】52 号文批准，公司 2,000 万股社会公众股于 2005 年 6 月 6 日起在深圳证券交易所上市交易，网下配售的 500 万股于 2005 年 9 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易。

首次公开发行股份后，公司总股本为 7,550 万股，股本结构如下：

股东名称	股数（股）	比例
一、发起人股东	50,500,000	66.89%
其中：唐山晶源科技有限公司	38,425,450	50.90%
自然人股东	12,074,550	15.99%
二、社会公众股	25,000,000	33.11%
合计	75,500,000	100.00%

### 三、公司历次股本变动情况

#### 1、2005 年股权分置改革

2005 年 10 月 28 日，晶源电子股权分置改革相关股东会议审议通过了《股权分置改革方案》，公司原非流通股股东向公司全体流通股股东每 10 股支付 3.5 股股份，以获得其所持股份的流通权。股权分置改革完成后，公司股本结构如下：

股东名称	股数（股）	比例
一、有限售条件的股份	41,750,000	55.30%
其中：唐山晶源科技有限公司	31,767,575	42.08%
其它限售股东	9,982,425	13.22%
二、无限售条件的股份	33,750,000	44.70%
合计	75,500,000	100.00%

#### 2、2007 年非公开发行股票

2007 年 2 月，经中国证监会证监发行字【2007】36 号文核准，公司以非公开发行股票的方式向六家特定投资者发行了 1,450 万股人民币普通股（A 股），该股份于 2007 年 3 月 14 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 7,550 万股增加至 9,000 万股。本次非公开发行完成后，公司前十名股东如下：

股东名称	股数（股）	比例
唐山晶源科技有限公司	31,767,575	35.30%
上海重阳资产管理有限公司	3,000,000	3.33%

交通银行—安顺证券投资基金	2,500,000	2.78%
中国工商银行—安瑞证券投资基金	2,100,000	2.33%
河南瑞贝卡控股有限责任公司	2,000,000	2.22%
中国建银投资证券有限责任公司	2,000,000	2.22%
中国工商银行—安信证券投资基金	1,500,000	1.67%
中信证券股份有限公司	1,500,000	1.67%
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,330,798	1.48%
陈继红	835,000	0.93%

### 3、2008年度资本公积金转增股本

2008年11月3日，根据公司2008年第三次临时股东大会决议，晶源电子实施2008年半年度资本公积金转增股本方案，以公司总股本9,000万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本由9,000万股增加至13,500万股。

### 4、目前股本结构

截至本报告书出具日，公司股本结构为：

股东名称	股数（股）	比例
一、有限售条件的股份	45,442,287	33.66%
其中：同方股份有限公司	33,750,000	25.00%
其它限售股东	11,692,287	8.66%
二、无限售条件的股份	89,557,713	66.34%
合计	135,000,000	100.00%

## 四、公司最近三年重大资产重组情况

公司最近三年无重大资产重组情况。

## 五、公司最近三年控股权变动情况

最近三年公司控股权发生了变动。

2009年6月21日，同方股份与公司原第一大股东晶源科技签署了《发行股份购买资产协议》，同方股份向晶源科技发行1,688万股股份，收购晶源科技持有的晶源电子3,375万股股份，占晶源电子总股本的25%。2010年3月30日，中国证监会核准该方案。2010年6月28日，同方股份与晶源科技完成了股份转让及过户登记手续。

本次交易完成后，同方股份持有公司25%的股权，成为公司第一大股东，晶

源科技持有公司 10.3% 股权，为公司第二大股东。公司控股股东由晶源科技变更为同方股份，实际控制人由自然人阎永江先生变更为教育部。

## 六、公司主营业务情况

公司为电子元器件制造企业，主营业务为压电石英晶体元器件的开发、生产和销售，主要产品为石英晶体谐振器和石英晶体振荡器。其中：石英晶体谐振器在数字电路和通讯产品电路中起着时间基准或频率基准作用，在所有电子产品领域中均有广泛的应用；石英晶体振荡器在程控交换机、移动通信基站、GPS（卫星）定位系统及终端产品、精密仪器仪表等民用和军工产品上有广泛的应用。

随着数字化电子信息产品的不断涌现以及产品成本的不断降低导致应用领域不断扩大，石英晶体元器件行业在可预见的将来仍将保持快速发展的趋势。我国《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》明确将“发展相关的片式电子元器件”作为未来5-15年发展的重点之一。公司是国内石英晶体元器件制造的龙头企业、中国电子元器件百强企业之一，其生产的石英晶体元器件是信息技术产业链中用于频率选择与控制不可替代的重要基础产品，在电子元器件制造方面具有坚实的工艺和技术基础以及良好的品牌知名度，最近三年公司的主营业务收入呈逐年上升趋势。

最近三年晶源电子的主营业务收入情况如下：

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
谐振器	24,935.33	22,812.51	22,547.20
振荡器	4,626.28	3,151.93	3,837.64
电容器	2,810.70	1,175.21	180.33
其它	2,453.26	1,410.11	139.15
<b>电子元器件制造业合计</b>	<b>34,825.57</b>	<b>28,549.76</b>	<b>26,704.33</b>

## 七、主要财务数据

公司2008年、2009年、2010年的财务报表已经北京市兴华会计师事务所审计，均出具了标准无保留意见的审计报告。最近三年简要财务数据如下：

### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
总资产	51,900.16	48,949.39	49,020.54
总负债	7,195.06	6,440.02	8,572.72
净资产	44,705.10	42,509.37	40,447.82
归属于母公司股东的所有者权益	43,374.23	41,098.78	39,183.51

## 2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
营业收入	34,869.38	28,890.67	26,925.90
利润总额	4,754.04	4,185.52	3,720.92
净利润	3,907.60	3,505.62	3,104.35
归属于母公司股东的净利润	3,760.45	3,409.34	3,054.79

## 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

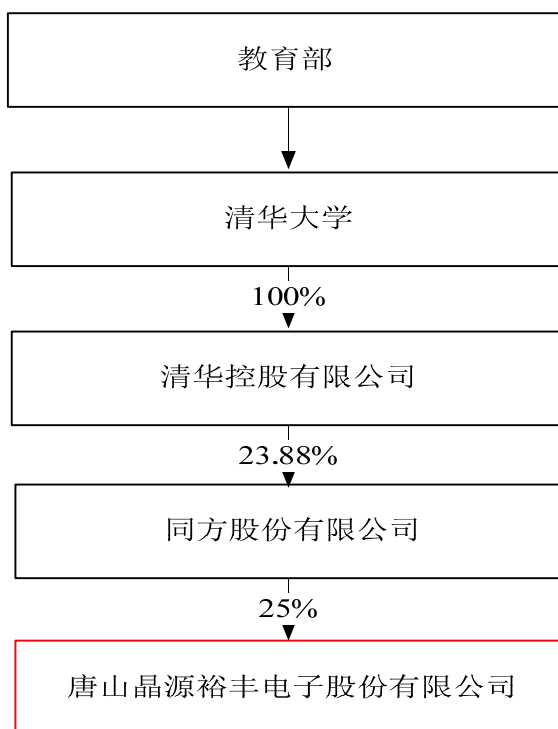
项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
经营活动产生的现金流量净额	4,758.98	8,169.63	6,429.80
投资活动产生的现金流量净额	-3,767.23	-2,573.38	-7,092.42
筹资活动产生的现金流量净额	-2,746.73	-5,695.31	-745.46
现金及现金等价物净增加	-1,889.19	-130.12	-1,913.71

## 八、公司控股股东及实际控制人概况

公司控股股东为同方股份，实际控制人为教育部。

### 1、公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系

截至到本报告出具日，公司的股权结构图如下：



## 2、控股股东情况

公司控股股东为同方股份，具体情况见“第三节 交易对方基本情况 二、交易对方之一：同方股份有限公司”。

## 3、实际控制人情况

公司控股股东同方股份的行政主管部门为教育部，同方股份实际控制人为教育部，因此本公司的实际控制人为教育部。

## 第三节 交易对方的基本情况

### 一、交易对方概况

本次交易涉及的交易对方如下表：

交易对方	持有同方微电子股权比例
同方股份有限公司	86.00%
北京清晶微科技有限公司	3.92%
赵维健	3.50%
葛元庆	1.54%
吴行军	1.54%
段立	1.36%
孟红霞	0.77%
宋翌	0.56%
丁义民	0.48%
李刚	0.33%
合 计	<b>100.00%</b>

同方股份的副董事长兼总裁陆致成先生同时担任清晶微科技的董事长。自然人赵维健先生、葛元庆先生同时是清晶微科技的股东，并担任其董事。除上述关系外，本次交易对方之间不存在其他关联关系。

### 二、交易对方之一：同方股份有限公司

#### （一）概况

中文名称：同方股份有限公司

法定代表人：荣泳霖

成立日期：1997年06月25日

注册资本：1,987,701,108元

公司类型：其它股份有限公司（上市）

注册地址：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层

办公地址：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层

企业法人营业执照注册号：110000010720704

税务登记号码：110108100026793

组织机构代码：10002679-3

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：同方股份

股票代码：600100

经营范围：许可经营项目：互联网信息服务业务不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械等内容；对外派遣实施与出口自产成套设备相关的境外工程所需的劳务人员；商用密码产品生产；商用密码产品销售；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能、大气与工业污染控制、废弃物处理与综合利用的工程和设备的生产；工业废水、生活污水、生活垃圾的处理；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产；水景喷泉制造。

一般经营项目：计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能、大气与工业污染控制、废弃物处理与综合利用的工程和设备的设计、销售、承接工程安装、技术开发与服务；除尘脱硫；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备的销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化设备的开发、销售；消防产品的销售；高科技项目的咨询、高新技术的转让与服务；物业管理；进出口业务；机电安装工程施工总承包；建筑智能化、城市及道路照明、环保、电子工程转业承包；室内空气净化工程；计算机系统集成；建筑智能化系统集成（不含消防子系统）专项工程设计；环境工程（废水）专项工程设计、咨询；工业废水、生活污水环境保护设施运营；水景喷泉设计、安装、调试；安防工程（设计、施工）；有线电视共用天线设计安装；广告发布与代理。

## （二）历史沿革

同方股份有限公司（原名清华同方股份有限公司）是经国家经济体制改革委

员会体改生（1997）78号文和国家教育委员会教技发字（1997）4号文批准，由清华控股（原名北京清华大学企业集团）联合泰豪集团有限公司（原名江西清华科技集团有限公司）等四家发起人以募集方式设立的股份公司。1997年公司首次公开发行股票42,000,000股，发行后总股本为110,700,000股。公司于1997年6月25日在国家工商行政管理局登记注册，注册资本为人民币110,700,000元。

1998年1月13日，同方股份实施向全体股东以每10股转增5股的资本公积转增股本方案。转增后，公司总股本为166,050,000股。

1999年6月24日，同方股份实施向全体股东以每10股配3股的配股方案。配股后，公司总股本为189,800,000股。

1999年6月12日，同方股份以每1.8股山东鲁颖电子股份有限公司(简称“鲁颖电子”)股份折合公司股份1股的比例，向鲁颖电子全体股东定向发行15,172,328股，吸收合并鲁颖电子。1999年8月5日刊登股份变动公告。吸收合并后，公司总股本为204,972,328股。

1999年9月9日，同方股份实施向全体股东以每10股送3股的利润分配方案。送股后，公司总股本为259,339,024股。

2000年5月13日，同方股份实施向全体股东以每10股转增4股的资本公积金转增股本方案。转增后，公司总股本为363,074,634股。

2000年12月4日，同方股份实施向机构投资者和老股东增发20,000,000股。增发后，公司总股本为383,074,634股。

2001年5月9日，同方股份实施向全体股东以每10股转增5股和每10股派发1元的资本公积金转增股本及派发红利的分配方案。转增后，公司总股本574,612,295股。

2007年8月3日，同方股份向10名特定对象以非公开发行方式发行5,400万股。增发后，公司总股本为628,612,295股。

2008年5月30日，同方股份向全体股东按每10股配2股的比例配售股份。配股完成后，公司总股本为751,515,811股。

2008年8月11日，同方股份实施向全体股东以每10股转增3股的资本公

积金转增股本方案。转增后，公司总股本为 976,970,554 股。

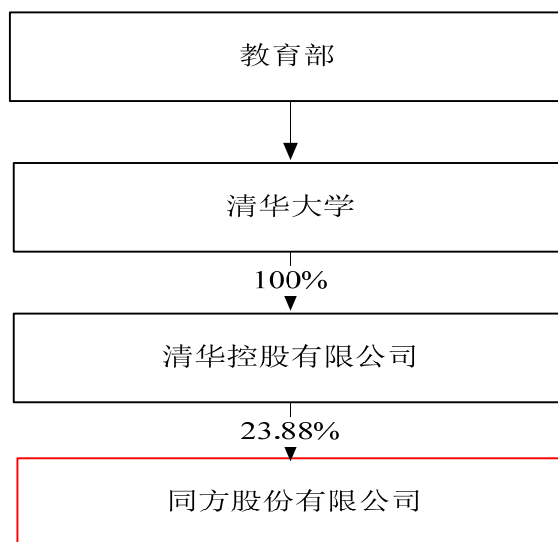
2010 年 6 月 28 日，同方股份向晶源科技非公开发行 16,880,000 万股收购其持有的晶源电子 25% 股权，发行完成后，公司总股本为 993,850,554 股。

2011 年 5 月 12 日，公司向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后，公司总股本为 1,987,701,108 股。

### （三）与其控股股东、实际控制人之间的主要产权控制关系图

#### 1、股权结构图

截至本报告书出具日，公司与其控股股东、实际控制人之间股权结构图如下：



#### 2、控股股东情况

##### （1）概况

公司名称：清华控股有限公司

住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼（科技大厦）A 座 25 层

法定代表人：荣泳霖

注册资本：200,000 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：许可经营项目：医疗器械经营（III 类：植入器材；植入性人体器官；体外循环及血液处理设备；介入器材；医疗 X 射线设备；医用磁共振设

备。II类：手术室、急救室、诊疗室设备及器具；) 易燃液体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、有毒品、腐蚀品。一般经营项目：资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训；化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化体育用品及器材的销售；进出口业务。

## (2) 经营业务情况

清华控股有限公司成立于1992年8月26日，原名为“北京清华大学企业集团”，系清华大学所属的全民所有制企业。2003年9月，根据国务院办公厅《关于北京大学清华大学规范校办企业管理体制试点问题的通知》（国办函【2001】58号）文件要求，经国务院批准，公司改制为国有独资有限责任公司，名称变更为“清华控股有限公司”。

清华控股依托清华大学雄厚的科技优势和人才资源，在制定清华大学科技产业发展战略、整合资产、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用，是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心。

## (四) 主营业务发展情况

同方股份主营业务可以概括为“两大产业、十一大领域”，即主要集中在信息和能源环境两大产业，其中，信息产业涉及计算机系统、数字城市、物联网应用、微电子与核心元器件、安防系统、多媒体、数字电视系统、军工、知识网络等九大领域；能源环境产业涉及建筑节能、半导体与照明两大领域。

同方股份依托清华大学等科研院所的人才、科技优势，对一大批国家“八五”攻关项目、“863”项目、国家级重点新产品和国家级火炬计划项目等高科技技术成果进行产业化，陆续培育了数字城市、安防系统、智能卡芯片设计、数字电视系统、互联网知识数据库出版、建筑节能、脱硫、半导体高亮度LED芯片制造、水处理等一系列在国内甚至国际处于领先地位的核心产业群组；并进一步延伸产业链，发展附加值高的业务领域，形成了卫星导航、知识搜索引擎应用、高铝粉煤灰综合利用等为代表的创新型业务群。

2009年，同方股份实现营业收入1,538,773.57万元，实现归属母公司所有者

的净利润 35,137.02 万元。2010 年，实现营业收入 1,825,750.94 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 47,955.55 万元。

最近三年，同方股份按行业和应用领域分类主营业务收入构成如下：

项目	2010 年		2009 年		2008 年		
	单位:万元	销售收入	比重	销售收入	比重	销售收入	比重
1、计算机系统		458,666.58	25.29%	427,226.35	28.06%	357,450.19	26.08%
2、数字城市		171,741.65	9.47%	151,619.76	9.96%	125,508.06	9.16%
3、安防系统		185,436.26	10.23%	175,176.24	11.51%	243,912.54	17.80%
4、物联网应用		83,763.47	4.62%	67,044.23	4.40%	61,109.19	4.46%
5、微电子与核心元器件		51,902.77	2.86%	44,800.36	2.94%	39,659.40	2.89%
6、多媒体产业		272,925.42	15.05%	172,592.32	11.34%	117,103.27	8.54%
7、知识网络产业		43,513.17	2.40%	42,138.37	2.77%	37,127.02	2.71%
8、军工产业		133,563.94	7.36%	85,438.94	5.61%	86,605.40	6.32%
9、数字电视系统		20,119.83	1.11%	23,211.76	1.52%	26,989.13	1.97%
10、建筑节能		316,727.25	17.46%	261,350.21	17.17%	248,408.52	18.12%
11、半导体与照明		66,764.17	3.68%	65,852.89	4.33%	14,660.25	1.07%
12、科技园产业		8,398.83	0.46%	6,027.17	0.39%	12,113.70	0.88%
合计		<b>1,813,523.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,522,478.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,370,646.67</b>	<b>100.00%</b>

## （五）最近三年主要财务数据

### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
总资产	2,486,463.82	2,138,992.17	1,808,199.41
总负债	1,426,686.29	1,198,935.78	964,051.43
净资产	1,059,777.54	940,056.39	844,147.99
归属于母公司股东的所有者权益	798,669.87	730,785.65	703,529.70

### 2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
营业收入	1,825,750.94	1,538,773.57	1,392,803.27
利润总额	71,801.51	56,319.26	45,592.16
归属于母公司股东的净利润	47,955.55	35,137.02	24,059.58

### 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动产生现金净额	26,977.94	75,563.75	4,757.60
投资活动产生现金净额	-80,312.89	-62,053.00	-153,190.23
筹资活动产生现金净额	79,376.86	104,207.85	182,757.08
现金及现金等价物净增加额	25,594.34	117,960.72	33,480.11

## (六) 下属企业主要名录

截至到本报告书出具日，同方股份下属企业主要名录如下：

产业类别	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例	主营业务
信息产业	唐山晶源裕丰电子股份有限公司	13,500.00	25.00%	压电石英晶体元器件的开发、生产和销售
	同方威视技术股份有限公司	15,000.00	76.00%	基于辐射成像技术的安全检查产品 and 应用系统
	北京同方微电子有限公司	3,160.00	86.00%	半导体集成电路芯片研发设计
	北京同方创新投资有限公司	18,000.00	100.00%	高新技术项目投资
	同方工业有限公司	40,000.00	100.00%	通信设备、电子产品
	山东同方鲁颖电子有限公司	8,000.00	83.07%	中高压瓷介电容器、片式电子元器件生产
	江苏同方云帆信息科技股份有限公司	5,200.00	16.93%	网络安全软硬件产品和技术服务
	同方锐安科技有限公司	6,000.00	100.00%	系统应用软件开发及技术服务
	北京同方软件股份有限公司	5,000.00	74.00%	计算机应用软件和软件开发平台的开发
	同方光盘股份有限公司	8,000.00	98.98%	知识资源数据库的开发、研制
	北京同方光盘股份有限公司	1,800.00	98.98%	光存储技术研发，光盘存储设备开发生产
	中国学术期刊(光盘版)电子杂志社	100.00	100.00%	编辑、出版、发行《中国学术期刊(光盘版)》、互联网出版
	沈阳同方多媒体科技有限公司	31,800.00	100.00%	数字平板电视机生产
	深圳市同方多媒体科技有限公司	30,000.00	100.00%	多媒体数字音视频技术及产品开发、销售
	北京同方凌讯科技有限公司	20,000.00	93.10%	数字电视信号地面无线传输系统建设与运营
	北京同方吉兆科技有限公司	7,000.00	85.46%	数字电视发射机、调频广播发射机、机顶盒研发生产
	北京同方易豪科技有限公司	6,380.00	32.25%	酒店互动数字电视系统解决方案及系统运营
	北京同方电子商务有限公司	13,500.00	16.00%	电子商务领域产业投资
	百视通网络电视技术发展有限责任公司	26,445.9557	15.4655%	IPTV 及其他新媒体技术服务
	北京中录同方文化传播有限公司	5,000.00	50.00%	数字影音光盘复制
	同方健康科技(北京)有限公司	4,144.00	42.23%	人体体质检查分析产品开发生产销售
	同方鼎欣信息技术有限公司	6,250.00	80.00%	软件开发，软件外包服务
	郑州同方神火科技有限公司	2,000.00	50.00%	电力仿真系统开发

产业类别	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例	主营业务
	云南云电同方科技有限公司	2,400.00	37.50%	电力自动控制系统开发
	吉林同方科贸有限责任公司	800.00	20.00%	计算机及信息产品、机电设备销售
	同方泰豪动漫产业投资有限公司	20,000.00	40.00%	动漫产业投资, 园区开发管理
	重庆同方合志科技有限公司	2,000.00	40.00%	物联网领域专业运营服务
	北京亚仕同方科技有限公司	欧元 300.00	49.9999%	非接触式纸质电子票卡的生产销售
	同方国际信息技术有限公司	美元 800.00	100.00%	计算机产品的研发和销售
	Resuccess Investments Ltd.	美元 2,000.01	100.00%	项目投资
	Technovator Int Private Ltd.	美元 908.00	25.33%	楼宇自动控制及安防产品的研发、生产和销售
	THTF U.S.A. Inc.	美元 249.00	100.00%	技术研发, 产品开发
	TongFang Asia Pacific (R&D Center) Pte Ltd.	美元 300.00	100.00%	新技术研发
	Legend Silicon Corp.	美元 3685.51	3.66%	数字电视传输信道及核心芯片技术的研究与开发
能源环境产业	泰豪科技股份有限公司	45,532.57	22.71%	智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品
	南通同方半导体有限公司	67,200.00	100.00%	高亮度发光二极管外延片、芯片的生产和销售
	同方人工环境有限公司	24,900.00	40.964%	基于热泵技术的节能产品生产和低品位热能转换利用系统的集成
	同方炭素科技有限公司	5,000.00	94.00%	竹基活性炭制备及相关产品生产、销售
	同方环境股份有限公司	11,120.00	31.50%	脱硫、脱销、城市生活垃圾及危险废弃物无害化处理等环保产品和工程承揽
	龙江环保集团股份有限公司	32,000.00	10.16%	水务投资、水厂建设运营
	淮安同方水务有限公司	11,000.00	49.55%	水务投资、水厂建设运营
	惠州市同方水务有限公司	3,600.00	100.00%	水务投资、水厂建设运营
	同方光电科技有限公司	8,000.00	100.00%	高亮度发光二极管外延芯片的开发、芯片的生产和销售
	同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	4,000.00	50.00%	用于水处理的有机膜及膜组件生产
	同方光电(香港)有限公司	美元 2,000.00	45.00%	LED 背光模组的开发和销售
清芯光电有限公司	美元 1,000.00	55.00%	发光二级管外延片、芯片生产	
科技园及其它	北京同方房地产开发有限公司	5,000.00	100.00%	自用办公楼、科技园开发
	北京同方物业管理有限公司	950.00	100.00%	自用办公楼物业管理
	无锡同方创新科技园有限公司	10,000.00	100.00%	科技园区及配套设施开发管理
	同方鞍山科技园有限公司	3,000.00	100.00%	科技园区及配套设施开发管理
	沈阳同方科技园有限公司	13,000.00	100.00%	科技园区及配套设施开发管理
	南通同方科技园有限公司	20,000.00	100.00%	科技园区及配套设施开发管理
	北京首开亿信置业股份有限公司	32,000.00	0.31%	房地产经营开发
	嘉融投资有限公司	54,000.00	25.00%	实业投资、创业投资
	同方投资有限公司	55,000.00	36.36%	项目投资
北京高新技术创业投资股份有限公司	31,000.00	3.23%	创业投资	

产业类别	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例	主营业务
	中投信用担保有限公司	100,000.00	1.00%	企业贷款、投融资担保
	北京银行股份有限公司	622,756.20	0.01%	
	武汉国际会展中心股份有限公司	22,600.00	2.21%	大型会议、展览及展销场馆经营
	北京市同方教育培训学校	100.00	100.00%	开办各类面授培训

### 三、交易对方之二：北京清晶微科技有限公司

#### (一) 概况

名称：北京清晶微科技有限公司

法定代表人：陆致成

成立日期：2010年10月15日

注册资本：168,000元

注册地址：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场A座29层2901

税务登记号码：110108100026793

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。）

#### (二) 股权结构

清晶微科技为同方微电子中高层管理人员及核心技术人员发起设立的公司，截至本报告书出具同日，清晶微科技股权结构为：

股东名称	实缴资本(万元)	持股比例(%)
赵维健	6.00	35.71%
葛元庆	4.50	26.79%
黄金煌	1.25	7.44%
盛敬刚	0.77	4.58%
王晓丹	0.57	3.39%
田蓉	0.50	2.98%
郝佳良	0.43	2.56%

乔瑛	0.43	2.56%
王征	0.43	2.56%
王国兵	0.43	2.56%
张云翔	0.38	2.26%
张廷晖	0.37	2.20%
孟庆云	0.27	1.61%
王强	0.19	1.13%
邵晓鹏	0.14	0.83%
陈冈	0.07	0.42%
黄钧	0.07	0.42%
<b>合计</b>	<b>16.80</b>	<b>100.00%</b>

### （三）主营业务发展情况

清晶微科技为同方微电子中高层管理人员及核心技术人员于2010年10月发起设立的公司，仅持有同方微电子3.92%股权，没有其它下属公司，没有具体的经营业务。

### （四）控股股东及实际控制人

清晶微科技的前五名股东赵维健、葛元庆、黄金煌、盛敬刚、王晓丹分别持有清晶微科技35.71%、26.79%、7.44%、4.58%、3.39%的股权。清晶微科技单个股东控制的股权均未超过50%，且股东之间不存在关联关系，单个股东无法对公司股东会行成控制权。

清晶微科技的董事会由三名董事构成，分别为赵维健、葛元庆及陆致成。清晶微科技各董事之间无关联关系，在董事会上按各自意志自主行使表决权，公司无股东对董事会的表决具有控制权。

由于清晶微科技无任何一方股东、董事能对公司的经营方针和重大事项的决策作出决定和实质影响，故清晶微科技无控股股东，无实际控制人。

### （五）公司设立的目的

较强的研发队伍和优秀的核心技术人员是同方微电子技术持续领先、产品不断创新的主要因素之一。为了吸引和留住核心技术人才，同方微电子制定了行业

内具有竞争力的薪酬政策和职业发展规划体系。随着行业的发展，企业间人才竞争的日趋激烈，人才流动可能增加，公司仍存在核心技术人才流失的风险。

同方微电子出于长远发展考虑，通过中高层管理人员和核心技术人员持股，增强相关人员对公司的归属感，以减少公司核心人才流失的风险。共有 23 名同方微电子中高层管理人员及核心技术人员直接或间接持有同方微电子有限公司。其中 8 名自然人直接持有同方微电子股权，17 名自然人通过清晶微科技间接持有同方微电子股权，赵维健、葛元庆既直接持有又通过清晶微科技间接持有同方微电子股权。同方微电子董事会和股东会在持股方案中分别设置法人持股和自然人持股的主要原因有：

1、安排管理层和核心技术人员持股的核心目的是为了尽可能吸引和留住人才，保持公司管理团队和技术研发队伍的稳定，尤其是非公司高管的管理人员和核心技术人员，该部分人员相比于已经为公司高管的管理人员及核心技术人员，市场需求量大、流动性更强。在持股方案中，这部分员工共有 15 人，持股数量相对较少，较易转让。如果他们在所持公司股票禁售期结束后，立即抛售股票，将达不到稳定团队的目的。为此，同方微电子董事会和股东会决定成立清晶微科技作为持股公司，上述非公司高管的管理人员和核心技术人员通过清晶微科技间接持有同方微电子股权，本次重组完成后，间接持有上市公司晶源电子股权。同时，考虑到该部分员工持有持股公司的股权比较分散，为了便于管理，同方微电子董事会和股东会在设置方案时，总经理赵维健和常务副总经理葛元庆也通过清晶微科技间接持有同方微电子股权，分别为清晶微科技的第一大股东和第二大股东。

2、本次持股对象还包括赵维健、葛元庆、吴行军、段立、孟红霞、宋翌、丁义民、李刚等 8 名同方微电子高级管理人员。该部分员工均为公司高管，在公司任职时间较长，多为创业阶段即加入公司，对公司归属感和认同感较强。同时，该部分员工持有的股权比例相对比较高，本次重组完成后，其持有的上市公司晶源电子股权的市值比较大，若通过清晶微科技间接持股，在转让上市公司股权时，持股公司与员工个人双层征税将产生较大的税负。为增强激励效果，兼顾公司与被激励者的利益，最终，公司董事会和股东会决定上述 8 名自然人直接持有同方微电子股权。

综上，清晶微科技为专为本次重组设立的持股公司。同方微电子董事会和股东会综合考虑了持股激励的目的、公司管理以及相关员工的经济利益等多方面因素，在持股方案中分别设置了法人持股和自然人持股。

## （六）现有股东的基本情况

### 1、自然人股东赵维健

姓 名	赵维健	曾用名	无	性 别	男	国 籍	中国
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		身份证号	110105196502247311			
通讯地址	北京市海淀区知春路 27 号量子芯座 11 层				邮政编码	100191	
家庭住址	北京市海淀区五道口华清嘉园甲 15 号楼 1702						
最近三年的职业和职务	2001.12.13 ~ 2006.08.30 北京同方微电子有限公司 执行总裁、监事 2010.05.18 ~ 2010.10.20 同方股份有限公司 副总裁 2006.09.01 ~ 至今 北京同方微电子有限公司 总经理、董事						

### 2、自然人股东葛元庆

姓 名	葛元庆	曾用名	无	性 别	男	国 籍	中国
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		身份证号	110105195908211517			
通讯地址	北京市海淀区知春路 27 号量子芯座 11 层				邮政编码	100191	
家庭住址	北京市海淀区清华园清华大学南 6 楼 3 单元 403 号						
最近三年的职业和职务	2001.12.13 ~ 2005.01.03 北京同方微电子有限公司 总工程师 2005.01.03 ~ 至今 北京同方微电子有限公司 副总经理						

### 3、自然人股东黄金煌

姓 名	黄金煌	曾用名	无	性 别	男	国 籍	中国
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		身份证号	350127197512206377			
通讯地址	北京市海淀区知春路 27 号量子芯座 11 层				邮政编码	100191	
家庭住址	北京市海淀区知春路 17 号院 1 号楼 1506						
最近三年的职业和职务	2001.12.13 ~ 2006.01.03 北京同方微电子有限公司 设计部工程师 2006.01.04 ~ 2010.06.10 北京同方微电子有限公司 模拟部工程师 2010.06.11 ~ 至今 北京同方微电子有限公司 研发二部经理						

### 4、自然人股东盛敬刚

姓 名	盛敬刚	曾用名	无	性 别	男	国 籍	中国
-----	-----	-----	---	-----	---	-----	----

是否取得其他国家或者地区的居留权	否	身份证号	210624197403310033
通讯地址	北京市海淀区知春路 27 号量子芯座 11 层		邮政编码 100191
家庭住址	北京市海淀区肖家河羊场一号 2-3-302		
最近三年的职业和职务	2005.05.08 ~ 2006.01.03	北京同方微电子有限公司	设计部工程师
	2006.01.04 ~ 2010.06.10	北京同方微电子有限公司	模拟部经理
	2010.06.11 ~ 至今	北京同方微电子有限公司	研发三部经理

### 5、自然人股东王晓丹

姓名	王晓丹	曾用名	无	性别	女	国籍	中国
是否取得其他国家或者地区的居留权	否	身份证号	320681197904139628				
通讯地址	北京市海淀区知春路 27 号量子芯座 11 层		邮政编码	100191			
家庭住址	北京市昌平区回龙观镇昌平路 380 号院 9 号楼 1 单元 1002 室						
最近三年的职业和职务	2002.10.08 ~ 2005.01.03	北京同方微电子有限公司	设计部工程师				
	2005.01.04 ~ 2010.06.10	北京同方微电子有限公司	市场部销售员				
	2010.06.11 ~ 至今	北京同方微电子有限公司	市场部经理				

### 6、自然人股东田蓉

姓名	田蓉	曾用名	无	性别	女	国籍	中国
是否取得其他国家或者地区的居留权	否	身份证号	231005197212293026				
通讯地址	北京市海淀区知春路 27 号量子芯座 11 层		邮政编码	100191			
家庭住址	北京市西城区三里河东路甲 8 号院 1 号楼						
最近三年的职业和职务	2002.09.24 ~ 2006.07.24	北京同方微电子有限公司	财务部会计				
	2006.07.25 ~ 至今	北京同方微电子有限公司	财务部经理				

### 7、自然人股东郝佳良

姓名	郝佳良	曾用名	无	性别	男	国籍	中国
是否取得其他国家或者地区的居留权	否	身份证号	23010319720513511X				
通讯地址	北京市海淀区知春路 27 号量子芯座 11 层		邮政编码	100191			
家庭住址	北京市朝阳区林萃西里 4 号楼 2 单元 502 室						
最近三年的职业和职务	2005.06.01 ~ 2010.06.10	北京同方微电子有限公司	销售部销售员				
	2010.06.11 ~ 至今	北京同方微电子有限公司	销售部经理				

### 8、自然人股东乔瑛

姓 名	乔璜	曾用名	无	性 别	女	国 籍	中国
是否取得其他国家或者地区的居留权			否	身份证号	610303197510233826		
通讯地址	北京市海淀区知春路 27 号量子芯座 11 层				邮政编码	100191	
家庭住址	北京市海淀区罗庄西里碧兴园 1 号楼 909 号						
最近三年的职业和职务	2006.05.26 ~ 2010.06.10		北京同方微电子有限公司		设计部工程师		
	2010.06.11 ~ 至今		北京同方微电子有限公司		研发一部经理		

### 9、自然人股东王征

姓 名	王征	曾用名	无	性 别	男	国 籍	中国
是否取得其他国家或者地区的居留权			否	身份证号	130227197903106634		
通讯地址	北京市海淀区知春路 27 号量子芯座 11 层				邮政编码	100191	
家庭住址	北京市昌平区回龙观镇昌平路 380 号院 18 楼 1 单元 1703 室						
最近三年的职业和职务	2006.02.15 ~ 2010.06.10		北京同方微电子有限公司		产品部工程师		
	2010.06.11 ~ 至今		北京同方微电子有限公司		采购部经理		

### 10、自然人股东王国兵

姓 名	王国兵	曾用名	无	性 别	男	国 籍	中国
是否取得其他国家或者地区的居留权			否	身份证号	320926198111074031		
通讯地址	北京市海淀区知春路 27 号量子芯座 11 层				邮政编码	100191	
家庭住址	北京市海淀区学院路 18 号院 54 号楼 504						
最近三年的职业和职务	2006.08.07 ~ 2010.06.10		北京同方微电子有限公司		产品部工程师		
	2010.06.11 ~ 至今		北京同方微电子有限公司		工程部经理		

### 11、自然人股东张云翔

姓 名	张云翔	曾用名	无	性 别	男	国 籍	中国
是否取得其他国家或者地区的居留权			否	身份证号	410203197906151517		
通讯地址	北京市海淀区知春路 27 号量子芯座 11 层				邮政编码	100191	
家庭住址	北京市海淀区知春路太月园 10 号楼 103						
最近三年的职业和职务	2003.08.04 ~ 2006.01.03		北京同方微电子有限公司		设计部工程师		
	2006.01.04 ~ 2010.06.10		北京同方微电子有限公司		模拟部工程师		
	2010.06.11 ~ 至今		北京同方微电子有限公司		研发四部工程师		

### 12、自然人股东张廷暄

姓 名	张廷暄	曾用名	无	性 别	男	国 籍	中国
是否取得其他国家或者地区的居留权			否	身份证号		61030219741205465X	
通讯地址	北京市海淀区知春路 27 号量子芯座 11 层				邮政编码	100191	
家庭住址	北京市昌平区回龙观龙锦苑 2 区 7 栋 5 单元 201						
最近三年的职业和职务		2002.07.08 ~ 2009.12.28	北京同方微电子有限公司	设计部工程师			
		2009.12.29 ~ 2010.06.10	北京同方微电子有限公司	模拟部工程师			
		2010.06.11 ~ 至今	北京同方微电子有限公司	研发二部工程师			

### 13、自然人股东孟庆云

姓 名	孟庆云	曾用名	无	性 别	男	国 籍	中国
是否取得其他国家或者地区的居留权			否	身份证号		372524197512070017	
通讯地址	北京市海淀区知春路 27 号量子芯座 11 层				邮政编码	100191	
家庭住址	北京市昌平区天通苑西苑一区 31 号楼 3-302						
最近三年的职业和职务		2001.12.13 ~ 2010.06.10	北京同方微电子有限公司	系统部工程师			
		2010.06.11 ~ 至今	北京同方微电子有限公司	市场部销售员			

### 14、自然人股东王强

姓 名	王强	曾用名	无	性 别	男	国 籍	中国
是否取得其他国家或者地区的居留权			否	身份证号		110107197409300656	
通讯地址	北京市海淀区知春路 27 号量子芯座 11 层				邮政编码	100191	
家庭住址	北京市丰台区梅市口路 12 号院 8 楼 4 门 1803 号						
最近三年的职业和职务		2002.03.20 ~ 2010.06.10	北京同方微电子有限公司	系统部工程师			
		2010.06.11 ~ 至今	北京同方微电子有限公司	研发三部工程师			

### 15、自然人股东邵晓鹏

姓 名	邵晓鹏	曾用名	无	性 别	男	国 籍	中国
是否取得其他国家或者地区的居留权			否	身份证号		610322197610241611	
通讯地址	北京市海淀区知春路 27 号量子芯座 11 层				邮政编码	100191	
家庭住址	北京市海淀区清河中街 69 号院 5-1203						
最近三年的职业和职务		2002.04.01 ~ 2006.01.03	北京同方微电子有限公司	设计部工程师			
		2006.01.04 ~ 2010.06.10	北京同方微电子有限公司	模拟部工程师			
		2010.06.11 ~ 至今	北京同方微电子有限公司	研发二部工程师			

### 16、自然人股东陈冈

姓 名	陈冈	曾用名	无	性 别	男	国 籍	中国
是否取得其他国家或者地区的居留权			否	身份证号		110108197405191436	
通讯地址	北京市海淀区知春路 27 号量子芯座 11 层				邮政编码	100191	
家庭住址	北京市朝阳区亚运村安慧北里 4 号楼 1901						
最近三年的职业和职务		2002.08.14 ~ 2010.06.10 北京同方微电子有限公司 设计部工程师 2010.06.11 ~ 至今 北京同方微电子有限公司 研发三部工程师					

### 17、自然人股东黄均

姓 名	黄均	曾用名	无	性 别	男	国 籍	中国
是否取得其他国家或者地区的居留权			否	身份证号		510108197708101519	
通讯地址	北京市海淀区知春路 27 号量子芯座 11 层				邮政编码	100191	
家庭住址	北京市昌平区回龙观龙博苑 2 区 8-4-601						
最近三年的职业和职务		2002.02.25 ~ 2010.06.10 北京同方微电子有限公司 设计部工程师 2010.06.11 ~ 至今 北京同方微电子有限公司 研发三部工程师					

根据工商部门提供的工商登记资料以及同方微电子 23 名中高层管理人员及核心技术人员出具的承诺，同方微电子 8 名自然人股东持有的同方微电子股权、清晶微科技 17 名自然人股东持有的清晶微科技股权系其真实所有的，权属清晰，不存在代持股份的行为。

### （七）陆致成未参股公司的原因

1、陆致成对同方微电子的直接持股系代同方微电子中高层管理人员及核心技术人员持有

2006 年 9 月 1 日，同方微电子 2005 年年度股东会决议，同意赵伟国将其持有的公司 7%股权转让给陆致成；同意陈弘毅将其持有的公司 7%股权转让给赵维健。陆致成、赵维健合计持有的公司 14%股权为代同方微电子中高层管理人员及核心技术人员持有。

由于 2006 年同方微电子业务尚不成熟，为促进公司业务更好发展，对公司管理层和核心技术人员形成更有效促进作用，14%股权暂由陆致成、赵维健代持。待公司发展成熟和稳定时，由同方微电子董事会和股东大会再行确定。因此，陆致成、赵维健合计持有的公司 14%股权为代公司中高层管理人员及核心技术人员

持有，陆致成本身并不实际持有同方微电子的股份。

## 2、陆致成未参股清晶微科技的原因

2010年10月18日，根据同方微电子第二届第四次董事会决议和2010年第一次股东会决议，为了稳定公司管理团队和核心技术人员，持续提升公司经营业绩，同方微电子本次股权落实对象主要为公司中高层管理人员及核心技术人员。

陆致成先生目前同时担任同方股份多家下属控股子公司的董事长，包括担任同方微电子董事长，除履行董事长职务外未实际参与同方微电子的经营管理活动，不符合同方微电子本次奖励的要求。同时，根据《关于实施〈关于规范国有企业职工持股、投资的意见〉有关问题的通知》（国资发改革【2009】49号）的规定，陆致成作为母公司的高层管理人员不得直接或间接持有企业所出资各级子企业、参股企业及集团公司所出资其他企业股权。因此，本次陆致成先生并不在股权落实对象名单中，并未在清晶微科技中持有股份。

根据陆致成先生以及清晶微科技现有17名股东出具的承诺，清晶微科技现有股东均真实持有清晶微科技的股权，并未代他人持有。陆致成先生转让其持有的同方微电子7%股权为真实转让，并未有其它安排。

## 四、交易对方之三：其它八名自然人股东

除了持有同方微电子股权，其它八名自然人无其它公司股权，亦无控制其它公司。具体情况如下：

### （一）赵维健

姓名	赵维健	曾用名	无	性别	男	国籍	中国
通讯地址	北京市海淀区知春路27号量子芯座11层						
家庭住址	北京市海淀区五道口华清嘉园						
是否取得其他国家或者地区的居留权	否						
是否与任职单位存在产权关系	直接持有同方微电子3.50%股权，通过清晶微科技间接持有同方微电子1.40%股权						
最近三年的职业和职务	2001.12.13~2006.08.30 北京同方微电子有限公司 执行总裁、监事 2010.05.18~2010.10.20 同方股份有限公司 副总裁 2006.09.01~至今 北京同方微电子有限公司 总经理、董事						

**(二) 葛元庆**

姓 名	葛元庆	曾用名	无	性 别	男	国 籍	中国
通讯地址	北京市海淀区知春路 27 号量子芯座 11 层						
家庭住址	北京市海淀区清华园清华大学南 6 楼						
是否取得其他国家或者地区的居留权	否						
是否与任职单位存在产权关系	直接持有同方微电子 1.54% 股权，通过清晶微科技间接持有同方微电子 1.05% 股权						
最近三年的职业和职务	2001.12.13 ~ 2005.01.03 北京同方微电子有限公司 总工程师 2005.01.03 ~ 至今 北京同方微电子有限公司 副总经理						

**(三) 吴行军**

姓 名	吴行军	曾用名	无	性 别	男	国 籍	中国
通讯地址	北京市海淀区知春路 27 号量子芯座 11 层						
家庭住址	北京市海淀区清华大学西南 15 楼						
是否取得其他国家或者地区的居留权	否						
是否与任职单位存在产权关系	直接持有同方微电子 1.54% 股权						
最近三年的职业和职务	2001 年 12 月 13 日至今 北京同方微电子有限公司 副总经理						

**(四) 段立**

姓 名	段立	曾用名	无	性 别	男	国 籍	中国
通讯地址	北京市海淀区知春路 27 号量子芯座 11 层						
家庭住址	北京市海淀区蓝靛厂翠叠园						
是否取得其他国家或者地区的居留权	否						
是否与任职单位存在产权关系	直接持有同方微电子 1.36% 股权						
最近三年的职业和职务	2006.09.01 ~ 2008.04.29 北京同方微电子有限公司 市场总监、监事 2008.04.30 ~ 至今 北京同方微电子有限公司 副总经理						

**(五) 孟红霞**

姓 名	孟红霞	曾用名	无	性 别	女	国 籍	中国
通讯地址	北京市海淀区知春路 27 号量子芯座 11 层						
家庭住址	北京市朝阳区仰山路万科星园						
是否取得其他国家或者地区的居留权	否						
是否与任职单位存在产权关系	直接持有同方微电子 0.77% 股权						
最近三年的职业和职务	2005.06.03 ~ 2008.04.29 北京同方微电子有限公司 质量总监 2008.04.30 ~ 至今 北京同方微电子有限公司 副总经理						

**(六) 宋翌**

姓 名	宋翌	曾用名	无	性 别	男	国 籍	中国
通讯地址	北京市海淀区知春路 27 号量子芯座 11 层						
家庭住址	北京市海淀区学清路逸成东苑						
是否取得其他国家或者地区的居留权	否						
是否与任职单位存在产权关系	直接持有同方微电子 0.56% 股权						
最近三年的职业和职务	2005.01.04 ~ 2010.06.10 北京同方微电子有限公司 产品部经理 2010.06.11 ~ 至今 北京同方微电子有限公司 金融支付产品总监						

**(七) 丁义民**

姓 名	丁义民	曾用名	无	性 别	男	国 籍	中国
通讯地址	北京市海淀区知春路 27 号量子芯座 11 层						
家庭住址	北京市海淀区罗庄南里 2 号楼						
是否取得其他国家或者地区的居留权	否						
是否与任职单位存在产权关系	直接持有同方微电子 0.48% 股权						
最近三年的职业和职务	2005.01.04 ~ 2010.06.10 北京同方微电子有限公司 系统部经理 2010.06.11 ~ 至今 北京同方微电子有限公司 身份识别产品总监						

**(八) 李刚**

姓 名	李刚	曾用名	无	性 别	男	国 籍	中国
-----	----	-----	---	-----	---	-----	----

通讯地址	北京市海淀区知春路 27 号量子芯座 11 层
家庭住址	北京市海淀区清河镇清缘东里小区
是否取得其他国家或者地区的居留权	否
是否与任职单位存在产权关系	直接持有同方微电子 0.33% 股权
最近三年的职业和职务	2006.01.04 ~ 2010.06.10 北京同方微电子有限公司 设计一部经理 2010.06.11 ~ 至今 北京同方微电子有限公司 电信产品总监

## 五、交易对方与上市公司的关联关系情况

### （一）交易对方与上市公司的关联关系

截至本报告书出具日，交易对方同方股份持有公司 25% 的股权，为公司控股股东；本次交易完成后，同方股份将持有公司 51.83% 的股权，仍为公司控股股东。

截至本报告书出具日，交易对方清晶微科技与晶源电子的董事长均为陆致成先生。清晶微科技的股东赵维健担任晶源电子的董事。

截至本报告书出具日，交易对方赵维健、段立担任晶源电子董事，吴行军担任晶源电子监事。

除此之外，交易对方与上市公司无其它关联关系。

### （二）交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

晶源电子现任董事长陆致成、董事赵维健、董事孙岷、董事潘晋、董事段立、副总经理兼董事会秘书杜林虎、财务总监杨秋平为同方股份推荐。

## 六、交易对方最近五年内受到行政处罚的基本情况

根据交易对方出具的承诺，本次交易对方最近五年内未受过行政处罚，刑事处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。

## 第四节 交易标的基本情况

### 一、交易标的概况

#### (一) 概况

名称：北京同方微电子有限公司

法定代表人：陆致成

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：3,160 万元

实收资本：3,160 万元

成立日期：2001 年 12 至 13 日

营业期限：2001 年 12 月 13 日至 2051 年 12 月 12 日

企业注册号：110000003458945

组织机构代码证：73345887-9

税务登记证号：110108733458879

注册地址：北京市海淀区知春路 27 号大运村 11 号楼 11 层

办公地址：北京市海淀区知春路 27 号大运村 11 号楼 11 层

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机构批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。）

同方微电子于 2008 年被北京市科委、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局共同认定为高新技术企业，并通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证。2005 年，公司成为信息产业部认定的“第一批集成电路设计企业”，连续五年入围中国半导体行业协会评选的“年度中国十大集成电路设计企业”，曾获得“国家科学技术进步一等奖”、“北京奥运会与残奥会证件门票制作、防伪和查验技术选

型项目入选企业”。

## （二）历史沿革

### 1、公司设立

2001年12月13日,清华同方股份有限公司(后更名为“同方股份有限公司”)货币出资2999万元、北京清华大学企业集团(后更名为“清华控股有限公司”)货币出资1万元、自然人陈弘毅非专利技术出资80万元、自然人赵伟国非专利技术出资80万元成立公司。同方股份、清华控股、陈弘毅、赵伟国持有的股权比例分别为51%、35%、7%、7%。北京正则会计事务所有限责任公司出具了《开业登记验资报告》(2001京正验字第162号)。

### 2、2005年25%股权转让

2005年3月21日,公司2005年第二次股东会决议,同意清华控股将其持有的公司25%股权转让于同方股份。转让完成后,同方股份、清华控股、陈弘毅、赵伟国分别持有公司76%、10%、7%、7%股权。

### 3、2006年14%股权转让

2006年9月1日,公司2005年年度股东会决议,同意赵伟国将其持有的公司7%股权转让给陆致成;同意陈弘毅将其持有的公司7%股权转让给赵维健。本次股权转让完成后,同方股份、清华控股、陆致成、赵维健分别持有公司76%、10%、7%、7%股权。其中陆致成、赵维健合计持有的公司14%股权为代公司中高层管理人员及核心技术人员持有。

由于2006年公司业务尚不成熟,为促进公司更好发展,对公司管理层和核心技术人员形成更有效促进作用,14%股权暂由陆致成、赵维健代持。待公司发展成熟和稳定时,由公司董事会和股东大会再行确定。

### 4、2006年10%股权转让

2006年12月24日,公司2006年第三次股东会决议,同意清华控股将其持有的公司10%股权转让于同方股份。本次转让完成后,同方股份、陆致成、赵维健分别持有公司86%、7%、7%股权。

### 5、2010年14%股权转让

2010年10月18日，公司2010年度第一次股东会决议，同意陆致成将其持有的公司3.92%、1.54%、1.54%股权分别转让于清晶微科技、葛元庆、吴行军。赵维健将其持有的公司1.36%、0.77%、0.56%、0.48%、0.33%股权转让于段立、孟红霞、宋翌、丁义民、李刚。陆致成、赵维健将其代持的公司股权转让于实际持有股权的公司中高层管理人员及核心技术人员。

截至本报告书出具日，公司的股权结构如下：

股东名称	股权比例
同方股份有限公司	86.00%
北京清晶微科技有限公司	3.92%
赵维健	3.50%
葛元庆	1.54%
吴行军	1.54%
段立	1.36%
孟红霞	0.77%
宋翌	0.56%
丁义民	0.48%
李刚	0.33%
合计	100.00%

截至本报告书出具日，交易对方合计持有同方微电子100%股权，同方微电子《公司章程》不存在对本次交易可能产生重大影响的内容，不存在让渡经营管理权和收益权等相关协议或者其他安排，交易对方合计持有同方微电子100%股权权属清晰。交易对方已出具如下声明：

“（1）本公司/本人已履行了北京同方微电子有限公司《章程》规定的全额出资义务；

（2）本公司/本人对所拥有同方微电子的股权享有有效的占有、使用、收益及处分权；

（3）本公司/本人所拥有同方微电子的股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷；

（4）本公司/本人所拥有同方微电子的股权不存在质押、抵押、其他担保或

第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本公司持有同方微电子股权之情形；

(5) 本公司/本人所拥有同方微电子的股权过户或者转移不存在法律障碍。”

### (三) 对外投资情况

截至本报告书出具日，同方微电子的对外投资情况如下：

被投资公司	持股比例	注册资本（万元）
易程科技股份有限公司	5%	6,000.00

#### 1、基本情况

名称：易程科技股份有限公司

注册资本：6,000 万元

法定代表人：陆致成

营业执照注册号：110000009390383

成立日期：2006 年 3 月 10 日

住所：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 18 层

企业性质：股份有限公司

经营范围：技术进出口；货物进出口；代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未经许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

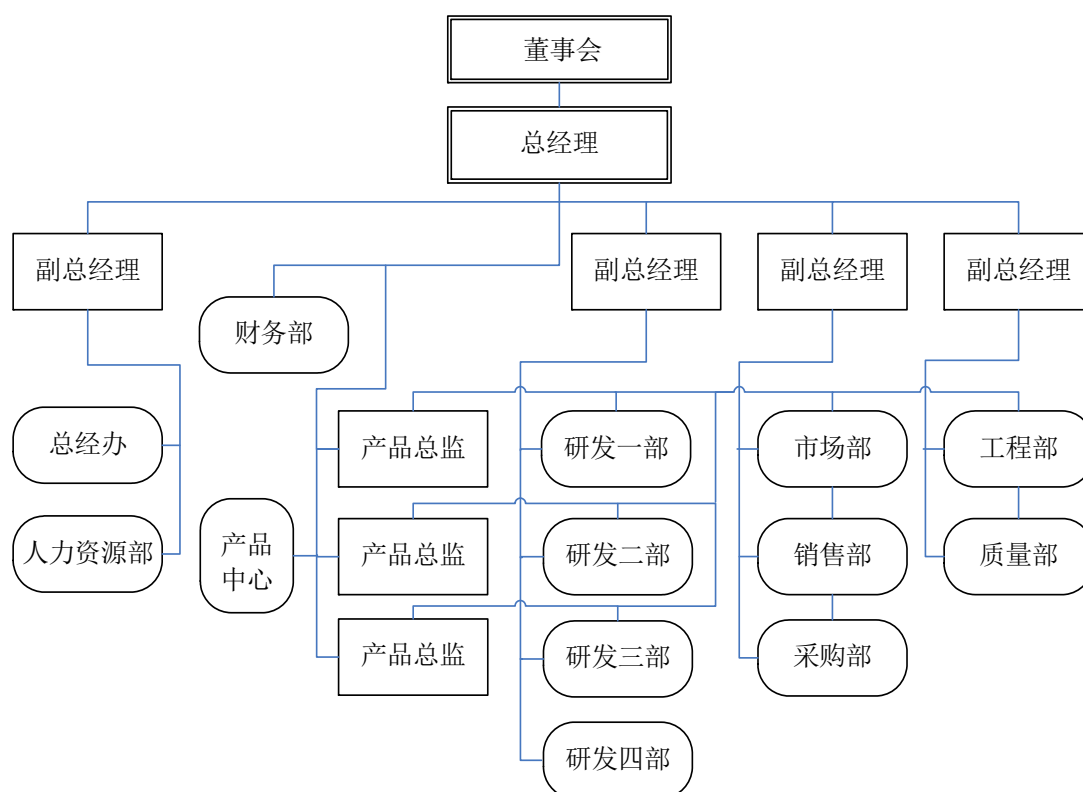
#### 2、股权结构

2006 年 3 月 6 日，同方微电子现金出资 300 万元与同方威视技术股份有限公司、北京神州亿品投资有限公司等四家公司发起设立易程科技股份有限公司。

股东名称	出资额（万元）	出资方式	股权比例
同方威视技术股份有限公司	1,800	现金	30.00%
北京神州亿品投资有限公司	1,800	现金	30.00%

深圳市华科投资有限公司	1,200	现金	20.00%
同方投资有限公司	900	现金	15.00%
北京同方微电子有限公司	300	现金	5.00%
合计	6,000	现金	100.00%

#### (四) 组织机构图



#### (五) 对外担保及负债情况

##### 1、交易标的对外担保情况

###### (1) 交易标的对外担保情况

截至到本报告书出具日，交易标的未对外提供担保。

###### (2) 交易标的被担保情况

同方股份为同方微电子的银行承兑汇票提供了担保。截至 2011 年 12 月 31 日，同方股份对同方微电子的担保余额为 73,218,706.67 元，明细如下：

贷款银行	银行承兑汇票金额	承兑票据期限	保证期间	是否履行完毕
交行北京林萃路支行	6,570,335.64	2011.8.24-2012.2.24	2011.8.24-2012.2.24	否
交行北京林萃路支行	9,000,000.00	2011.8.24-2012.2.24	2011.8.24-2012.2.24	否

交行北京林萃路支行	2,466,449.60	2011.9.22-2012.3.22	2011.9.22-2012.3.22	否
交行北京林萃路支行	9,000,000.00	2011.9.22-2012.3.22	2011.9.22-2012.3.22	否
交行北京林萃路支行	9,000,000.00	2011.9.22-2012.3.22	2011.9.22-2012.3.22	否
交行北京林萃路支行	9,000,000.00	2011.10.27-2012.04.24	2011.10.27-2012.4.24	否
交行北京林萃路支行	9,000,000.00	2011.10.27-2012.04.24	2011.10.27-2012.4.24	否
交行北京林萃路支行	3,742,574.43	2011.10.27-2012.04.24	2011.10.27-2012.4.24	否
交行北京林萃路支行	9,000,000.00	2011.11.16-2012.05.16	2011.11.16-2012.5.16	否
交行北京林萃路支行	6,439,347.00	2011.11.16-2012.05.16	2011.11.16-2012.5.16	否
合计	73,218,706.67			

## 2、交易标的主要负债情况

单位：万元

项 目	2011年9月30日		2010年12月31日		2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	-	-	-	-	-	-	-	-
应付票据	11,219.87	46.09%	9,257.53	52.74%	6,043.74	24.87%	10,394.17	35.61%
应付账款	6,999.18	28.75%	3,347.22	19.07%	3,269.42	13.45%	5,360.80	18.36%
预收款项	43.38	0.18%	17.74	0.10%	-	-	125.47	0.43%
应付职工薪酬	422.23	1.73%	509.28	2.90%	578.35	2.38%	198.96	0.68%
应交税费	749.21	3.08%	392.72	2.24%	1,707.12	7.02%	838	2.87%
应付股利	-	-	-	0.00%	9,300.00	38.27%	9,300.00	31.86%
其他应付款	948.95	3.90%	106.17	0.60%	28.02	0.12%	68.05	0.23%
<b>流动负债合计</b>	<b>20,382.83</b>	<b>83.73%</b>	<b>13,630.67</b>	<b>77.65%</b>	<b>20,926.65</b>	<b>86.10%</b>	<b>26,285.45</b>	<b>90.04%</b>
专项应付款	3,962.00	16.27%	3,923.60	22.35%	3,377.00	13.90%	2,907.00	9.96%
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,962.00</b>	<b>16.27%</b>	<b>3,923.60</b>	<b>22.35%</b>	<b>3,377.00</b>	<b>13.90%</b>	<b>2,907.00</b>	<b>9.96%</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>24,344.83</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,554.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>24,303.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>29,192.45</b>	<b>100.00%</b>

## (六) 主要资产及其权属情况

### 1、主要固定资产情况

截至2011年9月30日，公司正在使用的固定资产的账面价值为582.22万元。公司为高新技术企业，固定资产在资产总额中所占比例较小。主要固定资产情况如下：

序号	设备类别	数量	取得方式	原值(万元)	净值(万元)
1	研发测试设备	39	购置	442.64	245.34
2	电脑设备	558	购置	382.19	140.26
3	交通设备	11	购置	292.33	159.22
4	办公用具	661	购置	117.46	36.82
5	电器仪表	15	购置	3.47	0.58

## 2、主要无形资产情况

截至 2011 年 9 月 30 日，交易标的无形资产的账面价值为 2.52 万元。交易标的无土地使用权，且以前年度交易标的的研发支出大多费用化，资本化支出的主要部分尚未转入无形资产，因此无形资产价值较小。截至到本报告书出具日，交易标的的无形资产主要包括商标 1 项、专利权 39 项。交易标的目前正在申请的专利权有 21 项。具体明细如下：

### (1) 商标

截至到本报告书出具日，同方微电子商标情况如下：

权利人	注册内容	商标证号	有效期	核对使用商品	法律状态
北京同方微电子有限公司		4806603	2008 年 6 月 7 日至 2018 年 6 月 6 日	第九类：计算机外围设备；微处理机；读出器（数据处理设备）；集成电路卡；智能卡（集成电路卡）；电子出版物（可下载）；晶片（锗片）；印刷电路；集成电路；集成电路块	已批准

### (2) 专利

截至到本报告书出具日，同方微电子专利情况如下：

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利颁证日期	专利期限
1	一种用于非接触 IC 卡阅读设备的电源管理电路	北京同方微电子有限公司	ZL200510008784.3	2005 年 3 月 1 日	2005 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日
2	一种用于非接触 IC 卡阅读设备的调制电路	北京同方微电子有限公司	ZL200510008785.8	2005 年 3 月 1 日	2005 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日
3	一种用于智能卡仿真调试系统的接口	北京同方微电子有限公司	ZL200510011518.6	2005 年 4 月 1 日	2005 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日
4	一种用于智能卡仿真调试系统的硬件断点电路	北京同方微电子有限公司	ZL200510011519.0	2005 年 4 月 1 日	2005 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日
5	一种非接触式 IC 卡和读写器之间波特率自适应的装置	北京同方微电子有限公司	ZL200620023016.5	2006 年 5 月 29 日	2006 年 5 月 29 日至 2016 年 5 月 28 日
6	一种识别非接触	北京同方微电	ZL200620023017.X	2006 年 5 月 29 日	2006 年 5 月

	式 IC 卡的防冲突装置	子有限公司			29 日至 2016 年 5 月 28 日
7	一种用于第二代居民身份证的检测方法及其设备	信息产业部电子工业标准化研究所、北京同方微电子有限公司	ZL200610089779.4	2006 年 7 月 17 日	2006 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 16 日
8	一种用于密码学运算的微处理器内核装置	北京同方微电子有限公司	ZL200610112542.3	2006 年 8 月 23 日	2006 年 8 月 23 日至 2026 年 8 月 22 日
9	一种非接触 IC 卡负载 FSK 调制数据的解调方法	北京同方微电子有限公司	ZL200610114557.3	2006 年 11 月 15 日	2006 年 11 月 15 日至 2026 年 11 月 14 日
10	一种非接触 IC 卡负载调制数据的解调装置	北京同方微电子有限公司	ZL200620158469.9	2006 年 11 月 15 日	2006 年 11 月 15 日至 2016 年 11 月 14 日
11	一种对抗差分功耗分析的逻辑单元	北京同方微电子有限公司	ZL200610114558.8	2006 年 11 月 15 日	2006 年 11 月 15 日至 2026 年 11 月 14 日
12	一种用于非接触/接触 IC 卡的电源隔离电路	北京同方微电子有限公司	ZL200710065399.1	2007 年 4 月 13 日	2007 年 4 月 13 日至 2027 年 4 月 12 日
13	用于非接触 IC 卡的解调电路	北京同方微电子有限公司	ZL200720104229.5	2007 年 4 月 13 日	2007 年 4 月 13 日至 2017 年 4 月 12 日
14	一种射频识别标签芯片防冲突功能的验证电路	北京同方微电子有限公司	ZL200720170182.2	2007 年 8 月 14 日	2007 年 8 月 14 日至 2017 年 8 月 13 日
15	一种实现 NOR FLASH 坏块管理的控制电路	北京同方微电子有限公司	ZL200720173860.0	2007 年 10 月 30 日	2007 年 10 月 30 日至 2017 年 10 月 29 日
16	一种双界面智能卡电源管理电路	北京同方微电子有限公司	ZL200810101679.8	2008 年 3 月 11 日	2008 年 3 月 11 日至 2028 年 3 月 10 日
17	双界面智能卡电源管理电路	北京同方微电子有限公司	ZL200820079289.0	2008 年 3 月 11 日	2008 年 3 月 11 日至 2018 年 3 月 10 日
18	一种用于电源电压脉冲干扰的检测电路	北京同方微电子有限公司	ZL200810104554.0	2008 年 4 月 21 日	2008 年 4 月 21 日至 2028 年 4 月 20 日
19	一种用于发行带 USB 接口智能卡的系统及其发行方法	北京同方微电子有限公司	ZL200810104555.5	2008 年 4 月 21 日	2008 年 4 月 21 日至 2028 年 4 月 21 日
20	一种用于发行带 USB 接口智能卡的系统	北京同方微电子有限公司	ZL200820080098.6	2008 年 4 月 21 日	2008 年 4 月 21 日至 2018 年 4 月 20 日

21	一种用于无源射频识别标签芯片的掉电暂态存储器	北京同方微电子有限公司	ZL200810112077.2	2008年5月21日	2008年5月21日至2028年5月21日
22	一种基于闪速存储器的智能卡下载数据的方法	北京同方微电子有限公司	ZL200810116167.9	2008年7月4日	2008年7月4日至2028年7月3日
23	一种射频识别标签芯片的伪随机数产生电路	北京同方微电子有限公司	ZL200820110184.7	2008年9月11日	2008年9月11日至2018年9月10日
24	一种优化混合信号芯片面积的方法	北京同方微电子有限公司	ZL200810222199.7	2008年9月11日	2008年9月11日至2028年9月10日
25	一种适于CMOS集成的暂态存贮电路	北京同方微电子有限公司	ZL200820122996.3	2008年10月27日	2008年10月27日至2018年10月26日
26	用于真空荧光显示器的驱动电源电路	北京同方微电子有限公司	ZL200820123466.0	2008年11月4日	2008年11月4日至2018年11月3日
27	适用于PIE编码的解码器	北京同方微电子有限公司	ZL200810226289.3	2008年11月12日	2008年11月12日至2028年11月12日
28	近场通信射频接口集成电路	北京同方微电子有限公司	ZL200820123715.6	2008年11月12日	2008年11月12日至2018年11月11日
29	用于近场通信的射频接口集成电路	北京同方微电子有限公司	ZL200920109891.9	2009年7月23日	2009年7月23日至2019年7月22日
30	一种射频识别电子标签模拟器	中国电子技术标准化研究所、北京同方微电子有限公司	ZL201020171642.5	2010年4月21日	2010年4月21日至2020年4月20日
31	一种射频识别读写器模拟器	中国电子技术标准化研究所、北京同方微电子有限公司	ZL201020171646.3	2010年4月21日	2010年4月21日至2020年4月20日
32	一种射频识别检测系统	中国电子技术标准化研究所、北京同方微电子有限公司	ZL201020171707.6	2010年4月21日	2010年4月21日至2020年4月20日
33	用于移动支付的安全终端装置	北京同方微电子有限公司	ZL201020671635.1	2010年12月21日	2010年12月21日至2020年12月20日
34	语音识别网上交易的智能密码钥匙	北京同方微电子有限公司	ZL201120047639.7	2011年2月25日	2011年2月25日至2021年2月24日
35	用于非接触IC卡的调制电路	北京同方微电子有限公司	ZL201120047958.8	2011年2月25日	2011年2月25日至2021年2月25日

36	一种用于射频识别标签的时钟产生电路	北京同方微电子有限公司	ZL201120070623.8	2011年3月17日	2011年3月17日至2021年3月16日
37	用于芯片安全防护的光检测电路	北京同方微电子有限公司	ZL201120097171.2	2011年4月6日	2011年4月6日至2021年4月6日
38	用于非接触式智能卡多协议自适应选择电路	北京同方微电子有限公司	ZL201120128350.8	2011年4月27日	2011年4月27日至2021年4月26日
39	具有防拆功能的超高频抗金属电子标签结构	北京同方微电子有限公司	ZL201120191088.1	2011年6月9日	2011年6月9日至2021年6月8日

截至到本报告书出具日，同方微电子目前正在申请的专利情况如下：

序号	申请的发明/实用新型名称	申请人	申请号	申请日
1	一种用于非接触 IC 卡的解调电路	北京同方微电子有限公司	200710065405.3	2007年4月13日
2	一种实现 NOR FLASH 坏块管理的方法及其控制电路	北京同方微电子有限公司	200710176507.2	2007年10月30日
3	一种以应用协议数据单元访问与非门闪存存储器的方法	北京同方微电子有限公司	200810117557.8	2008年8月1日
4	一种适于 CMOS 集成的暂态存贮电路及其使用方法	北京同方微电子有限公司	200810224195.2	2008年10月27日
5	一种用于真空荧光显示器的驱动电源电路	北京同方微电子有限公司	200810225854.4	2008年11月4日
6	一种近场通信射频接口集成电路	北京同方微电子有限公司	200810226290.6	2008年11月12日
7	一种用于近场通信的射频接口集成电路	北京同方微电子有限公司	200910089762.2	2009年7月23日
8	一种在嵌入式设备中实现可信计算平台的方法	北京同方微电子有限公司	201010149049.5	2010年4月15日
9	一种传统计算机升级为可信计算机的方法	北京同方微电子有限公司	201010153807.0	2010年4月23日
10	一种用于移动支付的安全终端装置	北京同方微电子有限公司	201010598279.X	2010年12月21日
11	一种用于非接触 IC 卡的调制电路	北京同方微电子有限公司	201110045877.9	2011年2月25日
12	一种语音识别网上交易的智能密码钥匙	北京同方微电子有限公司	201110045593.X	2011年2月25日
13	一种独立于电源模块的芯片级闩锁现象过流保护电路	北京同方微电子有限公司	201110045697.0	2011年2月25日

14	独立于电源模块的芯片级 门锁现象过流保护电路	北京同方微电 子有限公司	201120047730.9	2011年2月25日
15	一种用于射频识别标签的 时钟产生电路及其校准方 法	北京同方微电 子有限公司	201110064422.1	2011年3月17日
16	一种用于芯片安全防护的 光检测电路	北京同方微电 子有限公司	201110084691.4	2011年4月6日
17	一种用于非接触式智能卡 多协议自适应选择电路	北京同方微电 子有限公司	201110106801.2	2011年4月27日
18	一种用于 IC 卡更新数据时 防掉电数据存储的方法	北京同方微电 子有限公司	201110131094.2	2011年5月20日
19	一种具有防拆功能的超高 频抗金属电子标签结构	北京同方微电 子有限公司	201110152675.4	2011年6月9日
20	一种具有选择识别功能的 电子标签结构	北京同方微电 子有限公司	201110412803.4	2011年12月13日
21	具有选择识别功能的电子 标签结构	北京同方微电 子有限公司	201120516641.4	2011年12月13日

### (3) 土地使用权

同方微电子目前使用的房屋均为租赁，不存在土地使用权。

### 3、资产租赁情况

同方微电子目前的办公场所均为租赁。2008年9月16日，同方微电子与北京集成电路设计园有限责任公司（以下简称“集成电路设计园”）签署《写字楼租赁合同》，双方约定集成电路设计园将北京市海淀区知春路27号量子芯座第11层1101-1112室、第18层1801-1812室，建筑面积为2,376平方米的房屋租赁给同方微电子使用，租赁期限为2008年10月1日至2010年9月30日。

2010年9月17日，同方微电子与集成电路设计园续签了《写字楼租赁合同》，租赁期限为2010年10月1日至2011年9月30日。2011年9月28日，同方微电子与集成电路设计园续签了《写字楼续租协议》，租赁期限为2011年10月1日至2012年9月30日。

房屋租赁期结束后，同方微电子将积极寻求与集成电路设计园续签租赁合同。同方微电子从2002年开始一直是集成电路设计园的租户，与集成电路设计园保持着良好的合作关系。另外，集成电路设计园的租户主要都是集成电路行业内企业，同方微电子作为国内集成电路设计行业的知名企业，集成电路设计园也希望同方微电子一直入驻。同方微电子在租赁期结束后，和集成电路设计园续签租赁合同不存在障碍。

另外，同方微电子是一家芯片设计与销售公司，没有任何生产线，芯片的生产、封装、测试全部外包给其它企业。同方微电子办公场所即使搬迁，搬迁时间至多需要三天，对公司的生产经营不会产生重大影响。

#### 4、公司专业资质

##### (1) 经营资质

资质名称	颁发单位	有效期
商用密码产品生产定点单位证书（国密局产字 SSC862 号）	国家密码管理局	2011年10月28日至2014年10月28日
商用密码产品销售许可证（国密局销字 SXS1238 号）	国家密码管理局	2010年7月12日至2013年7月12日
集成电路卡注册证书	国家集成电路卡注册中心	2010年2月1日至2012年2月1日
高新技术企业证书（CF201111001574）	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	2011年10月11日至2014年10月10日

##### (2) 协会资质

序号	资质名称
1	中国半导体行业协会理事、集成电路设计分会理事
2	中国电子学会理事
3	中国密码学会会员
4	中国信息产业商会会员、智能卡专业委员会副理事长
5	中国 RFID 产业联盟副理事长
6	中关村物联网产业技术创新战略联盟理事

##### (3) 体系资质

资质名称	颁发单位	有效期
GB/T 19001-2008 /ISO 9001:2008	北京赛西认证有限责任公司	2012年1月21日至2015年1月20日

#### 5、重要科研成果

序号	课题名称	课题编号	进展情况
<b>“863”计划课题</b>			
1	第二代居民身份证专用芯片关键技术研究	2004AA01Z1070	已经完成

2	符合 ISO18000-6 Type B/C 标准的 (UHF) 标签芯片研发和产业化	2006AA04A109	已经完成
3	超高频 (UHF) 读写器芯片的研发与产业化	2008AA04A102	已经完成
4	极低功耗系统芯片设计关键技术与应用	2008AA0107	在研项目
<b>“核高基”课题</b>			
5	大容量 SIM 卡芯片	2009ZX01032-003-005	在研项目
<b>信息产业部/工信部课题</b>			
6	机卡分离用条件接收卡及芯片	信部运[2004]479 号	已经完成
7	RFID 电子标签专用芯片和相关技术开发应用及产业化	信部运[2005]635 号	已经完成
8	面向安全识别集成电路的 IP 库开发和产品设计验证平台建设	信部运[2005]637 号	已经完成
9	多格式音视频超级解码 SOC 芯片	信部运[2006]634 号	已经完成
10	二代证用非接触式 IC 卡芯片优化	信部运[2007]329 号	已经完成
11	RFID 标签芯片和读写器核心模块开发及产业化	信部运[2008]14 号	已经完成
12	适用于 PC 和移动终端应用的 TCM/TPM 可信计算 SOC 芯片	工信部财[2008]418 号	已经完成
13	基于 eFlash 的移动通信用接触式 CPU 卡芯片系列产业化	工信部财[2008]418 号	已经完成
14	基于国密算法的高安全性多应用 CPU 卡芯片系列产业化	工信部财[2009]609 号	在研项目
15	交通、门禁用高安全性非接触式 IC 卡芯片研发及产业化	工信部财[2010]301 号	在研项目

## 6、重要获奖和荣誉情况

序号	奖项	颁证机构	颁证日期
1	国家科学技术进步一等奖	中华人民共和国国务院	2008 年 12 月 3 日
2	北京市科学技术二等奖	北京市人民政府	2005 年 2 月
3	北京奥运会与残奥会证件门票制作、防伪和查验技术选型项目入选企业	第 29 届奥运会组委会注册中心、中国防伪技术协会	2008 年 8 月 8 日
4	2008 中国 RFID 年度优秀应用成果奖	中国信息产业协会、中国 RFID 产业联盟	2009 年 4 月
5	2009 年度 RFID 芯片开发企业奖	亚太射频识别技术协会	2010 年 5 月

6	第八届中国国际半导体博览会暨高峰论坛（IC CHINA 2010）——优秀参展产品奖（可信计算芯片）	中国半导体行业协会、中国贸促会电子信息行业分会	2010年10月21日
7	十年中国芯（2001-2010）优秀设计企业奖	工业和信息化部软件与集成电路促进中心	2010年12月
8	2011年度国家金卡工程优秀成果金蚂蚁奖——创新产品奖	国家金卡工程协调领导小组办公室	2011年6月
9	2011中国国际金融展“金鼎奖”——优秀银行卡设备奖（THD86系列芯片）	中国国际金融银行技术暨设备展览会、中国国际金融服务展组委会	2011年9月3日

### （七）主营业务发展情况

同方微电子主要从事智能卡、RFID 电子标签和信息安全等核心芯片的设计开发与销售，并提供系统解决方案。公司致力于在身份识别、移动通信、金融支付、物流防伪和信息安全等行业应用领域成为领先的芯片解决方案提供商。公司具有丰富的数字、模拟及数模混合集成电路的设计经验，自主开发了通用微处理器、各种专用/通用加密算法加速引擎等核心电路。目前公司主要核心产品为非接触和接触式智能卡类芯片产品，包括 SIM 卡、第二代居民身份证、电子门票、交通一卡通等。

同方微电子生产的接触式 CPU 卡芯片产品已用于我国三大运营商的手机 SIM 卡以及有线电视机顶盒的条件接收卡，其中手机 SIM 卡芯片在国内市场占有率逐年增高，已成为国内出货量最大的手机 SIM 卡芯片供应商。同时，同方微电子生产的手机 SIM 卡芯片产品在全球具有良好的品牌知名度，通过了包括法国金雅拓公司、德国捷德公司在内的全球前五大智能卡商的资格审核，成为这些卡商的合格供应商。通过这些国际卡商，公司的产品已开始销往海外市场。目前，公司已经完成了 SIM 卡芯片的低端产品线布局，正在加强大容量 SIM 卡芯片等高端产品线布局，从跟进者的产品策略转换成领先者策略。

同方微电子是国家第二代居民身份证专用芯片模块开发和生产供应的承担单位，是公安部指定的四家二代身份证芯片供应商之一。目前第二代居民身份证大规模换证进入尾声，第二代居民身份证芯片供应进入平稳期，将为公司带来稳定的收入和利润。

与此同时，公司面对安全、无线与数据高速交换的信息社会未来发展趋势，

立足于多年积累的集成电路核心技术和市场渠道，积极开发信息安全领域、可信计算领域、移动支付领域、金融应用、RFID 电子标签领域等新兴市场。随着 USB-key 应用芯片、可信密码模块、大容量 SIM 卡芯片、银行卡芯片、UHF RFID 技术等项目在 2010-2014 年的逐渐商业化生产，公司未来业绩将得到持续增长。

关于同方微电子主营业务的详细情况见本节“二、交易标的的业务与技术”。

## （八）交易标的主要财务指标

### 1、资产负债表主要财务数据及指标

根据北京兴华事务所出具的审计报告（（2010）京会兴审字第 1-149 号和 2011）京会兴审字第 1-130 号），同方微电子最近三年及一期资产负债表主要数据如下：

单位：元

项 目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
资产总额	832,434,023.42	694,004,064.11	691,138,275.40	638,937,331.88
负债总额	243,448,273.00	175,542,658.81	243,036,502.40	291,924,539.73
股东权益合计	588,985,750.42	518,461,405.30	448,101,773.00	347,012,792.15
资产负债率（%）	29.25%	25.29%	35.16%	45.69%
流动比率（倍）	3.86	4.82	3.18	2.33
速动比率（倍）	3.55	4.55	2.98	1.82

### 2、利润表主要财务数据及指标

根据北京兴华事务所出具的审计报告（（2010）京会兴审字第 1-149 号和 2011）京会兴审字第 1-130 号），同方微电子最近三年及一期利润表主要数据如下：

单位：元

项目	2011 年 1-9 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
营业收入	268,039,556.11	344,285,563.18	450,056,812.89	396,665,247.84
营业利润	82,754,824.95	82,674,775.01	122,850,534.66	109,359,405.43
利润总额	82,654,824.95	82,631,658.48	124,786,091.21	115,494,056.35
净利润	70,524,345.12	70,359,632.30	101,088,980.85	105,724,239.27
毛利率（%）	37.94%	32.00%	38.07%	39.31%
净资产收益率（%）	12.74%	14.56%	25.43%	28.44%

## （九）交易标的最近三年资产评估、交易、增资、改制情况

2010年10月18日，公司2010年度第一次股东会决议，同意陆致成将其持有的公司3.92%、1.54%、1.54%股权分别转让于清晶微科技、葛元庆、吴行军。赵维健将其持有的公司1.36%、0.77%、0.56%、0.48%、0.33%股权转让于段立、孟红霞、宋翌、丁义民、李刚。股权转让价格为该部分转让股权所对应的原始出资额。其中葛元庆、吴行军、段立、孟红霞、宋翌、丁义民、李刚均为公司中高层管理人员及核心技术人员，清晶微科技公司的股东均为公司中高层管理人员及核心技术人员。

陆致成、赵维健持有的股权一直系代同方微电子中高层管理人员及核心技术人员持有。由于2006年公司业务尚不成熟，为促进公司更好发展，对公司管理层和核心技术人员形成更有效促进作用，14%股权暂由陆致成、赵维健代持。待公司发展成熟和稳定时，由公司董事会和股东大会再行确定。陆致成持有的同方微电子7%股权为2006年9月1日从自然人赵伟国处受让，赵维健持有的同方微电子7%股权为2006年9月1日从自然人陈弘毅处受让。

除此之外，交易标的最近三年无其它资产评估、交易、增资、改制事项。

## （十）股份代持基本情况

### 1、实施股份代持计划的过程

同方微电子于2006年9月1日实施股份代持计划。2006年，陈弘毅与赵伟国拟转让各自持有的同方微电子7%股权。2006年9月1日，赵伟国与陆致成签订股权转让协议，转让其持有的同方微电子7%股权。2006年9月1日，陈弘毅与赵维健签订股权转让协议，转让其持有的同方微电子7%股权。

同方微电子全体股东一致同意为稳定同方微电子管理团队和核心技术人员，持续提升同方微电子经营业绩，由同方微电子中高层管理人员、核心技术人员受让该部分股权。由于2006年公司业务尚不成熟，为促进公司更好发展，对公司管理层和核心技术人员形成更有效促进作用，14%股权暂由陆致成、赵维健代持。待公司发展成熟和稳定时，由公司董事会和股东会再行确定。

清华控股、同方股份、陆致成和赵维健分别出具说明，陆致成与赵维健系按

照当时的约定代持同方微电子部分股权，该约定未记载于书面材料。为落实上述约定，2006年9月1日，清华控股和同方股份于同方微电子股东会上，同意上述股权转让，并放弃优先受让权。

2010年10月18日，同方微电子召开第二届四次董事会，确认“为了稳定公司管理团队和核心技术人员，持续提升公司经营业绩，2006年9月1日，陆致成、赵维健受让的14%公司股权实际系二人代公司中高层管理人员、核心技术人员持有”。会议一致同意了向本次会议决议日仍在公司任职的中高层管理人员、核心技术人员落实股权方案。

2010年10月18日，同方微电子召开2010年度第一次临时股东会会议，会议一致同意上述董事会决议确认的股权落实方案及上述股权转让，其他股东放弃优先购买权。

2010年10月18日，陆致成、赵维健与同方微电子中高层管理人员、核心技术人员及其控制的公司签署出资转让协议。其中陆致成将其持有的同方微电子3.92%、1.54%、1.54%股权分别转让于清晶微科技、葛元庆、吴行军；赵维健将其持有的同方微电子1.36%、0.77%、0.56%、0.48%、0.33%股权转让于段立、孟红霞、宋翌、丁义民、李刚。赵维健、葛元庆、吴行军、段立、孟红霞、宋翌、丁义民、李刚及清晶微科技全部股东均为同方微电子中高层管理人员和核心技术人员。

## （2）被代持股东的出资情况

2006年9月1日，赵伟国与陆致成签订股权转让协议，转让其持有的同方微电子7%股权。2006年9月1日，陈弘毅与赵维健签订股权转让协议，转让其持有的同方微电子7%股权。由于当时尚未明确奖励的具体管理层和核心技术人员，上述股权转让款各80万元分别由陆致成、赵维健代为支付。

2010年10月18日，陆致成、赵维健与同方微电子中高层管理人员、核心技术人员及其控制的公司签署出资转让协议。其中陆致成将其持有的同方微电子3.92%、1.54%、1.54%股权分别转让于清晶微科技、葛元庆、吴行军；赵维健将其持有的同方微电子1.36%、0.77%、0.56%、0.48%、0.33%股权转让于段立、孟红霞、宋翌、丁义民、李刚。上述股权转让款已经全部支付完毕。具体金额如下：

转让方/收款方	受让方/付款方	金额（元）
陆致成	吴行军	176,000
陆致成	葛元庆	176,000
陆致成	清晶微	448,000
赵维健	段立	155,429
赵维健	孟红霞	88,000
赵维健	宋翌	64,000
赵维健	丁义民	54,857
赵维健	李刚	37,714

赵维健、葛元庆、吴行军、段立、孟红霞、宋翌、丁义民、李刚出具说明，用于出资的资金来源于合法的自有资金，不存在为他人代持股份行为。

清晶微科技用于支付股权转让款的资金来源于公司自有资本金14.8万元以及向股东葛元庆借款30万元。根据北京正瑞华会计师事务所有限责任公司出具的验资报告（正瑞华验字（2010）第2056号），清晶微科技股东已履行了出资义务。2010年10月18日，清晶微科技与葛元庆签订了借款合同。

法律顾问中咨律师认为：根据相关资料及同方微电子出具的关于上述被代持股东的薪酬说明，本所律师认为被代持股东以个人自有资金实际履行了出资义务，资金来源合法，不存在出资不实的情形。

综上，被代持股东实际履行了出资义务，资金来源合法，不存在出资不实的情形。

### （3）被代持股东参与利润分配的情况

2007年12月15日，同方微电子召开2007年第2次临时股东会，会议审议通过了利润分配方案，公司在2007年1-11月份实现的净利润78,407,133.55元，截止到2007年11月30日归属于母公司股东的累积未分配利润259,285,530.71元，现将2007年1-11月份实现的净利润中提出29,000,000元按出资比例向股东分配股利，剩余累积未分配利润留待以后分配。

2008年12月25日，同方微电子召开2008年第一次临时股东会，会议审议通过了利润分配议案，公司2008年期初帐面累计未分配利润238,342,663.07元，2008年1-11月实现归属于母公司股东的净利润80,141,907.8元，累计未分配利润共计

318,484,570.87元，本年度向2008年11月30日登记在册的股东分配6,400,000元，剩余未分配利润转入以后年度分配。”

2010年10月28日，同方股份有限公司、陆致成、赵维健分别收到上述股息、红利。

为了公司未来更好的发展，2010年11月12日，被代持股东共同签署协议，同意将陆致成、赵维健代持的股权对应的股息、红利1,302万元由同方微电子董事会作为奖金发放于同方微电子全体员工。

同方微电子董事会为此设定了特别奖金专用账户，用于存放上述奖金。公司制定了《特别奖金发放原则》，为了更好的激励全体员工，公司将根据年终考核结果，将上述奖金在5年内全部发放完毕。2010年11月12日和2011年2月1日，公司已经向公司员工发放了部分奖金，剩余奖金暂存放于同方微电子帐户上。

## 二、交易标的的业务和技术

### （一）主要产品及用途

同方微电子主要从事智能卡、RFID 电子标签和信息安全等核心芯片设计开发与销售，并提供系统解决方案。目前公司主要核心产品包括移动通信类芯片产品、身份识别类芯片产品、金融支付类芯片产品等，应用领域包括第二代居民身份证、电子门票、手机 SIM 卡、交通一卡通等。主要产品系列、型号及用途如下：

产品方向	产品分类	产品系列/型号	主要用途
移动通信类	常规 SIM 芯片	THC20F 系列 THC80F 系列	各种容量的手机 SIM 卡
	手机支付 SIM 芯片	THC80F09BC	支持手机支付应用的 SIM 卡，提供安全支付所需要的签名、认证和加解密等
	大容量 SIM 芯片	THC80F10AC THT 系列	超大容量的电话本和短信存储、具有数字版权管理的多媒体应用、加密存储的个人信息和数据、Smart Card Web Server 等
身份识别类	二代身份证芯片	THR9904	第二代居民身份证专用
	一卡通芯片	THR2 系列 THD20F 系列	公交一卡通、校园一卡通、安全门禁以及各种行业应用
	电子标签芯片	THR10 系列 THU 系列	各种票证、物品防伪、仓储、物流、生产管理等
	识别读写器芯片	THM10/30 系列	二代身份证读卡器、通用非接触读卡器、安全门禁读卡器

	可信计算芯片	THG 系列	安全 PC 和各种个人终端设备
金融支付类	金融管理芯片	THC20F07C	付费电视卡、税控卡
	支付功能芯片	THD20/26 系列	社保卡、加油卡、电卡、支付卡
	支付读卡器芯片	THM30 系列	单/双界面读卡器、安全 SAM 模块
	银行卡芯片	THD86/88 系列	银行卡
	USB Key 芯片	THK 系列	电子金融领域的网上银行、电子商务、电子政务，进行签名、认证和加解密等

## 1、移动通信类产品

移动通信类产品是接触式智能 IC 卡芯片，主要用作手机 SIM 卡，存储和保护用户身份信息、资料信息等。公司产品包括传统手机 SIM 卡芯片、大容量 SIM 卡芯片、支持手机支付功能的 SIM 卡芯片等。

### (1) 常规 SIM 卡

同方微电子研制开发了系列完善的常规 SIM 应用的芯片产品，产品包括 8 位 CPU 和 32 位 CPU 系列，非易失性存储器（NVM）容量从 80K 字节至 400K 字节，可以满足各种容量 SIM 应用需求。

### (2) 手机支付 SIM 卡

同方微电子研制的手机支付 SIM 卡芯片是一种可同时实现手机常规 SIM 卡功能和支付功能要求智能 IC 卡芯片。采用 32 位 CPU，集成 548K 字节的 NVM 存储器，集成多种安全加密算法，包括：DES，SM1，RSA 等，具有 SWP 接口和 SPI 接口，并集成了便于同时实现 SIM 功能和支付功能的专门功能部件。

### (3) 大容量 SIM 卡

大容量 SIM 卡采用“SIM 卡控制器+片外大容量存储器”的方式，其中 SIM 卡控制器本身是一种 768K 字节 NVM 的 32 位高性能智能 IC 卡芯片，并集成了多种安全密码算法和多种接口电路。可以实现超大容量的电话本和短信存储、具有数字版权管理的多媒体应用、加密存储个人信息和数据、Smart Card Web Server 等

## 2、身份识别类产品

身份识别类产品包括非接触和双界面（同时支持接触和非接触应用）智能 IC 卡芯片、电子标签芯片和身份识别类读写机具专用的射频芯片模块等，主要用于

电子门票、门禁、公交一卡通、校园一卡通等，用于对人员或物品的标识。

#### （1）二代身份证芯片

同方微电子的二代身份证芯片 THR9904 是专门为我国第二代居民身份证证应用而研制开发的专用芯片，符合公安部的第二代居民身份证芯片规范和工信部的《JS-1 规范》，广泛应用于我国的第二代居民身份证换发，用量超过 2.5 亿颗。

#### （2）一卡通芯片

同方微电子的一卡通芯片有 THR2 系列的非接触智能卡芯片和 THD20F 系列的双界面智能卡芯片。采用自主开发的 8 位高性能 CPU 和射频电路，集成国密算法 SM1，具有高性能、低功耗和高安全性等特点。应用于市政公交一卡通、校园一卡通、安全门禁以及各种行业应用。

#### （3）电子标签芯片

同方微电子的电子标签芯片包括高频（HF）和超高频（UHF）两类芯片。HF 电子标签芯片符合 ISO/IEC14443 协议，UHF 电子标签芯片符合 ISO18000-6 协议。用于各种票证、物品防伪、仓储、物流、生产管理等领域。

#### （4）识别读写器芯片/模块

同方微电子研制开发的身份识别类应用读写器芯片模块产品 THM10/30 系列，是用于非接触卡读写器的射频接口芯片/模块。主要用于第二代居民身份证读写器、通用非接触读卡器、安全门禁读卡器等。

#### （5）可信计算芯片

同方微电子自主研发的可信计算 TCM 芯片是可信计算解决方案的核心组成部分，该方案是一套符合我国自主规范的可信计算安全解决方案，主要应用于个人计算机（PC）中，用来保证电脑软件运行的合法性，杜绝病毒和木马的非法入侵，从而在电脑上创造一个可信的运行环境。同时，随着移动终端的普及应用，该芯片也可用于移动终端上，如智能手机等。

### 3、金融支付类产品

金融支付类产品包括高安全、高性能的智能 IC 卡芯片、支付类读写机具专用的射频芯片模块和 USBKEY 芯片，主要用于社保、加油、电（表）卡、税控、

付费电视卡、Native/Java 银行卡和相关单/双界面安全读写器以及网银应用等。其中智能卡芯片产品覆盖 8 位到 32 位 CPU 核，涵盖了金融管理芯片、支付功能芯片和银行卡芯片。

#### (1) 金融管理芯片

同方微电子研制的金融管理芯片 THC20F07C，采用自主高性能 8 位 CPU 核，支持同用的对称和非对称密码算法，应用于付费电视卡、税控卡等。

#### (2) 支付功能芯片

同方微电子研制的支付功能芯片 THD20/26 系列，采用自主高性能 8 位 CPU 核，支持国家商用密码算法，支持非对称密码算法。应用于社保保障卡、加油卡、电卡、支付卡等。

#### (3) 支付读卡器芯片

同方微电子研制开发的支付类应用读写器芯片模块产品 THM30 系列，是用于非接触卡或双界面卡读写器的射频接口芯片/模块。主要用于单/双界面联机读卡器、安全 SAM 模块等。

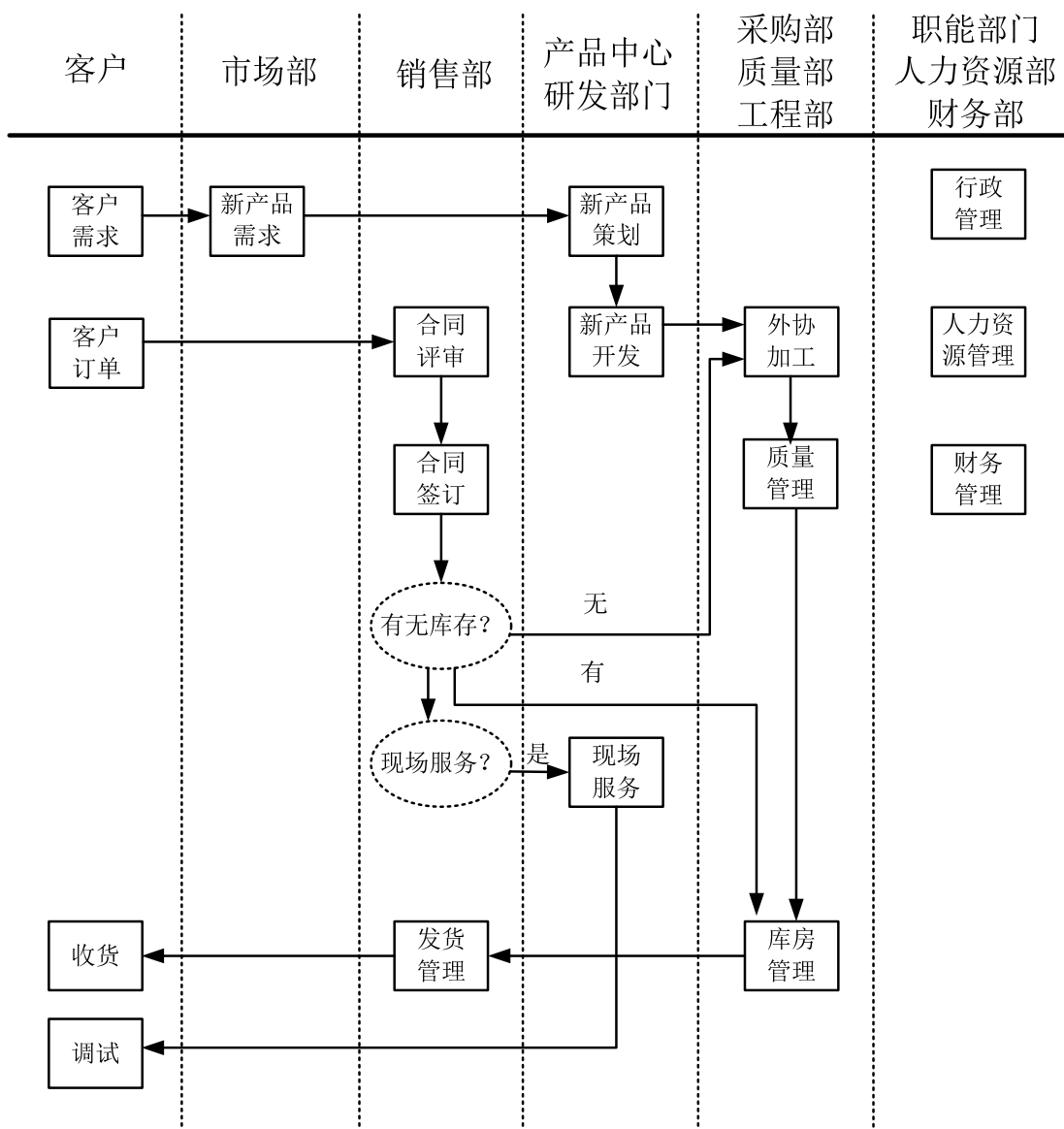
#### (4) 银行卡芯片

同方微电子研制的银行卡芯片 THD86/88 系列采用 32 位高性能 CPU 核，集成的大容量 NVM 存储器，加密算法包括对称和非对称算法，如 DES、RSA、SM1 等，能满足接触式和双界面的 Native/Java 等各类银行卡应用。

#### (4) USB Key 芯片

同方微电子研制开发了 USBKEY 安全芯片产品 THK 系列，支持国家商用密码算法应用。USBKEY 主要功能是身份认证和数据加解密，既可作为网络环境中的个人身份证，也可作为软件锁防止非法使用，主要应用于电子金融、电子商务、电子政务等领域。

## (二) 交易标的业务管理流程图



### (三) 主要经营模式

#### 1、研发模式

##### (1) 研发流程

公司有严格的产品设计开发流程，主要阶段包括：顾客要求确定、立项及审批、设计和开发实施、设计评审、工程试制验证、顾客试用等阶段：

顾客需求确定阶段：公司市场部负责跟踪市场趋势和顾客需求，并综合公司技术能力和产品标准要求，形成《市场需求报告》，作为公司新产品立项的依据。

立项及审批阶段：从技术可行性、财务可行性、生产可行性、质量可行性等

方面对新产品进行评估，以判断新产品的市场效益，确定产品所要采用的关键技术，以及产品所需要达到的性能、功能和质量要求，并对产品的投入和产出做出规划。规划审批通过后，正式立项。

**设计和开发实施阶段：**研发部对新产品需要达到的功能、性能等各项指标进行详细分析和分解，并确定解决方案。然后进行框架设计、编码，仿真及后端版图布局。

**设计评审阶段：**为保证产品设计质量，在设计的每一个关键节点都设置有设计评审，评审通过后才能进入工程试制阶段。

**工程试制验证阶段：**通过设计评审的产品进入试制阶段，并对试制样品进行详细的评估，以确保产品满足立项时的各项要求。

**顾客试用阶段：**通过试制验证的产品，交由顾客进行应用环境的实际使用和评估，对客户试用过程发现的问题进行改进和优化，确保产品满足顾客所有明示和未明示的要求。

## (2) 保证核心团技术人员稳定的具体措施

较强的研发队伍和优秀的核心技术人员是同方微电子技术持续领先、产品不断创新的主要因素之一。近五年来同方微电子员工的年离职率约为 5%。为了吸引和留住核心技术人才，同方微电子采取了一系列措施：

### ①建立了先进的企业文化

一个优秀的企业需要其先进的企业文化作为支撑，企业要做到走进核心技术人员，深入员工，换位思考，平等交流，主动沟通，让核心技术人员愉快的工作，同时形成团队意识，拥有业绩和归属感。

### ②制定了行业内具有竞争力的薪酬政策和职业发展规划体系

目前公司核心技术人员的工资在当地已处于领先水平。制订并落实工资增长计划，保证其报酬随公司效益一起提高。设立公司内部技术职称，定期组织评定和晋升，实现技术人员的自我发展。另外，对于承担研发、技改项目的技术骨干，根据项目重要性及完成情况，给予相应的奖励。具体包括：编制核心技术人员技能水平等级评定表及相应的技能工资标准；制定季度日

常考核标准，开展日常的考核，由所在部门直接领导负责，作为季度绩效工资发放的标准；制定项目考核办法与项目成员考核办法（项目成员的考核由所在项目的项目经理负责），作为项目奖金发放的标准。

### ③实施了包括股权激励在内的多种激励方式

由于企业核心技术人员普遍具有自主意识强、独立的价值观、高流动性的特点，因此，必须重视技术人员的管理与激励，以吸引、留住、激励他们，公司一直将物质激励与非物质激励相结合，将短期激励与长期激励相结合，运用股权激励、职业发展激励、精神激励等多种激励方式。

本次重组中前，同方微电子给予核心技术人员以股权激励。本次重组完成后，该部分核心技术人员将成为上市公司新员工和新股东，其职业发展及个人股东利益都将与上市公司紧密联系在一起。

### ④设立了完善的意见反馈机制

破除严格的等级观念，强调平等和对员工的尊重，建立公司内部信息共享平台，让公司核心技术人员甚至一般技术员工有机会就内部政策发表自己的观点，并给予及时的再反馈。

## 2、采购模式

为了确保生产稳定并控制原材料采购和外协加工成本，公司制定了相关采购管理制度，对采购的工作程序、供应商的选择和评价标准、采购材料的检验等流程操作均作了详细规定，并督促有关部门严格执行，最大限度避免了原材料断货或者供应商违约情况的出现，保证了公司的供应和生产稳定，并与许多优秀供应商建立了良好的长期合作关系。

公司制定了非常严格的供应商选择程序。公司制定了《外包过程控制程序》，通过接洽、实地考察等方式，从质量、价格、供货及时性等方面对供应商进行综合评价，公司选择其中信誉良好者建立备选的《合格供方名录》，并定期对名录中的供应商进行现场调研，并根据调研的情况更新名录。截至目前，公司尚未出现供应商违约的情况。

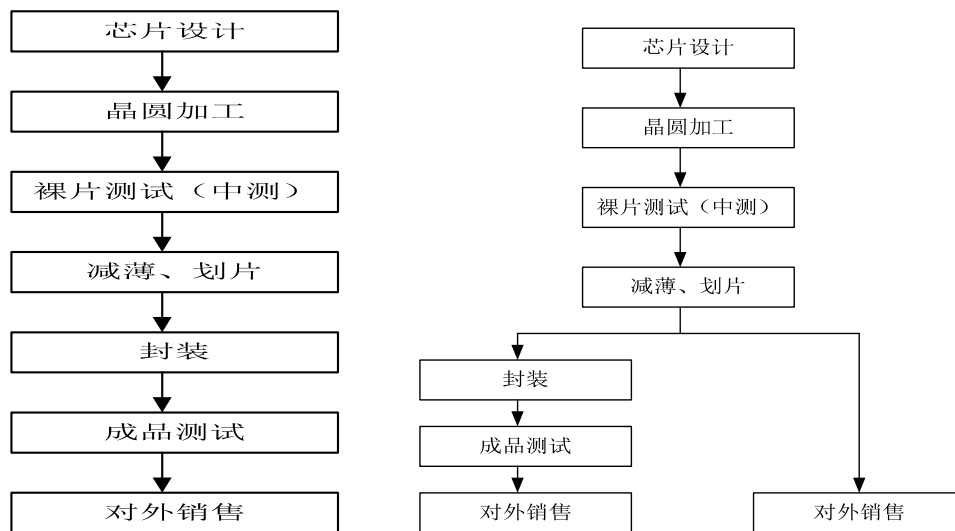
## 3、生产模式

公司采用Fabless经营模式，在集成电路芯片产品的生产流程中，公司将芯片的制造、封装、测试工序全部外包，自身基本不从事具体的生产活动。封装是指把晶圆上的芯片电路，用导线及各种连接方式，加工成含外壳和管脚的可使用芯片成品的生产加工过程。测试是指在集成电路制造过程中用一定的测试程序、测试方法，利用特定的仪器或设备（工装和治具）将所生产的集成电路裸片或者集成电路芯片成品分出良品和不良品的工程过程。从测试对象来看，分为集成电路裸片测试和集成电路芯片成品测试，也分别称为中测和成测。

公司具体流程为：接到客户的芯片订单后，根据客户的需求进行产品设计，并将芯片设计图交给代工厂商，由代工厂商根据企业的设计要求进行原材料的采购和加工，然后由代工厂商将代工后的芯片经过裸片测试（中测）、减薄、划片后直接发送给封装企业进行封装，封装完成后的芯片再交由测试企业进行成品测试（成测），测试合格的产品由公司交付客户。

身份证芯片主要供应公安部第一研究所，都是经过封装、成品测试后对外销售。移动通信类芯片（如手机SIM卡）及其它芯片一部分是在封装、成品测试后对外销售给客户，一部分是在减薄、划片后直接销售给客户。

交易标的的生产工艺流程图如下：



（身份证芯片生产工艺流程） （移动通信及其它芯片生产工艺流程）

公司采取委托代工方式进行主要产品生产，自身专注于从事集成电路研发活动。公司针对自身生产模式特点，制定了一系列生产管理制度，涉及人员培训、

服务提供、不合格产品回收各环节，有效地提升了生产效率。

#### 4、销售模式

同方微电子的产品不同于一般的消费类产品，主要客户需要在我公司提供的产品上进行二次开发，产品的推广销售过程和产品本身、研发、生产等密不可分。因为这些特性，目前公司主要采取直销的方式，以便以最快的速度了解需求，配合客户研发，达成销售，并且在后续商务处理中更好地服务客户。

新产品在定义阶段，市场销售人员就会与客户进行密切的沟通和互动，在不断完善产品性能指标等需求列表的同时，还将新产品整个时间安排发布到客户端，并及时更新，与客户保持该产品的市场情况的沟通，不断加强客户对新产品的认知和认同。新产品研发的后期过程中，市场销售人员会跟进客户在产品上的开发进度，保证在样品出来之后，客户能从实际应用开发的角度来试用产品，达成购买产品的初步意向。随后，销售端进行价格、供货、服务等常规商务谈判，进行量产产品合同签订。

公司将通过参加一些行业展会、论坛、业界沙龙活动等，通过演讲、展示和演示等方式将产品和理念推介给行业客户，利用恰当时机集中发布新产品信息，保证在行业客户密集场所的适度的曝光度，从而提高品牌和产品的认知度。公司也会通过组织资源为大客户公司做有效的产品、行业知识的培训，为大客户定制年度总结报告等，促进公司与大客户建立全面的战略合作。

此外，公司已建立一支由优秀的销售人员和技术支持服务人员组成的高素质营销团队，其营销和服务能力覆盖国内主流市场地区，能够提供及时的技术支持。

### （四）主要产品销售收入和价格变动趋势

#### 1、主要产品销售收入情况

报告期内，公司分产品类别实现的收入情况如下表所示：

主要产品类别	2011年1-9月		2010年度		2009年度		2008年度	
	金额(万元)	占销售收入比重(%)	金额(万元)	占销售收入比重(%)	金额(万元)	占销售收入比重(%)	金额(万元)	占销售收入比重(%)
移动通信产品	10,576.86	39.46%	19,079.97	55.42%	14,382.06	31.96%	10,501.32	26.47%

身份识别产品	13,672.53	51.01%	15,103.90	43.87%	30,594.51	67.98%	29,093.62	73.35%
金融支付产品	2,554.56	9.53%	244.68	0.71%	29.11	0.06%	71.58	0.18%
<b>合计</b>	<b>26,803.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>34,428.56</b>	<b>100.00%</b>	<b>45,005.68</b>	<b>100.00%</b>	<b>39,666.52</b>	<b>100.00%</b>

随着第二代居民身份证大规模换证进入尾声，报告期内，公司身份识别产品的销量在销售收入中所占的比例逐步下降，从73.35%下降到51.01%。

报告期内，公司SIM卡产品在国内市场份额的逐步提高，导致移动通信产品在公司销售收入中所占的比例逐年提高，从2008年度的26.47%上升到2010年度的55.42%。2011年1-9月份所占比例比2010年略有下降，主要是移动通信产品以模块形式（成品测试以后）销售的产品比例下降，以裸片形式（减薄划片以后）销售的产品比例上升，前者销售价格比后者高。另外，随着移动通信市场竞争的加剧，产品销售价格比2010年度有所下降。

报告期内，金融支付产品销售收入增长较快，随着金融支付产品逐渐商业化，进入产品推广阶段，金融支付产品销售收入占比由0.18%上升到9.53%。

## 2、销售价格变化情况

报告期内，公司主要产品价格变动情况如下表：

主要产品	2011年1-9月		2010年		2009年		2008年
	单价(元)	增幅(%)	单价(元)	增幅(%)	单价(元)	增幅(%)	单价(元)
移动通信产品	0.49	-16.39%	0.59	-24.36%	0.78	-26.42%	1.06
身份识别产品	6.34	0.40%	6.31	1.28%	6.23	-5.03%	6.56
金融支付产品	1.74	-67.37%	5.34	-10.70%	5.98	-8.28%	6.52

报告期内，在移动通讯芯片类产品方面，由于近年来国外芯片工厂加大了对国内移动通讯芯片市场的推广力度，加剧了国内移动通讯芯片市场竞争，公司移动通讯芯片销售价格有所下降。公司身份识别芯片类产品中，国家二代身份证芯片属于政府统一采购，销售价格变动较小。公司金融支付类产品基本处于商业化起步过程中，在公司销售收入中占比较低，但呈逐年提高的趋势。

## 3、主要产品的产销率情况

主要产品类别	2008年度
--------	--------

	产量 (万颗)	销量 (万颗)	产销率
移动通信产品线	10,300	9,902	96.13%
身份识别产品线	4,651	4,435	95.37%
金融支付产品线	14	11	79.99%
合计	14,965	14,348	95.88%
主要产品类别	2009年度		
	产量 (万颗)	销量 (万颗)	产销率
移动通信产品线	19,971	18,472	92.49%
身份识别产品线	5,154	4,913	95.31%
金融支付产品线	8	5	60.93%
合计	25,133	23,390	93.06%
主要产品类别	2010年度		
	产量 (万颗)	销量 (万颗)	产销率
移动通信产品线	34,335	32,399	94.36%
身份识别产品线	2,591	2,393	92.36%
金融支付产品线	49	46	93.88%
合计	36,975	34,838	94.22%
主要产品类别	2011年度1-9月		
	产量 (万颗)	销量 (万颗)	产销率 (%)
移动通信产品线	23,177	21,442	92.51%
身份识别产品线	2,386	2,158	90.44%
金融支付产品线	1,598	1,466	91.73%
合计	27,161	25,066	92.29%

#### 4、报告期前五名客户情况

报告期内，公司向前五名客户销售情况如下表：

序号	客户	销售内容	销售金额 (万元)	占当期销售总额 比例 (%)
<b>2008年前五名客户</b>				
1	公安部第一研究所	身份识别芯片	27,803.21	70.09%

2	金雅拓科技（上海）有限公司	移动通信芯片	4,587.34	11.56%
3	江西捷德智能卡系统有限公司	移动通信芯片	2,886.50	7.28%
4	上海华虹电子进出口有限公司	移动通信芯片	919.49	2.32%
5	同方股份有限公司	身份识别芯片	1,108.44	2.79%
合计			37,304.98	94.04%

**2009年前五名客户**

1	公安部第一研究所	身份识别芯片	29,698.54	65.99%
2	江西捷德智能卡系统有限公司	移动通信芯片	7,056.71	15.68%
3	金雅拓科技（上海）有限公司	移动通信芯片	4,310.37	9.58%
4	武汉天喻信息产业股份有限公司	移动通信芯片	1,242.25	2.76%
5	上海华虹电子进出口有限公司	移动通信芯片	867.17	1.93%
合计			43,175.04	95.94%

**2010年前五名客户**

1	公安部第一研究所	身份识别芯片	14,450.24	41.97%
2	金雅拓科技(上海)有限公司	移动通信芯片	6,142.09	17.84%
3	武汉天喻信息产业股份有限公司	身份识别芯片、 移动通信芯片、 金融支付芯片	4,756.61	13.82%
4	江西捷德智能卡系统有限公司	移动通信芯片	4,452.13	12.93%
5	东信和平智能卡股份有限公司	移动通信芯片	2,020.63	5.87%
合计			31,821.70	92.43%

**2011年1-9月前五名客户**

1	公安部第一研究所	身份识别芯片	13,494.36	50.34%
2	江西捷德智能卡系统有限公司	移动通信芯片、 金融支付芯片	4,116.93	15.36%
3	金雅拓科技（上海）有限公司	移动通信芯片	3,768.48	14.06%
4	江苏恒宝股份有限公司	移动通信芯片、 金融支付芯片	1,666.17	6.22%
5	武汉天喻信息产业股份有限公司	移动通信芯片、 金融支付芯片、 身份识别芯片	1,458.78	5.44%
合计			24,504.73	91.42%

同方微电子2008年、2009年、2010年、2011年1-9月份向前五名客户销售涉及金额合计分别为37,304.98万元、43,175.04万元、31,821.70万元、24,504.73万元，

占同期销售总金额的比例分别为94.04%、95.94%、92.43%、91.42%。报告期内，公司向前五名客户销售合计比例较高，主要是由于公司主导芯片产品的市场占有率较高，而公司主要客户均为细分市场内的领先企业，彼此存在良好的稳定合作关系，销售定价公允，对主要客户不存在重大依赖。

2008年、2009年、2010年、2011年1-9月份同方微电子向公安部第一研究所的销售占同期销售总金额的比例分别为70.09%、65.99%、41.97%、50.34%，销售的内容为国家二代身份证芯片。销售占比比较高的主要原因在于同方微电子在成立之初就承担了国家第二代居民身份证专用芯片模块开发和生产供应任务，是公安部指定的四家二代身份证芯片供应商之一。公安部每年根据二代身份证换发情况，给四家供应商下达芯片生产指标，由公安部第一研究所负责统一采购。同时，在成立之初，公司的产品线相对单一，二代身份证芯片在销售收入中所占比重比较高。随着第二代居民身份证大规模换证进入尾声，第二代居民身份证芯片供应进入平稳期，以及公司产品线的丰富，SIM卡业务的迅猛发展，同方微电子与公安部第一研究所的销售占比在报告期内持续下降，由70.09%下降到50.34%。

## （五）主要产品成本构成情况

### 1、主要成本构成

公司的集成电路芯片产品均借助代工厂商以委托代工模式进行生产。芯片产品的生产成本主要由晶圆采购代工费、掩膜制作费、裸片测试费、减薄划片费、封装费、成品测试费构成。掩膜制作、裸片测试和减薄划片一般可与晶圆代工服务打包完成。由于集成电路行业的特点，封装和成品测试业务联系紧密，通常封装和成品测试业务都是由同一家厂商提供。

报告期内，公司主要成本占生产成本的比重如下：

成本分类	2011年1-9月		2010年		2009年		2008年	
	金额(万元)	占生产成本比重(%)	金额(万元)	占生产成本比重(%)	金额(万元)	占生产成本比重(%)	金额(万元)	占生产成本比重(%)
晶圆	11,011.50	66.20%	14,511.14	61.64%	17,013.49	61.04%	15,574.39	64.70%
封装测试费	4,850.11	29.16%	7,909.86	33.60%	8,050.59	28.88%	5,482.15	22.77%
其它费用	771.73	4.64%	989.12	4.77%	2,809.48	10.08%	3,016.59	12.53%

合计	16,633.33	100.00%	23,410.11	100.00%	27,873.56	100.00%	24,073.14	100.00%
----	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------

注：晶圆包括委托晶圆代工厂的晶圆采购代工费、掩膜制作费、裸片测试费和减薄划片费。封装测试费包括封装费和成品测试费。

芯片的主要原材料为晶圆，报告期内平均约占芯片生产成本的60%左右。受人民币升值（晶圆价格一般以美元计价、人民币结算）、全球集成电路产业增长不佳等因素影响，晶圆代工业务市场竞争日趋激烈，报告期内晶圆价格整体呈稳中略降趋势。

报告期内芯片封装测试费平均约占芯片外协加工成本的30%。由于国内芯片封装测试业务发展较快，符合公司封装测试技术要求的厂商较多，公司具有较大选择空间。报告期内，公司主要产品封装测试平均单价呈下降趋势，但由于公司销售规模扩大，封装测试费用总额呈上升趋势。报告期内，公司芯片封装测试费占生产成本比例波动是由于不需要公司进行封装测试的产品比重发生变化所致。

### 3、报告期前五名供应商情况

报告期内，公司向前五名供应商采购情况如下表：

序号	供应商	采购内容	采购金额(万元)	占当期采购总额比例(%)
<b>2008年前五名供应商</b>				
1	上海华虹NEC电子有限公司	晶圆	18,020.40	68.68%
2	中电智能卡有限责任公司	封装费	5,601.54	21.35%
3	山东山铝电子技术有限公司	封装费	1,315.34	5.01%
4	中国航天时代电子公司	封装费	713.48	2.72%
5	上海长丰智能卡有限公司	测试费	228.78	0.87%
合计			25,879.54	98.64%
<b>2009年前五名供应商</b>				
1	上海华虹NEC电子有限公司	晶圆	9,564.77	59.35%
2	中电智能卡有限责任公司	封装费	2,863.05	17.76%
3	山东山铝电子技术有限公司	封装费	2,373.10	14.72%
4	北京时代民芯科技有限公司	封装费	463.45	2.88%
5	中国航天时代电子公司	封装费	349.59	2.17%
合计			15,613.96	96.88%

**2010年前五名供应商**

1	上海华虹NEC电子有限公司	晶圆	13,947.42	63.32%
2	山东山铝电子技术有限公司	封装费	2,135.27	9.69%
3	中电智能卡有限责任公司	封装费	2,077.50	9.43%
4	北京时代民芯科技有限公司	封装费	1,657.97	7.53%
5	江苏恒宝股份有限公司	封装费	1,635.88	7.43%
合计			21,454.04	97.40%

**2011年1-9月前五名供应商**

1	上海华虹NEC电子有限公司	晶圆	12,849.00	70.09%
2	中电智能卡有限责任公司	封装费	1,571.44	8.57%
3	江苏恒宝股份有限公司	封装费	1,153.08	6.29%
4	上海长丰智能卡有限公司	测试费	1,037.39	5.66%
5	北京时代民芯科技有限公司	封装费	780.00	4.25%
合计			17,390.91	94.86%

注：采购金额均为不含税金额。

同方微电子2008年、2009年、2010年、2011年1-9月份向前五名供应商采购金额合计分别为25,879.54万元、15,613.96万元、21,454.04万元、17,390.91万元，占同期采购总金额的比例分别为98.64%、96.88%、97.40%、94.86%，采购比例比较集中。报告期内，上海华虹NEC电子有限公司是公司最大的供应商，2008年、2009年、2010年、2011年1-9月份同方微电子向上海华虹NEC电子有限公司的采购金额占当期采购总额的比例分别为68.68%、59.35%、63.32%、70.09%。公司对其采购内容为晶圆。上海华虹NEC电子有限公司是全球领先的晶圆代工厂商，双方业已建立起长期稳定的良好合作关系，签署了战略合作协议。相对于其它可供选择的代工厂商，在公司部分的芯片产品中，上海华虹NEC电子有限公司的工艺和技术可更有效提升公司产品的成功率和稳定性。公司与上海华虹NEC电子有限公司的交易价格与业界平均水平相当，价格公允，双方为平等的合作关系，对主要供应商不存在重大依赖。

公司对供应商价格确定有完备、严格的决策程序，以“品质优先”、“货比三家”策略为基础，在保证产品质量的前提下，以“成本导向定价”方法为主。同时考虑，同等质量和价格条件下，交付周期最短者优先；同等上述条件下，技术

支持服务较好者优先。

#### 4、华虹NEC和华虹集成电路公司的关联关系

##### (1) 华虹 NEC 与华虹集成电路公司之间的关系

华虹 NEC 的间接控股股东为上海华虹（集团）有限公司（以下简称“华虹集团”），上海市国资委通过上海联和投资有限公司和上海仪电控股（集团）有限公司合计持有华虹集团 51.83% 股权，为华虹集团的实际控制人。根据上海国资委于 2010 年 8 月 10 日公布的《上海市国资委出资企业主业目录（第五批）》（沪国资委规划[2010]297 号），华虹集团属于上海国资委出资监管企业。综上，华虹 NEC 的实际控制人为上海市国资委。

华虹集团原先持有华虹集成电路公司 90.28% 股权，属于其控股子公司。2009 年 3 月，经华虹集团股东会决议和股东各方一致意见，华虹集团进行分立减资：将其持有的华虹集成电路公司等股权直接分立由中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）持有，不再拥有控股权。目前，中国电子持有华虹集成电路公司 72.69% 股权，为其控股股东。根据国务院国资委于 2007 年 6 月 12 日公布的《中央企业主业（第一批）》，其中中国电子属于中央企业，属于国务院国资委履行出资人职责的企业。

综上，华虹 NEC 和华虹集成电路公司的实际控制人分别为上海国资委和中国电子，在股权上没有直接关系。按照《公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）关于关联法人、关联自然人的规定，华虹 NEC 与华虹集成电路公司之间不存在关联关系。但华虹 NEC 的间接控股股东华虹集团参股华虹集成电路公司，华虹集成电路公司的控股股东中国电子则持有华虹集团部分股权，两者存在一定的关系。

##### (2) 华虹 NEC 与华虹集成电路公司之间的关系不影响标的资产的晶圆采购

2008 年度、2009 年、2010 年度、2011 年 1-9 月，同方微电子与华虹 NEC 之间的采购金额分别为 18,020.40 万元、9,564.77 万元、13,947.42 万元、12,849.00 万元，占同方微电子的采购比例分别达到 68.68%、59.35%、63.32%、70.09%，占比比较高。华虹 NEC 与华虹集成电路公司之间的关系不影响同方微电子的

晶圆采购，主要原因：

①华虹 NEC 在晶圆代工市场所占规模较小

2010 年，全球 14 家晶圆代工企业按收入的排名如下：

2010 排名	公司名称	2010 收入（亿美元）
1	台积电	133.07
2	联电	39.65
3	Globalfoundies	35.10
4	中芯国际	15.56
5	TowerJazz	5.10
6	Vanguard	5.08
7	Dongbu	4.95
8	IBM	4.30
9	Magnachip	4.20
10	三星电子	4.00
11	SSMC	3.30
12	X-Fab	3.20
13	华虹 NEC	2.95
14	德州仪器	2.85

（出处 IC Insights, CSIA 整理）

全球前十大晶圆代工厂排名中，台湾占有三个席次，且三家台湾厂商合计全球晶圆代工产业市占率高达 62%，显示出台湾地区在全球晶圆代工产业中所占有的重要地位。目前台积电、联电等全球领先晶圆代工企业纷纷在中国设立工厂，进入中国市场。华虹 NEC2010 年营业收入仅为 2.95 亿美元，在晶圆代工市场中所占比重较小，不具主导地位，对晶圆代工市场的影响有限，尤其是对中国晶圆代工市场。

②华虹 NEC 业务的独立性

华虹集成电路公司与华虹 NEC 虽然存在一定关系，但两者的实际控制人分别为中国电子和上海市国资委，两者之间的业务、人员、财务、资产都保证相对独立，不存在互相影响。根据华虹 NEC 出具的说明：公司在业务方面独立于实际控制人及其关联方，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与同方微电子业已建立了长期稳定的良好合作关系，在业务上将同等对待同方微电子与上海华虹集成电路有限公司，在产品销售定价方面保证公允、合理。

### ③同方微电子的采购决策程序

同方微电子对供应商价格确定有完备、严格的决策程序，以“品质优先”、“货比三家”策略为基础，在保证产品质量的前提下，以“成本导向定价”方法为主。同时考虑，同等质量和价格条件下，交付周期最短者优先；同等上述条件下，技术支持服务较好者优先。

### ④同方微电子与华虹 NEC 之间的合作关系

华虹 NEC 是全球领先的晶圆代工厂商，双方业已建立起长期稳定的良好合作关系，签署了战略合作协议。同方微电子与华虹 NEC 的交易价格与业界平均水平相当，价格公允，双方为平等的合作关系。

### ⑤同方微电子与其它供应商的合作关系

目前，公司已经与中芯国际集成电路制造有限公司（2010 年全球排名第 4）、上海宏力半导体制造有限公司（2010 年全球排名第 15）、无锡上华科技有限公司等晶圆代工企业开展合作，进行智能卡相关技术和芯片的开发与研究，并有少量的采购。鉴于公司与华虹 NEC 长期合作关系，目前公司产品仍主要交由华虹 NEC 进行代工生产。若华虹 NEC 产能供应出现问题，则同方微电子完全有能力很快转移到上述的其他代工厂商生产产品。

综上，华虹 NEC 和华虹集成电路公司的实际控制人分别为上海国资委和中国电子，在股权上没有直接关系，不属于法律法规规定的关联关系，但两者存在一定的关系。华虹集成电路公司与同方微电子的业务方面存在较强的竞争关系。由于全球晶圆代工市场容量较大，华虹 NEC 占有的市场份额较小，并且华虹 NEC 基于独立的经营决策作出的交易行为，与同方微电子之间的交易价格是公允的。同时，同方微电子与其它晶圆代工厂商已经建立了合作关系，正在开发相关产品。华虹 NEC 与华虹集成电路公司之间的关系不会对同方微电子产生影响。

## （六）质量控制情况

### 1、质量控制标准

交易标的主要产品为非接触和接触式智能卡类芯片产品。非接触式智能卡芯片产品主要遵守国际标准 ISO/IEC14443 标准，第二代居民身份证产品，同时还

遵守《居民身份证集成电路规范》和《JS-1 集成电路卡模块技术规范》（报批稿）。接触式智能卡芯片产品主要遵守国际标准 ISO/IEC7816 标准，手机 SIM 卡产品同时遵守 GSM11.17 标准。

交易标的产品在遵守相应的国际和国家技术标准之外，还特别遵循 JEDEC 系列集成电路可靠性标准，以及美军标 Military883E 等关于集成电路可靠性的标准，在可靠性方面对产品实行严格考核和把关。

同方微电子于 2006 年首次通过 ISO9001: 2000 版的审核，在 2009 年通过了 ISO9001: 2008 版的升级，认证范围为：集成电路产品的设计、开发、生产和服务。

## 2、质量控制措施

集成电路产品制造工艺复杂，技术含量高。为了控制产品质量，首先由制造商建立起全面的质量管理体系和生产管理体系，对每一个工艺步骤都规定了严格的来料检验、过程参数控制、过程检验等详细要求，特别是对生产过程中的关键工艺进行了明确识别，采用测试图形、陪片（试验片）等方法进行过程测量和结构确认，并采用统计分析技术（SPC）对工艺参数进行监控，以保证各项参数都在工艺规格和控制线之内，同时对工艺参数的波动趋势作出管理。基于供应商采集的过程数据，同方微电子对数据进一步分析和管理，监督并确认供应商的生产稳定性和质量水平，及时发现质量确实，并及时应对改善。

采用数据统计分析的方法进行过程控制，目的是建立并保持生产过程处于可接受的并且稳定的生产水平，一旦发现被监测数据出现异常趋势，则及时发出警告信息，及时对过程进行干预和修复。通过这种控制方法，保证复杂的生产工艺和生产流程处于稳定状态，从而保证产品的质量。

## 3、产品质量纠纷情况

根据北京海淀区质量技术监督局出具的证明，同方微电子最近三年内没有因违反质量监督行政管理法律法规受到质量技术监督部门的行政处罚。

## （七）安全生产和环境保护情况

公司的核心业务为集成电路设计，公司对外销售的产品均通过委托代工方式生产，公司只负责集成电路的设计，因此基本上不存在安全生产和环境污染隐患。最近三年公司未发生重大安全、环境污染事故，符合国家关于安全生产和环境保护的要求。

## 三、交易标的评估情况说明

### （一）评估结论

中发评估采用了市场法和收益法对标的资产的价值进行了评估，出具了《资产评估报告》（中发评报字【2010】第083号）。截至2010年10月31日，同方微电子净资产账面价值为50,833.27万元。根据收益法评估结果，评估后的全部股东权益价值为149,134.01万元，较账面增值98,300.74万元，增值率193.38%。根据市场法评估结果，评估后的全部股东权益价值为区间值144,167.48万元~156,181.15万元，比股东权益账面价值增值93,334.22万元~105,347.88万元，增值率为183.61%~207.24%。本次评估最终采用了收益法评估结果作为本次交易标的的最终评估结论。

### （二）市场法评估情况

市场法属于间接评估方法，是基于经济理论和常识都认同的基本原则，即类似的资产应该有类似的交易价格的评估思路，根据替代原则，采用比较与类比方法判断资产价值的一种评估方法。市场法能够直观体现资产估价的基本原理，在国际通行的各种估价规范中，都将公开市场价值标准确定为通常情况下估价应采用的价值标准。

#### 1、市场法的适用条件

（1）要有一个充分活跃的公开市场。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是一个有自愿的买者和卖者的竞争性市场，在这个市场上，买者与卖者的地位是平等的，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易行为都是在自愿的、理智的而非强制或不受限制条件下进行的，在这种条件下，资产的交换价值受市场机制的约束并由市场行情决定，排除个别交易的偶然性，其

市场成交价格基本上可以反映市场行情，按此市场行情评估资产价值，评估结果更贴近市场，更容易被资产交易各方接受。

(2) 参照物及其与被评估资产可比较的指标、技术参数等资料是可以收集、量化的。

## 2、可比公司的选择

### (1) 可比公司选择的依据和合理性

根据《企业价值评估指导意见》：“参考企业通常应当与被评估企业属于同一行业，或受相同经济因素的影响”。一般选择可比公司的方法是从同一行业中进行挑选，如果同行业内有足够多的可比公司用以选择，应尽量在同行业内选择可比公司，如果同行业内没有足够多的可比公司用以选择，也可以在其他行业内选择具有类似现金流、增长潜力和风险因素的公司作为可比公司。

本次评估市场法的运用有二个特点，一是以电子元器件制造业行业整体作为样本，非针对某些个别样本单个指标进行对比，评估师通过数理统计方法对样本整体进行分析，通过定义的检验、描述性检验、分析性检验、应用检验等必要的技术保障手段，以保证样本整体具有可比性；二是比较参数选择多因素而非单因素建立多元回归，具体运用了净资产收益率、贝他系数等参数建立多元回归方程，比较分析后确定适用于本次评估的指标如市净率（PB）、市盈率（PE）等方程；然后将该方程分别代入样本进行估计，验证方程的准确性；最后将被评估对象数据代入经过验证后的方程得出评估对象相关指标，由此指标计算公司价值。

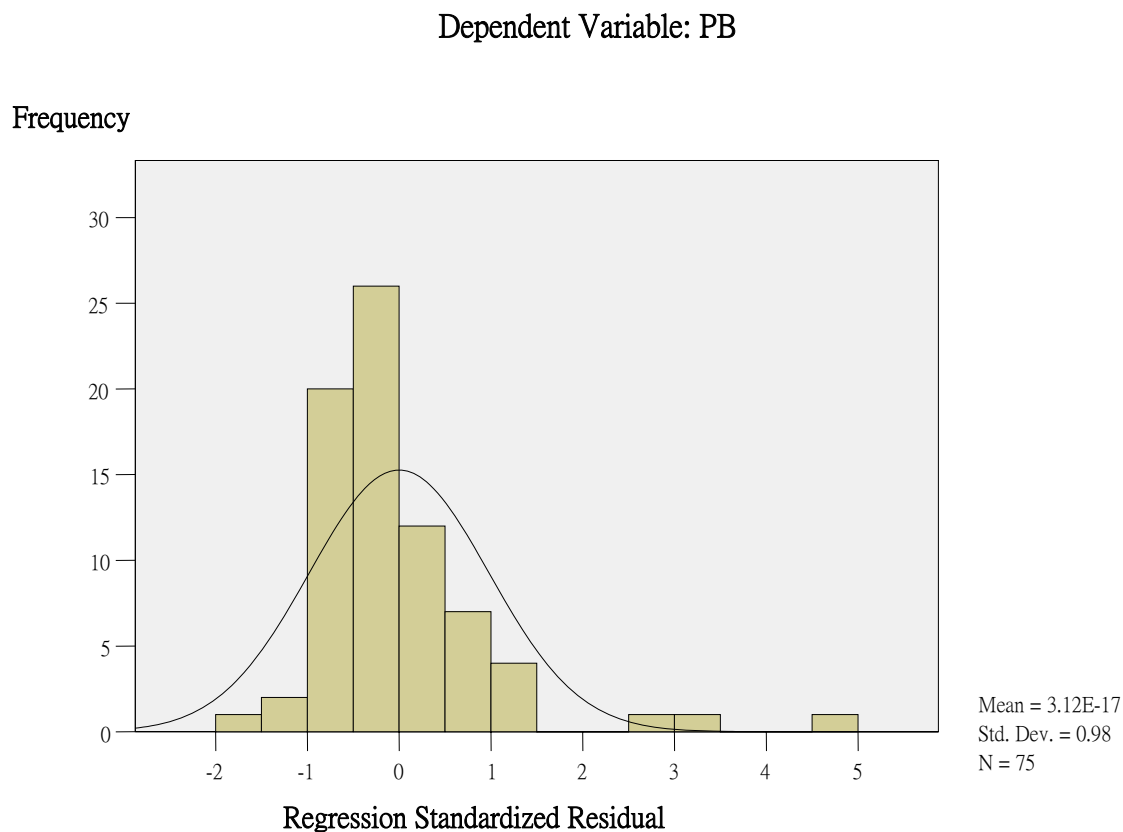
本次评估基准日通过 WIND 数据查询的证监会电子元器件制造业样本公司有 84 家，评估师根据数理统计方法进行筛选，本次参数选择多因素回归，剔除标准是整体回归检验结果，而不是单个公司主营业务与评估对象的比较，也不是单项指标如市净率等的比较。因为从微观角度来讲，人不能二次踏进同一河流，世界上也没有两片完全相同的叶子，但从行业整体来讲具有其共性，这种共性通过技术方法进行归纳总结后可作为可比性的判断依据。

本次选取 75 家可比公司中，存在个别样本数据与交易标的相关参数存在差异。在数理统计分析中，个别样本数据溢出的“长尾”现象是正常的。对 75 个样本整体而言，样本数据近似正态分布，因而个别数据的无效“长尾”不能否决

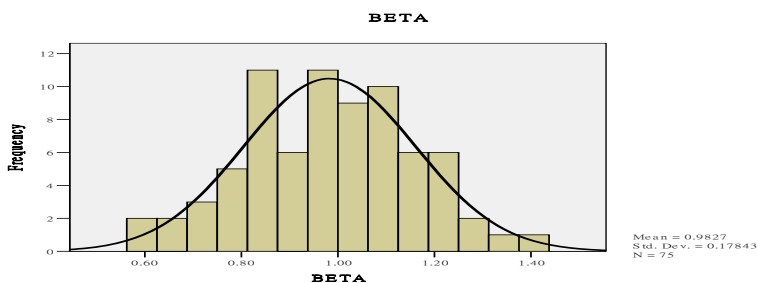
整体样本的有效性。评估机构在选择样本时不需要根据个别指标剔除差异较大的样本。

①样本相关指标符合正态分布

样本市净率（PB）的平均值为 5.3131，中位数为 4.5117，95%置信度为 0.6612，符合正态分布：

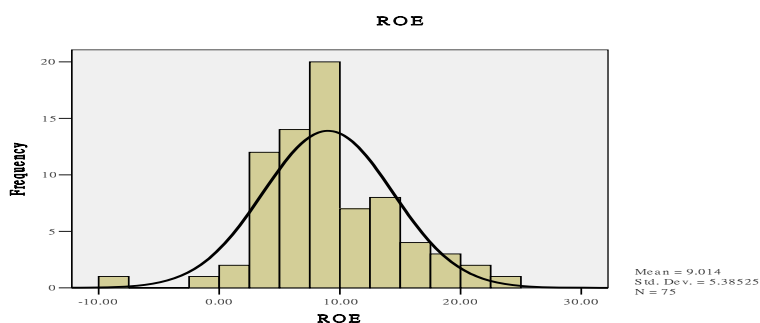


样本贝塔系数（BETA）的平均值为 0.9827，中位数为 0.9885，95%置信度为 0.0411，符合正态分布：

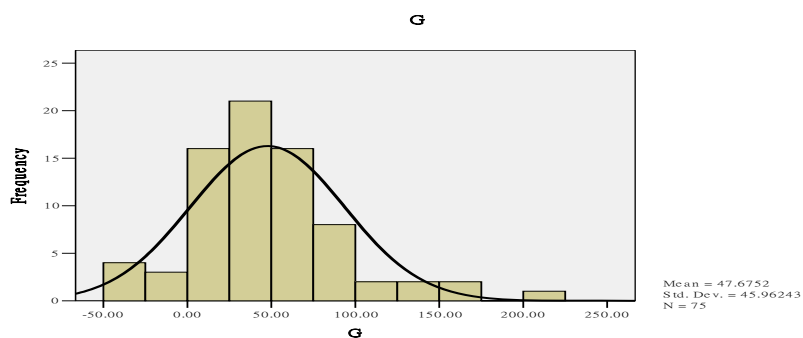


样本净资产收益率（ROE）的平均值为 9.0140，中位数为 8.2600，95%置信

度为 1.2390，符合正态分布：



样本增长率 (G) 的平均值为 47.6752，中位数为 45.9624，95%置信度为 1.1220，符合正态分布：



## ②评估模型符合统计要求

从评估模型的分析性检验结果来看，同样符合统计要求：

拟合优度分析：模型 Multiple R 为 0.86829，表明变量高度正相关；

F 检验：多元回归方程 F 值为 111.83，对应的 P 值非常接近于零，说明该模型在 5% 的显著水平下成立。

t 检验：方程中的自变量贝塔系数、净资产收益率系数经过 t 检验后，其 P 值远小于零，该结果表明方程中的自变量贝塔系数、净资产收益率对市净率有显著影响。

应用检验：各样本残差平均值为 0.1423，95%置信度为 0.6922，残差值分布均衡，说明方程回归结果较好。

综上，评估机构根据数理统计方法进行筛选，本次参数选择多因素回归，剔除标准是整体回归检验结果。经过检验，样本数据近似正态分布，个别数据的无效“长尾”不能否决整体样本的有效性。

### 3、评估过程

评估机构首先以国内 A 股市场电子元器件业上市公司为样本，建立多元回归方程，比较分析后确定适用于本次评估的市净率、市盈率等方程；然后将该方程分别代入样本进行估计，验证方程的准确性；最后将被评估对象数据代入经过验证后的方程得出评估对象相关指标，由此指标计算公司价值。

### 4、评估结论

同方微电子于评估基准日 2010 年 10 月 31 日市场法评估值为区间值 144,167.48 万元~156,181.15 万元，比股东权益账面价值增值 93,334.22 万元~105,347.88 万元，增值率为 183.61%~207.24%。

## （三）收益法评估情况

收益法是通过估算被评估企业在未来的预期收益，并采用适当的折现率折现成基准日的现值，求得被评估企业在基准日时点的公允价值。本次评估以交易标的的自由现金流做为收益额，选用分段收益折现模型，将以持续经营为前提的未来收益分为前后两个阶段进行预测，首先预测前阶段各年的收益额；再假设从前阶段的最后一年开始，以后各年预期收益额均相同或有规律变动。

根据同方微电子的发展计划，对未来收益指标进行预测，在此基础上考虑资本性支出及流动资金补充，进而确定同方微电子未来期间各年度的自由现金流指标。最后，将未来预期收益进行折现求和，即得到同方微电子在评估基准日时点的市场公允价值。

评估基本计算公式为：

$$P = \sum_{i=1}^n R_i(1+r)^{-i} + P_m/(1+i)^n + \text{非经营性资产负债项目 的调整}$$

其中： $P$ ——委估企业股权于评估基准日的公允价值；

$R_i$ ——企业股权未来第  $i$  个会计年度预期净现金流量；

$r$ ——折现率，由资本资产定价模型确定；

$i$ ——计算年期；

$P_m$ ——永续期年净现金流。

### 1、股权净现金流量

股权净现金流量，即同方微电子的息后税后净利润加上折旧及摊销等非现金支出，再减去资本性支出、营运资金追加，加上固定资产余值、营运资金回收后的余额。

### 2、折现率

本次评估采用资本资产定价模型（CAPM）来确定净现金流量的折现率。CAPM模型是普遍应用的估算投资者收益的办法。CAPM模型可用下列数学公式表示：

$$R=R_f+\beta*(R_m- R_f)+d$$

$R_f$ 为无风险报酬率，无风险报酬率是对资金时间价值的补偿，这种补偿分两个方面，一方面是在无通货膨胀、无风险情况下的平均利润率，是转让资金使用权的报酬；另一方面是通货膨胀附加率，是对因通货膨胀造成购买力下降的补偿。由于现实中无法将这两种补偿分开，它们共同构成无风险利率。

$\beta$ 为衡量公司系统风险的指标。

$R_m- R_f$ 为市场风险溢价。市场风险溢价反映的是投资者因投资于风险相对较高的资本市场与投资于风险相对较低（或无风险）的债券市场相比所得到的风险补偿。它的取值为市场在一段时间内的平均收益水平和无风险报酬率之差。

$d$ 为企业个别风险调整系数，需根据企业规模，经营风险和财务风险水平取值。

### 3、预测期限的确定

根据同方微电子的特点和其规划，本次评估将2010年11月1日至2014年12月31日作为明确预测期，2014年后设为永续期。

### 4、非营业资产负债价值的确定

非营业资产负债价值包括溢余货币资金、交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、应收及应付股利、未投入生产运营的其他溢余资产等在将来预测中未考虑的项目。

## 5、评估结论

同方微电子于评估基准日 2010 年 10 月 31 日收益法评估值为 149,134.01 万元，较公司股东权益增值 98,300.74 万元，增值率 193.38%。

### （四）收益法评估参数选择

#### 1、营业收入整体的预测

同方微电子系一家快速成长的高新技术企业，在研发、市场地位和市场渠道方面拥有明显优势，自成立以来一直保持了较高的盈利能力。随着同方微电子 USB-key 应用芯片、可信密码模块、大容量 SIM 卡芯片、银行卡芯片、UHF RFID 技术等项目在 2010-2014 年的逐渐商业化生产，以及和国际知名智能卡商保持的长期合作关系，保证了同方微电子未来营业收入和自由现金流的生长有充足的保障。根据宏观经济因素及同方微电子的总体规划，预测 2011-2014 期间同方微电子整体业务收入增速维持在 15%—20%左右，2014 年以后进入一个稳定发展期。具体如下：

（1）移动通信类产品线。产品主要为手机 SIM 卡芯片。同方微电子的手机 SIM 卡芯片自 2006 年进入市场以来，销量逐年增长，已经成为国内最大的手机 SIM 卡芯片供应商。目前，同方微电子的 SIM 卡芯片主要为小容量 SIM 卡芯片，该产品毛利率较低，自 2010 年起，公司研发的大容量 SIM 卡芯片逐渐投入市场，公司将在保持小容量 SIM 卡芯片市场份额的情况下，逐渐提升大容量 SIM 卡芯片市场份额。随着大容量 SIM 卡以及其它高附加值产品的推广，预测期内同方微电子移动通信类产品的收入和利润都将有所提高。

（2）身份识别类产品线。主要产品包括二代身份证芯片、非接触智能卡芯片、非接触卡读写机具射频芯片、RFID 电子标签芯片等。第二代居民身份证是我国最大的电子证件应用，2006 年达到集中换发阶段的发卡量高峰，年发卡 2.8 亿张。二代身份证集中换发自 2009 年度结束后，已经进入平稳更换期。2011 年-2013 年每年发卡量约 6000 万-8000 万。二代身份证芯片共有四家供货商，四家

供货商不存在恶性竞争，每家供应四分之一。预计同方微电子的二代证芯片产品 2011 年-2014 年每年的销售量大约维持在 2,000-2,500 万颗左右。这是同方微电子的一个稳定收入和利润来源。一部分第二代居民身份证有效期为十年，2014 年以后，随着一部分第二代居民身份证有效期过期，又将出现换发高峰期，二代证芯片产品的销售量将会有所增加。随着公交卡、城市一卡通等换“芯”工程的全面开展，以及国内金融支付工具和手段的发展，小额支付、水电气表、金融 POS 等读写器应用需求将逐渐增加。国内物联网市场的启动，对 RFID 电子标签芯片的需求也会大量增加。因此，预测期内同方微电子在身份识别领域的芯片销量及利润将逐渐增加。

(3) 金融支付产品线。产品主要为网络银行 USB-Key 应用芯片、银行卡、移动支付。目前，网络银行支付采用双因素认证，除了密码口令之外，USB-key 是应用最广泛的一种实体介质型认证因素。公司现有的 USB-key 应用芯片产品已于 2010 年通过国家有关主管部门的相关资质认证，并已经完成重点客户的开发试用，将于 2010 年底前形成生产销售。公司在 2011 年将推出新一代的 USB-key 芯片，以满足高端客户的需求。同时，移动支付正作为一种新的支付方式在全球快速蔓延。各电信运营商和金融机构纷纷把支撑业务的发展重点转向手机支付的发展。2011 年同方微电子将推出基于 SIMPASS 技术的移动支付芯片。预测期内，同方微电子的金融支付类芯片产品的收入和利润将逐渐提高。

同方微电子各产品线历史营业收入如下：

单位：万元

项目/年限	2010 年 1-10 月	2009 年	2008 年
移动通信产品线	14,644.93	14,382.06	10,501.32
身份识别产品线	13,005.50	30,594.51	29,093.62
金融支付产品线	74.56	29.11	71.58
合计	27,724.99	45,005.68	39,666.52

同方微电子各产品线营业收入预测如下：

单位：万元

项目/年限	2010 年 11-12 月	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
移动通信产品线	4,430.49	21,512.50	25,578.19	28,501.10	30,703.80

身份识别产品线	2,008.66	15,305.20	16,142.42	18,501.13	22,503.15
金融支付产品线	203.44	5,110.90	8,969.00	15,167.00	18,481.94
合计	6,642.59	41,928.59	50,689.61	62,169.23	71,688.89

## 2、金融支付产品收入未来增长的原因及合理性

金融支付产品线是同方微电子近两年为未来业绩发展而布局新开发建立的，在预测期内的增幅较大。同方微电子目前的金融支付产品线主要包括有：

产品方向	产品分类	产品系列/型号	主要用途
金融支付类	支付功能芯片	THC26/THD20 系列	社保卡、加油卡、电卡、支付卡等
	安全管理芯片	THC20/80 系列	付费电视卡、税控卡、安全控制等
	银行卡芯片	THD86/88 系列	银行卡
	支付终端芯片	THM30 系列	单/双界面读卡器、安全 SAM 模块
	USB Key 芯片	THK 系列	电子金融领域的网上银行、电子商务、电子政务，进行签名、认证和加解密等

### (1) 评估机构对金融支付产品销售预测情况

根据中发国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中发评报字【2010】第 083 号），评估机构对同方微电子金融支付类产品的销售情况预测如下表：

单位：万元

项目/年限	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
金融支付产品线	278.00	5,110.90	8,969.00	15,167.00	18,481.94

### (2) 金融支付产品的市场状况

2011年—2014年金融支付产品业绩的增长主要来源于USB-Key等信息安全芯片、银行卡芯片、社保卡芯片未来销售的增长。这里将主要分析USB-Key等信息安全芯片、银行卡芯片、社保卡芯片的市场前景。

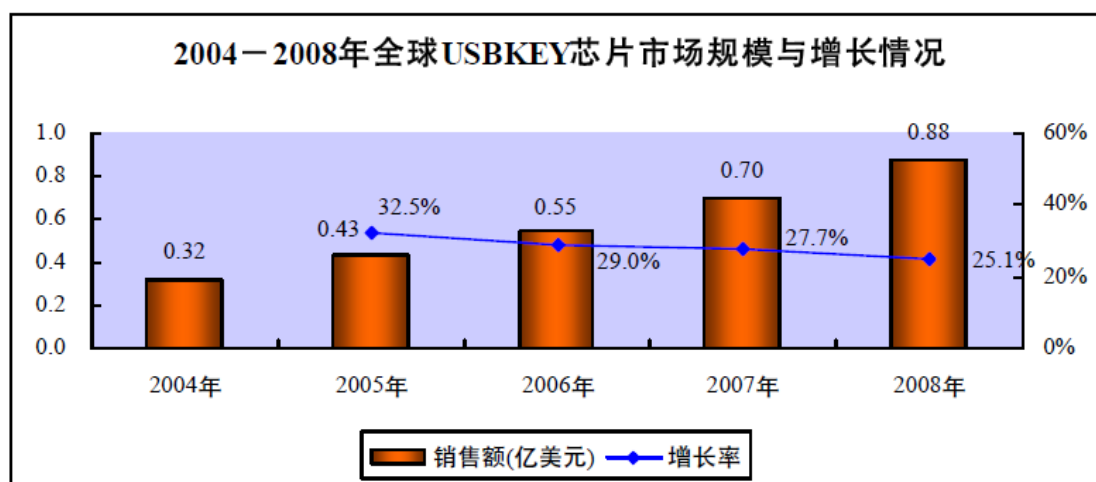
#### ①USB-Key等信息安全芯片的市场状况

##### A、USB-Key等信息安全芯片的发展现状

信息安全芯片是实现网络社会身份认证的基础，为网络社会中的商业交易、个人信息提供法律认可的安全保障。我国从“十五”期间开始，把研发自主信息安全领域的核心芯片作为超大规模集成电路重大专项主要内容。经过几年的发展，

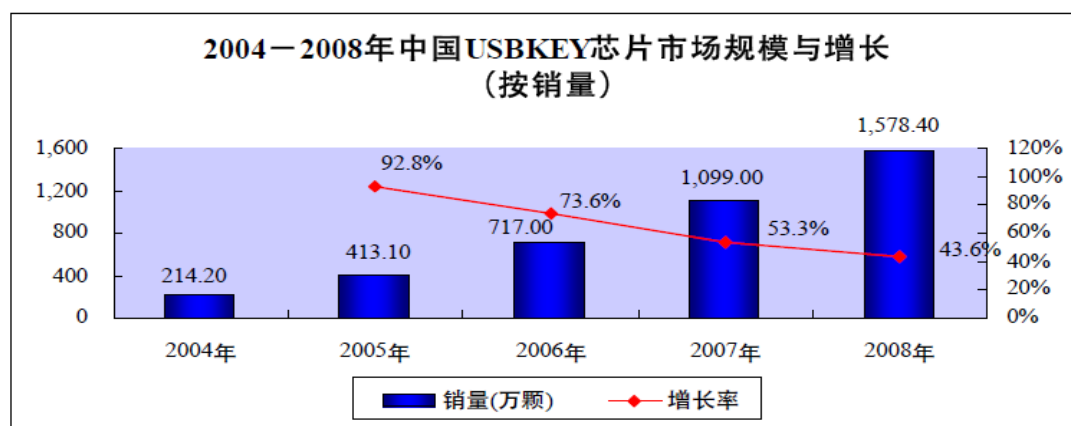
安全芯片市场已经初具规模，并进一步形成USB-Key、安全存储、可信计算以及移动支付等细分市场，在电子金融、电子商务、电子政务以及消费类等领域应用日益普及。

近年来，全球USB-Key安全芯片市场在电子金融、电子政务以及企业网络认证等应用的带动下保持了快速增长。截至2008年末，全球USB-Key安全芯片市场销量达到3,716.8万颗，销售额达0.88亿美元。2004-2008年全球USB-Key安全芯片市场规模与增长情况如下图：



数据来源：CCID 2009.6

近年来，网上银行用户数量快速增长，推动了中国USB-Key安全芯片市场规模快速增长。2004-2008年，中国USB-Key安全芯片市场销量规模从214.2万颗增加到1,578.4万颗，销售额也由2004年的4,441.3万元增长到2008年21,673.0万元，并已成为全球芯片市场快速增长的主要推动力。



数据来源：CCID 2009.6

## B、USB-Key等信息安全芯片的发展前景

未来几年，中国 USB-Key 安全芯片市场将随着 USB-Key 在国内电子金融、电子政务、电子商务的普及而快速增长；此外，中国 USB-Key 网上银行解决方案向海外市场的推广也将为中国 USB-Key 安全芯片市场的增长提供支持。根据中国电子信息产业发展研究院报告，预计到 2014 年，中国 USB-Key 安全芯片市场销量将达到 9,709.5 万颗，销售额达到 12.66 亿元，销量和销售额的年均复合增长率将分别达到 34.7%和 35.0%。

其它信息安全芯片市场的未来发展前景如下：

移动支付是指交易双方通过移动终端（主要为手机）进行商业交易，其主要用途包括公共交通系统现场支付，超市、餐饮、零售、娱乐现场支付，也包含通过手机实现转账、缴费等远程支付。近距离无线通讯技术在手机上的应用，推动了移动支付技术系统在国际通讯行业迅速发展。据国外媒体Telecomseurope.net 预测，到2012年，使用该项技术的手机用户将占全球手机用户总数的3%（约为1.9亿人），而2008年移动支付用户数量仅为7,340万人，未来几年将保持高速增长。

可信计算芯片嵌在电脑主板上，用来保证电脑软件运行的合法性，杜绝病毒和木马的非法入侵，从而在电脑上创造一个可信的运行环境。目前国内可信计算产品使用的是国家自主TCM规范，与国际通用的TPM标准不同。在国际市场，日本市场的笔记本电脑几乎全部配置TPM可信计算模块，美国市场的可信计算电脑已占据了2/3的市场份额。根据IDC（国际数据公司）的预测，到2010年配备TPM可信计算模块的电脑全球销售量将达到2亿台以上。

根据《可信计算密码支撑平台功能与接口规范》、《商用密码管理条例》、《含有密码技术的信息产品政府采购规定》等法律及规定，国内所有可信计算产品均应配备TCM芯片；政府采购中凡采购含密码技术的信息产品，必须采购自主密码技术产品。目前国内市场，TCM芯片已启动产业化准备，国内个人电脑供应商联想、同方、方正均推出了多款支持TCM规范的可信个人电脑产品，而国外厂家戴尔已经推出面向国内市场、支持TCM规范的产品。由此预见，TCM可信计算模块市场前景广阔。

## ②银行卡芯片的市场状况

我国的银行卡基本上是以磁卡为主，现有磁条借记卡 20 亿和信用卡 2

亿，真正的中国金融集成电路（IC）卡的发行量尚不超过 1,000 万张。我国银行卡从磁卡走向 IC 卡的 EMV 迁移计划将本着“先标准、后试点，先收单、后发卡，先外卡、后内卡，先贷记、后借记”的策略进行。中国人民银行要求从 2010 年开始，在五年内中国将不再发行磁条卡，全部改为 IC 卡。

在标准方面，中国银联于 2005 年推出了 IC 卡标准即《中国金融集成电路(IC)卡规范》（PBOC2.0）。中国银联于 2010 年 5 月制定具体时间表，力争用 5 年时间，实现境内全面发行和受理金融 IC 卡。国有商业银行应在 2010 年年底前全面发行金融 IC 卡；全国性股份制商业银行应在 2012 年年底前全面发行金融 IC 卡；自 2015 年 1 月 1 日起，所有新发行的银行卡应为金融 IC 卡。预计 2012 年开始有年超过千万的金融 IC 卡需求，逐年呈倍数增加。



数据来源：CCID 2009

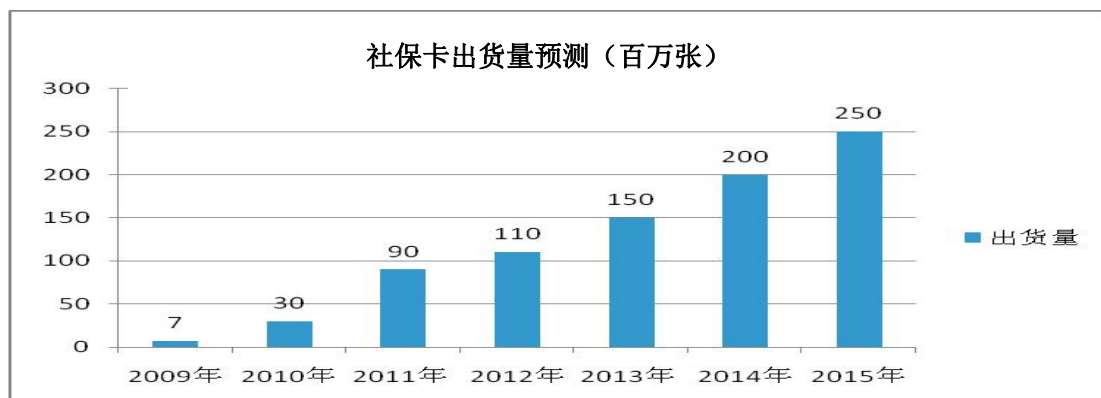
2011 年公司将推出符合中国银联 PBOC2.0 标准的芯片产品 THD80E05，满足低端借记卡需求。2012 年再推出 THD88E06BC，满足高端信用卡需求。该类芯片产品自 2012 年开始进入市场。

### ③社保卡芯片的市场状况

社保卡主要用于就业服务、劳动合同管理、工资收入管理、职业资格、养老保险、失业与医疗保险等劳动保障业务。国家劳动和社会保障部主持的以社保卡为基础的“金保工程”经过多年的建设，目前已建成统一规范的数据中心 248 个（包括 4 个直辖市、26 个省级劳动保障部门和 218 个地市）。32 个省级劳动保障部门全部实现了与部中央数据中心的联网，310 个地市实现了与省级数据中心的联网，占全国地市总数的 87.32%。目前社保卡已经累计发行近 1 亿张。

由于社保应用市场还处于发展期，各地使用的社保卡种类各异，有逻辑加密卡和 CPU 卡，系统建设的差异导致了应用层次的区别。于是劳动和社会保障部

颁布《社会保障(个人)卡规范》，明确要求社保卡采用 CPU 卡，并支持国密 33 算法，能够实现“一卡多用、全国通用”的功能。因此，符合社保规范、基于国密 33 算法的 CPU 卡将是未来社保的发展方向。



数据来源：CCID 2009

2010 年末，公司推出了符合《社会保障（个人）卡规范》的社保卡产品 THC26E05C。2011 年 3 月已经完成国密局的资质认证，目前已有客户完成了相关产品开发，并正在相关检测机构进行送检测试，预计 2012 年开始形成生产销售。

### （3）同方微电子具备相应的研发、管理、销售能力

#### ①研发能力

同方微电子自成立至今，致力于智能卡芯片的开发与销售，并提供系统解决方案。公司依托清华大学的技术优势，在数字、模拟及数模混合集成电路的设计和产业化方面积累了丰富的丰富经验，先后承担、完成了国家“863”重大科技专项、“核高基”重大专项、工信部电子发展基金、北京市科委、北京市经信委和中关村等多个集成电路项目的产品开发任务，完成了多项智能卡相关产品研发和产业化成果。在智能卡芯片相关技术方面居于国内领先和国际先进水平，并获得了北京市科学技术二等奖和国家科技进步一等奖。

目前，公司拥有各种专利61种，其中主要用于金融支付产品的专利见下表：

类型	专利名称	状态	用途
发明	一种用于密码学运算的微处理器内核装置	授权	协处理器
发明	一种非接触 IC 卡负载调制数据的解调方法及其装置	授权	非接触接口
新型	一种非接触式 IC 卡和读写器之间波特率自适应的装置	授权	非接触接口
新型	一种识别非接触式 IC 卡的防冲突装置	授权	非接触协议
发明	一种用于非接触/接触 IC 卡的电源隔离电路	授权	通信接口

发明	一种对抗差分功耗分析的逻辑单元	授权	安全性
发明	一种用于非接触 IC 卡阅读设备的电源管理电路	授权	读写机具
发明	一种用于非接触 IC 卡阅读设备的调制电路	授权	读写机具
发明	一种用于智能卡仿真调试系统的接口	授权	仿真系统
发明	一种用于智能卡仿真调试系统的硬件断点电路	授权	仿真系统
发明	一种用于非接触/接触 IC 卡的电源隔离电路	授权	通信接口
发明	一种用于发行带 USB 接口智能卡的系统及其发行方法	授权	通信接口
发明	一种实现 NOR FLASH 坏块管理的方法及其控制电路	实审	存储器
发明	一种基于闪存存储器的智能卡下载数据的方法	授权	存储器
发明	一种以应用协议数据单元访问与非门闪存存储器的方法	实审	存储器
发明	一种双界面智能卡电源管理电路	授权	通信接口
发明	一种用于非接触 IC 卡的解调电路	实审	非接触接口
发明	一种近场通信射频接口集成电路	实审	NFC 接口
发明	一种用于电源电压脉冲干扰的检测电路	授权	安全性
发明	一种优化混合信号芯片面积的方法	授权	可靠性
发明	一种用于近场通信的射频接口集成电路	实审	NFC 接口
发明	一种用于移动支付的安全终端装置	受理	移动支付终端
发明	一种用于非接触式智能卡多协议自适应选择电路	受理	接口协议
发明	一种用于芯片安全防护的光检测电路	受理	安全性
发明	一种用于非接触 IC 卡的调制电路	受理	非接触接口
发明	一种语音识别网上交易的智能密码钥匙	受理	安全交易装置
发明	一种独立于电源模块的芯片级门锁现象过流保护电路	受理	可靠性

公司拥有的各种 IP 模块技术见下表：

模块名称	具体描述
CPU 内核	8 位、16 位、32 位通用嵌入式 CPU 核
存储器	ROM、SRAM、NVM（包括 EEPROM 和 eFlash）、OTP、MTP 存储器
协处理器	DES/TDES、RSA、SHA-1、ECC 和国密算法等协处理器
接口与协议	ISO7816、ISO14443、双界面、ISO18000、USB、SWP、SD 等接口与协议
安全与可靠性	随机数发生器、电压检测、频率检测、光检测、高场强保护等

从上表可以看出，公司的模块技术已涵盖智能卡芯片和配套读卡器射频芯片。基于上述专利和 IP 模块技术，公司完全有能力开发出符合金融支付需求的智能卡芯片产品，并具有较强的更新换代能力。经过多年的技术积累，公司在金融支付理论和实践方面在国内已经处于领先地位。2011 年公司根据市场需求开发了适合二代 USB-key 应用的芯片产品 07ACV11 和 07ACV12，已经提交重点客户开发产品，将于 2012 年形成生产销售。2011 年公司推出了符合中国银联 PBOC2.0 标准的芯片产品 THD86E05，满足低端借记卡需求；2012 年拟推出 THD88E06BC，以满足高端信用卡需求。此外，2011 年公司推出的 THD86 系列芯片平台，还能满足各种移动支付应用，已有多家客户在开发相关产品，目前已开始形成生产销售。同时，2010 年末公司推出了符合《社会保障（个人）卡规范》的社保卡产品 THC26E05C，2011 年 3 月已经完成国密局的资质认证，目前

已有客户完成了相关产品开发，并正在相关检测机构进行送检测试，预计 2012 年开始形成生产销售。

## ②管理能力

公司拥有一支优秀的集成电路管理团队。公司的管理团队具有平均超过 15 年的集成电路从业经历，在业内有广泛的资源和影响力，为公司新产品的发展奠定了良好的管理基础。2010 年 6 月，为适应产品线增加对公司管理带来的要求，公司成立了产品中心，并任命了身份识别产品总监、金融支付产品总监、移动通信产品总监，分别管理三个产品线的市场、研发、生产与销售，实现了虚拟事业部制的产品线一体化管理，以快速响应市场对各产品的需求。

同时，公司建立健全了各项经营管理制度，实施了科学规范的经营管理。2006 年 1 月，公司顺利通过 ISO9001:2000 质量管理体系认证。2010 年 2 月，公司又顺利通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证。

## ③市场销售能力

同方微电子的金融支付产品不同于一般的消费类产品，主要客户需要在公司提供的产品上进行二次开发，产品的推广销售过程和产品本身、研发、生产等密不可分。因为这些特性，目前公司主要采取直销的方式，以便快速了解需求，配合客户研发，达成销售，并且在后续商务处理中更好地服务客户。公司已建立一支由优秀的销售人员和技术支持服务人员组成的高素质营销团队，其营销和服务能力覆盖国内主流市场地区，能够提供及时的技术支持。

同方微电子通过 SIM 卡市场积累了深厚的客户资源，成为包括法国金雅拓公司、德国捷德公司在内的全球主要智能卡商的供应商。2010 年全球前六名卡商有五家是公司客户，其中是前三名国外智能卡商的唯一中国芯片供应商。这些智能卡商在金融支付终端产品市场上占有较大的市场份额。因此，公司的金融支付产品直接依托 SIM 卡芯片业务，与这些智能卡商建立其它产品业务合作关系。客户的同质性、较强的技术优势及良好的市场信誉为同方微电子开拓 USB-key 芯片等金融支付产品奠定了良好的基础。

同时，公司将积极开拓新的客户。公司将通过参加一些行业展会、论坛、业界沙龙活动等，通过演讲、展示和演示等方式将产品和理念推介给行业客户，利

用恰当时机集中发布新产品信息，保证在行业客户密集场所的适度的曝光度，从而提高品牌和产品的认知度。公司也会通过组织资源为大客户公司做有效的产品、行业知识的培训，为大客户定制年度总结报告等，促进公司与大客户建立全面的战略合作。

#### （4）同方微电子金融支付业务目前发展状况

目前，同方微电子现有的 USB-key 产品 THK20F07AC，已于 2010 年通过国家有关主管部门的相关资质认证，并已经完成重点客户的开发试用，并得到客户认可，形成生产销售。由于国内银行对 USB Key 应用安全等级的提高，从 2011 年开始，国内银行全面采购二代 USB Key 产品，一代 USB Key 市场急剧萎缩，公司 USB-key 芯片 2011 年销售收入未达到预期。通过对二代 USB-Key 市场和重点客户的需求调研，与重点客户开展紧密合作，在原 USB-Key 芯片基础上完成了相应的芯片改进。目前，新改进的芯片产品已经提供给相关客户，部分客户已完成初步评测，现正在该芯片上进行产品开发。该类芯片产品将在 2012 年开始形成销售。同时，2012 年公司将开发新一代的 USB-key 芯片 THK80F08C，满足高端客户扩展应用，该产品将在 2012 年开始销售，并在以后年度逐步增长，获得稳定的市场占有率。

2011 年公司推出了适合移动支付应用的芯片产品 THC80F09BC，可用于多种移动支付应用中。目前正在紧密开发应用方案，2011 年底已开始进入市场。2011 年公司还推出了适合金融支付和移动支付应用的 THD86 系列芯片 EF59AC 平台。目前有多家客户在基于该芯片平台开发移动支付应用，2011 年底前已开始形成销售。移动支付应用将在未来几年有较大的增长，并使公司获得较好的营收增长。

自 2010 年起，同方微电子积极参与银联的银行 IC 卡方面相关工作，并参加了《中国银联芯片安全规范》标准的制定工作。同时，为配合金融行业日益增长的安全需求，同方微电子积极配合了银行卡检测中心建立安全测试实验室的有关工作。2011 年公司推出了符合中国银联 PBOC2.0 标准的芯片产品 THD80E05，满足低端借记卡需求，该产品目前正在与中国银联合作一起开发应用方案。2012 年拟推出 THD88E06BC，以满足高端信用卡需求。该类芯片产品自 2012 年开始进入市场。

2010年末，公司推出了符合《社会保障（个人）卡规范》的社保卡产品THC26E05C。2011年3月已完成国密局的资质认证，即将形成生产销售。

### 3、净利润和现金流量的预测

同方微电子未来各年度股权净现金流量预测如下：

单位：万元

项目/年度	2010年11-12月	2011年	2012年	2013年	2014年	永续年度
净利润	1,006.13	7,246.57	9,009.69	10,715.19	12,081.80	12,081.80
净现金流量	2,027.75	13,437.99	8,373.57	9,659.53	10,402.75	12,081.80

注：根据审计报告，同方微电子2010年、2011年1-9月份实际实现净利润分别为1,012.87万元、7,052.43万元。

### 4、折现率的确定

本次评估采用资本资产定价模型（CAPM）来确定净现金流量的折现率。

#### （1）无风险报酬率 $R_f$ 的确定

本次估值采用9只长期国债于2010年10月26日的到期收益率平均值3.94%作为无风险报酬率。

#### （2）市场风险溢价 $R_m - R_f$ 的确定

由于目前国内A股市场是一个新兴而且相对封闭的市场，一方面，历史数据较短，并且在市场建立的前几年中投机气氛较浓，投资者结构、投资理念在不断的发生变化，市场波动幅度很大；另一方面，目前国内对资本项目下的外汇流动仍实行较严格的管制，再加上国内市场股权割裂的特有属性（存在非流通股），因此，直接通过历史数据得出的股权风险溢价包含有较多的异常因素，不具有可信度，整体的市场风险溢价水平较难确定。在本次评估中，评估机构采用美国金融学家AswathDamodaran所统计的各国家市场风险溢价水平作为参考。根据AswathDamodaran的统计结果，市场风险溢价水平为6.45%。

#### （3）企业风险系数 $\beta$

本次评估根据沪、深A股电子元器件类上市公司的Beta计算出各公司无财务杠杆的Beta，然后得出电子元器件行业类上市公司无财务杠杆的平均Beta为

0.8545。

企业风险系数 Beta 根据企业的预测年度每年资本结构 D/E 进行计算，计算公式如下：

$$\beta_L = [1 + (1 - T) \times D/E] \times \beta_U$$

式中  $\beta_L$ ：有财务杠杆的 Beta；

$\beta_U$ ：无财务杠杆的 Beta，取同类上市公司平均数 0.8545

T：所得税率取 15%；

企业 D/E：由于企业以前年度未发生借款及贷款，且考虑到管理层对公司未来战略目标部署情况，取 D/E=0.00%；

根据上述公式，企业风险系数 Beta 为 0.8545。

(4) 企业特定风险调整系数 d 的确定：

综合考虑同方微电子的风险因素，设定同方微电子特定风险调整系数为 1.00%。

综上，本次评估净现金流量的折现率为 10.45%。

(5) 折现率取值的合理性

①交易标的所属行业基本情况

交易标的所属行业是证监会行业分类中的“电子元器件制造业”。电子元器件处于电子信息产业链上游，是通信、计算机及网络、数字音视频等系统和终端产品发展的基础，对电子信息产业的发展起着至关重要的作用。

信息技术是当今世界经济和社会发展的重要驱动力，以网络通信、计算机、集成电路和软件为代表的信息技术的发展改变了人类的生产、生活和思维方式，极大地促进了人类社会由工业化社会向信息化社会的转变。近年来中国电子工业持续高速增长，带动电子元器件产业强劲发展。我国的电子元器件行业目前国内电子制造业中已居第二位，仅次于电子计算机制造业。我国许多门类的电子元器件的产量已稳居全球第一位，在国际市场上占据很重要的地位。我国已经成为扬声器、铝电解电容器、显像管、印制电路板、半导体分立器件等电子元器件的

世界生产基地。

国家出台多项政策支持电子元器件行业的发展。2009年4月，国务院正式出台《电子信息产业调整和振兴规划》，电子元器件被列入规划九大重点振兴领域。根据我国《中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”是我国十六个科技重大专项之一。2011年1月，国务院制定了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，增加了国家对集成电路企业投融资等方面支持，并增加对于集成电路相关企业给予企业所得税优惠的政策。

根据 WSTS 公布的数据，2010 年前三季度世界电子元器件行业销售额累计为 2,240.22 亿美元，同比增长 40.87%。根据 WIND 数据，2010 年前三季度，我国电子元器件行业上市公司实现营业收入 778.6 亿元，同比增长 40.6%。在中国拥有庞大人口和地域支撑的新兴市场上，随着国家家电下乡和以旧换新政策、3G 建设计划及手机换代等需求的持续作用，我国电子元器件市场将保持持续高速发展。

## ②折现率的取值充分考虑了行业的特征和风险、收益情况

折现率是投资者在投资风险一定的情况下，对投资所期望的回报率，为一种期望投资报酬率。

期望的回报率=无风险报酬率+风险报酬率

无风险报酬率是一个相对固定的取值。风险报酬率由行业风险报酬率和企业特定风险报酬率组成，而行业风险报酬率的取值又决定于行业 Beta 和市场风险溢价。因此，对于交易标的的行业特性、风险及收益情况都在行业 Beta 和市场风险溢价集中体现。

行业 Beta 为衡量行业系统风险的指标。Beta 系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。评估机构收集了沪、深 A 股电子元器件行业所有上市公司的股票交易价格数据和分红、配股及送股方面的资料，得出电子元器件行业类上市公司无财务杠杆的平均 Beta 为 0.8545。

$R_m - R_f$  为市场风险溢价。市场风险溢价反映的是投资者因投资于风险相对

较高的资本市场与投资于风险相对较低（或无风险）的债券市场相比所得到的风险补偿。它的取值为市场在一段时间内的平均收益水平和无风险报酬率之差额。

由于目前国内 A 股市场是一个新兴而且相对封闭的市场，一方面，历史数据较短，并且在市场建立的前几年中投机气氛较浓，投资者结构、投资理念在不断的发生变化，市场波动幅度很大；另一方面，目前国内对资本项目下的外汇流动仍实行较严格的管制，因此，直接通过历史数据得出的股权风险溢价包含有较多的异常因素，不具有可信度，整体的市场风险溢价水平较难确定。在本次评估中，评估机构采用美国金融学家 AswathDamodaran 所统计的各国家市场风险溢价水平作为参考，市场风险溢价包括两方面，即成熟的金融市场风险溢价（采用美国股票市场的历史风险溢价水平）加上由于国别的不同所产生的国家风险溢价。国家的风险溢价的确定是依据美国的权威金融分析公司 Moody'sInvestorsService 所统计的国家金融等级排名和此排名的波动程度来综合考虑一个国家的金融风险水平。根据 AswathDamodaran 的统计结构，综合的市场风险溢价水平为 6.45%。

综上，在评估过程中，评估机构通过行业 Beta 和市场风险溢价指标，充分考虑了交易标的行业特征、风险和收益情况。

### ③折现率还充分考虑了交易标的自身风险

本次评估采用资本资产定价模型（CAPM）来确定净现金流量的折现率。折现率的计算公式为：

$$R=R_f+\beta*(R_m-R_f)+d$$

评估机构在确定折现率时还充分考虑了交易标的自身特定风险 d。企业特定风险调整系数表示一个公司的非系统风险，是由评估对象特定因素而要求的风险回报，它综合反映企业所处竞争环境分析，包括外部行业因素和内部企业因素，以揭示待估企业所在的行业地位，以及具有的优势和劣势。根据《企业价值评估指导意见》，评估师在确定企业特定风险调整系数时，通常需要结合考虑以下方面：历史经营情况、企业的财务风险、企业经营业务、产品和地区的分布、公司内部管理及控制机制、管理人员的经验和资历等因素。

#### A、同方微电子的历史经营业绩

根据 WIND 数据，电子元器件制造业全部样本平均净资产收益率为 7.26%，销售净利率为 11.95%，销售毛利率为 23.43%，销售期间费用率为 15.09%。同方微电子近三年收益指标数据如下，同方微电子盈利能力要远远好于电子元器件制造业平均水平。

项目	净资产收益率(%)	销售净利率(%)	销售毛利率(%)	销售期间费用率(%)
2008 年	30.47	26.65	39.31	10.82
2009 年	22.56	22.46	38.07	10.04
2010 年	13.57	20.44	31.62	7.06
平均值	22.20	23.18	36.33	9.31
行业水平	7.26	11.95	23.43	15.09

### B、同方微电子的财务风险

同方微电子最近三个年度经营现金充足，未向银行贷款，财务费用均为负，也未占用供货商经销商资金。同时，公司每年年末存在长期、大额的定期存款。根据公司发展规划，大规模投资扩张的财务风险也不存在。因此，公司的财务风险非常低。

指标	2010 年度	2009 年度	2008 年度
短期借款	--	--	--
长期借款	--	--	--
货币资金（元）	484,035,593.81	503,061,584.12	359,478,833.34
财务费用（元）	-4,677,857.10	-4,515,675.38	-3,863,457.52

### C、同方微电子产品的市场地位

公司在细分行业市场中占据较大优势，公司目前的主导产品二代身份证芯片和手机SIM卡芯片都具有较强的竞争力和较高的市场份额。同方微电子是国家第二代居民身份证芯片四家供应商之一，每家供应四分之一，同方微电子占有市场 25% 的市场份额。同方微电子生产的接触卡芯片产品已用于我国三大运营商的手机SIM卡以及有线电视顶盒的条件接收卡，其中手机SIM卡芯片在国内市场占有率逐年增高，已成为国内出货量最大的手机SIM卡芯片供应商。公司在主导产品方面的竞争优势，使得公司已经被国内主要电信运营商和国际主要智能卡商所认可。

与此同时，公司面对安全、无线与数据高速交换的信息社会未来发展趋势，立足于多年积累的集成电路核心技术和市场渠道，积极开发信息安全领域、可信

计算领域、移动支付领域、金融应用、RFID 电子标签领域等新兴市场。随着 USB-key 应用芯片、可信密码模块、大容量 SIM 卡芯片、银行卡芯片、UHF RFID 技术等项目在 2010-2014 年的逐渐商业化生产，公司未来业绩将得到持续增长。

#### D、同方微电子的技术研发实力

同方微电子汲取同方股份有限公司的管理经验，依托清华大学的技术优势，在数字、模拟及数模混合集成电路的设计和产业化方面积累了丰富的丰富经验，先后承担、完成了国家“863”重大科技专项、“核高基”重大专项、工信部电子发展基金、北京市科委、北京市经信委和中关村等多个集成电路项目的产品开发任务，完成了多项智能卡相关产品研发和产业化成果。在智能卡芯片相关技术方面居于国内领先和国际先进水平。公司承担了国家第二代居民身份证专用芯片模块开发和生产供应任务，并获得了北京市科学技术二等奖和国家科技进步一等奖。

#### E、同方微电子内部管理及控制机制

公司拥有一支优秀的集成电路管理团队。公司的管理团队具有平均超过 15 年的集成电路从业经历，在业内有广泛的资源和影响力，完全具有公司经营所需要的开拓与经营管理能力。同时，公司建立健全了各项经营管理制度，实施了科学规范的经营管理。2006 年 1 月，公司顺利通过 ISO9001:2000 质量管理体系认证。2010 年 2 月，公司又顺利通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证。

综上，评估机构综合考虑同方微电子上述风险因素，设定同方微电子特定风险调整系数为 1%。

因此，评估机构在计算折现率时通过行业 Beta 和市场风险溢价指标，充分考虑了交易标的行业特征、风险和收益情况。同时，评估机构还充分考虑交易标的自身风险，10.45%的折现率是非常合理的。

### 5、溢余资产的确定方法和确定过程

《企业价值评估指导意见》中指出，在进行企业价值评估时要对其经营性资产及非经营性资产进行区分。溢余资产是指与企业收益无直接关系的资产，包括非经营性资产、无效资产等。

非经营性资产、负债包括溢余货币资金、交易性金融资产、可供出售金融资

产、持有至到期投资、应收应付股利、未投入生产运营的其他溢余资产等与企业经营无直接关系在未来预测中未考虑的项目。在评估溢余资产价值时一般采用两种方法：一是把溢余资产单列评估，二是将溢余资产合并到非经营性资产中，作为非经营性资产的一个组成部分。在本次评估中，评估机构采用了第二种方法，将溢余资产合并到非经营性资产中。

同方微电子没有其他非经营性资产、负债，本次评估溢余资产主要为溢余货币资金。截至 2010 年 10 月 31 日，同方微电子的货币资金为 45,049.14 万元，主要以前年度生产经营利润的积累。由于货币资金并非全部为生产经营所必需，企业可以通过正常经营获得一定的营运资金。基准日的货币资金余额与日常经营所必需的现金持有量之间的差额为溢余货币资金。

现金持有量依据企业实际经营管理状况、企业现金周转能力以及管理层对风险的态度来预测。经调查，同方微电子保持正常运营需要的正常现金保有量主要包括原材料采购款、职工工资等。如果企业基准日的银行存款余额超过了上述资金需求量的合计值，则说明企业存在溢余资金。根据同方微电子历史经营状况、经营规模、营运资金的周转情况及未来的经营策略，同方微电子的采购周期通常为 73 天，本次评估中将同方微电子一个采购周期的经营活动现金流出作为现金保有量，即使在整个采购周期企业都没有现金流入，该现金保有量也可保障公司日常经营运转，现金保有量计算过程如下：

单位：人民币万元

项目/年限	2008 年	2009 年	2010 年 1-10 月
经营活动现金流出合计	34,243.17	39,233.73	23,932.87
当年平均每日现金流出金额	93.82	107.49	97.10
评估预测现金保有量	7,305.00		

根据上述数据，2008 年、2009 年、2010 年 1-10 月平均每日现金流出金额分别为 93.82 万元、107.49 万元和 97.10 万元。本次评估根据最近二年一期的平均值得出基准日现金保有量 = 报告期内平均每日现金流出金额 \* 平均采购周期  $(93.82+107.49+97.10) / 3 * 73 = 7,305.00$  万元，则基准日溢余资金为  $45,049.14 - 7,305.00 = 37,744.14$  万元。

## 6、预测年度付现次数的确定方法和确定过程

本次评估过程中，评估机构对公司经营情况进行了了解，公司付现成本主要是成本、期间费用等，然后通过公司历史签订合同及通常付款期限分析，其中身份证类产品付现期限为 144 天，移动通信类产品和金融支付类产品付现期限为 60 天，其他成本(期间费用)付现期限为 30 天，评估机构为了更能准确地反映公司现金周转次数，本次评估采用加权平均法来预测平均付现次数。

首先根据公司三类主要产品线的付现期限，以每类产品成本占总成本费用的比例为权数，用加权平均法计算出综合付现期限，然后得出平均付现次数。

在本次评估预测中，身份识别类产品的销量保持相对稳定，金融支付类产品的销量保持高速增长，因此公司整体周转率有所提高，平均付现次数有所增加。预测年度公司付现次数基本维持在 5 次左右。具体如下表：

项目/年限	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
身份证成本所占比例	0.13	0.10	0.08	0.09
其他产品成本所占比例	0.76	0.81	0.84	0.84
其他付现成本所占比例	0.11	0.09	0.08	0.07
综合付现期限(天)	67.62	65.70	64.32	65.46
平均付现次数(次)	5.40	5.56	5.67	5.58

#### (四) 交易标的评估方法合理性分析

本次评估的目的是为同方微电子整体股权收购提供价值参考。收益法是指将被评估企业的预期未来收益依一定折现率资本化或折成现值以确定其价值的评估方法。该评估方法以决定企业内在价值的根本依据--未来盈利能力为基础评价企业价值，反映了企业对于所有者具有价值的本质方面。而且，收益法考虑企业是一个有机的结合体，企业除单项资产能够产生价值以外，其专有技术等可确指无形资产以及合理的资源配置、优良的管理、经验、经营、市场份额、客户等综合因素形成的不可确指无形资产均是企业价值的重要组成部分。

同方微电子作为高新技术企业，采用收益法对股东权益价值进行评估综合考虑了同方微电子在行业中的地位、其所拥有的各种技术积累、无形资产的价值以及技术人员队伍、管理等因素的价值。具体如下：

(1) 技术积累：同方微电子自成立以来，一直潜心于技术开发，自主开发了通用微处理器、各种专用/通用加密算法加速引擎等核心电路，并达到了国际先进水平，积累了丰富的数字、模拟及数模混合集成电路的设计经验，曾获得国

家科学技术进步一等奖。

(2) 行业地位：同方微电子目前是国内最大的SIM卡芯片供应商，通过了全球前五大智能卡商的资格审核，并形成了良好的合作关系。同时，同方微电子还承担了国家第二代居民身份证专用芯片及供货任务，是其四家供货商之一。

(3) 营销网络：同方微电子通过SIM卡市场积累了深厚的客户资源，并开始走向海外市场，成为包括法国金雅拓公司、德国捷德公司在内的全球前五大智能卡商的供应商。由于客户的同类性，这为同方微电子开拓RFID 芯片、读卡机具产品等其他应用奠定了很好的客户基础。

本次交易的评估机构中发评估认为：同方微电子属于高新技术企业，在各类芯片技术领域取得众多无形资产，由于无形资产的特有性，用市场法很难体现出同方微电子无形资产价值；根据高新技术企业特点，一般都是前期投入大，后期发挥效益，同方微电子已经发展到收益阶段，因此收益法的更能体现企业基准日的公允价值；市场法样本取自于证券市场，因中国证券市场不成熟，波动较大，受政策、资金等因素影响较大，估值结果有一定偏差。因此，本次评估最终采用了收益法评估结果作为本次交易标的的最终评估结论。

鉴于中发评估出具的以 2010 年 10 月 31 日为评估基准日《资产评估报告》已过有效期。公司聘请中发评估出具了以 2010 年 12 月 31 日为评估基准日的《资产评估报告》（中发评报字【2011】第 103 号），并经教育部备案。在评估基准日 2010 年 12 月 31 日，同方微电子净资产账面价值为 51,846.14 万元；采用市场法确定的股东全部权益评估价值为区间值 146,594.49 万元~158,810.70 万元，比股东权益账面价值增值 94,748.35 万元~106,964.56 万元，增值率为 182.75% ~ 206.31%；采用收益法确定的股东全部权益评估价值为 151,071.75 万元，增值额为 99,225.61 万元，增值率为 191.38%。本次交易标的的评估价值最终仍以收益法的评估结果作为评估结论。

鉴于中发评估出具的以 2010 年 12 月 31 日为《资产评估报告》（中发评报字【2011】第 103 号）已过有效期。公司聘请中发评估出具了以 2011 年 9 月 30 日为评估基准日的《资产评估报告》（中发评报字【2011】第 138 号），并经教育部备案。在评估基准日 2011 年 9 月 30 日，同方微电子净资产账面价值为 58,898.58

万元；采用市场法确定的股东全部权益评估价值为区间值 170,634.80 万元~184,854.36 万元，比股东权益账面价值增值 111,736.22 万元~125,955.79 万元，增值率为 189.71%~ 213.85%；采用收益法确定的股东全部权益评估价值为 153,412.31 万元，增值额为 94,513.73 万元，增值率为 160.47%。本次交易标的的评估价值最终仍以收益法的评估结果作为评估结论。

经交易双方协商一致，本次交易标的资产的交易价格维持公司第四届董事会第四次会议确定的交易价格不变，仍为 149,134.01 万元。

#### **四、债权债务转移情况**

本次交易为晶源电子非公开发行股份购买交易对方持有的同方微电子 100% 的股权，不涉及债权债务的转移。

#### **五、重大会计政策或会计估计差异情况**

同方微电子与上市公司晶源电子会计政策和会计估计无重大差异。

## 第五节 本次股份发行情况

### 一、本次发行股份购买资产的具体方案

#### （一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

#### （二）发行方式

采取非公开发行方式，在中国证监会核准后6个月内向特定对象发行股票。

#### （三）发行对象及认购方式

发行对象：同方股份、清晶微科技、自然人赵维健、葛元庆、吴行军、段立、孟红霞、宋翌、丁义民、李刚。

认购方式：同方股份、清晶微科技、其它八名自然人股东以其各自持有的同方微电子的股权认购本次晶源电子拟发行的股份。

#### （四）发行价格

按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条规定，上市公司发行股份的价格为本次非公开发行股份购买资产的首次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，即14.07元/股。最终发行价格尚需经本公司股东大会批准。

定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。

#### （五）发行数量

交易各方以经中发评估出具的交易标的评估报告中的评估结果为基础，经协商确定，标的资产作价为149,134.01万元，按照每股价格14.07元，公司向交易对方共发行10,599.43万股股份作为支付对价，占发行后总股本的43.98%。最终以中国证监会核准的发行数量为准。

#### （六）发行股份的禁售期

同方股份、清晶微科技、其它八名自然人股东以资产认购的股份，自本次非

公开发行结束之日起 36 个月内不上市交易，36 个月之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

### （七）上市地点

在禁售期满后，本次非公开发行的股份在深圳证券交易所上市交易。

### （八）本次发行决议有效期限

与本次发行股票议案有关的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### （九）本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案

本次向特定对象非公开发行股份完成后，公司本次非公开发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股权比例共享。

### （十）基准日至交割日期间的损益安排

自评估基准日 2010 年 10 月 31 日至交割日期间，如交易标的产生的利润为正数，则该利润所形成的权益归晶源电子享有；如产生的利润为负数，则由本次交易对方按照其在同方微电子的持股比例以现金全额补偿予晶源电子。

## 二、本次交易对上市公司的影响

### （一）发行前后股权结构变化

公司目前的总股本为 13,500.00 万股，同方股份持有本公司股份 3,375.00 万股，占交易前公司总股本比例为 25%，为本公司控股股东。本次交易中公司将向交易对方发行股份 10,599.43 万股作为支付对价收购其持有的同方微电子 100% 股权。本次交易完成后，本公司的总股本为 24,099.43 万股，同方股份持有本公司股份 12,490.51 万股，占公司总股本比例为 51.83%，仍为公司的控股股东。本次发行不会导致公司控制权变化。

本次发行前后的股权结构如下：

项 目	本次交易前		本次交易后	
	持股数（万股）	持股比例	持股数（万股）	持股比例
1、限售流通股	4,544.23	33.66%	15,143.66	62.84%

其中：同方股份	3,375.00	25.00%	12,490.51	51.83%
本次交易其他交易对方	-	-	1,483.92	6.16%
其它限售流通股	1,169.23	8.66%	1,169.23	4.85%
<b>2、无限售流通股</b>	<b>8,955.77</b>	<b>66.34%</b>	<b>8,955.77</b>	<b>37.16%</b>
<b>总股本</b>	<b>13,500.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>24,099.43</b>	<b>100.00%</b>

## (二) 发行前后财务指标变化

根据本公司截至 2011 年 9 月 30 日经审计的财务报告及备考合并财务报告，  
本公司本次交易前后的主要财务数据和其他重要财务指标如下：

### 1、资产负债表数据及财务指标

单位：万元

2011 年 9 月 30 日	交易完成后		交易前		交易前后比较	
	金额	比例	金额	比例	增长额	增长幅度
流动资产	102,323.05	75.96%	23,626.23	45.90%	78,696.82	333.09%
非流动资产	32,391.40	24.04%	27,844.82	54.10%	4,546.58	16.33%
总资产	134,714.45	100.00%	51,471.05	100.00%	83,243.40	161.73%
流动负债	24,563.60	82.36%	4,180.77	76.28%	20,382.83	487.54%
非流动负债	5,262.31	17.64%	1,300.31	23.72%	3,962.00	304.70%
总负债	29,825.90	100.00%	5,481.08	100.00%	24,344.82	444.16%
所有者权益合计	104,888.54		45,989.97		58,898.57	128.07%
归属于母公司的所有者权益	103,494.98		44,596.41		58,898.57	132.07%
股本总额(万股)	24,099.43		13,500.00		78.51%	
每股净资产(元/股)	4.29		3.30		30.00%	
资产负债率	22.14%		10.65%		107.91%	
流动比率(倍)	4.17		5.65		-26.29%	
速动比率(倍)	3.64		4.06		-10.40%	

### 2、利润表数据及盈利指标

#### ①利润表数据

单位：万元

2009 年度	交易完成后	交易完成前	交易前后比较	
			增长额	增长幅度
营业收入	73,896.35	28,890.67	45,005.68	155.78%
营业成本	49,936.30	22,062.74	27,873.56	126.34%
营业利润	16,180.42	3,895.37	12,285.05	315.38%
净利润	13,614.52	3,505.62	10,108.90	288.36%
归属母公司的净利润	13,518.24	3,409.34	10,108.90	296.51%
2010 年度	交易完成后	交易完成前	交易前后比较	
			增长额	增长幅度
营业收入	69,297.94	34,869.38	34,428.56	98.74%
营业成本	49,311.00	25,900.88	23,410.11	90.38%
营业利润	13,018.94	4,751.46	8,267.48	174.00%
净利润	10,943.57	3,907.60	7,035.96	180.06%
归属母公司的净利润	10,796.41	3,760.45	7,035.96	187.10%
2011 年 1-9 月	交易完成后	交易完成前	交易前后比较	
			增长额	增长幅度
营业收入	48,605.25	21,801.29	26,803.96	122.95%
营业成本	33,343.61	16,710.28	16,633.33	99.54%
营业利润	11,428.56	3,153.08	8,275.48	262.46%
净利润	9,822.30	2,769.87	7,052.43	254.61%
归属母公司的净利润	9,759.61	2,707.18	7,052.43	260.51%

## ②盈利指标

2009 年度	交易完成后	交易完成前	增长幅度
销售毛利率	32.42%	23.63%	37.19%
销售净利率	18.42%	12.13%	51.83%
加权平均净资产收益率	16.94%	8.52%	98.91%
基本每股收益	0.561	0.253	122.11%
期间费用率	9.69%	9.14%	5.99%

2010 年度	交易完成后	交易完成前	增长幅度
销售毛利率	28.84%	25.72%	12.14%
销售净利率	15.79%	11.21%	40.92%
加权平均净资产收益率	11.95%	8.96%	33.48%
基本每股收益	0.448	0.279	60.80%
期间费用率	8.71%	9.96%	-12.54%
2011 年 1-9 月	交易完成后	交易完成前	增长幅度
销售毛利率	31.40%	23.35%	34.46%
销售净利率	20.21%	12.71%	59.06%
加权平均净资产收益率	9.75%	6.05%	61.09%
基本每股收益	0.40	0.20	101.95%
期间费用率	7.59%	9.20%	-17.49

注：交易完成后每股收益按照发行后总股本 24,099.43 万股计算。

### 三、本次交易对同方股份的影响

本次交易完成后，同方股份对晶源电子的持股比例将由 25.00% 增加至 51.83%，从而实现了同方股份对晶源电子的绝对控股地位。同时，同方微电子由同方股份的控股子公司变成孙公司。

根据经兴华事务所审计的晶源电子、同方微电子的财务报告以及经审计的同方股份的财务报告，本次交易完成前后，同方股份的财务状况及盈利水平如下：

单位：万元

项目	2010 年末/2010 年度	
	重组完成前	重组完成后
总资产	2,486,463.82	2,486,463.82
总负债	1,426,686.29	1,426,686.29
所有者权益	1,059,777.54	1,059,777.54
归属于母公司股东权益	798,669.87	792,590.46
营业收入	1,825,750.94	1,825,750.94
营业利润	63,148.10	63,148.10
净利润	59,973.78	59,973.78
归属于母公司的净利润	47,955.55	46,560.19
项目	2011 年 9 月末/2011 年 1-9 月	

	重组完成前	重组完成后
总资产	2,381,486.87	2,381,486.87
总负债	1,467,631.07	1,467,631.07
所有者权益	913,855.80	913,855.80
归属于母公司股东权益	809,369.52	801,208.13
营业收入	1,381,619.83	1,381,619.83
营业利润	27,662.93	27,662.93
净利润	33,881.43	33,881.43
归属于母公司的净利润	23,150.48	21,466.90

注：本次重组中同方股份无需编制备考财务报告，因此重组完成后数据以重组前同方股份经审计的财务数据为基础，结合经兴华事务所审计的同方微电子、晶源电子财务报告得出。由于同方股份、晶源电子、同方微电子的关联交易较小，因此上表中重组完成后的数据仅根据重组后股权比例变动计算得出，忽略合并报表过程中少量的抵销。

本次重组之前，同方股份为晶源电子和同方微电子的控股股东，已将两家公司纳入合并报表范围，本次重组完成后，同方股份的合并范围没有发生变化。因此，合并财务报告中总资产、总负债、所有者权益、营业收入、营业利润、净利润等报表项目没有发生变化。重组完成后，由于同方股份对晶源电子的持股比例以及对同方微电子的间接持股比例发生变化，使同方股份归属于母公司股东权益和归属于母公司股东的净利润发生变化。如上表所示，重组完成后 2010 年度同方股份归属于母公司股东权益和归属于母公司股东的净利润分别由 798,669.87 万元、47,955.55 万元变为 792,590.46 万元、46,560.19 万元，2011 年 1-9 月份同方股份归属于母公司股东权益和归属于母公司股东的净利润分别由 809,369.52 万元、23,150.48 万元变为 801,208.13 万元、21,466.90 万元，影响较小。

上表中重组后同方股份财务状况和盈利水平的变化，仅为重组前各公司的财务数据按照重组后的股权比例的计算后得出的结果。本次交易完成后，同方股份通过产业整合，结合同方微电子和晶源电子的各自的优势，拓展核心和高端电子器件相关业务，向信息产业的上游进一步延伸公司的产业链。同方微电子在集成电路设计方面的核心技术优势和相关经验，可以配合晶源电子开发石英晶体振荡器专用集成电路等高端精密电子元器件产品，晶源电子主要产品将由普通低档晶体元器件逐渐发展为高档晶体元器件和高附加值的集成电路芯片。通过本次交易，同方股份、晶源电子的整体抵御风险的能力和盈利能力都将得到加强，有利于实现两个上市公司价值最大化，提高上市公司全体股东利益。

## 第六节 本次交易合同的主要内容

2010年11月6日，本公司与交易对方签署了《非公开发行股票购买资产协议》、《利润补偿协议》，2011年1月6日，本公司与交易对方签署了《非公开发行股票购买资产补充协议》、《利润补偿补充协议》。

### 一、《非公开发行股票购买资产协议》及《非公开发行股票购买资产之补充协议》的主要内容

#### （一）交易价格及定价依据

本公司拟向交易对方购买的资产为同方微电子100%股权。根据具有证券业务资格的资产评估机构中发评估出具的《资产评估报告》（中发评报字【2010】第083号），截至评估基准日2010年10月31日，同方微电子净资产账面价值为50,833.27万元；市场法评估后的净资产评估价值为区间值144,167.48万元~156,181.15万元，收益法评估后的净资产评估价值为149,134.01万元。最终以收益法的评估结果作为评估结论。经交易双方协商，标的资产作价为149,134.01万元。

截至2011年10月31日，《资产评估报告》（中发评报字【2010】第083号）已过有效期。公司聘请中发评估出具了以2010年12月31日为评估基准日的《资产评估报告》（中发评报字【2011】第103号），并经教育部备案。在评估基准日2010年12月31日，同方微电子净资产账面价值为51,846.14万元；采用市场法确定的股东全部权益评估价值为区间值146,594.49万元~158,810.70万元，比股东权益账面价值增值94,748.35万元~106,964.56万元，增值率为182.75%~206.31%；采用收益法确定的股东全部权益评估价值为151,071.75万元，增值额为99,225.61万元，增值率为191.38%。本次交易标的的评估价值最终仍以收益法的评估结果作为评估结论。

截至2011年12月31日，《资产评估报告》（中发评报字【2011】第103号）已过有效期。公司聘请中发评估出具了以2011年9月30日为评估基准日的《资产评估报告》（中发评报字【2011】第138号），并经教育部备案。在评估基准日

2011年9月30日，同方微电子净资产账面价值为58,898.58万元；采用市场法确定的股东全部权益评估价值为区间值170,634.80万元~184,854.36万元，比股东权益账面价值增值111,736.22万元~125,955.79万元，增值率为189.71%~213.85%；采用收益法确定的股东全部权益评估价值为153,412.31万元，增值额为94,513.73万元，增值率为160.47%。本次交易标的的评估价值最终仍以收益法的评估结果作为评估结论。

经交易双方协商一致，本次交易标的资产的交易价格维持公司第四届董事会第四次会议确定的交易价格不变，仍为149,134.01万元。即公司拟向交易对方购买的标的资产的价格仍为149,134.01万元，相应的本公司向交易对方发行新增股份数量也保持不变（最终以中国证监会核准的发行数量为准）。

## （二）支付方式

本公司以审议本次交易的首次董事会决议公告日前20个交易日晶源电子股票交易均价（决议公告日前20个交易日公司股票交易总额除以决议公告日前20个交易日公司股票交易总量），即14.07元/股，向交易对方发行10,599.43万股股份，以换取交易对方持有的同方微电子100%的股权。

## （三）资产交付及过户时间安排

交易各方应在协议生效之日起十二个月内办理完毕全部标的资产的过户、移交手续（包括但不限于公司股东名册变更、工商登记变更）。

本次资产交割涉及的交易对方取得的本公司股份，由晶源电子协助交易对方依照有关法律规定和登记规范在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续。

## （四）交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属

自评估基准日2010年10月31日至资产交割日期间，如交易标的所产生的利润为正数，则该利润所形成的权益归本公司享有；如产生的利润为负数，则由本次交易对方按照其同方微电子的持股比例以现金全额补偿予本公司。

## （五）协议生效条件

协议自双方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自公章之日起成立，自下述条件全部满足之日起生效：

- 1、晶源电子依据适用法律的相关规定以及其章程规定履行完为签署本协议而需履行的内部决策批准程序；
- 2、交易对方依据适用法律的相关规定以及其章程规定履行完为签署本协议而需履行的内部决策批准程序；
- 3、国有资产相关主管部门对本次交易事项的核准；
- 4、中国证监会对本次交易事项的核准；
- 5、同方股份及其一致行动人因认购本次晶源电子非公开发行股份而触发之要约收购义务获得中国证监会豁免。

## （六）违约责任

本协议任何一方不履行协议的义务或者履行协议义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。各方都违反协议的，应当各自承担相应的责任。因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。一方与第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

## 二、《利润补偿协议》的主要内容

根据公司与同方股份、清晶微科技、其它八名自然人股东签署的《利润补偿协议》及《利润补偿补充协议》，同方股份、清晶微科技、其它八名自然人股东承诺：如果本次交易于 2011 年度实施完毕（本次交易实施完毕以本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限公司办理完成证券登记手续为准），2011 年、2012 年、2013 年同方微电子实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于人民币 7,246.57 万元、9,009.69 万元和 10,715.19 万元。若同方微电子 2011 年、2012 年、2013 年实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润低于上述利润预测值，则由同方股份、清晶微科技、其它八名自然人股东负责向公司进行补偿，具体补偿方式为：

同方股份、清晶微科技、其它八名自然人股东在 2011 年、2012 年、2013 年公司年度审计报告出具后 30 个工作日内按照下述公式计算应回购股份数并协助公司通知证券登记结算机构，将应回购股份转移至公司董事会设立的专门账户，进行单独锁定。交易对方自应回购股份转移至公司董事会设立的专门账户后，不再拥有回购股份的表决权且不享有股利分配的权利，该部分被锁定的股份应分配的利润归公司所有。同方股份、清晶微科技、其它八名自然人股东按照其各自在本次交易前持有同方微电子的股权比例分别计算该部分补偿股份。回购股份数计算公式为：

回购股份数量=（截至当期期末对应标的资产累积预测净利润数—截至当期期末对应标的资产累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的对应标的资产预测净利润数总和—已补偿股份数量

如果利润补偿期内公司以转增或送股方式进行分配而导致交易对方持有的公司股份数发生变化，则回购股份的数量应调整为：按上款公式计算的回购股份数×（1+转增或送股比例）。

在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。

在补偿期限届满时，晶源电子将对标的资产进行减值测试，如期末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则交易对方将另行补偿股份。另需补偿的股份数量为：期末减值额/每股发行价格—补偿期限内已补偿股份总数。

公司将在利润补偿期限届满且确定最后一个会计年度应回购股份数量并完成锁定手续后，在两个月内就全部应回购股份的股票回购事宜召开股东大会。若股东大会通过定向回购议案，公司将以总价人民币 1.00 元的价格定向回购上述专户中存放的全部股份，并予以注销；若股东大会未通过上述定向回购议案，则公司应在股东大会决议公告后 10 个交易日内书面通知交易对方，交易对方将在接到通知后的 30 日内将上述存放于公司董事会设立的专门账户中的全部已锁定股份赠送给公司董事会确定的股权登记日在册的除交易对方以外的其他股东，其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除交易对方持有的股份数后公司的股

本数量的比例享有获赠股份。

### 三、交易标的其他股东放弃优先购买权的主要内容

本次交易标的资产为同方微电子 100%股权。2010 年 11 月 22 日，同方微电子召开股东会，同方股份、清晶微科技、赵维健、葛元庆、吴行军、段立、孟红霞、宋翌、丁义民、李刚同意将各自持有的同方微电子股权（合计 100%股权）转让于晶源电子，其他股东放弃优先购买权。

## 第七节 本次交易的合规性分析

本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》以及《上市规则》等法律法规。现就本次交易符合《重组办法》第十条和第四十一条规定的情况具体说明如下：

### 一、本次交易符合《重组办法》第十条的规定

#### （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定

##### 1、本次交易符合国家产业政策

近些年来我国电子和信息技术产业的整体水平得到了很大的提高，但与发达国家相比还有较大差距，特别是高端通用芯片、基础软件和核心电子器件的研发能力和产业化水平与世界发达国家相比差距更大，还不能满足电子信息产业高速发展的需求。

2006年2月，国务院出台了《中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，纲要确定了包括“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”在内的国家十六个科技重大专项。2006年3月，国务院制订的《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出，电子信息产品制造业是我国增强高技术产业核心竞争力的关键，“十一五”期间，必须大力发展集成电路、软件和新型元器件等基础性核心产业。2009年4月，国务院发布的《电子信息产业调整和振兴规划》明确将片式元器件、高频频率器件列入加快电子元器件产品升级，提升研发生产能力的范围。

因此，晶源电子和同方微电子的主营业务及主要产品符合国家的产业政策，属国家产业发展规划重点产品，得到国家产业政策的支持。本次重大资产重组完成后，将进一步提高公司产品的自主知识产权和技术附加值，增强公司的核心竞争力和持续发展能力，符合国家的产业政策。

##### 2、本次交易符合有关环境保护的法律和行政法规的规定

同方微电子的核心业务为集成电路设计，公司对外销售的产品均通过委托代

工方式生产，基本上不存在安全生产和环境污染隐患。最近三年公司未发生重大安全、环境污染事故，符合国家关于安全生产和环境保护的要求。

本次交易符合有关环境保护的法律和行政法规的规定。

### **3、本次交易符合有关土地的法律和行政法规的规定**

同方微电子对外销售的产品均通过委托代工方式生产，公司自身无需生产场所，公司的办公场所均为租赁方式取得。最近三年内，公司不存在违反我国土地管理法律法规的行为。

本次交易符合国家关于土地方面有关法律和行政法规的规定。

### **4、本次交易不存在违反有关反垄断法律和行政法规的规定**

本次交易完成后，公司从事的各项生产经营业务不构成垄断行为，本次资产重组不存在违反《中华人民共和国反垄断法》和其他反垄断行政法规的相关规定的情形。

本次交易法律顾问中咨律师认为：本次发行符合国家相关产业政策，符合环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的相关规定，不存在违反环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规规定的情形。

## **(二) 本次交易完成后，本公司仍具备股票上市条件**

### **1、符合上市公司股本总额要求**

本次发行完成后，公司的股本总额将增至 24,099.43 万元，符合《上市规则》所规定的“公司股本总额不少于人民币 5,000 万元”的要求。

### **2、符合上市公司股权分布要求**

本次交易完成后，社会公众股持股比例超过 25%，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》所规定的上市条件。

## **(三) 本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形**

### **1、发行股份的定价情况**

本次发行股份的定价按照《重组办法》的有关规定，遵循市场化原则，以本公司关于本次交易的首次董事会（第四届董事会第二次会议）决议公告日为定价基准日；以该定价基准日前 20 个交易日公司股票均价，即 14.07 元/股，作为本次发行股份的发行价格。

## 2、标的资产的定价情况

截至 2010 年 10 月 31 日，根据具有证券业务资格的中发评估出具并经教育部备案的《资产评估报告书》（中发评报字【2010】第 083 号）。同方微电子净资产账面价值为 50,833.27 万元，按照收益法评估净资产为 149,134.01 万元，增值率为 193.38%；按照市场法评估净资产为区间值 144,167.48 万元~156,181.15 万元，增值率为 183.61%~207.24%。

截至 2010 年 12 月 31 日，根据具有证券业务资格的中发评估出具并经教育部备案的《资产评估报告书》（中发评报字【2011】第 103 号）。同方微电子净资产账面价值为 51,846.14 万元，按照收益法评估净资产为 151,071.75 万元，增值率 191.38%；按照市场法评估净资产为区间值 146,594.49 万元~158,810.70 万元，增值率为 182.75%~206.31%。

截至 2011 年 9 月 30 日，根据具有证券业务资格的中发评估出具并经教育部备案的《资产评估报告书》（中发评报字【2011】第 138 号）。同方微电子净资产账面价值为 58,898.58 万元，按照收益法评估净资产为 153,412.31 万元，增值率 160.47%；按照市场法评估净资产为区间值 170,634.80 万元~184,854.36 万元，增值率为 189.71%~213.85%。

经交易双方协商一致，本次交易标的资产的交易价格维持不变，以 2010 年 10 月 31 日收益法评估结果 149,134.01 万元为作价依据。

中发评估及其项目经办人员与交易标的、交易对象及本公司均没有现实和预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，其出具的评估报告符合客观、公正、独立、科学的原则。本次交易价格以评估确认的同方微电子 100%股权对应的比例确定，定价合法、公允，没有损害公司及非关联股东利益。

## 3、本次交易程序合法合规

本次交易已经公司及中介机构充分论证，相关中介机构已针对本次交易出具

审计、评估、法律、财务顾问等专业报告，并按程序报有关监管部门审批。本次交易中涉及到关联交易的处理，依据《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等规定遵循公开、公平、公正的原则并履行合法程序，关联董事在董事会上回避表决，也将提请关联股东在股东大会上回避表决，不存在损害公司及其股东利益的情形。

#### 4、独立董事意见

公司独立董事对本次重大资产重组发表了独立董事意见，认为：

(1) 公司聘请的评估机构具有证券从业资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估机构具有充分的独立性。

(2) 公司本次非公开发行股份购买资产暨关联交易涉及评估报告的评估假设前提能按照国家有关法规与规定进行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；评估目的与评估方法相关，评估方法合理。

(3) 公司本次交易标的资产的最终交易价格以评估机构出具评估报告的评估值为参考依据，并经公司与交易对方协商确定，交易价格合理、公允，不会损害中小投资者利益。

因此，本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

#### **(四) 本次交易涉及的资产产权清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法**

本次交易标的为同方股份、清晶微科技、赵维健、葛元庆、吴行军、段立、孟红霞、宋翌、丁义民、李刚合法拥有的同方微电子 100% 的股权。根据交易对方出具的承诺和工商登记备案资料，截至本报告书出具之日，同方微电子为合法设立、有效存续的有限责任公司。交易对方所拥有的同方微电子 100% 的股权权属清晰、完整，不存在质押、权利担保或其它受限制的情形。

因此，本次交易涉及的资产产权清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，

本次交易完成后，同方微电子的原债权债务仍由同方微电子承继，不涉及债权、债务转让或变更。

### **（五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形**

同方微电子是国家认定的高新技术企业和集成电路设计企业，主要从事智能卡、RFID 电子标签和信息安全等核心芯片的设计开发与销售。2005 年，同方微电子成为信息产业部认定的“第一批集成电路设计企业”，连续五年入围中国半导体行业协会评选的“年度中国十大集成电路设计企业”，曾获得“国家科学技术进步一等奖”、“北京奥运会与残奥会证件门票制作、防伪和查验技术选型项目入选企业”，掌握了集成电路设计的核心技术。

本次交易完成后，公司可利用同方微电子在智能卡芯片和集成电路设计等方面的先进技术，结合公司自身在晶体元器件方面的研发实力和技术资源，加快研发高端精密电子器件产品和专用设备、仪器及应用系统，以提升公司现有高端产品的市场竞争力，进一步提高公司产品的自主知识产权和技术附加值，增强公司的核心竞争力和持续发展能力。

本次交易完成后，公司的生产经营符合相关法律法规的规定，不存在因违反法律、法规和规范性文件而导致公司无法持续经营的情形，也不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

### **（六）本次交易符合证监会关于上市公司独立性的相关规定**

本次交易前，公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均已独立于控股股东及实际控制人控制的其他企业，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

本次交易后，公司将持有同方微电子 100%的股权，同方微电子与本公司的关系由“同受控股股东控制”变为“全资子公司”，该变化不会导致公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性发生重大变化，同时，控股股东同方股份将按照法律、法规及公司章程等规范性文件的要求，保持晶源电子在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

控股股东同方股份及间接控股股东清华控股出具了承诺：保证在本次重组完成后，将按照中国证券监督管理委员会规范性文件的要求，做到与晶源电子在人员、财务、资产、业务和机构方面完全分开，切实保障上市公司在人员、财务、资产、业务和机构方面的独立运作。

因此，本次交易符合证监会关于上市公司独立性的相关规定。

## （七）本次交易有利于上市公司形成健全有效的法人治理结构

公司建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并逐步按上市公司治理标准规范法人治理结构。本次交易完成后，公司将完善相关管理制度，进一步强化法人治理结构，因此本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构。

## 二、本次交易符合《重组办法》第四十二条要求的说明

### （一）本次发行股份购买资产有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力

本次交易拟购买的同方微电子是国家认定的高新技术企业和集成电路设计企业，主要从事智能卡、RFID 电子标签和信息安全等核心芯片的设计开发与销售。同方微电子生产的手机 SIM 卡产品在全球具有良好的品牌知名度，通过了包括法国金雅拓公司、德国捷德公司在内的全球前五大智能卡商的资格审核，成为这些卡商的合格供应商。目前其生产的该产品已用于我国三大运营商的手机 SIM 卡以及有线电视机顶盒的条件接收卡，其中手机 SIM 卡芯片在国内市场占有率逐年增高，已成为国内出货量最大的手机 SIM 卡芯片供应商。同方微电子还是国家第二代居民身份证芯片四家供应商之一。与此同时，公司通过积极开发接触式 CPU 卡产品、RFID 芯片及读卡机具产品等新兴市场，以保持公司未来业绩的持续增长。

根据兴华事务所出具的标的资产《审计报告》及《盈利预测审核报告》，同方微电子 2009 年度实现净利润 10,108.90 万元，2010 年度实现净利润 7,035.96 万元。2011 年预计可产生净利润 7,246.89 万元。本次重组完成后，晶源电子 2010 年全年实现净利润 10,943.57 万元，2011 年全年实现净利润约 10,034.54 万元。按照发行完成后 24,099.43 万股计算，2010 年、2011 年晶源电子基本每股收益为

0.45 元/股、0.42 元/股。目前晶源电子 2010 年归属于母公司的净利润为 3,760.45 万元，基本每股收益为 0.279 元/股，本次交易将有利于提高上市公司盈利能力。

通过本次交易，同方微电子的资产和业务整体进入上市公司，将有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力，符合全体股东的利益。

## **(二) 本次发行股份购买资产有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争**

### **1、规范关联交易的安排**

根据备考财务报告，本次交易完成后，晶源电子与同方股份及其关联方之间存在较少经营性关联交易。

本次交易完成后，同方股份将继续严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

为充分保护上市公司的利益，公司控股股东同方股份和间接控股股东清华控股做出规范关联交易的承诺：

(1) 尽量避免或减少本公司及其所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与晶源电子及其子公司之间发生关联交易。

(2) 不利用股东地位及影响谋求晶源电子及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；

(3) 不利用股东地位及影响谋求与晶源电子及其子公司达成交易的优先权利；

(4) 将以市场公允价格与晶源电子及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害晶源电子及其子公司利益的行为；

(5) 就本公司及其下属子公司与晶源电子及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促上市公司履行合法决策程序，按照《上市规则》和上市公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。

## 2、避免同业竞争的安排

本次交易前，公司与控股股东或其控制的其他企业之间不存在同业竞争。本次交易完成后，公司的控股股东仍为同方股份，公司与控股股东及其控制的其他企业之间仍不存在同业竞争。

为充分保护上市公司的利益，公司控股股东同方股份与间接控股股东清华控股做出避免同业竞争的承诺：

(1) 本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司目前均未从事任何与晶源电子、同方微电子构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。

(2) 本公司及相关企业将来亦不直接或间接从事任何与晶源电子、同方微电子相同或类似的业务，不直接或间接从事、参与或进行与晶源电子、同方微电子的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动。

该等规范关联交易、避免同业竞争的措施或承诺函将有利于本次交易完成后上市公司规范关联交易与避免同业竞争。

## 3、保证上市公司独立性的安排

控股股东同方股份及间接控股股东清华控股出具了承诺，保证在本次重组完成后，将按照中国证券监督管理委员会规范性文件的要求，做到与晶源电子在人员、财务、资产、业务和机构方面完全分开，切实保障上市公司在人员、财务、资产、业务和机构方面的独立运作。

因此，本次交易有利于上市公司规范关联交易，避免同业竞争，不会损害上市公司的独立性。

详细情况请参见本报告书“第十一节 同业竞争和关联交易”。

## **(三) 上市公司最近两年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告**

晶源电子2009年度、2010年度财务报告已经兴华事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

#### **（四）上市公司发行股份所购买的资产，应当为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续**

截至本报告签署日，标的资产权属清晰，股权转让不存在法律障碍，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续。具体情况详见本节“一、本次交易符合《重组办法》第十条的规定”之“（四）本次交易涉及的资产产权清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法”。

因此，本次交易上市公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续。

综上所述，本次交易符合证监会《重组办法》第十条及第四十一条的规定。

## 第八节 董事会对交易定价依据及公平合理性分析

本次非公开发行股份购买资产综合考虑了交易标的的资产质量、盈利能力、财务状况等因素，充分保护了资产出售方、资产购买方及社会公众股东的利益，有助于进一步规范上市公司运作，提升公司的持续经营能力和盈利水平。其中，本次非公开发行股份购买资产的价值是以经具有证券期货从业资格的评估机构的评估值为依据，并经教育部备案，评估价值公允、合理；本次非公开发行股票的价格为定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价，切实有效地保障了上市公司和全体股东的合法权益。

### 一、本次交易定价的依据

中发评估接受委托，采用市场法和收益法对同方微电子 100%的股权价值进行了评估，并经教育部备案。根据中发评估出具的《评估报告》（中发评报字【2010】第 083 号），截至评估基准日 2010 年 10 月 31 日，同方微电子净资产账面价值为 50,833.27 万元；采用市场法确定的股东全部权益评估价值为区间值 144,167.48 万元~156,181.15 万元，比股东权益账面价值增值 93,334.22 万元~105,347.88 万元，增值率为 183.61%~207.24%；采用收益法确定的股东全部权益评估价值为 149,134.01 万元，增值额为 98,300.74 万元，增值率为 193.38%。

收益法对股东权益价值进行评估时综合考虑了目标公司在周边市场的地位、其所拥有的各种技术积累、科学的管理水平、稳定的客户资源、供不应求的产品等因素的价值，是对目标公司价值构成要素的综合反映。收益法评估结果充分反映了目前目标公司运营特征和生产要素的完整构成。鉴于以上原因，本次评估决定采用收益法评估结果作为目标资产的最终评估结果，即：同方微电子股东全部权益价值评估结果为 149,134.01 万元。

以上述评估值为基础，经交易双方协商，本次标的资产作价为 149,134.01 万元。

截至 2011 年 10 月 31 日，以 2010 年 10 月 31 日为评估基准日的《资产评估报告》（中发评报字【2010】第 083 号）已过有效期。公司聘请中发评估出具了以 2010 年 12 月 31 日为评估基准日的《资产评估报告》（中发评报字【2011】第

103号), 并经教育部备案。在评估基准日 2010 年 12 月 31 日, 同方微电子净资产账面价值为 51,846.14 万元; 采用市场法确定的股东全部权益评估价值为区间值 146,594.49 万元~158,810.70 万元, 比股东权益账面价值增值 94,748.35 万元~106,964.56 万元, 增值率为 182.75%~206.31%; 采用收益法确定的股东全部权益评估价值为 151,071.75 万元, 增值额为 99,225.61 万元, 增值率为 191.38%。本次交易标的的评估价值最终仍以收益法的评估结果作为评估结论。

截至 2011 年 12 月 31 日, 《资产评估报告》(中发评报字【2011】第 103 号) 已过有效期。公司聘请中发评估出具了以 2011 年 9 月 30 日为评估基准日的《资产评估报告》(中发评报字【2011】第 138 号), 并经教育部备案。在评估基准日 2011 年 9 月 30 日, 同方微电子净资产账面价值为 58,898.58 万元; 采用市场法确定的股东全部权益评估价值为区间值 170,634.80 万元~184,854.36 万元, 比股东权益账面价值增值 111,736.22 万元~125,955.79 万元, 增值率为 189.71%~213.85%; 采用收益法确定的股东全部权益评估价值为 153,412.31 万元, 增值额为 94,513.73 万元, 增值率为 160.47%。本次交易标的的评估价值最终仍以收益法的评估结果作为评估结论。

经交易双方协商一致, 本次交易标的资产的交易价格维持公司第四届董事会第四次会议确定的交易价格不变, 仍为 149,134.01 万元。即公司拟向交易对方购买的标的资产的价格仍为 149,134.01 万元。

## 二、标的资产价格公允性分析

### (一) 交易标的的盈利能力分析

根据经兴华事务所出具的同方微电子审计报告, 本次交易标的的最近三年一期的主要利润指标如下:

单位: 元

项目	2011 年 1-9 月	2010 年	2009 年	2008 年
营业收入	268,039,556.11	344,285,563.18	450,056,812.89	396,665,247.84
营业利润	82,754,824.95	82,674,775.01	122,850,534.66	109,359,405.43
利润总额	82,654,824.95	82,631,658.48	124,786,091.21	115,494,056.35
净利润	70,524,345.12	70,359,632.30	101,088,980.85	105,724,239.27

同方微电子系一家快速成长的高新技术企业, 在研发、市场地位和市场渠道

方面拥有明显优势，自成立以来一直保持了较高的盈利能力。根据同方微电子现有合同订单、现有产能和成本费用水平，可以合理预计同方微电子未来营业收入和净利润将保持较高的增长速度，保持较强的盈利能力。

根据兴华事务所出具的标的资产《审计报告》及《盈利预测审核报告》，同方微电子 2009 年度实现净利润 10,108.90 万元，2010 年度实现净利润 7,035.96 万元。2011 年预计可产生净利润 7,246.89 万元。2011 年 1-9 月，同方微电子已实现净利润 7,035.96 万元，预计同方微电子 2011 年度全年净利润将超过盈利预测数。本次重组完成后，晶源电子 2010 年全年实现净利润 10,943.57 万元，2011 年全年实现净利润约 10,034.54 万元。按照发行完成后 24,099.43 万股计算，2010 年、2011 年晶源电子基本每股收益为 0.45 元/股、0.42 元/股。目前晶源电子 2010 年归属于母公司的净利润为 3,760.45 万元，基本每股收益为 0.279 元/股，本次交易将有利于提高上市公司盈利能力。

## （二）交易标的定价合理性分析

在评估基准日 2010 年 10 月 31 日，预计同方微电子 2010 年可实现净利润 7,028.16 万元（实际实现 7,035.96 万元净利润），本次交易价格为 149,134.01 万元，市盈率为 21.22 倍。若不考虑溢余资产价值，同方微电子营业资产价值即经营性资产产生的现金流量现值为 111,013.98 万元，市盈率为 15.80 倍。

为分析本次交易估值的合理性，本报告选取了与同方微电子业务相同或相近的电子元器件类上市公司在评估基准日 2010 年 10 月 31 日（剔除亏损公司）的市盈率与同方微电子进行了对比，具体如下表所示：

股票代码	股票名称	2010 年 10 月 31 日市盈率	股票代码	股票名称	2010 年 10 月 31 日市盈率
600171.SH	上海贝岭	377.50	002179.SZ	中航光电	56.28
600206.SH	有研硅股	779.17	002156.SZ	通富微电	38.99
600207.SH	ST 安彩	93.38	300127.SZ	银河磁体	75.53
600478.SH	科力远	201.11	002289.SZ	宇顺电子	59.74
002188.SZ	新嘉联	132.86	002045.SZ	广州国光	39.92
002189.SZ	利达光电	147.96	002463.SZ	沪电股份	34.60
002141.SZ	蓉胜超微	124.41	002138.SZ	顺络电子	44.12
002137.SZ	实益达	92.01	600183.SH	生益科技	20.36
000733.SZ	振华科技	92.10	600460.SH	士兰微	37.11
002129.SZ	中环股份	131.71	002456.SZ	欧菲光	93.12
600330.SH	天通股份	110.39	002484.SZ	江海股份	38.91

600602.SH	广电电子	60.21	300114.SZ	中航电测	53.14
000050.SZ	深天马 A	81.25	002241.SZ	歌尔声学	60.53
600360.SH	华微电子	58.33	002351.SZ	漫步者	42.01
002288.SZ	超华科技	91.50	002475.SZ	立讯精密	58.53
600363.SH	联创光电	69.82	002056.SZ	横店东磁	55.08
600353.SH	旭光股份	70.52	002273.SZ	水晶光电	49.17
002055.SZ	得润电子	76.73	002449.SZ	国星光电	42.07
002079.SZ	苏州固锟	61.54	002106.SZ	莱宝高科	60.23
002199.SZ	东晶电子	65.08	002402.SZ	和而泰	45.91
600584.SH	长电科技	45.42	300083.SZ	劲胜股份	38.67
002222.SZ	福晶科技	44.15	002389.SZ	南洋科技	59.57
002119.SZ	康强电子	39.22	300131.SZ	英唐智控	53.66
300053.SZ	欧比特	78.04	300088.SZ	长信科技	44.74
000823.SZ	超声电子	49.80	600563.SH	法拉电子	29.86
002025.SZ	航天电器	44.91	300128.SZ	锦富新材	49.63
300014.SZ	亿纬锂能	88.50	300046.SZ	台基股份	40.03
300032.SZ	金龙机电	55.18	002436.SZ	兴森科技	38.20
002049.SZ	晶源电子	39.81	300115.SZ	长盈精密	42.94
002185.SZ	华天科技	32.98	300102.SZ	乾照光电	62.78
000970.SZ	中科三环	72.95	300139.SZ	福星晓程	0.00
000636.SZ	风华高科	37.47	300077.SZ	国民技术	64.59
<b>平均值</b>		<b>79.31</b>			
<b>同方微电子</b>		<b>21.22</b>			

注：1、上市公司股价取 2010 年 10 月 31 日的收盘价，若当天无交易，则取 2010 年 10 月 31 日前一交易日的收盘价，上市公司的每股收益根据 2010 年三季度报模拟计算；2、同方微电子净利润取 2010 年盈利预测数为准；3、平均值为电子元器件行业上市公司（计算市盈率时剔除亏损企业）的算术平均值。

由上表可以看出，与国内证券市场中电子元器件行业上市公司估值相比，本次交易拟购买资产市盈率指标低于选取样本的平均值，充分地考虑了上市公司及中小股东的利益。

### 三、董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见

#### 1、关于评估机构的独立性

本次交易聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、同方微电子除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。

#### 2、关于评估假设前提的合理性

标的资产评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

### 3、关于评估方法与评估目的的相关性

评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的的相关性一致。

### 4、评估定价的公允性

公司以标的资产的评估结果为参考依据，经交易双方协商确定标的资产的交易价格，标的资产的交易价格是公允的。

综上所述，董事会认为：公司本次重大资产重组事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。

## 四、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见

独立董事一致认为：

公司聘请的评估机构具有证券从业资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估机构具有充分的独立性。

公司本次非公开发行股份购买资产暨关联交易涉及评估报告的评估假设前提能按照国家有关法规与规定进行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；评估目的与评估方法相关，评估方法合理。

公司本次交易标的资产的最终交易价格以评估机构出具评估报告的评估值为参考依据，并经公司与交易对方协商确定，交易价格合理、公允，不会损害中小投资者利益。

## 第九节 本次交易对上市公司的影响

本公司董事会以经兴华事务所审计的本公司最近三年的财务报告、最近两年一期的备考财务报告以及经兴华事务所审计的标的资产最近三年一期的财务报告，经兴华事务所审核的标的资产2010至2011年度的盈利预测报告和本公司2010至2011年度的备考盈利预测报告为基础，完成了本节的分析与讨论。投资者在阅读本章时，请同时参考本报告书“第十章 财务会计信息”以及上述财务报告和盈利预测报告。

### 一、本次交易前上市公司财务状况、经营成果的讨论与分析

#### （一）本次交易前，上市公司财务状况分析

根据兴华事务所出具的（2009）京会兴审字第 6-148 号、（2010）京会兴审字第 1-42 号和（2011）京会兴审字第 1-007 号审计报告，上市公司最近三年一期的资产、负债结构情况如下：

单位：万元

项 目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
资产总额	51,471.05	51,900.16	48,949.39	49,020.54
负债总额	4,180.77	7,195.06	6,440.01	8,572.72
所有者权益	45,989.97	44,705.10	42,509.37	40,447.82
其中：归属母公司所有者权益	44,596.41	43,374.23	41,098.78	39,183.51
每股净资产（元/股）	3.30	3.21	3.04	2.90
资产负债率（%）	10.65%	13.86%	13.16%	17.49%

注：晶源电子 2011 年 1-9 月的财务数据未经审计。

2008 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日、2011 年 9 月 30 日，上市公司的资产负债率分别为 17.49%、13.16%、13.86%、10.65%。2010 年，公司负债总额的增长幅度大于资产总额的增长幅度使资产负债率略有上升，2011 年 9 月 30 日，公司的短期借款全部偿还，使公司资产负债率大幅降低。上市公司资产负债率处于较低水平，公司的每股净资产呈逐渐上升趋势，偿债能力较强。

## 1、本次交易前，上市公司资产结构及变动分析

本次交易前，上市公司最近三年一期的资产结构如下表：

单位：万元

项目	2011年9月30日		2010年12月31日		2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
<b>流动资产</b>	<b>23,626.23</b>	<b>45.90%</b>	<b>23,138.49</b>	<b>44.58%</b>	<b>19,825.03</b>	<b>40.50%</b>	<b>19,453.03</b>	<b>39.68%</b>
其中：货币资金	5,860.88	11.39%	6,316.98	12.17%	6,014.17	12.29%	6,144.29	12.53%
应收账款	6,670.91	12.96%	7,515.87	14.48%	7,571.76	15.47%	5,249.20	10.71%
预付款项	2,203.92	4.28%	1,306.40	2.52%	704.88	1.44%	662.07	1.35%
其他应收款	1,965.84	3.82%	1,406.80	2.71%	610.35	1.25%	1,441.43	2.94%
存货	6,641.27	12.90%	6,081.81	11.72%	4,617.74	9.43%	5,877.85	11.99%
<b>非流动资产</b>	<b>27,844.82</b>	<b>54.10%</b>	<b>28,761.67</b>	<b>55.42%</b>	<b>29,124.36</b>	<b>59.50%</b>	<b>29,567.51</b>	<b>60.32%</b>
其中：固定资产	26,137.61	50.78%	26,993.56	52.01%	25,096.36	51.27%	26,215.07	53.48%
无形资产	1,125.87	2.19%	1,167.64	2.25%	1,223.32	2.50%	1,314.04	2.68%
<b>资产总计</b>	<b>51,471.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>51,900.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>48,949.39</b>	<b>100.00%</b>	<b>49,020.54</b>	<b>100.00%</b>

### (1) 资产规模变化分析

最近三年一期，公司资产总额比较稳定，没有发生较大变化。

公司2008年末、2009年末、2010年末和2011年9月末的资产总额分别为49,020.54万元、48,949.39万元、51,900.16万元和51,471.05万元，其中2009年末比2008年末略有下降，2010年末比2009年末增加6.03%。

### (2) 资产结构分析

最近三年一期，公司的资产结构较为稳定，没有发生较大变化。

2008年末，公司流动资产、非流动资产在资产总额中的比例分别为39.68%、60.32%，2009年末，公司流动资产、非流动资产在资产总额中的比例分别为40.50%、59.50%，2010年末，公司流动资产、非流动资产在资产结构中的比例分别为44.58%和55.42%，2011年9月末，公司流动资产、非流动资产在资产结构中的比例分别为45.90%和54.10%。公司流动资产的比重逐渐提高，非流动性资产的比重逐年下降，资产的流动性提高。

截至2011年9月末，公司资产构成中，流动资产主要由货币资金、应收账款、存货构成，占资产总额的比例分别为11.39%、12.96%、12.90%；非流动资产主要由固定资产、无形资产构成，占资产总额的比例分别为50.78%、2.19%。

上市公司为高新技术企业、电子元器件制造企业，拥有较强的研发实力，同时公司又拥有独立生产车间，具有生产、制造能力。目前，公司处于较为成熟的阶段，公司的资产结构符合该行业的特性。

## 2、本次交易前，上市公司负债结构及变动分析

本次交易前，上市公司最近三年一期负债结构如下表：

单位：万元

负债	2011年9月30日		2010年12月31日		2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
<b>流动负债</b>	<b>4,180.77</b>	<b>76.28%</b>	<b>5,769.98</b>	<b>80.19%</b>	<b>5,209.91</b>	<b>80.90%</b>	<b>7,695.22</b>	<b>89.76%</b>
其中：短期借款	-	-	2,149.76	29.88%	1,000.00	15.53%	5,183.46	60.46%
应付账款	2,871.72	52.39%	2,391.66	33.24%	2,756.09	42.80%	1,784.25	20.81%
应付职工薪酬	699.26	12.76%	834.98	11.60%	696.02	10.81%	539.79	6.30%
<b>非流动负债</b>	<b>1,300.31</b>	<b>23.72%</b>	<b>1,425.08</b>	<b>19.81%</b>	<b>1,230.11</b>	<b>19.10%</b>	<b>877.50</b>	<b>10.24%</b>
<b>总负债</b>	<b>5,481.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,195.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,440.01</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,572.72</b>	<b>100.00%</b>

### (1) 负债规模分析

公司2008年末、2009年末、2010年末和2011年9月末的负债总额分别为8,572.72万元、6,440.01万元、7,195.06万元和5,481.08万元，其中2009年末比2008年末下降了24.88%，2010年末比2009年末增加了11.72%，2011年9月末比2010年末降低了23.82%，2011年9月末负债总额的降低主要是短期借款归还引起的。

最近三年一期，公司的负债规模较小，各期末负债总额变化不大。

### (2) 负债结构分析

2008年末、2009年末、2010年末、2011年9月末，公司流动负债占负债总额的比例分别为89.76%、80.90%、80.19%、76.28%。2011年9月末，公司流动负债主要由应付账款、应付职工薪酬构成，占负债总额的比例分别为29.88%、52.39%、12.76%。

公司短期借款2009年末比2008年末减少了4,183.46万元。2010年末，公司短期借款为2,149.76万元，占负债总额的比例为29.88%。2011年9月末，短期借款全部归还。

## 3、公司偿债能力分析

本次交易前，公司偿债能力情况如下：

项 目	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动比率	5.65	4.01	3.81	2.53
速动比率	4.06	2.96	2.92	1.76
资产负债率	10.65%	13.86%	13.16%	17.49%

最近三年一期，公司的流动比率和速动比率呈逐渐提高的趋势，资产负债率逐渐降低。

公司的各种偿债指标较为良好，偿债能力较强，财务风险较低。

## （二）本次交易前，上市公司盈利状况分析

根据兴华事务所出具的（2009）京会兴审字第 6-148 号、（2010）京会兴审字第 1-42 号和（2011）京会兴审字第 1-007 号审计报告，上市公司最近三年一期的盈利情况如下：

单位：万元

项 目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	21,801.29	34,869.38	28,890.67	26,925.90
营业成本	16,710.28	25,900.88	22,062.74	20,095.60
营业税金及附加	136.34	144.95	123.62	139.22
销售费用	339.33	885.44	555.62	658.16
管理费用	1,393.09	2,184.69	1,910.99	1,419.93
财务费用	273.79	402.35	173.66	808.95
营业利润	3,153.08	4,751.46	3,895.37	3,677.47
利润总额	3,278.48	4,754.04	4,185.52	3,720.92
净利润	2,769.87	<b>3,907.60</b>	<b>3,505.62</b>	<b>3,104.35</b>
归属于母公司所有者的净利润	<b>2,707.18</b>	<b>3,760.45</b>	<b>3,409.34</b>	<b>3,054.79</b>
基本每股收益（元/股）	<b>0.20</b>	<b>0.28</b>	<b>0.25</b>	<b>0.23</b>

### 1、营业收入分析

上市公司最近三年一期的主营业务收入结构情况如下：

单位：万元

项目	2011年1-9月		2010年度		2009年度		2008年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
谐振器	15,133.37	70.14%	24,935.33	71.60%	22,812.51	78.96%	22,547.20	83.74%
振荡器	3,702.82	17.16%	4,626.28	13.28%	3,151.93	10.91%	3,837.64	14.25%
电容器	2,333.85	10.82%	2,810.70	8.07%	1,175.21	4.07%	180.33	0.67%
其他	405.48	1.88%	2,453.26	7.04%	1,751.02	6.06%	360.73	1.34%
<b>合计</b>	<b>21,575.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>34,825.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>28,890.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>26,925.90</b>	<b>100.00%</b>

公司属于电子元器件制造业，主要产品为压电石英晶体器件，分为谐振器、振荡器、电容器三大块，其中谐振器的销售收入占公司营业收入总额的比重最大。2008年度、2009年度、2010年度、2011年1-9月，谐振器的销售收入占公司营业收入总额的比例分别为83.74%、78.96%、71.60%、70.14%。

公司目前营业总收入的80%左右来源于出口销售，面临一定的出口风险和汇率变动风险。公司产品的最终用户也多为大型跨国公司，全球的经济形势和电子信息产业的发展变化以及产品进口国或地区的进口政策，都可能对公司产品销售产生直接影响。面对出口风险，公司在巩固国际市场的基础上，积极开拓国内销售渠道，拓展新型元器件和高端精密器件市场，逐步形成国外国内两个市场优势互补的营销网络，以规避出口风险。

通过本次重组，公司可利用同方微电子在智能卡芯片领域的市场影响力及良好的客户关系，扩大国内市场份额，降低出口风险、汇率变动风险。

## 2、盈利指标分析

上市公司最近三年一期的盈利能力指标如下：

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
主营业务毛利率	22.89%	25.72%	23.20%	24.97%
期间费用率	9.20%	9.96%	9.14%	10.72%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.28	0.25	0.23
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股）	0.19	0.28	0.24	0.22

### （1）毛利率分析

最近三年一期，公司主要产品毛利率情况如下：

业 务	2011 年 1-9 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
谐振器	21.26%	25.60%	21.92%	22.74%
振荡器	31.84%	37.24%	40.08%	38.58%
电容器	17.39%	14.76%	12.45%	17.57%
主要产品综合毛利率	22.68%	26.33%	23.20%	24.97%

2008 年至 2010 年，公司的营业收入有所上升，主要产品的综合毛利率也略有上升，但是随着公司主要产品下游行业如通信设备、家电、计算机等电子整机产品价格的不断下降，以及压电石英晶体元器件行业竞争日益激烈，公司主要产品销售价格呈现下降的趋势，2008 年度、2009 年度公司主要产品价格综合售价分别下降了 9.85%、10%，而主要原材料价格未发生较大变化。2010 年度公司主要产品价格综合售价上升 1.84%，主要原因是产品结构的变化。2011 年 1-9 月，公司各主要产品的销售毛利率比 2010 年度均有所下降。

面对公司产品价格下降的风险，公司通过加大新产品的研发力度和优化产品结构，提高附加值较高产品的销售比重，从而增强对下游产品价格波动的承受能力以保持相对稳定的综合毛利率，同时，公司通过加强内部管理，完善成本考核机制，加大市场开拓力度，扩大生产规模，实现规模经济，进而有效地降低产品的生产成本。

通过本次交易，公司可利用同方微电子在集成电路设计等方面的先进技术，再结合公司自身在晶体元器件方面的研发实力和技术资源，加快研发高端精密电子器件产品和专用设备、仪器及应用系统，以提升公司现有高端产品的市场竞争力和盈利能力。

### （2）期间费用率

2008 年度、2009 年度、2010 年度、2011 年 1-9 月，公司的期间费用率分别为 10.72%、9.14%、9.96%、9.20%。公司的期间费用主要为管理费用、销售费用，财务费用较少。最近三年，公司的期间费用率变化不大，处于较低水平。

### （3）每股收益

2008 年度、2009 年度、2010 年度、2011 年 1-9 月，公司的基本每股收益分别为 0.23 元、0.25 元、0.28 元、0.20 元，扣除非经常损益的基本每股收益分别

为 0.22 元、0.24 元、0.28、0.19 元。

最近三年，公司目前的主要产品销售价格逐渐下降，而原材料价格预期将会上涨，对公司的盈利能力的提高产生较大压力。

通过本次交易，公司将通过同方微电子的技术优势，进一步提高公司产品的自主知识产权和技术附加值，提升公司在电子元器件高端产品的市场竞争力，增强公司的盈利能力。

## 二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析

### （一）集成电路行业基本情况

#### 1、行业类别

交易标的主要业务是从事智能卡、RFID电子标签和信息安全等核心芯片的设计开发与销售，并提供系统解决方案。目标是在身份识别、移动通信、金融支付、物流防伪和信息安全等行业应用领域成为领先的芯片解决方案提供商，属于集成电路行业。

集成电路（Integrated Circuit，IC）俗称芯片，其成品化过程为：通过采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连在一起，制作在半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，使其成为具有所需电路功能的微型电子器件。集成电路具有体积小、重量轻、引出线和焊接点少、寿命长、可靠性高、性能好、成本较低等优点，在工、民用电子设备及军事、通信、遥控等方面已得到广泛的应用。

集成电路设计指应特定用户要求和特定电子系统的需要，在一块较小的单晶硅片上集成许多晶体管及电阻、电容等元器件，并按照多层布线或隧道布线的方法，将元器件组合成完整的电子电路的整个过程。集成电路设计将系统、逻辑与性能的设计要求转化为具体的物理版图，是一个把产品从抽象到逐步具体化、直至最终物理实现的过程。

集成电路行业与现代科学技术密切相关，是当前国家重点鼓励支持发展的行业，也是国防安全和电子信息基础产品的支柱产业。信息安全行业是国家信息化战略的重要组成，已列入国家中长期发展纲要。

## 2、行业主管部门与监管体制

集成电路设计行业的主管部门是工信部。工信部负责制订行业的产业政策、产业规划，组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准，并对行业的发展方向进行宏观调控。

中国半导体行业协会是中国集成电路行业的行业自律管理机构，主要负责产业及市场研究，对会员企业提供行业引导、咨询服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。公司是中国半导体行业协会会员单位。

工信部和中国半导体行业协会构成了集成电路行业的管理体系，各集成电路企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下，面向市场自主经营，自主承担市场风险。

## 3、行业主要法律法规和政策

集成电路行业作为关系国家经济发展和国防安全的支柱行业，国家给予了高度重视和大力支持。

2000年6月，国务院出台了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）。该文件制定了集成电路产业的核心政策，对集成电路行业的发展具有重要意义。

2000年11月，财政部、国家税务总局、海关总署颁布了《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号），出台了针对集成电路行业的税收优惠政策。

2001年4月，国务院颁布《集成电路布图设计保护条例》；2001年9月，国家知识产权局颁布了《集成电路布图设计保护条例实施细则》，对保护集成电路布图设计专有权、鼓励集成电路技术的创新起到了积极促进作用。

2002年10月，财政部、国家税务总局发布了《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》（财税[2002]70号），出台了针对集成电路产业更多的税收优惠政策。

2004年4月，国家发改委、科技部以及商务部联合发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2004年度）》，其中集成电路被列为第十七类。

2005年3月，财政部、原信息产业部、国家发改委联合出台了《集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法》（财建[2005]132号），该办法是《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）的重要补充。

2006年2月，国务院发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》（国发[2005]44号），纲要中确定并安排了16个国家科技重大专项。其中，“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”、“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”与“新一代宽带无线移动通信网”分别列在规划的16个国家科技重大专项的前三位。

2006年3月，国务院制订的《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出，电子信息产品制造业是我国增强高技术产业核心竞争力的关键，“十一五”期间，必须大力发展集成电路、软件和新型元器件等基础性核心产业。

2008年1月，原信息产业部编制并颁布了《集成电路产业“十一五”专项规划》，分别从设计、制造、封装和测试等方面指出了集成电路行业的发展思路。其中对设计业的发展思路是：鼓励设计业与整机之间的合作，加快涉及国家安全和量大面广集成电路产品的设计开发，培育一批具有较强自主创新能力的骨干企业，开发具有自主知识产权的集成电路产品。

2011年1月，国务院颁发了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号）。该文件进一步落实和完善了集成电路产业的核心政策，对集成电路行业的进一步发展壮大具有重要意义。

### 中国集成电路行业主要政策措施一览表

序号	政策措施	颁布时间
1	《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	2000年
2	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》	2000年
3	《集成电路布图设计保护条例》、《集成电路布图设计保护条例实施细则》	2001年
4	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》	2002年
5	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2004年度）》	2004年
6	《集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法》	2005年
7	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》	2006年
8	《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》	2006年

9	《集成电路产业“十一五”专项规划》	2008年
10	《关于企业所得税若干优惠政策的通知》	2008年
11	《电子信息产业调整和振兴规划》	2009年
12	《电子信息产业技术进步和技术改造投资方向》	2009年
13	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	2011年

#### 4、影响行业发展的有利因素

##### (1) 国家产业政策支持集成电路行业及其子行业的发展

集成电路行业作为关系经济发展和国防安全的支柱产业，对于国民经济和国家安全具有重要影响，国家对集成电路行业的发展给予了一贯的高度关注和政策支持。国家产业政策的扶持加快了行业内企业的技术进步，增强了企业自主开发能力，提高了国内行业龙头企业的市场竞争力。

##### (2) 下游产业发展为行业发展提供了广阔的市场空间

面对全球金融危机蔓延带来的国内外经济环境的恶化，我国政府出台了多项拉动内需的举措，包括发放了 TD-SCDMA、WCDMA 和 CDMA2000 制式的三张 3G 牌照，采取“家电下乡”的政策，将手机和个人电脑等电子产品纳入政府补贴范围。上述措施将间接拉动相关集成电路产品的市场需求，为行业内企业提供了广阔的市场空间。

##### (3) 工艺水平发展提升行业内企业产品性价比

集成电路的制程工艺技术遵循“摩尔定律”，后段工序封装和测试工艺水平亦快速提高，这推动集成电路加工、封装和测试的单位成本逐步降低，产能逐步扩大。行业工艺水平的快速发展推动整个行业产品的更新换代，产品性价比不断提升，提升整个行业的竞争力。

##### (4) 新兴应用领域高速发展带动安全芯片行业深度发展

信息网络的快速发展以及近年来发生众多信息安全突发事件的增加，人们对信息安全重要性和紧迫性的认识变得更加深刻，对信息安全防护能力的要求也在不断提升。同时，金融、电信等行业对信息安全基础设施的需求将带动安全芯片行业快速发展。

#### 5、影响行业发展的不利因素

##### (1) 研发投入巨大

集成电路设计行业需要投入大量研发费用，一是为开展集成电路设计产品研发，需形成开发工具、服务器等开发环境，并且需要安排大额的试制费用；二是为保证产品系列化以及适应设计工艺升级，往往在产品尚未收回研发成本的同时，即需要开发同类型的升级产品；三是由于前期研发投入大，企业研制的芯片产品盈亏平衡点较高，市场销售规模通常要达到至少几十万颗至上百万颗，才能确保盈利。若产品不能符合市场的需求或销售规模有限，巨额研发费用的投入将无法收回，企业将面临损失。

## （2）设计人才不足

作为智力高度集中的知识密集型行业，集成电路设计行业对于人才的依赖远高于其他行业。目前，我国集成电路设计行业人员培训力度逐步加大，专业设计人员的供给量逐年上升，但人才匮乏的情况依然存在，成为目前制约我国集成电路设计行业发展的瓶颈。

## （二）集成电路行业壁垒

集成电路设计行业属于知识密集、技术密集和资金密集型产业，对研发、设计技术要求高，人才储备和资金投入具有较高的进入门槛。行业进入的主要壁垒如下：

### 1、人才储备壁垒

集成电路设计行业是知识密集型企业，高素质的经营管理团队和富有技术创新理念的研发队伍是集成电路设计企业的价值核心，而人力资源优势是企业核心竞争力的体现。目前国内集成电路设计行业专业人才较为匮乏，行业内具有丰富经验的高端技术人才相对稀缺，且优秀技术人才多集中在少数领先厂商。因此，人才储备难题成为新进入企业的障碍。

### 2、资金和规模壁垒

集成电路设计行业属于资金密集型产业，企业要形成规模经济才能获得生存和发展的空间，行业进入风险集中体现为产品适销性不足，无法弥补大规模的研发资金投入，具体体现在两个方面：

一是大额的前期开发投入。企业形成规模经济前需要持续的前期投资，企业

前期资金投入集中于研发费用，主要是人力成本和研发材料耗费。

二是高门槛的规模经济标准。集成电路设计业量产标准很高，由于集成电路产品开发费用高，企业开发的芯片产品市场销售规模低限为几十万颗至上百万颗，才能确保盈利。

### 3、资质认证壁垒

集成电路行业技术专业性强，企业在本行业从事经营需要取得相关资质。对于涉及国家秘密以及商用密码产品，国家实行较为严格的资质认可和产品测评专控管理。目前，国内拥有国家密码管理局颁发的商用密码销售许可证和生产定点单位资质的芯片供应商数量较为有限。

同时，根据《集成电路卡注册管理办法》，从事集成电路卡生产、发行和应用服务提供的机构，按照一定程序和要求，向国家集成电路卡注册管理机构申请，获得惟一注册标识号，并将其写入集成电路卡。

### 4、政策壁垒

根据《商用密码管理条例》、《商用密码产品使用管理规定》和《信息安全等级保护管理办法》等政策法规的规定，基于信息安全对国家利益的重要影响，计算机信息安全领域属于国家强制性保护的行业，相关产品采购实行窗口指导。目前国外的信息安全厂商和一些大型 IT 企业涉足的信息安全业务主要局限在一些通用的网络安全设备上；在关系国家安全的国家基础设施和政府、金融和军工等敏感行业，在国内信息安全产业能够提供信息安全技术与产品的情况下，以自主可控原则为指导优先采购国内信息安全产品。

## （三）集成电路行业经营模式

### 1、经营模式

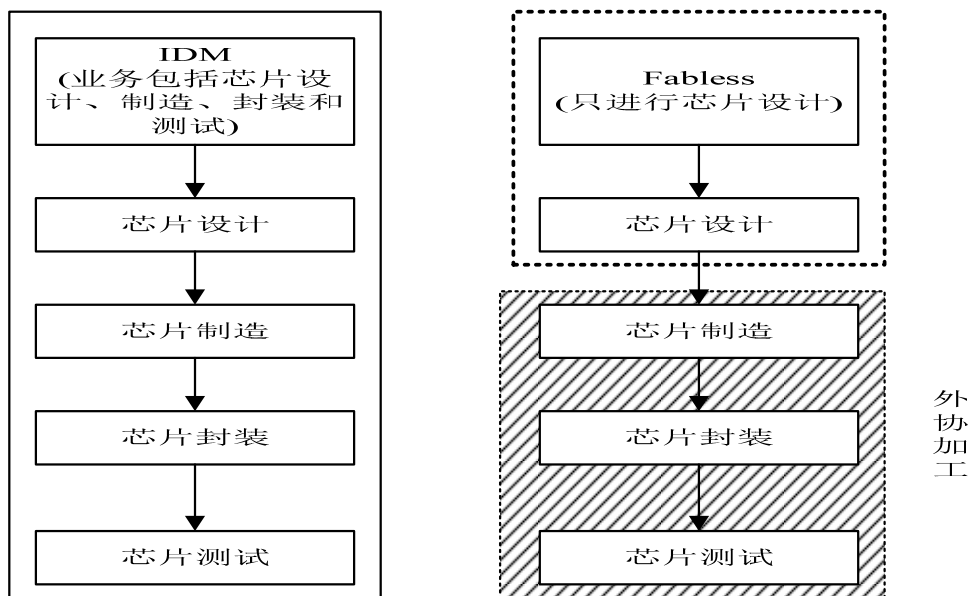
集成电路产业链内部主要由上游的集成电路设计公司、中游的集成电路加工制造厂和下游的集成电路后工序（包括测试、封装）厂等三大相关产业群体构成。上游的设计公司按照客户要求设计出线路图，然后由中游的加工制造厂将其线路图建造在硅片上，硅片再送往下游的后工序厂进行封装测试，最后制成客户所需要的产品。

随着集成电路制造工艺不断进步和产业所需的投资规模越来越大，全球集成电路产业链经过多次专业化分工，逐渐形成两种主要经营模式：IDM模式和垂直分工模式。

IDM（Integrated Device Manufacture，集成器件制造）模式集合芯片设计、制造、封装测试和销售各个环节为一体或其中两三个环节为一体，能够充分整合产业链各环节资源，企业通常规模较大，综合实力很强，在行业处于景气上升阶段能够充分发挥其规模经济优势。典型的IDM企业包括英特尔（Intel）、三星（Samsung）、东芝（Toshiba）、意法半导体（STMicroelectronics，ST）等。

由于IDM模式所需的投资十分巨大，仅投资一条芯片生产线就至少需要数亿美元以上，一般的企业根本无法承担，于是出现了对产业链各环节进行细分后形成的垂直分工模式，涌现了大批专业的集成电路设计、制造和封装测试企业。

目前，国内大部分集成电路设计企业（包括本公司）属于单纯从事集成电路设计、开发业务，将芯片制造和封装测试工序外包，即无生产线的集成电路设计公司（Fabless）。与实力雄厚的IDM企业相比，Fabless在技术开发、技术整合上的实力，以及能否准确把握市场需求并迅速开发出适合市场需求的产品是构成其竞争力的关键要素。



图：集成电路行业经营模式

## 2、周期性及区域性

从近三十多年来全球半导体市场发展状况来看，集成电路产业存在着随宏观经济变动而呈现周期性上升（繁荣）与下降（衰退）的“硅周期”现象，其主要原因是经济波动影响电子产品的市场需求，进而引起上游集成电路产业供求关系发生变化。2008-2009年，受全球经济不景气影响，世界集成电路市场出现下滑，中国集成电路产业的整体销售额规模也连续两年出现负增长。但国内的集成电路设计子行业在技术创新和内需市场拉动下仍然保持了持续增长，其发展状况明显好于行业整体和集成电路制造、集成电路封装测试两个子行业的表现。

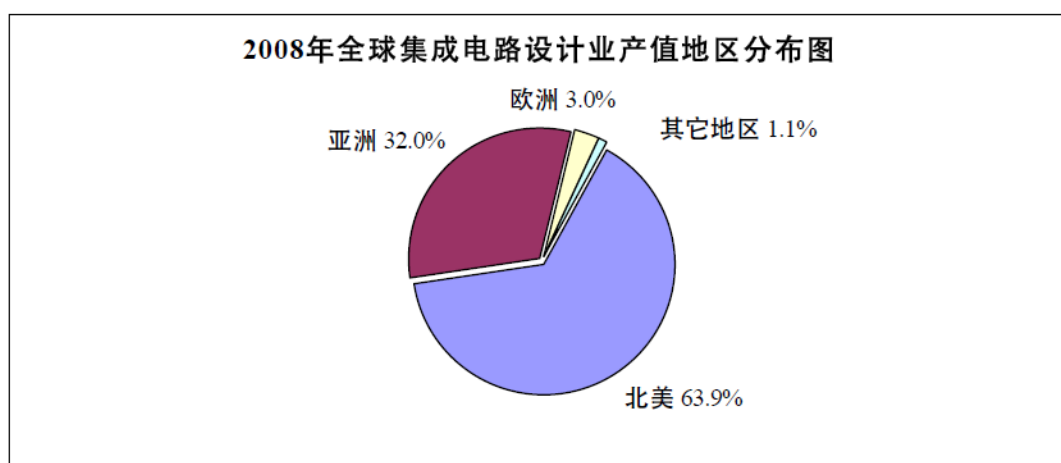
集成电路行业不具有明显的区域性特征。

#### （四）集成电路行业现状及竞争状况

##### 1、行业现状及发展趋势

随着集成电路技术和产业的发展，世界集成电路的年市场规模已高达二千多亿美元。在集成电路不断向经济、国防、民生和文化等各个领域渗透的作用下，这二千多亿美元的市场支撑了电子产品制造及其增值服务在内的三万多亿美元信息产业市场的发展。

近年来，市场需求带动全球集成电路设计行业持续增长。根据赛迪顾问出具的《2008—2009年中国集成电路设计业市场研究年度总报告》，全球集成电路设计行业2004年至2007年间年平均增长率达到19.8%，2008年在金融危机影响下仍维持了2.4%的增长率。全球集成电路设计行业2008年产业规模已达到542.7亿美元，亚洲地区特别是中国集成电路市场在逐步扩大。



自上世纪90年代以来，我国的集成电路市场平均增长速度为世界市场增长

速度的六倍，成为世界上增产速度最快的集成电路市场。据统计，2005年，我国集成电路市场占世界市场总额的25.4%；2007年，我国集成电路市场占世界市场总额的33.9%；2009年，我国集成电路市场占世界市场总额的36.7%。近几年，我国的集成电路市场已占世界市场的三分之一以上，成为世界规模最大的集成电路市场。集成电路的进口额也一直在我国进口商品中位列第一。我国各级政府也相继出台了多项鼓励发展集成电路产业的政策，有力推动了我国自主集成电路产业的发展。

随着国内3G移动通信网络、宽带光纤接入网和下一代互联网等新一代移动通信及移动互联网的建设，将带动系统和终端产品的升级换代。同时，政府针对全球金融危机出台的一系列鼓励投资和消费的政策措施，将使得2010-2012年集成电路设计行业仍将保持快速增长。从中长期来看，集成电路设计行业也将是整体集成电路产业中增长最为迅速的领域。

早期的集成电路行业以生产为导向，制程工艺为核心关键要素。随着技术的进步和市场的不断变化，集成电路行业在经历了多次结构调整之后，已经逐渐由原来“大而全”形式的产业演化成目前“专而精”的多个细分子产业。在传统IDM公司继续发挥较大作用的基础上，集成电路产业结构进一步专业化细分成为一种趋势，形成了设计业、制造业、封装和测试业独立成行的局面。其中，集成电路设计行业具有更接近和了解市场、更具创新性的特点，作为集成电路行业高增值环节，在整个集成电路行业中的比重逐步加大。

交易标的主要产品为智能卡、RFID电子标签和信息安全等核心芯片，属于专用集成电路类的细分应用市场。

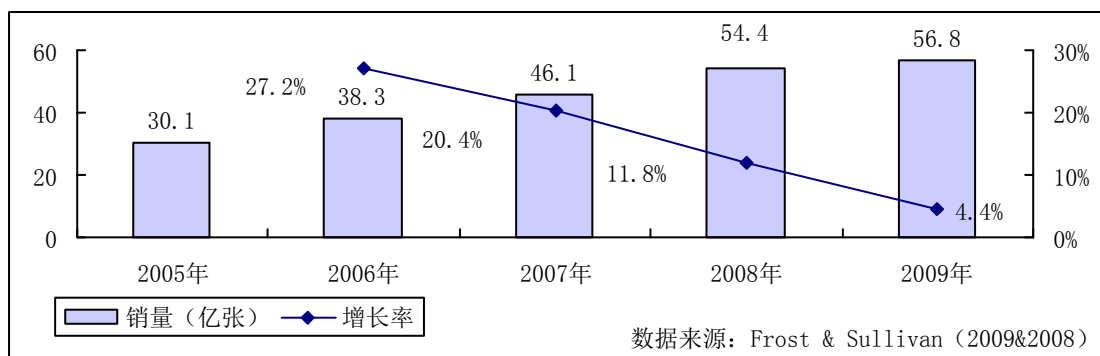
### (1) 智能卡行业现状及发展趋势

全球智能卡行业过去五年的发展情况如下。

**表 1：2005—2009 年全球智能卡市场统计数据**

年份	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年
出货数量(百万张)	30.081	38.261	46.071	54.365	56.765
增长率		27.2%	20.4%	11.8%	4.4%

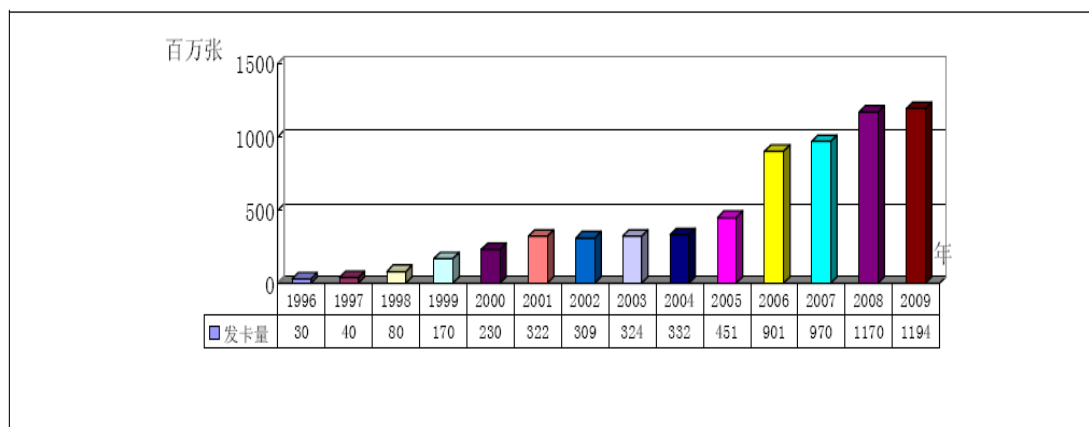
数据来源：Frost & Sullivan (2009&2008)



图：2005—2009 年全球智能卡市场规模（按销量）

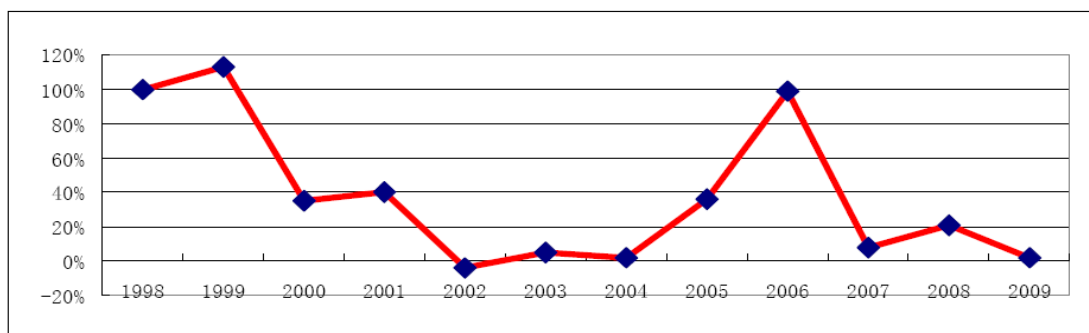
2009 年，全球智能卡市场的销量达到了 56.77 亿张，市场增长了 4.4%，市场增长主要源自于政府项目（如身份证、电子护照、电子驾照等）、移动通信智能卡增长以及区域性市场（中国）的快速增长。2009 年，在智能卡产品结构中，销量上占了 83.7% 市场份额的 CPU 卡在销售额上占了 95% 的份额，远远超过 Memory 卡在市场销售额中所占的比例。

国家“金卡工程”的启动实施，促进了各类卡基应用，迅速渗透到国民经济各行各业。随着市场的发展，行业性智能卡应用工程陆续启动，智能卡已在我国电信、社保、公安、工商、税务、交通、建设及公用事业、卫生、石油石化、物流等多个领域得到广泛应用，截止到 2009 年底，发卡总量已达 65.23 亿张。



数据来源于：中国信息产业商会智能卡专业委员会《中国 IC 卡市场分析报告》

图：我国历年智能卡发卡情况统计



数据来源于：中国信息产业商会智能卡专业委员会《中国 IC 卡市场分析报告》

图：我国历年智能卡增长速度统计

从上图明显可以看出，我国智能卡的应用市场有几个明晰的发展阶段，一是 2001 年以前，可以说是智能卡应用市场的起步阶段，这阶段的特点是，发卡量较小，应用的行业除电信外不具规模，很多处于试点探索状况，而且这阶段比较混杂。由于国内的芯片企业尚未起来，大部分的智能卡芯片需要进口，形成卡片成品后售价较高，难以得到普遍应用。

第二阶段是 2001 年至 2005 年，市场进入到发展中的调整阶段。由于前一阶段的无序发展，导致了政府相关部门出台了许多的管理措施，旨在正确引导应用与产业的有序发展，同时鼓励国内的企业做强做大。这一期间，国内智能卡产业队伍经过一轮竞争，崛起了一批重量级的智能卡企业，在未来发展中起到了领头羊作用。在智能卡芯片方面，大唐微电子技术公司、上海华虹集成电路有限公司、上海复旦微电子股份有限公司、同方微电子有限公司、华大电子设计公司等纷纷开发了相关产品，打破跨国芯片企业诸多垄断市场地位。大唐微电子有限公司、东信和平智能卡股份有限公司、握奇数据系统公司等更是在电信领域取得突破，重新构筑了电信卡市场的竞争格局，为移动电话卡的大规模采购奠定了基础。

第三阶段就是 2006 年以后至今，市场进入到规模应用的发展阶段。这一阶段最大特点就是发卡量迅速增长，出货量更是创新高。几大行业大卡的启动，加快了我国智能卡应用市场的发展步伐。第二代居民身份证项目是这一阶段的一大亮点项目，至今换发二代证超过九亿张，带动了智能卡产业部门的跨跃式发展。移动电话卡也得益于本土企业的竞争，产品价格直线下降，最终导致每年几亿张的采购量。奥运会、世博会、亚运会等大型运动会也为智能卡市场起到了促进作用。我国迎来了智能卡规模应用的发展阶段，智能卡也正以自身的优势为人们

工作和生活提供了便利，拉近了人与信息化科技的距离。

在智能卡发展的最初几年，全球市场几乎被国外厂商垄断，以市场主流产品移动通信卡为例，发展初期，Gemalto（金雅拓）、G&D（捷德）等国外大公司一直占据着主导地位。但自从本公司、大唐微电子等一批快速成长起来的本土厂商加入了移动通信卡市场供应商之列，整个智能卡市场呈现较为激烈的竞争态势。由于智能卡需要在技术、价格、生产能力、资质、服务等多层面上展开综合实力的竞争，存在比较高的进入壁垒。因此在国际市场上，主要的竞争者均为市场占有率前几名的厂商，呈现出相对稳定的竞争格局。

## （2）RFID 电子标签行业现状及发展趋势

RFID 是一项先进的自动识别和数据采集技术。RFID 技术已经成功应用于身份识别、生产制造、物流管理、公共安全、防伪等诸多领域。



图：美国 RFID 市场发展状况

资料来源：IDC International Data Corporation

中国 RFID 市场规模已居全球第三位。非接触式智能卡已广泛用于公交、不停车收费、路桥管理、铁路机车识别管理，以及电子证照、身份识别等方面，开展了成功试点和规模应用。特别是电信智能卡整合了电子钱包功能推出的移动支付应用，以手机做为 RFID 的读写器开展的食物、药品安全管理与贵重物品的识别防伪等，以及遍布三十个试点城市的“一卡通”工程应用，推动了社会信息化进程，并取得了明显成效。

研究机构驰昂咨询公司发布的《2008~2009 年 RFID 产业发展研究年度报告》显示，中国 RFID 产业链各环节如芯片、机具、应用等逐步壮大。2008 年中国 RFID 市场规模达到 80.4 亿元，比 2007 年增长 45.9%。

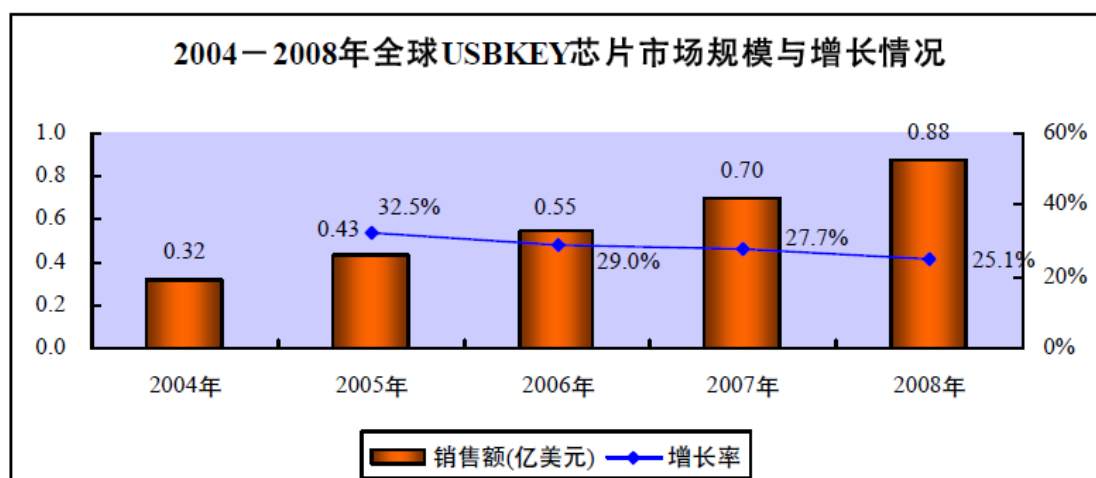
2010年6月，中国RFID产业联盟理事长张琪表示，2009年全球RFID产业规模55.6亿美元，同比增长5%，高频仍居市场主流；预计至2013年，全球RFID市场规模将达到175亿美元，2019年达到280亿美元。

RFID产业有比较高的技术壁垒，在UHF RFID芯片技术方面，国内与国外相比尚有一定的差距。因此，国内的RFID市场仍以HF应用为主。目前，国内RFID行业标准尚未制定完备。从当前国际市场表现的情况来看，UHF RFID市场即将处于快速增长期。由于具有的距离和成本优势，未来UHF RFID将成为标签应用的主流。

### (3) 信息安全芯片行业现状及发展趋势

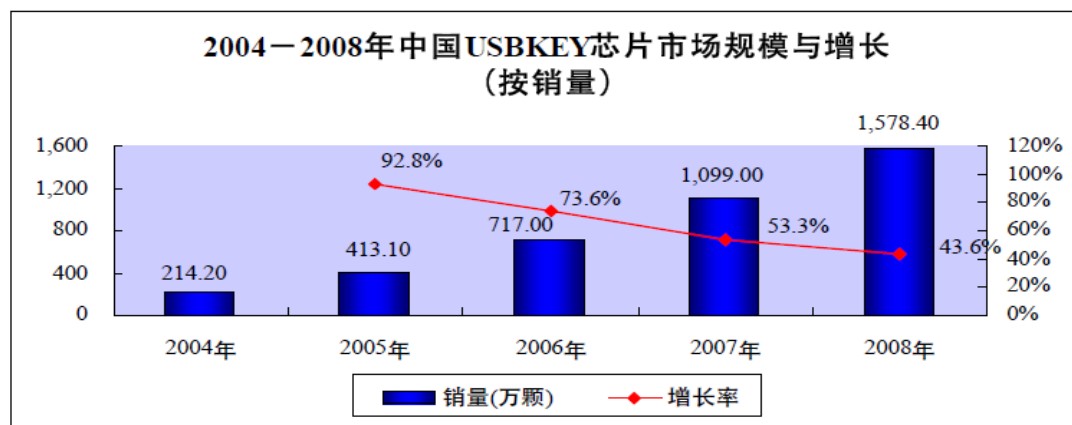
安全芯片是实现网络社会身份认证的基础，为网络社会中的商业交易、个人信息提供法律认可的安全保障。我国从“十五”期间开始，把研发自主信息安全领域的核心芯片作为超大规模集成电路重大专项主要内容。经过几年的发展，安全芯片市场已经初具规模，并进一步形成USBKEY、安全存储、可信计算以及移动支付等细分市场，在电子金融、电子商务、电子政务以及消费类等领域应用日益普及。

近年来，全球USBKEY安全芯片市场在电子金融、电子政务以及企业网络认证等应用的带动下保持了快速增长。截至2008年末，全球USBKEY安全芯片市场销量达到3,716.8万颗，销售额达0.88亿美元。2004-2008年全球USBKEY安全芯片市场规模与增长情况如下图：



数据来源：CCID 2009.6

近年来，网上银行用户数量快速增长，推动了中国USBKEY安全芯片市场规模快速增长。2004-2008年，中国USBKEY安全芯片市场销量规模从214.2万颗增加到1,578.4万颗，销售额也由2004年的4,441.3万元增长到2008年21,673.0万元，并已成为全球市场快速增长的主要推动力。



数据来源：CCID 2009.6

从未来发展趋势看，国内安全芯片市场仍将保持高速增长，其主要的增长驱动因素如下：

#### ①移动支付芯片增长潜力巨大

移动支付是指交易双方通过移动终端（主要为手机）进行商业交易，其主要用途包括公共交通系统现场支付，超市、餐饮、零售、娱乐现场支付，也包含通过手机实现转账、缴费等远程支付。

近距离无线通讯技术在手机上的应用，推动了移动支付技术系统在国际通讯行业迅速发展。据国外媒体Telecomseurope.net预测，到2012年，使用该项技术的手机用户将占全球手机用户总数的3%（约为1.9亿人），而2008年移动支付用户数量仅为7,340万人，未来几年将保持高速增长。

#### ②可信计算芯片市场前景广阔

可信计算芯片嵌在电脑主板上，用来保证电脑软件运行的合法性，杜绝病毒和木马的非法入侵，从而在电脑上创建一个可信的运行环境。目前国内可信计算产品使用的是国家自主TCM规范，与国际通用的TPM标准不同。在国际市场，日本市场的笔记本电脑几乎全部配置TPM可信计算模块，美国市场的可信计算电脑已占据了2/3的市场份额。根据IDC（国际数据公司）的预测，到2010年配备TPM

可信计算模块的电脑全球销售量将达到2亿台以上。

根据《可信计算密码支撑平台功能与接口规范》、《商用密码管理条例》、《含有密码技术的信息产品政府采购规定》等法律及规定，国内所有可信计算产品均应配备TCM芯片；政府采购中凡采购含密码技术的信息产品，必须采购自主密码技术产品。目前国内市场，TCM芯片已启动产业化准备，国内个人电脑供应商联想、同方、方正均推出了多款支持TCM规范的可信个人电脑产品，而国外厂家DELL已经推出面向国内市场、支持TCM规范的产品。由此预见，TCM可信计算模块市场前景广阔。

## 2、行业竞争状况

### (1) 行业市场化程度

芯片设计行业本身高度市场化，而安全芯片行业由于涉及信息安全，受到国家政策、经营资质等方面的影响，存在行业准入门槛。

### (2) 集成电路设计行业竞争格局

集成电路产业链主要由设计、制造、封装和测试组成。集成电路设计行业是集成电路产业链的一个细分行业，该行业的竞争格局具有集成电路行业竞争状况的共性因素，具备完整集成电路设计、制造、封装和测试的IDM厂商与专业从事集成电路设计业务的Fabless厂商构成了市场的竞争主体。集成电路设计行业主要有如下几个特征：

#### ①IDM 厂商具有较强的全球市场控制力

一方面，IDM企业规模庞大，整体投入巨大，全面涉入芯片设计、制造、封装和测试的IC 产业链，个别企业还涉及芯片应用领域，抗风险能力强。

另一方面，IDM 企业设计能力及制造技术均处于领先地位，引领行业基础技术走向，在整个半导体产业链上拥有自己的产品，具有产品市场主导权。由于集成电路设计行业利润率高于集成电路产业整体利润率，IDM 企业运营成本高，许多IDM 企业也通过轻资产策略，以提升其新产品开发的竞争力。

②Fabless厂商在集成电路设计业市场具备竞争优势，国内集成电路设计企业主要采用Fabless模式运营。Fabless厂商专门从事集成电路设计业务，具有三方面

竞争优势：

一是投资规模小，Fabless厂商只需要组织研发团队和建设测试实验环境室，无须购置昂贵的生产厂房和设备；

二是团队素质要求高，集成电路设计作为集成电路产业的前段环节，其技术含量高，企业创新能力强，需要配置高素质的人员团队；

三是市场敏感性高，Fabless厂商更专注市场产品需求变化，能快速响应市场需求，推出适合市场发展的新产品。对比IDM厂商，Fabless厂商在新兴市场和细分市场具备竞争优势。

## （五）交易标的核心竞争力及行业地位

### 1、交易标的核心竞争力

#### （1）技术与研发优势

同方微电子汲取同方股份有限公司的管理经验，依托清华大学的技术优势，在数字、模拟及数模混合集成电路的设计和产业化方面积累了丰富的经验，先后承担、完成了国家“863”重大科技专项、“核高基”重大专项、工信部电子发展基金、北京市科委、北京市经信委和中关村等多个集成电路项目的产品开发任务，完成了多项智能卡相关产品研发和产业化成果。在智能卡芯片相关技术方面居于国内领先和国际先进水平。公司承担了国家第二代居民身份证专用芯片模块开发和生产供应任务，并获得了北京市科学技术二等奖和国家科技进步一等奖。

公司拥有一支优秀的集成电路研发、技术团队和管理团队。公司的管理团队具有平均超过15年的集成电路从业经历，在业内有广泛的资源和影响力，为公司的发展奠定了良好的人才基础。

#### （2）渠道优势

同方微电子通过SIM卡市场积累了深厚的客户资源，成为包括法国金雅拓公司、德国捷德公司在内的全球前五大智能卡商的供应商。通过这些国际卡商，公司的产品已开始销往海外市场。

公司立足于多年积累的集成电路核心技术，积极开发信息安全领域、可信计算领域、移动支付领域、RFID电子标签领域等新兴市场。公司目前的客户都是

各自细分市场的领先企业，由于客户的同类性，这将为公司其他应用的市场开拓奠定了良好的客户基础。

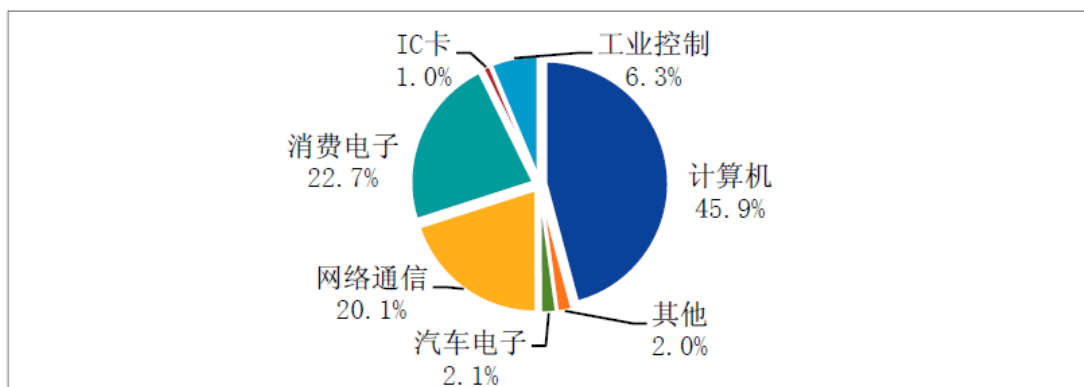
### (3) 市场主导优势

公司在细分行业中占据较大优势，公司目前的主导产品二代身份证芯片和手机SIM卡芯片都具有较强的竞争力和较高的市场份额。同方微电子是国家第二代居民身份证芯片四家供应商之一，每家供应四分之一，同方微电子占有市场25%的市场份额。同方微电子生产的接触卡芯片产品已用于我国三大运营商的手机SIM卡以及有线电视顶盒的条件接收卡，其中手机SIM卡芯片在国内市场占有率逐年增高，已成为国内出货量最大的手机SIM卡芯片供应商。公司在主导产品方面的竞争优势，使得公司已经被国内主要电信运营商和国际主要智能卡商所认可。

## 2、行业地位

### (1) 主要竞争对手

我国集成电路设计业的下游产品涉及计算机、网络通信、IC卡、消费电子、工业控制、电子仪器等众多应用领域。从目前看，计算机领域成为最大的集成电路应用市场，网络通信领域在中国3G网络建设带动下表现较好，消费电子类和工业控制类受全球金融危机冲击影响，市场份额出现大幅下滑。



图：2009年中国集成电路设计市场应用结构

资料来源：《2009年中国集成电路市场回顾与展望》

目前我国集成电路设计业在各细分市场中的主要企业有：

①网络通信类：深圳市海思半导体有限公司、展讯通信（上海）有限公司。

②智能卡类：中国华大集成电路设计集团有限公司、大唐微电子技术有限公司、上海华虹集成电路有限责任公司、北京同方微电子有限公司。

③消费电子类：杭州士兰微电子股份有限公司、炬力集成电路设计有限公司、无锡华润矽科微电子有限公司、北京中星微电子有限公司、日电电子（中国）有限公司。

④专用芯片类：北京福星晓程电子科技股份有限公司（电力线载波芯片）、杭州国芯科技有限公司（数字电视解码芯片）、逐点半导体（上海）有限公司（数字显示芯片）、北京思旺电子技术有限公司（电源管理芯片）等。

## （2）主要产品市场占有率及变化趋势

同方微电子生产的接触卡芯片产品已用于我国三大运营商的手机 SIM 卡以及有线电视机顶盒的条件接收卡，其中手机 SIM 卡芯片在国内市场占有率逐年增高，已成为国内出货量最大的手机 SIM 卡芯片供应商。

同方微电子是国家第二代居民身份证芯片四家供应商之一，每家供应四分之一，同方微电子占有市场25%的市场份额。国家第二代居民身份证从2004年开始换发，到2006年换发量进入高峰期，年发卡量达到2.8亿张。目前第二代居民身份证大规模换发已告尾声，第二代居民身份证芯片供应进入平稳期，年发卡量约为8000万张至1亿张，成为公司的一个稳定收入和利润来源。二代身份证的更换年限一般为10年或20年，2014年二代身份证换发将进入一轮新的高峰期。

## 三、交易标的最近三年一期财务状况、盈利能力分析

### （一）交易标的财务状况分析

#### 1、交易标的的资产结构分析

根据兴华事务所出具的审计报告，交易标的最近三年一期的资产结构情况如下：

单位：万元

项目	2011年9月30日		2010年12月31日		2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	55,309.18	66.44%	48,403.56	69.75%	50,306.16	72.79%	35,947.88	56.26%
应收票据	716.13	0.86%	2,113.75	3.05%	-	-	-	-

应收账款	15,883.64	19.08%	11,213.08	16.16%	11,697.95	16.93%	11,718.57	18.34%
预付款项	259.21	0.31%	172.83	0.25%	136.06	0.20%	22.07	0.03%
其他应收款	261.56	0.31%	113.02	0.16%	125.94	0.18%	223.96	0.35%
存货	6,267.10	7.53%	3,658.89	5.27%	4,261.53	6.17%	13,433.81	21.03%
<b>流动资产合计</b>	<b>78,696.82</b>	<b>94.54%</b>	<b>65,675.13</b>	<b>94.63%</b>	<b>66,527.64</b>	<b>96.26%</b>	<b>61,346.30</b>	<b>96.01%</b>
长期股权投资	300.00	0.36%	300.00	0.43%	276.94	0.40%	276.94	0.43%
固定资产	582.22	0.70%	671.17	0.97%	527.69	0.76%	535.27	0.84%
在建工程	-	0.00%	0.00	0.00%	177.97	0.26%	-	-
无形资产	2.52	0.00%	14.67	0.02%	32.5	0.05%	53.3	0.08%
开发支出	3,251.07	3.91%	2,302.48	3.32%	1,168.93	1.69%	1,535.95	2.40%
长期待摊费用	110.63	0.13%	139.40	0.20%	173.67	0.25%	-	-
递延所得税资产	300.14	0.36%	297.57	0.43%	228.49	0.33%	145.97	0.23%
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,546.58</b>	<b>5.46%</b>	<b>3,725.28</b>	<b>5.37%</b>	<b>2,586.19</b>	<b>3.74%</b>	<b>2,547.43</b>	<b>3.99%</b>
<b>资产总计</b>	<b>83,243.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>69,400.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>69,113.83</b>	<b>100.00%</b>	<b>63,893.73</b>	<b>100.00%</b>

2008年末、2009年末、2010年末、2011年9月末，同方微电子的资产总额分别为63,893.73万元、69,113.83万元、69,400.41万元、83,243.40万元。报告期前三年末，同方微电子资产总额变化不大，较为稳定，2011年9月末，资产总额比以前年度所有增加，主要是2011年1-9月生产经营利润积累等因素使资产总额增加。

同方微电子的资产以流动资产为主，符合高新技术企业的资产结构特征。2008年末、2009年末、2010年末、2011年9月末，同方微电子的流动资产占总资产的比重分别为96.01%、96.26%、94.63%、94.54%。流动资产主要由货币资金、应收账款、存货构成。

截至2011年9月30日，同方微电子的主要资产情况如下：

#### (1) 货币资金

截至2011年9月30日，同方微电子货币资金账面价值为55,309.18万元，明细如下：

单位：万元

项 目	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
现金	0.02	0.02	0.02	0.31
银行存款	55,309.16	48,403.54	50,306.14	35,947.57
<b>合 计</b>	<b>55,309.18</b>	<b>48,403.56</b>	<b>50,306.16</b>	<b>35,947.88</b>

企业货币资金余额的变动是其经营活动、投资活动、筹资活动等事项的综合反映。同方微电子的货币资金 2009 年末较 2008 年末增加了 39.94%，主要是 2009 年度生产经营形成的利润积累；2010 年年末较 2009 年末减少了 3.78%，主要是同方微电子 2010 年 10 月发放现金股利 9,300.00 万元；2011 年 9 月末较 2010 年末增加了 14.27%，主要是 2011 年 1-9 月生产经营形成的利润积累。

## (2) 应收票据

截至 2011 年 9 月 30 日，同方微电子应收票据账面价值为 716.13 万元，主要情况如下：

单位：万元

项 目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	716.13	2,113.75	-	-
合 计	<b>716.13</b>	<b>2,113.75</b>	-	-

2008 年度、2009 年度，同方微电子的主要客户均未采用票据结算。应收票据余额 2011 年 9 月末比 2010 年末减少了 66.12%，主要是票据到期承兑收回货币资金所致。

## (3) 应收账款

截至 2011 年 9 月 30 日，同方微电子的应收账款账面价值为 15,883.64 万元，主要情况如下：

单位：万元

账 龄 结 构	2011 年 9 月 30 日		2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	账面余额	坏账准备	账面余额
1 年以内	16,003.93	158.60	11,316.50	112.92	11,805.61	117.87	11,992.85	274.28
1-2 年	40.32	2.02	10.00	0.50	10.74	0.54	-	-
2 年以上	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	<b>16,044.25</b>	<b>160.61</b>	<b>11,326.50</b>	<b>113.42</b>	<b>11,816.35</b>	<b>118.4</b>	<b>11,992.85</b>	<b>274.28</b>

同方微电子主要产品的应收账款收款期均较短，其中国家二代身份证芯片的收款期约为 4 个半月左右，其他产品的收款期主要为 2 个月。截至到 2011 年 9 月末，同方微电子无二年以上的应收账款。2011 年 9 月末，同方微电子的应收账款账面价值比 2010 年末增加了 41.65%，主要是在第三季度末销售款项尚未到结算期。

截至2011年9月30日，账面余额较大的应收账款明细表如下：

单位：万元

单位名称	金 额	占总额比例	款项性质	账 龄
公安部第一研究所	7,827.84	48.79%	销售款	一年以内
江西捷德智能卡系统有限公司	3,759.24	23.43%	销售款	一年以内
江苏恒宝股份有限公司	1,897.27	11.83%	销售款	一年以内
北京握奇数据系统有限公司	750.97	4.68%	销售款	一年以内
金雅拓科技(上海)有限公司	479.27	2.99%	销售款	一年以内
<b>合 计</b>	<b>14,714.60</b>	<b>91.71%</b>		

截至2011年9月30日标的资产中应收账款前五名欠款单位的欠款总金额为14,714.60万元，占应收账款总额的比例为91.71%，其中应收公安部第一研究所7,827.84万元，占应收账款总额的比例为48.79%，该应收账款为国家二代身份证芯片销售款。公司为国家二代身份证芯片定点生产单位，公安部第一研究所为公安部下属单位，负责统一采购二代身份证芯片。

#### (4) 其他应收款

截至2011年9月30日，同方微电子的其他应收账款账面价值为261.56万元，主要情况如下：

单位：万元

账龄结构	2011年9月30日		2010年12月31日		2009年12月31日		2008年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内	174.25	1.74	26.46	0.26	125.71	0.89	172.02	1.72
1—2年	93.28	4.66	90.48	4.52	1.18	0.06	54.21	0.54
2-3年	0.52	0.08	1.02	0.15	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>268.05</b>	<b>6.48</b>	<b>117.96</b>	<b>4.94</b>	<b>126.89</b>	<b>0.95</b>	<b>226.23</b>	<b>2.26</b>

2008年末、2009年末、2010年末、2011年9月末，同方微电子其他应收款账面价值均较小，主要为支付给北京集成电路设计园的房屋租赁款。

截至2011年9月30日，同方微电子其他应收款主要包括预付上海擎睿电子技术有限公司设备采购款100.00万元和预付北京集成电路设计园的办公场所租赁款90.48万元，以上两项占其他应收款总额的比例为71.07%。

#### (5) 存货

截至2011年9月30日，同方微电子存货账面余额为6,267.10万元，无存货减值准备。构成明细如下：

单位：万元

项 目	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
原材料	34.59	28.12	14.22	12.57
在产品	3,173.86	1,417.16	1,313.13	10,657.52
产成品	1,130.83	1,623.66	111.01	336.09
库存商品	68.38	70.98	44.57	50.17
发出商品	1,858.54	518.08	2,777.71	2,368.49
委托加工物资	0.89	0.89	0.89	8.98
<b>减值准备</b>		-	-	-
<b>合计</b>	<b>6,267.10</b>	<b>3,658.89</b>	<b>4,261.53</b>	13,433.81

同方微电子存货主要是原材料、在产品、库存商品、发出商品。同方微电子无生产车间，自身不从事具体的生产活动，公司针对不同客户的需求，进行独立研发、设计，然后将主要产品芯片的制造、封装、测试工序全部外包。

同方微电子自身不从事生产制造，存货中的“原材料”主要是低值易耗品、研发设计所需材料等零星材料，不是各主要产品生产制造所需原材料。同方微电子产品成本的主要构成部分晶圆、加工费、测试费等均通过“在产品”核算。

同方微电子2009年末的存货余额比2008年末减少了9,172.28万元，下降幅度为68.28%，存货的减少主要是在产品减少了9,344.38万元，主要原因是2008年度、2009年度是同方微电子主要产品国家第二代居民身份证芯片卡的销售高峰期，每年销售芯片约为4000-5000万颗左右，由于该芯片没有特定的供货时间，为了满足销售需求，防止因库存不足而失去销售机会，2008年标的资产存货的保有量较高。2010年以后，国家第二代居民身份证芯片的销售将处于稳定期，预计每年销售芯片约2,000-2,500万颗，2009标的资产存货的保有量下降，因此2009年末、2010年末存货账面余额下降。同方微电子2011年9月末的存货余额比2010年末增加了71.28%，主要原因是金融支付产品销售量及订单比以前年度大幅增加，同时第三季度末已发出但尚未结算的商品有所增加。

同方微电子的大部分存货都存放于委托加工、封装、测试厂商。所有产品均按照客户的订单生产，不存在存货积压或过时现象，无需提取存货减值。

#### (6) 固定资产

截至2011年9月30日，同方微电子的固定资产账面价值为582.22万元，主要明细如下：

单位：万元

项 目	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
<b>一、固定资产原价合计</b>	<b>1,238.09</b>	<b>1,198.13</b>	<b>928.34</b>	<b>833.51</b>
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输设备	292.33	292.33	319.73	320.91
电子设备	945.76	905.80	608.61	512.60
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>655.87</b>	<b>526.96</b>	<b>400.65</b>	<b>298.24</b>
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输设备	133.13	114.65	91.02	70.49
电子设备	522.73	412.31	309.63	227.75
<b>三、减值准备</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>四、固定资产账面价值合计</b>	<b>582.22</b>	<b>671.17</b>	<b>527.69</b>	<b>535.27</b>
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输设备	159.20	177.68	228.71	250.42
电子设备	423.03	493.49	298.98	284.85

同方微电子是高新技术企业，以高科技产品的研发和创新作为企业的盈利核心。同方微电子没有独立的生产车间和生产设备，固定资产主要包括车辆、计算机、研发设备等运输设备和电子设备。因此，同方微电子的各期末账面价值较小。

同方微电子2010年年末固定资产账面价值比2009年末增加143.48万元，增长了27.19%，主要是大容量SIM卡芯片研发项目由在建工程转入所致。

同方微电子的固定资产多为电子设备，设备较新，总折旧年限较短，对于不满足需求的设备更新报废较为及时，因此，各期末固定资产无需提取减值准备。

### (7) 无形资产

#### ①无形资产情况

截至2011年9月30日，同方微电子的无形资产账面价值为2.52万元，主要明细如下：

单位：万元

项 目	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
<b>一、无形资产原价合计</b>	<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	<b>183.00</b>	<b>183.00</b>
1、非专利技术	160.00	160.00	160.00	160.00
2、ERP 软件	-	-	23.00	23.00
<b>二、无形资产累计摊销额合计</b>	<b>157.48</b>	<b>145.33</b>	<b>150.50</b>	<b>129.70</b>
1、非专利技术	157.48	145.33	130.95	114.75
2、ERP 软件	-	-	19.55	14.95
<b>三、无形资产减值准备合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1、非专利技术	-	-	-	-
2、ERP 软件	-	-	-	-
<b>四、无形资产账面净值合计</b>	<b>2.52</b>	<b>14.67</b>	<b>32.50</b>	<b>53.30</b>
1、非专利技术	2.52	14.67	29.05	45.25
2、ERP 软件	-	-	3.45	8.05

同方微电子的无形资产主要包括非专利技术、ERP 软件。除 ERP 软件外，其他各项无形资产主要为自主研发。标的资产每年投入研发的各项费用较多，研发支出是各项费用开支的主要组成部分。目前标的资产的无形资产期末余额较小，主要原因为标的资产近几年的主要研发项目尚未完工，各项新产品不断推出，且不断更新，已经资本化的研发支出，尚未完工，未转入无形资产。具体情况请参照下列开发支出情况介绍。

#### ②开发支出情况

截至2011年9月30日，同方微电子的开发支出账面价值为3,251.07万元，主要明细如下：

单位：万元

项 目	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
身份识别	-	116.61	233.23	600.25
电子标签芯片和读写器研发	935.70	935.70	935.70	935.70
移动通信	2,315.37	1,250.17	-	-
<b>合计</b>	<b>3,251.07</b>	<b>2,302.48</b>	<b>1,168.93</b>	<b>1,535.95</b>

同方微电子的研发支出围绕其各项主要产品，主要由身份识别、电子标签芯片和读写器研发、移动通信构成。

同方微电子2010年末的开发支出账面价值比2009年末增加了1,133.55万元，2011年9月末比2010年末增加了948.59万元，主要是移动通讯项目大容量SIM卡芯片的研发投入增加形成的。

报告期内，同方微电子在金融支付项目的研发支出有较大投入，由于与该研发相关的产品目前市场销售还未形成较大规模，且后续还有较大的研发投入，因此采用谨慎性原则，将其直接计入各期费用。

#### (8) 长期股权投资

截至2011年9月30日，同方微电子长期股权投资账面价值为300.00万元，明细如下：

单位：万元

被投资单位	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
易程科技股份有限公司	300.00	300.00	276.94	276.94
<b>合 计</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>276.94</b>	<b>276.94</b>

同方微电子的长期股权投资全部为对易程科技股份有限公司的股权投资，同方微电子持有易程科技股份有限公司5%的股权比例，采用成本法核算。

#### (9) 递延所得税资产

①截至2011年9月30日，同方微电子递延所得税资产为300.14万元，明

细如下：

单位：万元

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产减值准备	25.06	17.75	17.90	41.48
已计提未发放应付职工薪酬	22.68	27.42	45.59	9.99
拨付的专项应付款	252.39	252.39	165.00	94.50
<b>合计</b>	<b>300.14</b>	<b>297.57</b>	<b>228.49</b>	<b>145.97</b>

同方微电子的递延所得税资产主要由资产减值准备、已计提未发放应付职工薪酬、拨付的专项应付款构成。

同方微电子2010年末的递延所得税资产账面价值比2009年末增长了30.23%，主要是收到的与研发项目相关的政府补助增加导致。

②引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异情况如下：

单位：万元

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
坏账准备	167.10	118.37	119.35	276.54
已计提未发放应付职工薪酬	151.21	182.83	303.94	66.62
拨付的专项应付款	1,682.60	1,682.60	1,100.00	630.00
<b>合计</b>	<b>2,000.91</b>	<b>1,983.80</b>	<b>1,523.29</b>	<b>973.16</b>

## 2、交易标的的负债结构分析

根据兴华事务所出具的审计报告，交易标的最近三年一期的资产结构情况如下：

单位：万元

项目	2011年9月30日		2010年12月31日		2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	-	-	-	-	-	-	-	-
应付票据	11,219.87	46.09%	9,257.53	52.74%	6,043.74	24.87%	10,394.17	35.61%
应付账款	6,999.18	28.75%	3,347.22	19.07%	3,269.42	13.45%	5,360.80	18.36%
预收款项	43.38	0.18%	17.74	0.10%	-	-	125.47	0.43%
应付职工薪酬	422.23	1.73%	509.28	2.90%	578.35	2.38%	198.96	0.68%

应交税费	749.21	3.08%	392.72	2.24%	1,707.12	7.02%	838	2.87%
应付股利	-	-	-	0.00%	9,300.00	38.27%	9,300.00	31.86%
其他应付款	948.95	3.90%	106.17	0.60%	28.02	0.12%	68.05	0.23%
<b>流动负债合计</b>	<b>20,382.83</b>	<b>83.73%</b>	<b>13,630.67</b>	<b>77.65%</b>	<b>20,926.65</b>	<b>86.10%</b>	<b>26,285.45</b>	<b>90.04%</b>
专项应付款	3,962.00	16.27%	3,923.60	22.35%	3,377.00	13.90%	2,907.00	9.96%
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,962.00</b>	<b>16.27%</b>	<b>3,923.60</b>	<b>22.35%</b>	<b>3,377.00</b>	<b>13.90%</b>	<b>2,907.00</b>	<b>9.96%</b>
<b>负债合计</b>	<b>24,344.83</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,554.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>24,303.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>29,192.45</b>	<b>100.00%</b>

2008年末、2009年末、2010年末、2011年9月末，同方微电子负债总额分别为29,192.45万元、24,303.65万元、17,554.27万元、24,344.83万元。2010年末，同方微电子负债规模的减少主要是当期支付现金股利所致。2011年9月末，负债总额增加，主要是原材料采购增加引起的应付账款、应付票据的增加。

2008年末、2009年末、2010年末、2011年9月末，同方微电子流动负债占总负债的比例分别为90.04%、86.10%、77.65%、83.73%；非流动负债占总负债的比例分别为9.96%、13.90%、22.35%、16.27%。流动性负债以应付票据、应付账款为主；非流动性负债全部为专项应付款。同方微电子无任何有息负债。

同方微电子最近三年一期的负债结构未发生较大变化，均以流动负债为主。

截至2011年9月末，标的资产的主要负债情况说明如下：

#### (1) 应付票据

截至2011年9月30日，同方微电子应付票据账面价值为11,219.87万元，主要情况如下：

单位：万元

项 目	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
银行承兑汇票	11,219.87	9,257.53	6,043.74	10,394.17
<b>合 计</b>	<b>11,219.87</b>	<b>9,257.53</b>	<b>6,043.74</b>	<b>10,394.17</b>

同方微电子开出的应付票据均为银行承兑汇票，所有票据均由同方股份提供担保。具体情况请参照本报告书“第十一节 同业竞争和关联交易 二、本次交易对关联交易的影响”。

同方微电子2009年末的应付票据账面价值比2008年末减少了4,350.43万元，减少幅度为41.85%，主要原因是2008年、2009年国家第二代身份证销量比

较大，导致 2008 年期末存货较多。同时，2010 年国家第二代身份证芯片的销售减少，导致 2009 年末标的资产的采购支出也大量减少。2011 年 9 月末应付票据账面价值比 2010 年末增加了 21.20%，主要是由于金融支付产品等产品订单增加，使应付原材料采购款增加。

### (2) 应付账款

截至2011年9月30日，标的资产中应付账款账面价值为6,999.18万元，主要情况如下：

单位：万元

账龄	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
1年以内	6,999.18	3,347.22	3,269.42	5,360.80
1-2年	-	-	-	-
2年以上	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>6,999.18</b>	<b>3,347.22</b>	3,269.42	5,360.80

同方微电子的应付账款账龄均在1年以内，公司现金流情况良好，顾客信誉度良好，不存在长期未付款项。

同方微电子 2009 年末的应付账款账面价值比 2008 年末减少了 2,091.39 万元，减少幅度为 39.01%，主要原因与应付票据的变化原因相同，2008 年、2009 年国家第二代身份证销量比较大，导致 2008 年期末存货较多。同时，2010 年国家第二代身份证芯片的销售减少，导致 2009 年末标的资产的采购支出也大量减少。2011 年 9 月末应付账款账面价值比 2010 年末增加了 109.10%，主要是由于金融支付产品等产品订单增加，使应付原材料采购款增加。

### (3) 应交税费

截至2011年9月末，应交税费账面价值为749.21万元，应交税费的明细如下表所示：

单位：万元

税项	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
增值税	400.94	266.91	1,139.52	232.35

城市维护建设税	28.07	18.68	79.77	18.94
企业所得税	301.64	90.38	435.53	437.64
个人所得税	6.53	8.73	18.12	142.02
教育费附加	12.03	8.01	34.19	7.05
<b>合 计</b>	<b>749.21</b>	<b>392.72</b>	<b>1,707.12</b>	<b>838.00</b>

同方微电子 2009 年末应交税费余额比 2008 年末增加了 869.12 万元，增长幅度为 103.71%，主要是 2009 年末应交增值税比 2008 年末增加了 907.17 万元。

2009 年度，标的资产的销售收入比 2008 年度有所提高，增值税销项税提高，但由于国家二代身份证芯片 2010 年供货量减少，2009 年末采购支出大幅减少，增值税进项税额减少，导致 2009 年末应交增值税大量提高。2011 年 9 月末应交税费余额期末比 2010 年末增加了 90.78%，主要是因为增值税、企业所得税等税金的计提与正常缴纳存在时间存在差异而引起的。

#### (4) 专项应付款

截至 2011 年 9 月 30 日，专项应付款的账面价值为 3,962.00 万元，主要明细如下：

单位：万元

项 目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
工信部	3,295.00	3,295.00	2,780.00	2,330.00
财政部	96.00	57.60	-	-
北京市自然科学基金委员会办公室	7.00	7.00	7.00	7.00
北京市中关村管委会	80.00	80.00	100.00	100.00
北京市经济委员会	100.00	100.00	100.00	100.00
北京市工业促进局	300.00	300.00	300.00	300.00
科学技术部	84.00	84.00	90.00	70.00
<b>合 计</b>	<b>3,962.00</b>	<b>3,923.60</b>	<b>3,377.00</b>	<b>2,907.00</b>

同方微电子是国家认定的高新技术企业和集成电路设计企业，主要从事智能卡、RFID 电子标签和信息安全等核心芯片的设计开发与销售。2005 年，同方微电子成为信息产业部认定的“第一批集成电路设计企业”，曾获得“国家科学技术

进步一等奖”、“北京奥运会与残奥会证件门票制作、防伪和查验技术选型项目入选企业”，掌握了集成电路设计的核心技术。

同方微电子的专项应付款均属于政府补助性质，主要为各种高新技术项目的研发补助，该款项无需偿还，将在未来年度逐渐确认为收入。2011年9月末，同方微电子的各种补助中来自工信部为3,295.00万元，占期末专项应付款总额的比例为83.17%，主要是非接触式IC卡芯片优化项目、电子标签芯片及读写器研发项目、基于国密算法的高安全性多应用CPU卡芯片系列产业化项目、大容量SIM卡芯片项目等补助。

### 3、标的资产财务状况指标分析

#### (1) 同方微电子最近三年及一期的财务指标

根据兴华事务所出具的审计报告，交易标的最近三年一期的财务指标如下：

项目	2011.9.30 或 2011年1-9月	2011.3.31 或 2011年1-3月	2010.12.31 或 2010年度	2009.12.31 或 2009年度	2008.12.31 或 2008年度
流动比率(倍)	3.86	4.64	4.82	3.18	2.33
速动比率(倍) [注1]	3.55	4.41	4.55	2.98	1.82
应收账款周转率(次/年) [注2]	1.98	0.76	3.01	3.84	3.04
存货周转率(次/年) [注3]	3.35	1.60	5.91	3.15	2.06
资产负债率(%)	29.25%	25.80%	25.29%	35.16%	45.69%

注1：速动比率=（流动资产期末数-存货期末数）/流动负债期末数

注2：应收账款周转率=计算期间营业收入/[(计算期应收账款期初数+期末数)/2]

注3：存货周转率=计算期间营业成本/[(计算期存货期初数+期末数)/2]

2008年末、2009年末、2010年末、2011年9月末，同方微电子的流动比率分别为2.33、3.18、4.82、3.86，速动比率分别为1.82、2.98、4.55、3.55。报告期的前三年度，同方微电子的流动比率与速动比率逐渐提高，主要是标的资产的应付票据、应付股利等流动负债的减少。2011年9月末，同方微电子的流动比率与速动比率比2010年末降低，主要是由于产品订单增加，使应付原材料采购款增加。

2008年度、2009年度、2010年度、2011年1-9月，同方微电子存货周转率

分别为 2.06、3.15、5.91、3.35，呈逐渐提高的趋势。存货周转率提高的主要是因为 2010 年度以后，标的资产的国家二代居民身份证芯片销量大幅减少，使存货采购量和存货保有量也大幅减少，使存货周转率提高。同方微电子主要根据客户订单来安排生产，以销定产的销售模式可以降低企业存货平均余额，降低存货占用资金使用费。随着同方微电子存货管理的进一步加强，各种产品的生产、销售更加合理化，存货周转率将进一步提高。

2008 年度、2009 年度、2010 年度、2011 年 1-9 月，同方微电子应收账款周转率分别为 3.04、3.84、3.01、1.98。2010 年度、2011 年 1-9 月，同方微电子的应收账款周转率降低，主要是因为 2010 年以后年度国家二代居民身份证芯片销量下降使标的资产的销售收入下降，但国家二代居民身份证芯片的应收账款收款期相对较长，2011 年 9 月末尚有对公安部第一研究所的应收账款 7,827.84 万元，占 2011 年 9 月末同方微电子应收账款总额的比例为 48.79%。随着该款项的收回，同方微电子的应收账款周转率将逐渐提高，应收账款周转率变化趋势将与存货周转率的变化趋同。

2008 年末、2009 年末、2010 年末、2011 年 9 月末，同方微电子的资产负债率分别为 45.69%、35.16%、25.29%、29.25%，呈逐渐下降的趋势。同方微电子的盈利能力较强，现金流较为充足，净资产规模不断增长，使公司的资产负债率不断降低。目前，公司不存在任何有息负债。

## (2) 财务指标分析

### ① 偿债能力

下表列举了证监会行业分类中电子元器件业（剔除净利润或每股收益为负的公司）不同市值水平可比上市公司的偿债能力财务指标，与同方微电子的偿债能力财务指标进行比较：

公司名称	流动比率		速动比率		资产负债率 (%)	
	2011.3.31	2010.12.31	2011.3.31	2010.12.31	2011.3.31	2010.12.31
金龙机电	21.02	14.17	20.49	13.62	4.04	6.02
超声电子	1.44	1.38	1.10	1.06	41.32	42.39
亿纬锂能	4.89	4.49	4.16	3.86	14.42	15.68

欧比特	13.63	13.66	12.79	12.91	6.05	6.05
康强电子	1.31	1.34	0.82	0.85	51.46	51.48
福晶科技	5.44	5.42	4.56	4.63	9.71	9.86
长电科技	1.03	1.22	0.77	0.89	50.27	46.47
东晶电子	2.26	1.50	1.69	0.89	34.14	49.09
苏州固得	1.36	1.45	0.87	0.88	35.28	33.12
得润电子	1.78	1.13	1.48	0.89	48.95	70.54
旭光股份	3.40	2.08	2.87	1.59	23.28	35.04
联创光电	1.48	1.51	1.04	1.05	40.59	41.25
超华科技	1.69	1.86	1.16	1.33	33.63	29.93
华微电子	1.13	1.14	0.94	0.96	48.53	49.40
广电电子	8.28	7.44	8.03	7.27	6.96	7.81
上电 B 股	8.28	7.44	8.03	7.27	6.96	7.81
振华科技	2.16	2.24	1.37	1.52	35.88	33.50
实益达	1.28	1.20	1.05	0.98	56.30	61.73
睿胜超微	1.12	1.17	0.80	0.90	55.29	51.31
科力远	1.70	1.64	1.38	1.42	40.34	43.31
新嘉联	2.34	2.16	1.79	1.60	25.08	26.60
利达光电	2.37	2.21	2.00	1.87	32.13	29.00
航天电器	4.94	4.95	3.75	3.78	16.51	16.28
福星晓程	12.94	10.67	12.13	9.94	7.73	9.28
国民技术	18.16	18.00	17.49	17.30	5.59	5.71
晶源电子	5.82	4.01	4.33	2.96	10.00	13.86
华天科技	1.13	1.52	0.92	1.29	44.77	41.53
乾照光电	53.52	31.26	51.53	30.42	3.80	4.81
中科三环	1.62	1.72	0.99	1.04	43.17	38.31
风华高科	1.70	1.89	1.20	1.45	29.05	26.87
中航光电	2.07	2.10	1.56	1.61	50.18	49.90
银河磁体	12.83	17.52	11.71	16.37	7.22	5.45

通富微电	1.75	1.70	1.55	1.54	36.68	41.33
宇顺电子	2.13	2.05	1.69	1.65	42.52	44.61
广州国光	1.69	1.72	1.17	1.16	50.28	49.35
沪电股份	2.98	3.29	2.72	3.02	26.32	24.45
顺络电子	2.33	1.14	1.87	0.73	27.35	37.98
生益科技	1.19	1.33	0.89	1.02	52.24	47.97
士兰微	1.58	1.78	1.16	1.40	35.60	34.90
欧菲光	2.49	3.14	1.99	2.63	42.98	28.32
江海股份	6.52	5.67	5.45	4.89	11.87	13.81
中航电测	6.33	7.70	5.73	7.37	15.43	13.52
歌尔声学	1.30	1.42	1.08	1.20	50.73	47.93
漫步者	10.22	11.46	9.51	10.68	8.07	7.19
立讯精密	5.15	5.64	4.80	5.43	18.81	16.45
横店东磁	1.67	1.83	1.21	1.39	29.92	26.89
水晶光电	7.20	5.38	6.29	4.77	11.38	13.09
国星光电	10.09	8.90	8.72	7.77	9.79	10.68
莱宝高科	9.23	4.50	8.47	4.19	9.62	16.22
和而泰	4.42	5.24	3.73	4.57	18.96	16.42
劲胜股份	3.30	4.17	2.71	3.59	21.31	18.32
南洋科技	6.40	12.14	5.90	11.51	12.80	7.85
英唐智控	9.02	10.55	7.31	9.11	10.29	8.88
长信科技	27.81	14.62	26.87	13.92	2.59	5.02
法拉电子	4.00	3.84	3.08	2.96	16.92	16.98
锦富新材	4.46	5.07	4.08	4.69	18.90	17.81
台基股份	12.56	12.65	11.51	11.83	8.00	7.67
兴森科技	5.65	5.07	5.33	4.85	12.66	13.24
长盈精密	13.37	9.41	11.46	8.14	6.75	9.64
<b>行业可比公司均值</b>	<b>6.25</b>	<b>5.47</b>	<b>5.61</b>	<b>4.92</b>	<b>25.89</b>	<b>26.37</b>
<b>同方微电子(2011.3.31 或2010.12.31)</b>	<b>4.64</b>	<b>4.82</b>	<b>4.41</b>	<b>4.55</b>	<b>25.80</b>	<b>25.29</b>

注：数据来源于 wind 资讯。

2010 年末同方微电子的流动比率和速动比率分别为 4.82 和 4.55，2011 年 3 月末，同方微电子的流动比率和速动比率分别为 4.64 和 4.41。同方微电子流动比率和速动比率低于可比上市公司平均水平，但仍保持较好的流动性。同方微电子的盈利能力较强，现金流充足，不存在任何有息负债。同方微电子无短期偿债压力。

2010 年末、2011 年 3 月末，同方微电子的资产负债率分别为 25.29%和 25.80%，略低于可比上市公司的平均水平。同方微电子的非流动负债均为专项应付款，该款项为政府补助性质，无需偿还。同方微电子有较强的偿债能力。

## ② 营运能力

下表列举了证监会行业分类中电子元器件业（剔除净利润或每股收益为负的公司）不同市值水平可比上市公司的营运能力财务指标，与同方微电子的营运能力财务指标进行比较：

公司名称	应收账款周转率（次/年）		存货周转率（次/年）	
	2011 年 1-3 月	2010 年度	2011 年 1-3 月	2010 年度
金龙机电	0.75	2.87	1.62	6.74
超声电子	1.04	4.51	1.33	6.01
亿纬锂能	0.59	2.99	0.93	3.72
欧比特	0.43	2.77	0.93	4.89
康强电子	1.08	4.38	0.83	3.88
福晶科技	1.24	6.31	0.34	1.64
长电科技	2.24	8.74	1.72	7.07
东晶电子	1.25	6.81	0.43	3.43
苏州固锝	1.70	7.47	1.20	5.21
得润电子	0.88	3.45	1.08	4.76
旭光股份	0.71	3.52	0.49	2.20
联创光电	0.83	3.48	0.81	3.38
超华科技	0.43	2.18	0.38	2.22

华微电子	1.07	4.50	0.68	3.12
广电电子	0.96	4.36	3.08	12.71
上电 B 股	0.96	4.36	3.08	12.71
振华科技	1.58	6.89	0.90	3.70
实益达	0.99	4.27	2.09	8.97
蓉胜超微	1.21	5.32	2.28	10.40
科力远	2.09	9.60	1.84	10.28
新嘉联	0.76	3.67	0.90	4.72
利达光电	0.80	3.61	1.39	8.44
航天电器	0.78	3.16	0.38	1.38
福星晓程	0.34	2.43	0.39	2.38
国民技术	0.93	6.17	0.86	3.75
晶源电子	1.05	4.62	0.98	4.84
华天科技	1.20	5.50	1.85	8.29
乾照光电	0.48	2.68	0.53	4.13
中科三环	1.16	4.58	0.70	3.33
风华高科	1.49	6.35	1.25	5.12
中航光电	0.66	2.96	0.61	2.59
银河磁体	1.05	4.06	1.10	5.68
通富微电	1.30	6.43	1.51	7.95
宇顺电子	1.22	5.69	1.10	4.45
广州国光	0.75	3.82	0.64	3.56
沪电股份	1.01	4.42	2.63	10.71
顺络电子	1.11	4.96	0.62	2.53
生益科技	0.78	3.34	1.43	7.04
士兰微	1.03	5.17	0.65	3.24
欧菲光	1.42	5.02	0.96	4.23
江海股份	1.01	4.54	1.02	4.72
中航电测	0.72	3.81	1.07	8.03
歌尔声学	1.10	6.21	1.53	8.15

漫步者	6.48	26.50	1.56	5.76
立讯精密	0.72	2.90	2.89	12.73
横店东磁	1.89	7.00	1.54	7.03
水晶光电	1.12	4.89	0.92	6.22
国星光电	1.26	6.25	0.73	3.44
莱宝高科	1.56	7.12	1.22	6.65
和而泰	0.89	4.12	0.84	4.31
劲胜股份	3.13	15.75	1.14	6.56
南洋科技	1.89	7.79	1.09	5.83
英唐智控	1.33	5.84	0.90	5.76
长信科技	0.93	4.33	2.00	8.40
法拉电子	1.05	4.64	0.91	4.19
锦富新材	0.85	4.10	1.73	7.89
台基股份	2.23	17.01	0.62	3.60
兴森科技	1.16	5.72	2.42	11.96
长盈精密	1.31	5.47	0.62	2.46
<b>行业可比公司均值</b>	<b>1.22</b>	<b>5.62</b>	<b>1.21</b>	<b>5.75</b>
<b>同方微电子 (2010年度 或2011年一季度)</b>	<b>0.76</b>	<b>3.01</b>	<b>1.60</b>	<b>5.91</b>

注：数据来源于 wind 资讯。

2009 年度、2010 年度、2011 年 1-3 月，同方微电子的存货周转率分别为 3.15、5.91、1.60，呈上升趋势。2009 年度同方微电子的存货周转率低于可比上市公司平均水平，2010 年度、2011 年 1-3 月的存货周转率高于同期可比上市公司平均水平。2009 年度，同方微电子的存货周转率较低主要是由于 2008 年度、2009 年度是同方微电子主要产品国家第二代居民身份证芯片卡的销售高峰期，每年销售芯片约为 4000-5000 万颗左右，为了满足销售需求，防止因库存不足而失去销售机会，标的资产存货的保有量较高。2010 年以后，国家第二代居民身份证芯片的销售将处于稳定期，预计每年销售芯片约 2,000 万-2,500 万颗，标的资产存货的保有量下降，因此，同方微电子 2009 年末的存货账面余额下降，2010 年度的存货周转率上升。随着同方微电子存货管理的进一步加强，各种产品的生产、销

售更加合理化，存货周转率将进一步提高。

2009年度、2010年度、2011年1-3月，同方微电子应收账款周转率分别为3.84、3.01、0.76，低于可比上市公司平均水平。2010年度，同方微电子的应收账款周转率较低，主要是因为2010年度国家二代居民身份证芯片销量下降，使标的资产的销售收入下降，但国家二代居民身份证芯片的应收账款收款期相对较长，2011年3月末尚有对公安部第一研究所的应收账款5,260.62万元，占2011年3月末同方微电子应收账款总额的比例为41.15%。除国家二代居民身份证芯片外，同方微电子的其他主要产品的应收账款平均收款期较短，约为60天。随着国家二代居民身份证芯片销售款的收回，以及其他主要产品销售收入的提高，同方微电子的应收账款周转率将逐渐提高。

## （二）交易标的经营成果分析

根据兴华事务所出具的审计报告，交易标的最近三年一期的盈利情况如下：

单位：万元

项 目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	26,803.96	34,428.56	45,005.68	39,666.52
营业成本	16,633.33	23,410.11	27,873.56	24,073.14
营业税金及附加	162.09	212.11	486.55	233.37
销售费用	617.54	569.98	544.34	651.68
管理费用	1,788.42	2,460.71	4,424.94	4,028.14
财务费用	-721.64	-467.79	-451.57	-386.35
资产减值损失	48.73	-0.99	-157.19	130.60
营业利润	8,275.48	8,267.48	12,285.05	10,935.94
利润总额	8,265.48	8,263.17	12,478.61	11,549.41
<b>净利润</b>	<b>7,052.43</b>	<b>7,035.96</b>	<b>10,108.90</b>	<b>10,572.42</b>

### 1、同方微电子的营业收入变化趋势、构成及其变化原因分析

（1）根据兴华事务所出具的审计报告，同方微电子最近三年一期的营业收入结构情况如下：

单位：万元

项 目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
主营业务收入	26,803.96	34,428.56	45,005.68	39,666.52
其他业务收入	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>26,803.96</b>	<b>34,428.56</b>	<b>45,005.68</b>	<b>39,666.52</b>

报告期内，同方微电子2009年度营业收入比2008年度增加了5,339.16万元，增长幅度为13.46%，主要原因是2009年度移动通信产品销售收入比2008年度增加了3,880.74万元，增长幅度为36.95%。同方微电子2010年度营业收入比2009年下降，主要原因是身份识别产品—国家二代居民身份证芯片销售收入下降引起的。公安部于2004年度开始换发国家第二代居民身份证，同方微电子是国家第二代居民身份证芯片的四家供应商之一。2006年至2009年度是二代身份证换发的高峰期，每年销售芯片约为4000-5000万颗左右，2010年至2014年为稳定期，每年销售芯片2,000-2,500万颗。2011年1-9月，同方微电子的金融支付产品销售收入大幅增加，移动通信产品销售收入有所下降。

未来年度，同方微电子在国家二代居民身份证芯片的销售收入趋于稳定，移动通信产品、金融支付产品以及其他身份识别芯片产品的销售收入将逐渐提高，营业收入总额将逐渐提高。

(2) 主营业务收入产品结构如下：

单位：万元

项 目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
身份识别产品	13,672.53	15,103.90	30,594.51	29,093.62
移动通信产品	10,576.86	19,079.97	14,382.06	10,501.32
金融支付产品	2,554.56	244.68	29.11	71.58
<b>合计</b>	<b>26,803.96</b>	<b>34,428.56</b>	<b>45,005.68</b>	<b>39,666.52</b>

标的资产2008年度、2009年度的营业收入主要来自身份识别产品，占各年度营业收入总额的比重分别为73.35%、67.98%，2010年度，身份识别产品销售收入占营业收入总额的比重下降为43.87%，移动通信产品销售收入占营业收入总额的比重上升为55.42%。2011年1-9月，金融支付产品销售收入占营业收入总额的比重上升为9.53%。

### ①身份识别产品的营业收入变化分析

2008年度、2009年度，标的资产身份识别产品销售收入分别为29,093.62万元、30,594.51万元，基本持平。2010年度、2011年1-9月，身份识别产品销售收入为15,103.90万元、13,672.53万元，与前两年度同期相比大幅减少，主要原因是2010年度国家第二代居民身份证芯片销量大幅下降，由2009年度的4,721万颗降低到2,296万颗。

公安部于2004年度开始换发国家第二代居民身份证，同方微电子是国家二代身份证芯片的主要供应商，2007、2008、2009年度是二代身份证换发的高峰期，2010年-2014年为稳定期。2007年至2010年，同方微电子二代身份证芯片的供应数量分别为5,965万张、4,419万张、4,721万张，2,296万张，2010年度换发数量显著下降。预计2010年-2014年，同方微电子的国家二代身份证芯片的销量稳定在2,000-2,500万颗。

### ②移动通信产品的营业收入变化分析

2008年度、2009年度、2010年度，标的资产移动通信产品销售收入分别为10,501.32万元、14,382.06万元、19,079.97万元，呈逐年上升的趋势。2010年度，标的资产的移动通信产品销售收入超过身份识别芯片，占营业收入总额的比重达到55.42%。

2011年1-9月份，标的资产的移动通信产品销售收入收入为10,576.86万元，较2010年度有一定下降，下降的主要原因是公司2011年移动通信产品以模块形式（成品测试以后）销售的产品比例下降，以裸片形式（减薄划片以后）销售的产品比例上升，前者销售价格比后者高。2010年移动通信芯片以模块方式和裸片方式销售的比例大约为50%和50%，2011年1—9月份，芯片以模块方式和裸片方式销售的比例大约为35%和65%。另外，随着移动通信市场竞争的加剧，产品销售价格比2010年度有所下降。根据以往市场趋势，四季度为移动通信芯片出货旺季，同时，三季度末公司有超过4,000万颗芯片已经发货但是尚未确认为收入，2011年全年预计销售收入将在2011年三季度基础上有较大提高。

移动通信产品主要为手机SIM卡芯片。同方微电子的手机SIM卡芯片

自 2006 年进入市场以来，销量逐年增长，已经成为国内最大的手机 SIM 卡芯片供应商。目前，同方微电子的 SIM 卡芯片主要为小容量 SIM 卡芯片，该产品毛利率较低，自 2010 年起，标的资产研发的大容量 SIM 卡芯片逐渐投入市场，公司将在保持小容量 SIM 卡芯片市场份额的情况下，逐渐提升大容量 SIM 卡芯片市场份额。随着大容量 SIM 卡以及其它高附加值产品的普及，未来同方微电子移动通信产品的销售收入和利润都将有所提高。

### ③金融支付产品的营业收入变化分析

2008 年至 2010 年，标的资产在金融支付产品的销售收入较小。金融支付产品主要为网络银行 USB-Key 应用芯片。目前，网络银行支付采用双因素认证，除了密码口令之外，USB-key 是应用最广泛的一种实体介质型认证因素。近几年，同方微电子致力于 USB-Key 应用芯片的研发，不断创新，报告期内，部分产品小批量生产，并投入市场。同方微电子现有的 USB-key 应用芯片产品，于 2010 年通过国家有关主管部门的相关资质认证，并完成重点客户的开发试用，在 2010 年以后年度形成较大批量的生产销售。同时，公司在 2011 年将推出新一代的 USB-key 芯片，以满足高端客户的需求。2011 年 1-9 月，同方微电子的金融支付产品的销售收入为 2,554.56 万元，金融支付产品的销售额与销售比重都明显提高。

## 2、主营业务毛利率及其变动情况分析

### (1) 同方微电子最近三年一期毛利率变化分析

根据兴华事务所出具的审计报告，报告期内同方微电子主营业务毛利率的变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2011 年 1-9 月			2010 年度			2009 年度			2008 年度		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
身份识别产品	13,672.53	5,147.72	62.35%	15,103.90	6,031.04	60.07%	30,594.51	13,669.92	55.32%	29,093.62	14,078.06	51.61%
移动通信产品	10,576.86	9,923.63	6.18%	19,079.97	17,180.81	9.95%	14,382.06	14,182.73	1.39%	10,501.32	9,948.33	5.27%
金融支付产品	2,554.56	1,561.98	38.86%	244.68	198.26	18.97%	29.11	20.9	28.20%	71.58	46.75	34.69%
合计	<b>26,803.96</b>	<b>16,633.33</b>	<b>37.94%</b>	<b>34,428.56</b>	<b>23,410.11</b>	<b>32.00%</b>	<b>45,005.68</b>	<b>27,873.56</b>	<b>38.07%</b>	<b>39,666.52</b>	<b>24,073.14</b>	<b>39.31%</b>

最近三年一期，同方微电子身份识别产品的毛利率较高，主要是由于国家第二代居民身份证芯片毛利率较高。国家第二代居民身份证芯片属于政府采购产

品，同方微电子是国内四家供应商之一，该产品价格较为稳定，基本不存在同业竞争，毛利率将维持较高水平。

最近三年一期，同方微电子移动通信产品的毛利率均较低，主要原因是：为开拓市场，在产品布局方面，同方微电子采取从市场需求量较大的低端产品开始进入市场的销售策略。同方微电子电信通讯芯片自 2006 年开始形成销售以来，销量连年翻番，2008 年销量超过 1 亿颗，2009 年销售 2 亿颗，2010 年电信智能卡销量超过 3 亿颗。自 2010 年起，同方微电子研发的大容量 SIM 卡芯片逐渐投入市场，公司将在保持小容量 SIM 卡芯片市场份额的情况下，逐渐提升大容量 SIM 卡芯片市场份额。随着大容量 SIM 卡以及其它高附加值产品的普及，同方微电子移动通信产品的收入和毛利率都将逐渐上升。2011 年 1-9 月，同方微电子移动通信产品的毛利率为 6.18%，低于 2010 年度，主要原因是根据客户的需求，2011 年 1-9 月同方微电子移动通信产品主要以裸片芯片销售为主，产品的加工环节比 2010 年简化，毛利率有所降低。

报告期内，同方微电子金融支付产品的毛利率较高。2008 年至 2010 年，同方微电子致力于 USB-Key 应用芯片的研发，部分产品小批量生产，并投入市场。同方微电子现有的 USB-key 应用芯片产品，于 2010 年通过国家有关主管部门的相关资质认证，并已经完成重点客户的开发试用。于 2011 年开始全面进入市场，形成大批量生产、销售，市场占有率将有望超过 10%。2011 年 1-9 月，同方微电子的金融支付产品的销售收入为 2,554.56 万元，毛利率为 38.86%，金融支付产品的销售额与毛利率都明显提高。金融支付产品具有较高的利润空间，将成为同方微电子未来年度的主要利润产生点。

2008 年、2009 年、2010 年度、2011 年 1-9 月，同方微电子主要产品的综合毛利率整体保持在 30%以上的较高水平，2010 年度主要产品的综合毛利率下降，主要原因是身份识别产品销售额下降引起的。2008 年度、2009 年度，身份识别产品收入占营业收入总额的比重分别为 73.35%、67.98%，2010 年度，身份识别产品收入占营业收入总额的比重下降为 43.87%。身份识别产品的毛利率较高，因此，其收入占营业收入总额的比重下降引起同方微电子综合毛利率的下降。2011 年 1-9 月，同方微电子主要产品的综合毛利率比 2010 年度提高，主要原因是 2011 年 1-9 月同方微电子金融支付产品占营业收入总额的比重比 2010 年度有

所提高，该类产品的毛利率较高，使 2011 年 1-9 月的综合毛利率提高。2011 年以后年度，同方微电子的国家第二代居民身份证芯片的销售额将保持稳定，移动通讯产品、金融支付产品将随着高端产品的批量生产、销售使销售收入及销售毛利仍将逐步提高。

(2) 与可比上市公司毛利率水平的比较

公司名称	毛利率 (%)	
	2011 年 1-3 月	2010 年度
金龙机电	32.79	29.73
超声电子	20.21	19.75
亿纬锂能	27.40	29.70
欧比特	36.32	35.68
康强电子	12.89	15.14
福晶科技	63.45	56.57
长电科技	21.36	24.46
东晶电子	14.75	20.65
苏州固得	16.40	17.92
得润电子	17.45	18.82
旭光股份	21.18	23.60
联创光电	16.53	17.21
超华科技	17.10	21.19
华微电子	28.62	30.56
广电电子	16.04	13.63
上电 B 股	16.04	13.63
振华科技	15.53	15.91
实益达	7.38	6.82
蓉胜超微	7.80	9.06
科力远	6.86	9.05
新嘉联	15.64	21.84
利达光电	13.11	16.86
航天电器	43.57	46.00
福星晓程	41.17	48.18
国民技术	45.98	47.27
晶源电子	24.83	25.72
华天科技	21.29	23.09
乾照光电	64.35	61.24
中科三环	20.84	25.19
风华高科	15.59	24.42

中航光电	32.03	35.44
银河磁体	25.37	29.06
通富微电	16.52	17.10
宇顺电子	13.20	14.00
广州国光	17.00	19.00
沪电股份	19.47	22.27
顺络电子	36.00	45.50
生益科技	17.88	16.87
士兰微	31.17	35.48
欧菲光	14.87	22.65
江海股份	20.60	20.60
中航电测	34.00	35.29
歌尔声学	26.55	25.25
漫步者	28.19	30.38
立讯精密	16.64	18.77
横店东磁	20.08	24.50
水晶光电	53.56	47.38
国星光电	22.97	30.73
莱宝高科	57.35	55.08
和而泰	17.92	21.56
劲胜股份	22.08	23.08
南洋科技	42.19	36.94
英唐智控	16.57	19.51
长信科技	42.23	38.62
法拉电子	38.34	37.06
锦富新材	24.50	25.34
台基股份	37.32	42.39
兴森科技	41.05	38.16
长盈精密	36.63	37.32
<b>平均</b>	<b>26.18</b>	<b>27.70</b>
<b>同方微电子的综合 毛利率</b>	<b>37.14</b>	<b>32.00</b>

注：数据来源于 wind 资讯。

报告期内，同方微电子的综合毛利率水平显著高于可比上市公司同期平均水平，其中 2010 年度高出 15.52%、2011 年 1-3 月高出 41.86%，主要原因分析如下：

①产品科技含量高

同方微电子主营业务与传统的电子元器件行业有所不同，其主要产品均系自主研发，投入市场初期，毛利较高。同方微电子主要产品的科技含量较高，市场对该领域产品的要求也较为严格，行业门槛较高，市场竞争较少，如国家第二代居民身份证芯片。同方微电子是最早取得二代居民身份证芯片技术，并申请国家专利的四家机构之一，也成为公安部二代居民身份证芯片的四家供应商之一，国家第二代居民身份证芯片属于政府采购产品，该产品价格较为稳定，基本不存在同业竞争，毛利率维持较高水平。

### ②委托加工生产，降低成本

同方微电子的生产经营模式与传统的电子元器件制造业也有所不同。同方微电子无自有的生产车间和生产设备，采用Fabless经营模式，即在集成电路芯片产品的生产流程中，公司将芯片的制造、封装、测试工序全部外包，具体流程为：接到客户的芯片订单后，公司自行采购所需的原材料，并将芯片设计图交给代工厂商，然后由代工厂商将代工后的芯片直接发送给封装企业进行封装，封装完成后的芯片再交由测试企业进行测试，测试合格的产品由公司交付客户。

同方微电子的代工厂商多为国内外知名的电子元器件加工厂商。同方微电子采取委托代工方式进行主要产品生产，企业自身专注于从事集成电路等各种高科技产品的研发活动，这种优势互补的生产经营模式，有效地提升了生产效率和产品质量，降低了产品成本。

## 3、期间费用

(1) 根据兴华事务所出具的审计报告，报告期内同方微电子的期间费用如下表所示：

单位：万元

项 目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
销售费用	617.54	569.98	544.34	651.68
管理费用	1,788.42	2,460.71	4,424.94	4,028.14
财务费用	-721.64	-467.79	-451.57	-386.35
<b>期间费用合计</b>	<b>1,684.32</b>	<b>2,562.90</b>	<b>4,517.71</b>	<b>4,293.47</b>
<b>期间费用率</b>	<b>6.28%</b>	<b>7.44%</b>	<b>10.04%</b>	<b>10.82%</b>

报告期内，同方微电子的期间费用率总体保持较低水平，并呈逐渐下降的趋势。2008年度、2009年度，同方微电子的期间费用变化不大。2010年度、2011年1-9月，同方微电子的期间费用与前两年度同期相比有较大幅度减少，主要是管理费用的减少。同方微电子的管理费用中，研发支出占较大比重。同方微电子的大容量SIM卡芯片将逐渐投入市场，且有着良好的盈利空间，2010年度、2011年1-9月，公司将大容量SIM卡芯片研发支出予以资本化，使同方微电子2010年度的管理费用有所下降。另外，同方微电子加强公司管理，节约各项开支和成本，也使管理费用有所下降。

报告期内，同方微电子的销售费用金额较小，主要原因是同方微电子的产品质量较好，市场信誉度高，客户较为稳定，产品销售渠道通畅，且多项产品属于政府采购，因此其销售费用较少。

报告期内，同方微电子的财务费用均为负值，主要是因为同方微电子现金流充足，无任何有息负债，且有较大金额的定期存款和银行协定存款，因此，财务费用均为负值。

## (2) 与可比上市公司期间费用率水平的比较

公司名称	期间费用率 (%)	
	2011年1-3月	2010年度
金龙机电	10.29	10.88
超声电子	11.47	11.44
亿纬锂能	8.23	7.52
欧比特	7.05	15.89
康强电子	12.23	10.12
福晶科技	22.89	19.31
长电科技	15.60	17.29
东晶电子	3.80	13.29
苏州固锴	9.50	8.37
得润电子	9.27	10.24
旭光股份	16.57	18.98

联创光电	18.26	17.42
超华科技	11.39	7.93
华微电子	22.62	19.79
广电电子	19.23	19.74
上电 B 股	19.23	19.74
振华科技	12.87	12.83
实益达	3.18	4.13
蓉胜超微	6.11	6.87
科力远	8.94	8.25
新嘉联	17.05	18.39
利达光电	19.54	14.06
航天电器	20.86	25.27
福星晓程	15.04	14.80
国民技术	21.85	24.87
晶源电子	9.33	9.96
华天科技	10.38	12.12
乾照光电	15.56	13.19
中科三环	13.50	12.97
风华高科	9.80	12.23
中航光电	22.66	21.10
银河磁体	6.96	10.52
通富微电	16.28	11.03
宇顺电子	9.29	8.51
广州国光	14.03	12.75
沪电股份	8.79	9.90
顺络电子	15.46	19.56
生益科技	6.28	6.47
士兰微	19.28	17.60
欧菲光	11.29	13.38
江海股份	10.94	11.19

中航电测	20.60	18.14
歌尔声学	14.48	12.17
漫步者	12.58	15.63
立讯精密	5.53	4.51
横店东磁	14.16	9.55
水晶光电	16.24	13.75
国星光电	9.23	10.76
莱宝高科	5.76	8.94
和而泰	8.26	11.56
劲胜股份	16.44	14.19
南洋科技	-1.50	9.63
英唐智控	13.76	10.15
长信科技	8.38	11.25
法拉电子	11.44	11.47
锦富新材	8.70	9.61
台基股份	6.88	6.50
兴森科技	22.48	18.61
长盈精密	13.13	14.13
平均	12.70	13.06
<b>同方微电子的期间费用率</b>	<b>9.63</b>	<b>7.44</b>

注：数据来源于 wind 资讯。

报告期内，同方微电子的期间费用率均低于可比上市公司同期平均水平，主要由于与其他可比上市公司相比，同方微电子的资产负债率较低，且无有息负债，且定期存款和银行协定存款较多，致使财务费用负值；同时，同方微电子产品质量好、产品供货稳定，公司信誉好，也使同方微电子在销售和管理方面的费用较少。

#### 4、同方微电子盈利指标分析

表列举了证监会行业分类中电子元器件业(剔除净利润或每股收益为负的公司)不同市值水平可比上市公司的盈利能力财务指标，与同方微电子的盈利能力

财务指标进行比较：

公司名称	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
	2011年1-3月	2010年度	2011年1-3月	2010年度
金龙机电	1.29	4.85	0.08	0.28
超声电子	2.31	9.90	0.09	0.36
亿纬锂能	2.28	10.11	0.10	0.43
欧比特	1.79	8.38	0.10	0.31
康强电子	0.86	11.02	0.03	0.35
福晶科技	2.96	10.58	0.09	0.32
长电科技	1.64	10.23	0.05	0.27
东晶电子	1.29	11.33	0.04	0.28
苏州固锴	3.84	12.86	0.08	0.25
得润电子	2.96	17.26	0.11	0.35
旭光股份	0.20	14.75	0.01	0.58
联创光电	1.30	5.84	0.03	0.14
超华科技	0.51	4.40	0.02	0.15
华微电子	0.69	5.38	0.02	0.16
广电电子	2.28	7.41	0.04	0.13
上电B股	2.28	7.41	0.04	0.13
振华科技	0.56	1.87	0.03	0.10
实益达	2.95	5.30	0.06	0.10
蓉胜超微	0.64	5.23	0.02	0.14
科力远	-0.56	2.31	-0.02	0.07
新嘉联	-0.35	1.40	-0.01	0.03
利达光电	-1.30	3.28	-0.03	0.08
航天电器	2.44	9.47	0.10	0.36
福星晓程	1.02	9.70	0.20	1.10
国民技术	1.55	12.10	0.39	1.77
晶源电子	2.41	8.90	0.08	0.28

公司名称	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
	2011年1-3月	2010年度	2011年1-3月	2010年度
华天科技	2.42	11.60	0.07	0.30
乾照光电	2.09	14.77	0.29	1.39
中科三环	2.07	15.46	0.06	0.41
风华高科	1.04	10.55	0.04	0.33
中航光电	2.24	13.87	0.07	0.40
银河磁体	1.61	9.61	0.09	0.41
通富微电	0.90	8.70	0.05	0.40
宇顺电子	1.10	6.17	0.07	0.39
广州国光	0.86	10.14	0.04	0.43
沪电股份	2.24	14.47	0.10	0.51
顺络电子	2.68	16.50	0.12	0.50
生益科技	5.29	21.87	0.15	0.56
士兰微	2.52	20.72	0.10	0.62
欧菲光	0.61	8.59	0.06	0.64
江海股份	1.55	10.85	0.12	0.66
中航电测	1.40	11.72	0.12	0.76
歌尔声学	3.55	22.03	0.16	0.76
漫步者	1.84	10.42	0.19	0.67
立讯精密	1.64	11.79	0.16	0.82
横店东磁	1.93	14.05	0.13	0.88
水晶光电	5.72	21.07	0.25	0.83
国星光电	1.24	11.84	0.12	0.81
莱宝高科	5.91	23.97	0.29	1.05
和而泰	1.34	9.39	0.15	0.71
劲胜股份	0.90	10.66	0.11	0.84
南洋科技	3.10	13.11	0.34	0.95
英唐智控	0.73	10.23	0.04	0.85
长信科技	3.11	15.71	0.29	1.04

公司名称	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
	2011年1-3月	2010年度	2011年1-3月	2010年度
法拉电子	5.64	22.22	0.30	1.09
锦富新材	2.30	12.53	0.26	1.02
台基股份	1.77	16.01	0.21	1.16
兴森科技	2.03	14.33	0.26	1.24
长盈精密	2.48	12.23	0.35	1.27
<b>行业可比公司均值</b>	<b>1.93</b>	<b>11.33</b>	<b>0.12</b>	<b>0.56</b>
<b>同方微电子</b>	<b>3.87</b>	<b>14.56</b>	<b>0.19</b>	<b>0.66</b>

注：同方微电子的每股收益=计算期同方微电子的净利润/本次交易晶源电子拟发行股份

2010年度、2011年1-3月，标的资产的净资产收益率分别为14.56%、3.87%，均高于可比上市公司同期平均水平，说明标的资产的盈利能力较强。

2010年度、2011年1-3月，标的资产的每股收益分别为0.66元/股、0.19元/股，均高于可比上市公司同期平均水平，说明标的资产具有较强的盈利能力，能给股东带来满意的投资回报，充分保护广大中小股东的利益。

2011年1-9月，标的资产的净资产收益率和每股收益分别为12.74%和0.66元/股，高于上年同期水平。标的资产盈利状况较好。

### 5、2011年盈利预测实现情况分析

北京兴华事务所审核了标的资产同方微电子编制的2011年度的盈利预测报告，并出具了（2010）京会兴核字第1-52号审核报告。根据盈利预测报告，同方微电子2011年度预计可实现营业收入419,285,920.84元，净利润72,468,878.10元。截至2011年12月31日，根据同方微电子未经审计的财务报告，同方微电子2011年实际实现营业收入342,294,817.43元，净利润72,723,462.84元。具体如下：

单位：元

科目	实际金额	盈利预测金额
主营业务收入	342,294,817.43	419,285,920.84
主营业务成本	223,621,378.04	295,145,543.06

利润总额	85,341,061.72	85,257,503.65
净利润	72,723,462.84	72,468,878.10

同方微电子主要包括身份识别类、移动通信类和金融支付类三大产品线。

2011年三大产品线实现的收入、成本和毛利情况如下表所示：

单位：元

科目		实际金额	盈利预测金额
身份识别类产品线	营业收入	148,380,168.44	153,051,965.81
	营业成本	56,012,176.18	57,881,588.03
	毛利	92,367,992.26	95,170,377.78
移动通信类产品线	营业收入	154,727,047.72	215,124,955.03
	营业成本	143,773,063.58	201,253,955.03
	毛利	10,953,984.14	13,871,000.00
金融支付类产品线	营业收入	39,187,601.27	51,109,000.00
	营业成本	23,836,138.28	36,010,000.00
	毛利	15,351,462.99	15,099,000.00

#### (1) 2011年实现的销售收入未达到盈利预测值

根据2011年盈利预测报告，同方微电子预计2011年可实现销售收入4.19亿元，实际实现营业收入3.42亿元，有一定的差异。差异的主要原因是移动通信类产品线的销售收入未达到盈利预测，相差6,000万元。

移动通信类产品线收入未达到盈利预测的原因：公司2011年移动通信产品以模块形式（成品测试以后）销售的产品比例下降，以裸片形式（减薄划片以后）销售的产品比例上升，前者销售价格比后者高。2010年移动通信芯片以模块方式和裸片方式销售的比例大约为50%和50%，2011年，芯片以模块方式和裸片方式销售的比例大约为35%和65%。另外，随着移动通信市场竞争的加剧，2011年产品销售价格比2010年度有所下降。

2011年三季度，同方微电子完成了一种新的低成本移动通信芯片产品（新工艺和新供应商）开发，目前已完成样品研发和产品试生产等量产准备，2012年一季度将实现量产。在该新工艺平台上开发的移动通信产品与现有产品相比能较大幅度地降低成本，有效提升产品的持续竞争力，使产品的销量和毛利率得到提高。因此，2012年起公司的移动通信类产品将陆续全部移植到该新工艺平台，使公司移动通信类芯片单位成本显著下降，使该类产品销价具有持续竞争力，使

公司未来几年获得更大的销量。

金融支付类产品线收入未达到盈利预测的原因：由于国内银行对 USB Key 应用安全等级的提高，从 2011 年开始，国内银行全面采购二代 USB Key 产品，一代 USB Key 市场急剧萎缩，一些客户和同方微电子关于金融支付产品的采购计划被迫调整。因此，导致公司的 USB Key 产品的实际销售数量较盈利预测减少。目前，同方微电子针对 USB Key 市场的应用需求，已经对公司产品进行了升级，以满足二代 USB Key 市场的应用，主要客户已经完成了对公司二代 USB Key 产品的测试，2012 年初将会投入市场。

#### (2) 2011 年实现的净利润达到盈利预测值

根据 2011 年盈利预测报告，同方微电子预计 2011 年可实现净利润 7,246.89 万元，实际实现净利润 7,272.35 万元，实现了盈利预测。

2011 年度移动通信类产品线的收入较盈利预测有一定程度的下降，但是移动通信类产品的毛利率较低，只有 6%—7%，移动通信类产品销售收入的下降对公司整体毛利的影响较小。2011 年移动通信类产品线实现毛利 1,095.40 万元，仅比 2011 年盈利预测的 1,387.10 万元减少了 300 万元。

公司金融支付类产品线的产品种类较多，盈利预测时，公司基于谨慎角度，预测金融支付类产品线的毛利率为 29.54%。2011 年金融支付类产品线毛利率实际达到 39.17%，全年实现毛利 1,535.15 万元，超过了 2011 年盈利预测的 1,509.90 万元。

### 四、上市公司完成交易后的财务状况、盈利能力及未来盈利趋势分析

本次交易前，晶源电子是国内石英晶体元器件制造的龙头企业，石英晶体元器件作为频率选择与控制及时频基准元器件，在移动通讯、消费类电子产品、汽车电子、无线通讯产品等领域有着非常广泛的应用。

目前公司的石英晶体元器件产品以低档为主，中、高档产品发展较为缓慢，特别是高端通用芯片、基础软件和核心电子器件的研发能力和产业化水平与世界发达国家相比差距更大。虽然国内的低档电子元器件需求量近年来增幅较大，但

销售价格下滑较快，普通低档晶体元器件价格已经降到接近产品成本的水平，市场竞争激烈。

目前公司的营业总收入的80%以上来源于出口销售，面临一定的出口风险和汇率变动风险。公司产品的最终用户也多为大型跨国公司，全球的经济形势和电子信息产业的发展变化以及产品进口国或地区的进口政策，都可能对公司产品销售产生直接影响。

本次交易标的同方微电子是国家认定的高新技术企业和集成电路设计企业，主要从事智能卡、RFID 电子标签和信息安全等核心芯片的设计开发与销售。2005年，同方微电子成为信息产业部认定的“第一批集成电路设计企业”，连续五年入围中国半导体行业协会评选的“年度中国十大集成电路设计企业”，曾获得“国家科学技术进步一等奖”、“北京奥运会与残奥会证件门票制作、防伪和查验技术选型项目入选企业”，掌握了集成电路设计的核心技术。

交易完成后，同方微电子在集成电路设计方面的核心技术优势和相关经验，可以配合晶源电子开发石英晶体振荡器专用集成电路（IC）等高端精密电子元器件产品，极大拓展公司高端精密器件相关业务，进一步延伸公司的产业链。同时通过本次重组，公司可利用同方微电子在智能卡芯片领域的市场影响力及良好的客户关系，扩大国内市场份额，降低出口风险、汇率变动风险。

根据经兴华事务所审计的同方微电子三年一期财务报告和经兴华事务所审核的同方微电子 2010 年至 2011 年的盈利预测报告，同方微电子 2009 年度实现净利润 10,108.90 万元，2010 年度实现净利润 7,035.96 万元，预计同方微电子 2011 年全年实现净利润 7,246.89 万元。根据经兴华事务所审计的上市公司最近两年一期的备考财务报告和经兴华事务所审核的上市公司 2010 年至 2011 年的备考盈利预测报告，交易完成后，上市公司 2009 年度实现净利润 13,614.52 万元，2010 年实现净利润 10,943.57 万元，2011 年 1-9 月实现净利润 9,822.30 万元，预计 2011 年全年实现净利润 10,034.54 万元。

按本次交易拟发行 10,599.43 万股计算，交易完成后，上市公司 2009 年、2010 年、2011 年的每股收益分别为 0.56 元/股、0.45 元/股、0.42 元/股。目前晶源电子 2009 年、2010 年归属于母公司的净利润分别为 3,409.34 万元、3,760.45 万元，基本每股收益分别为 0.253 元/股、0.279 元/股，本次交易将有利于提高上市公司

盈利能力。

本次交易完成后，公司将拥有同方微电子 100% 股权，本次交易对公司财务状况、经营成果的影响如下：

### （一）交易前后公司主要财务状况和资产负债指标比较分析

根据兴华事务所出具的上市公司财务报告的审计报告（（2010）京会兴审字第 1-42 号和（2011）京会兴审字第 1—007 号审计报告）和兴华事务所出具的上市公司备考财务报告的审计报告（（2010）京会兴审字第 1-150 号和（2011）京会兴审字第 1—129 号），交易前后上市公司主要财务状况和指标比较如下：

单位：万元

2011 年 9 月 30 日	交易完成后		交易前		交易前后比较	
	金额	比例	金额	比例	增长额	增长幅度
流动资产	102,323.05	75.96%	23,626.23	45.90%	78,696.82	333.09%
非流动资产	32,391.40	24.04%	27,844.82	54.10%	4,546.58	16.33%
总资产	134,714.45	100.00%	51,471.05	100.00%	83,243.40	161.73%
流动负债	24,563.60	82.36%	4,180.77	76.28%	20,382.83	487.54%
非流动负债	5,262.31	17.64%	1,300.31	23.72%	3,962.00	304.70%
总负债	29,825.90	100.00%	5,481.08	100.00%	24,344.83	444.16%
所有者权益合计	104,888.54		45,989.97		58,898.58	128.07%
归属于母公司的所有者权益	103,494.98		44,596.41		58,898.58	132.07%
股本总额(万股)	24,099.43		13,500.00		78.51%	
每股净资产(元/股)	4.29		3.30		30.00%	
资产负债率	22.14%		10.65%		107.91%	
流动比率(倍)	4.17		5.65		-26.29%	
速动比率(倍)	3.64		4.06		-10.40%	

注：速动比率=（流动资产期末数-存货期末数）/流动负债期末数

#### 1、本次交易前后的资产规模、结构分析

本次交易完成后，截至2011年9月30日，公司的资产总额由本次交易前的 51,471.05 万元增加至 134,714.45 万元，资产总额增加了 83,243.40 万元，增长幅度

为161.73%。公司资产规模大幅上升，抗风险能力显著增强。交易完成后，公司的资产结构变化如下：

(1) 本次交易前，公司流动资产占资产总额的比重为45.90%，本次交易后，公司流动资产占资产总额的比重为75.96%，流动资产占资产总额比重有所上升，公司资产流动性增强。

截至2011年9月30日，公司流动资产由本次交易前的23,626.23万元增加至102,323.05万元，增加金额为78,696.82万元，增长幅度为333.09%，流动资产的增长主要是货币资金增加了55,309.18万元，应收账款增加了15,883.64万元，存货增加了6,267.10万元。

(2) 本次交易前，公司非流动资产占资产总额的比重为54.10%，本次交易后，公司非流动资产占资产总额的比重为24.04%，非流动资产占资产总额比重显著下降。

本次交易完成后，截至2011年9月30日，公司非流动资产由本次交易前27,844.82万元增加至32,391.40万元，增加金额为4,546.58万元，增长幅度为16.33%。本次交易完成前后，公司非流动资产规模较小，主要原因是同方微电子是高新技术企业，以高科技产品的研发和创新作为企业的盈利核心，自身没有独立的生产车间和生产设备，无土地使用权，非流动资产较少。因此，交易完成后，上市公司的非流动资产变化较小。

综上所述，备考上市公司财务报表的资产结构综合反映了本次交易完成后上市公司的资产结构，符合高新技术企业的资产结构特征。交易完成后，公司资产规模显著增大，抵御风险的能力增强；公司的流动资产大幅增加，资产的流动性增强，资产质量有较大提高。

## 2、本次交易前后的负债规模、结构分析

本次交易完成后，截至2011年9月30日，公司的负债总额由本次交易前的5,481.08万元增加至29,825.90万元，负债总额增加了24,344.83万元，增长幅度为444.16%。负债的增长幅度大于资产的增长幅度，公司的资产负债率略有提高。交易完成后，公司的负债结构如下：

本次交易前，公司的流动负债占总负债的比例为76.28%，非流动负债占总负

债的比例为23.72%；交易完成后公司的流动负债占总负债的比例为82.36%，非流动负债占总负债的比例为17.64%。交易完成后，公司的资产负债率略有提高，但公司的货币资金大量增加，现金流较好，没有增加任何有息负债，公司的偿债能力增强。

(1) 本次交易完成后，截至2011年9月30日，公司流动负债由本次交易前的4,180.77万元增加至24,563.60万元，增长金额为20,382.83万元，增长幅度为487.54%，流动负债的增加主要是应付票据增加了11,219.87万元，应付账款增加了6,999.18万元。

(2) 本次交易完成后，截至2011年9月30日，公司非流动负债由本次交易前的1,300.31万元增加至5,262.31万元，增长金额为3,962.00万元，增长幅度为304.70%，非流动负债的增加主要是专项应付款增加了3,962.00万元。同方微电子的专项应付款均属于政府补助性质，主要为各种高新技术项目的研发补助，该款项无需偿还，将在未来年度逐渐确认为收入。

综上所述，本次交易完成后，公司的负债规模上升，但公司负债结构未发生较大变化，仍保持较合理的结构，其财务安全性有保障。

### 3、交易前后的偿债能力分析

本次交易完成后，公司的资产负债率为22.14%，比交易前的资产负债率10.65%有所提高，但仍保持较低的水平，且低于可比上市公司平均水平。

本次交易完成后，公司负债仍以流动负债为主，其中应付票据、应付账款的比重较大，二者合计金额占负债总额的比重为70.71%。公司应付款项的账龄基本都在一年以内，公司的市场信誉度良好，无大额长期未付款。2011年9月末，公司的货币资金与负债总额的比值由交易前的1.07增加到交易后的2.05。

本次交易完成后，公司的流动比率、速动比率分别为4.17、3.64，低于交易前的水平。交易后，公司的资产流动性仍较高，短期偿债能力增强，公司不存在短期偿债风险。

总体来看，本次交易完成后，公司的资产负债率较低，现金流较充足，无偿债压力，抵御风险的能力较强。

#### 4、交易前后的营运能力分析

公司名称	交易完成后			交易完成前		
	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2011年1-9月	2010年度	2009年度
应收账款周转率(次/年)	2.35	3.65	4.07	3.07	4.62	4.51
存货周转率(次/年)	2.94	5.30	3.54	2.63	4.84	4.20

注1：应收账款周转率=计算期间营业收入/[(计算期应收账款期初数+期末数)/2]

注2：存货周转率=计算期间营业成本/[(计算期存货期初数+期末数)/2]

本次交易前，公司2009年度、2010年度、2011年1-9月的应收账款周转率分别为4.51、4.62、3.07；本次交易完成后，公司2009年度、2010年度、2011年1-9月的应收账款周转率分别为4.07、3.65、2.35。交易后，公司的应收账款周转率降低，主要原因是标的资产2010年度的主要产品国家二代居民身份证芯片销量下降，使标的资产的销售收入下降，但国家二代居民身份证芯片的应收账款收款期相对较长，2011年9月末尚有对公安部第一研究所的应收账款7,827.84万元，占2011年9月末同方微电子应收账款总额的比例为48.79%。除国家二代居民身份证芯片外，同方微电子的其他主要产品的应收账款平均收款期较短，约为60天。随着国家二代居民身份证芯片销售款的收回，以及其他主要产品销售收入的提高，公司的应收账款周转率将逐渐提高。

本次交易前，公司2009年度、2010年度、2011年1-9月的存货周转率分别为4.20、4.84、2.63；本次交易完成后，公司2009年度、2010年度、2011年1-9月的存货周转率分别为3.54、5.30、2.94，交易完成后，公司的存货周转率比交易前有所提高。

#### (二) 交易前后公司主要经营状况和盈利指标比较分析

根据兴华事务所出具的上市公司财务报告的审计报告（（2010）京会兴审字第1—42号和（2011）京会兴审字第1—007号审计报告）和兴华事务所出具的上市公司备考财务报告的审计报告（（2010）京会兴审字第1-150号和（2011）京会兴审字第1—129号）：交易前后上市公司主要经营状况和盈利指标比较如下：

## 1、本次交易前后营业收入、净利润分析

单位：万元

2009 年度	交易完成后	交易完成前	交易前后比较	
			增长额	增长幅度
营业收入	73,896.35	28,890.67	45,005.68	155.78%
营业成本	49,936.30	22,062.74	27,873.56	126.34%
营业利润	16,180.42	3,895.37	12,285.05	315.38%
净利润	13,614.52	3,505.62	10,108.90	288.36%
归属母公司的净利润	13,518.24	3,409.34	10,108.90	296.51%
2010 年度	交易完成后	交易完成前	交易前后比较	
			增长额	增长幅度
营业收入	69,297.94	34,869.38	34,428.56	98.74%
营业成本	49,311.00	25,900.88	23,410.11	90.38%
营业利润	13,018.94	4,751.46	8,267.48	174.00%
净利润	10,943.57	3,907.60	7,035.96	180.06%
归属母公司的净利润	10,796.41	3,760.45	7,035.96	187.10%
2011 年 1-9 月	交易完成后	交易完成前	交易前后比较	
			增长额	增长幅度
营业收入	48,605.25	21,801.29	26,803.96	122.95%
营业成本	33,343.61	16,710.28	16,633.33	99.54%
营业利润	11,428.56	3,153.08	8,275.48	262.46%
净利润	9,822.30	2,769.87	7,052.43	254.61%
归属母公司的净利润	9,759.61	2,707.18	7,052.43	260.51%

如上表所示，本次交易完成后，公司的营业收入及利润规模均有较大幅度上升，公司盈利能力发生了实质性改变。公司2009 年度的营业收入由交易前的28,890.67万元增加到73,896.35万元，增长了45,005.68万元，增长幅度为155.78%。2009年度归属于母公司所有者的净利润由交易前的3,409.34万元增加到13,518.24万元，增长了10,108.90万元，增长幅度为296.51%。公司2010年度的营业收入由交易前的34,869.38万元增加到69,297.94万元，增长了34,428.56万元，增长幅度为

98.74%。2010年度归属于母公司所有者的净利润由交易前的3,760.45万元增加到10,796.41万元，增长了7,035.96万元，增长幅度为187.10%。公司2011年1-9月的营业收入由交易前的21,801.29万元增加到48,605.25万元，增长了26,803.96万元，增长幅度为122.95%。2011年1-9月归属于母公司所有者的净利润由交易前的2,707.18万元增加到9,759.61万元，增长了7,052.43万元，增长幅度为260.51%。交易完成后，公司的盈利能力发生了根本性改变，盈利水平显著增强。

本次交易前，最近三年一期，公司的营业收入有所上升，但是随着公司主要产品下游行业如通信设备、家电、计算机等电子整机产品价格的不断下降，以及压电石英晶体元器件行业竞争日益激烈，公司主要产品销售价格呈现下降的趋势。2008年度、2009年度公司主要产品价格综合售价分别下降了9.85%、10%，而主要原材料价格未发生较大变化，2010年度公司主要产品销售结构发生变化，使主要产品价格综合售价上升1.84%。总体来看，交易前公司的主要产品普通低档晶体元器件的盈利空间受到较大限制。

面对公司产品价格下降的风险，公司通过加大新产品的研发力度和优化产品结构，提高附加值较高产品的销售比重，从而增强对下游产品价格波动的承受能力以保持相对稳定的综合毛利率，同时，公司通过加强内部管理，完善成本考核机制，加大市场开拓力度，扩大生产规模，实现规模经济，进而有效地降低产品的生产成本。

公司通过本次交易购入在高端电子元器件、集成电路领域有较强实力的同方微电子100%股权。同方微电子2008年度至2011年9月累计实现营业收入145,904.72万元，累计实现净利润34,769.72万元，为股东实现了丰厚的回报。综上所述，本次交易完成后，公司的销售规模、盈利能力都将有较大提升，公司的持续盈利能力增强。

## (2) 交易前后盈利能力指标比较分析

2009年度	交易完成后	交易完成前	增长幅度
销售毛利率	32.42%	23.63%	37.19%
销售净利率	18.42%	12.13%	51.83%
加权平均净资产收益率	16.94%	8.52%	98.91%

基本每股收益	0.561	0.253	122.11%
期间费用率	9.69%	9.14%	5.99%
<b>2010 年度</b>	<b>交易完成后</b>	<b>交易完成前</b>	<b>增长幅度</b>
销售毛利率	28.84%	25.72%	12.14%
销售净利率	15.79%	11.21%	40.92%
加权平均净资产收益率	11.95%	8.96%	33.48%
基本每股收益	0.448	0.279	60.80%
期间费用率	8.71%	9.96%	-12.54%
<b>2011 年 1-9 月</b>	<b>交易完成后</b>	<b>交易完成前</b>	<b>增长幅度</b>
销售毛利率	31.40%	23.35%	34.46%
销售净利率	20.21%	12.71%	59.06%
加权平均净资产收益率	9.75%	6.05%	61.09%
基本每股收益	0.405	0.201	101.95%
期间费用率	7.59%	9.20%	-17.49%

2009 年、2010 年度、2011 年 1-9 月，销售毛利率分别由交易前的 23.63%、25.72%、23.35%增长为交易后的 32.42%、28.84%、31.40%；销售净利润分别由交易前的 12.13%、11.21%、12.71%增长为交易后的 18.42%、15.79%、20.21%；加权平均净资产收益率分别由交易前的 8.52%、8.96%、6.05%增长为交易后 16.94%、11.95%、9.75%，基本每股收益分别由交易前的 0.253 元/股、0.279 元/股、0.201 元/股增长为交易后 0.561 元/股、0.448 元/股、0.405 元/股。本次交易前后，公司各项盈利能力均发生了较大的变化，各项盈利能力指标显著增强。

综上所述，本次交易完成后，公司主营业务将由普通低档晶体元器件逐渐变为高档元器件和其他科技含量较高、盈利空间较大的电子芯片。公司的主业业务，资产质量、财务状况、盈利能力得到了较大的改变，有力的实现了公司股东利益最大化。

### （三）本次交易对公司未来盈利趋势的影响

#### 1、公司未来经营中的优势

##### （1）行业地位优势

晶源电子自1997年以来公司产销量和销售收入一直名列国内压电石英晶体行业首位，已连续12年进入中国电子元器件百强企业，成为国内压电石英晶体行业内的龙头企业。

同方微电子是国家第二代居民身份证芯片四家供应商之一。同方微电子生产的SIM卡产已用于我国三大电信运营商的手机SIM卡以及有线电视顶盒的条件接收卡，其中手机SIM卡芯片在国内市场占有率逐年增高，已成为国内出货量最大的手机SIM卡芯片供应商。公司的品牌形象和知名度、生产规模以及技术水平均领先于国内同行业，具有明显的行业地位优势。

## （2）技术优势

同方微电子是信息产业部认定的“第一批集成电路设计企业”，是国内最早从事集成电路设计的公司，连续五年入围中国半导体行业协会评选的“年度中国十大集成电路设计企业”，曾获得“国家科学技术进步一等奖”、“北京奥运会与残奥会证件门票制作、防伪和查验技术选型项目入选企业”，掌握了集成电路设计的核心技术。

交易完成后，同方微电子在集成电路设计方面的核心技术优势和相关经验，可以配合晶源电子开发石英晶体振荡器专用集成电路（IC）等高端精密电子元器件产品，极大拓展公司高端精密器件相关业务。

## （3）较强的盈利能力与现金创造能力

2008年、2009年、2010年度，同方微电子的综合毛利率保持在30%以上的较高水平，净资产收益率也保持较高水平，表明同方微电子具备较强的盈利能力。

2008年末、2009年末、2010年末、2011年9月末，同方微电子的货币资金期末余额分别为35,947.88万元、50,306.16万元、48,403.56万元、55,309.18万元。2008年度，同方微电子向股东分配现金股利9,300.00万元。本次交易完成后，上市公司将具备较强的现金创造能力与现金分红能力。

## 2、公司未来经营中的劣势

### （1）市场风险

随着信息产业的高速发展，电子产品不断更新换代，电子元器件的市场需求

持续快速增长，新进厂商日益增多，行业内的竞争日益激烈。2008年下半年以来，受全球性金融危机的影响，电子元器件行业的市场也存在一定的不确定性。面对市场风险，公司需加强市场情报的收集与分析，及时根据市场的变化调整产品研发、涉及策略以及销售策略，增强市场应变能力；在巩固国内市场的基础上，积极拓展新型元器件和高端精密器件市场、规避低端产品的竞争，以应对市场风险。

## （2）产品价格下降的风险

随着公司下游行业如通信设备、家电、计算机等电子整机产品价格的不断下降，以及电子元器件行业竞争日益激烈，电子元器件产品的销售价格将呈现下降的趋势。面对公司产品价格下降的风险，公司将通过加大新产品的研发力度和优化产品结构，提高附加值较高产品的销售比重，从而增强对下游产品价格波动的承受能力以保持相对稳定的综合毛利率，同时，公司通过加强内部管理，完善成本考核机制，加大市场开拓力度，扩大生产规模，实现规模经济，进而有效地降低产品的生产成本。

## 五、交易完成后，公司的资产、业务整合及人员调整计划

本次交易完成后，同方微电子成为上市公司的全资子公司。同方微电子仍然作为独立的法人主体存在，同方微电子的资产、业务及人员保持相对独立和稳定，没有重大的资产、业务整合及人员调整计划。

本次交易完成后，晶源电子将整合内部资源，将同方微电子的研发、销售、管理纳入公司统一管理，以实现晶源电子与同方微电子的整合效应和协同效应，具体如下：

### 1、研发体系的整合

公司将成立新的研发中心，整合晶源电子和同方微电子的研发团队。公司将结合晶源电子在石英晶体方面的技术以及同方微电子在集成电路方面的技术，共同解决振荡器专用集成电路的技术瓶颈，开发具有自主知识产权的各种高端晶体振荡器产品，将石英晶体产品向中高端方向发展。

### 2、销售体系的整合

目前晶源电子的石英晶体产品绝大部分是出口销售，主要是以代理商和代工生产（OEM）的方式，国内市场份额比较小。随着人民币对美元汇率的不断提高，公司经营风险持续增加。公司现有的销售队伍较小、力量薄弱，尤其是在国内销售市场方面，缺少相关经验和能胜任的团队。本此重组完成后，公司将在北京设立统一的营销中心，借助同方微电子成熟的营销资源，大力开拓国内市场，逐步形成国外、国内市场优势互补的格局，降低公司经营风险，拓展公司发展空间。

### 3、人才的整合

晶源电子地处河北省玉田县，技术和管理人才相对贫瘠。同方微电子作为同方股份的控股子公司，地处北京市中关村园区，依托清华大学等科研院所的人才优势，技术实力和管理理念都处于国内领先水平。本次交易完成后，同方微电子将充分发挥自身的人才优势和管理优势，针对晶源电子员工的文化层次、知识技能以及不同岗位的人员制定不同的培训方案，加强对晶源电子员工的培训，提升晶源电子员工的整体素质。同时，公司将根据新产品和新技术开展的需要，重新选拔适合公司发展战略需要的管理层。

## 第十节 财务会计信息

### 一、交易标的最近三年一期合并财务报表

#### （一）交易标的最近三年一期合并财务报表审计情况

兴华事务所对同方微电子最近三年一期的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告（（2010）京会兴审字第 1-149 号和（2011）京会兴审字第 1-130 号）。

#### （二）标的资产财务报表

## 1、资产负债表

单位：元

资 产	2011年9月30日	2010年12月31日	2010年10月3月1日	2009年12月31日	2008年12月31日
货币资金	553,091,827.63	484,035,593.81	450,491,426.42	503,061,584.12	359,478,833.34
交易性金融资产			-	-	-
应收账款	158,836,383.45	112,130,755.79	117,801,025.69	116,979,453.00	117,185,696.64
预付款项	2,592,145.75	1,728,273.95	1,436,243.25	1,360,619.65	220,676.54
应收利息			-	-	-
应收股利			-	-	-
其他应收款	2,615,611.94	1,130,171.44	1,316,091.95	1,259,403.56	2,239,645.98
存货	62,670,963.63	36,588,945.71	46,897,672.58	42,615,321.47	134,338,131.00
一年内到期的非流动资产			-	-	-
其他流动资产			-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>786,968,221.00</b>	<b>656,751,256.37</b>	<b>651,006,816.90</b>	<b>665,276,381.80</b>	<b>613,462,983.50</b>
非流动资产：			-	-	-
可供出售金融资产			-	-	-
持有至到期投资			-	-	-

资 产	2011年9月30日	2010年12月31日	2010年10月3月1日	2009年12月31日	2008年12月31日
长期应收款			-	-	-
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,769,448.77	2,769,448.77
投资性房地产			-	-	-
固定资产	5,822,244.55	6,711,671.55	6,945,892.65	5,276,899.81	5,352,663.86
在建工程			-	1,779,667.60	-
工程物资			-	-	-
无形资产	25,166.67	146,666.67	155,520.00	325,017.00	533,013.00
开发支出	32,510,716.31	23,024,806.87	19,481,540.12	11,689,257.72	15,359,485.56
长期待摊费用	1,106,313.46	1,393,968.40	1,457,891.72	1,736,666.67	-
递延所得税资产	3,001,361.43	2,975,694.25	2,803,576.18	2,284,936.03	1,459,737.19
其他非流动资产			-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>45,465,802.42</b>	<b>37,252,807.74</b>	<b>33,844,420.67</b>	<b>25,861,893.60</b>	<b>25,474,348.38</b>
<b>资产总计</b>	<b>832,434,023.42</b>	<b>694,004,064.11</b>	<b>684,851,237.57</b>	<b>691,138,275.40</b>	<b>638,937,331.88</b>
<b>负债及所有者权益</b>	<b>2011年9月30日</b>	<b>2010年12月31日</b>	<b>2010年10月31日</b>	<b>2009年12月31日</b>	<b>2008年12月31日</b>
流动负债：					
短期借款			-	-	-

资 产	2011年9月30日	2010年12月31日	2010年10月3月1日	2009年12月31日	2008年12月31日
交易性金融负债			-	-	-
应付票据	112,198,736.25	92,575,331.20	83,234,365.82	60,437,440.05	103,941,715.65
应付账款	69,991,832.60	33,472,167.02	42,716,119.91	32,694,197.01	53,608,047.69
预收款项	433,824.00	177,444.00	163,478.70	-	1,254,674.25
应付职工薪酬	4,222,309.85	5,092,805.68	4,247,233.54	5,783,456.14	1,989,565.53
应交税费	7,492,062.87	3,927,161.52	5,551,544.78	17,071,226.47	8,380,003.56
应付利息			-	-	-
应付股利			-	93,000,000.00	93,000,000.00
其他应付款	9,489,507.43	1,061,749.39	1,369,818.40	280,182.73	680,533.05
一年内到期的非流动负债			-	-	-
其他流动负债			-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>203,828,273.00</b>	<b>136,306,658.81</b>	<b>137,282,561.15</b>	<b>209,266,502.40</b>	<b>262,854,539.73</b>
非流动负债：			-	-	-
长期借款			-	-	-
应付债券			-	-	-
长期应付款			-	-	-

资 产	2011年9月30日	2010年12月31日	2010年10月3月1日	2009年12月31日	2008年12月31日
专项应付款	39,620,000.00	39,236,000.00	39,236,000.00	33,770,000.00	29,070,000.00
预计负债			-	-	-
递延所得税负债			-	-	-
其他非流动负债			-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>39,620,000.00</b>	<b>39,236,000.00</b>	<b>39,236,000.00</b>	<b>33,770,000.00</b>	<b>29,070,000.00</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>243,448,273.00</b>	<b>175,542,658.81</b>	<b>176,518,561.15</b>	<b>243,036,502.40</b>	<b>291,924,539.73</b>
所有者权益：			-	-	-
实收资本	31,600,000.00	31,600,000.00	31,600,000.00	31,600,000.00	31,600,000.00
资本公积	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00
减：库存股			-	-	-
盈余公积	59,377,556.32	59,377,556.32	52,341,593.09	52,341,593.09	42,232,695.00
一般风险准备			-	-	-
未分配利润	495,208,194.10	424,683,848.98	421,591,083.33	361,360,179.91	270,380,097.15
外币报表折算差额			-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>588,985,750.42</b>	<b>518,461,405.30</b>	<b>508,332,676.42</b>	<b>448,101,773.00</b>	<b>347,012,792.15</b>
<b>负债及所有者权益合计</b>	<b>832,434,023.42</b>	<b>694,004,064.11</b>	<b>684,851,237.57</b>	<b>691,138,275.40</b>	<b>638,937,331.88</b>

## 2、利润表

单位：元

项 目	2011年1-9月	2010年度	2010年1-10月	2009年度	2008年度
一、营业收入	<b>268,039,556.11</b>	<b>344,285,563.18</b>	<b>277,249,865.23</b>	<b>450,056,812.89</b>	<b>396,665,247.84</b>
减：营业成本	166,333,324.03	234,101,118.49	185,289,409.84	278,735,593.94	240,731,402.32
营业税金及附加	1,620,895.65	2,121,118.07	1,661,758.67	4,865,493.39	2,333,718.59
销售费用	6,175,383.99	5,699,779.83	4,394,941.70	5,443,385.68	6,516,805.21
管理费用	17,884,204.07	24,607,061.61	19,995,704.05	44,249,356.54	40,281,375.11
财务费用	-7,216,412.13	-4,677,857.10	-4,153,792.32	-4,515,675.38	-3,863,457.52
资产减值损失	487,335.55	-9,881.50	7,439.82	-1,571,875.94	1,305,998.70
加：公允价值变动收益	-	-	-	-	-
投资收益	-	230,551.23	230,551.23	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-	-
二、营业利润	<b>82,754,824.95</b>	<b>82,674,775.01</b>	<b>70,284,954.70</b>	<b>122,850,534.66</b>	<b>109,359,405.43</b>
加：营业外收入			-	2,000,000.00	8,149,389.51
减：营业外支出	100,000.00	43,116.53	35,233.20	64,443.45	2,014,738.59
其中：非流动资产处置损失		43,116.53	35,233.20	64,443.45	14,738.59

项 目	2011年1-9月	2010年度	2010年1-10月	2009年度	2008年度
三、利润总额	82,654,824.95	82,631,658.48	70,249,721.50	124,786,091.21	115,494,056.35
减：所得税费用	12,130,479.83	12,272,026.18	10,018,818.08	23,697,110.36	9,769,817.08
四、净利润	70,524,345.12	70,359,632.30	60,230,903.42	101,088,980.85	105,724,239.27

### 3、现金流量表

单位：元

项 目	2011年1-9月	2010年度	2010年1-10月	2009年度	2008年度
一、经营活动产生的现金流量					
销售商品、提供劳务收到的现金	280,661,350.71	386,752,525.07	290,654,005.41	527,242,929.23	486,258,857.69
收到的税费返还	-	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	15,953,628.59	5,907,122.70	5,183,286.98	5,034,265.51	5,229,390.64
<b>现金流入小计</b>	<b>296,614,979.30</b>	<b>392,659,647.77</b>	<b>295,837,292.39</b>	<b>532,277,194.74</b>	<b>491,488,248.33</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	168,655,842.40	230,853,976.24	183,349,702.87	270,927,334.75	260,094,735.28
支付给职工以及为职工支付的现金	13,061,349.77	18,718,355.12	17,810,362.51	27,616,274.43	31,716,032.51
支付的各项税费	27,932,575.99	55,231,483.14	45,742,702.86	74,804,088.49	41,192,537.25

项 目	2011年1-9月	2010年度	2010年1-10月	2009年度	2008年度
支付其他与经营活动有关的现金	7,241,335.80	8,124,306.25	6,309,533.83	18,989,602.98	9,428,396.85
<b>现金流出小计</b>	<b>216,891,103.96</b>	<b>312,928,120.75</b>	<b>253,212,302.07</b>	<b>392,337,300.65</b>	<b>342,431,701.89</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>79,723,875.34</b>	<b>79,731,527.02</b>	<b>42,624,990.32</b>	<b>139,939,894.09</b>	<b>149,056,546.44</b>
二、投资活动产生的现金流量			-	-	-
收回投资收到的现金			-	-	-
取得投资收益收到的现金			-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	153,000.00	152,000.00	66,000.00	2,240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金			-	-	-
<b>现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>153,000.00</b>	<b>152,000.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>2,240.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,051,641.52	13,980,517.33	10,417,148.02	3,123,143.31	16,913,261.91
投资支付的现金			-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金			-	-	-
<b>现金流出小计</b>	<b>11,051,641.52</b>	<b>13,980,517.33</b>	<b>10,417,148.02</b>	<b>3,123,143.31</b>	<b>16,913,261.91</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-11,051,641.52</b>	<b>-13,827,517.33</b>	<b>-10,265,148.02</b>	<b>-3,057,143.31</b>	<b>-16,911,021.91</b>

项 目	2011年1-9月	2010年度	2010年1-10月	2009年度	2008年度
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金			-	-	-
取得借款收到的现金			-	-	-
发行债券收到的现金			-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	384,000.00	5,826,000.00	5,826,000.00	6,700,000.00	7,300,000.00
<b>现金流入小计</b>	<b>384,000.00</b>	<b>5,826,000.00</b>	<b>5,826,000.00</b>	<b>6,700,000.00</b>	<b>7,300,000.00</b>
偿还债务支付的现金			-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	90,396,000.00	90,396,000.00	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	360,000.00	360,000.00	-	2,000,000.00
<b>现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>90,756,000.00</b>	<b>90,756,000.00</b>	<b>-</b>	<b>2,000,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>384,000.00</b>	<b>-84,930,000.00</b>	<b>-84,930,000.00</b>	<b>6,700,000.00</b>	<b>5,300,000.00</b>
四、汇率变动对现金的影响额			-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	<b>69,056,233.82</b>	<b>-19,025,990.31</b>	<b>-52,570,157.70</b>	<b>143,582,750.78</b>	<b>137,445,524.53</b>
加：期初现金及现金等价物余额	484,035,593.81	503,061,584.12	503,061,584.12	359,478,833.34	222,033,308.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>553,091,827.63</b>	<b>484,035,593.81</b>	<b>450,491,426.42</b>	<b>503,061,584.12</b>	<b>359,478,833.34</b>

## 二、上市公司最近两年一期备考合并财务报表

### （一）上市公司最近两年一期备考合并财务报表的编制基础

#### 1、以非公开发行股份购买同方微电子股权相关的假设：

（1）本次交易方案能够获得公司股东大会和同方股份股东大会的批准，并获得中国证券监督管理委员会及其他相关监管部门的核准通过核准；

（2）假设 2009 年 1 月 1 日公司已完成向交易对方发行股份购买资产的行为，并办妥相关财产转移的过户手续。

#### 2、备考财务报表合并报表编制情况

本次交易前，本公司与同方微电子均受同方股份控制，且该控制并非暂时控制，因此本次企业合并为同一控制下企业合并。公司自 2009 年 1 月 1 日起将同方微电子纳入财务报表的编制范围，公司按照此架构持续经营。

本备考合并财务报表以本公司、同方微电子经兴华事务所有限公司审计的最近两年一期的财务报表为基础，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的有关规定，采用公司重要会计政策、会计估计及合并财务报表的编制方法进行了相关调整和重新表述，并根据《企业会计准则-企业合并》中关于同一控制的企业合并的要求进行编制。

### （二）上市公司最近两年一期备考合并财务报表的审计意见

兴华事务所审计了晶源电子按照上述“上市公司最近两年一期备考合并财务报表的编制基础”编制的备考合并资产负债表和备考合并利润表。兴华事务所对上述财务报表出具了标准无保留意见的审计报告（（2010）京会兴审字第 1-150 号和（2011）京会兴审字第 1-129 号）。

### （三）上市公司最近两年一期备考合并财务报表

#### 1、备考合并资产负债表

单位：元

资 产	2011年9月30日	2010年12月31日	2010年10月31日	2009年12月31日
流动资产：				
货币资金	611,700,637.07	547,205,408.50	505,248,765.95	563,203,273.17
交易性金融资产			-	-
应收票据	9,993,346.27	26,243,895.00	37,543,292.09	3,061,347.98
应收账款	225,545,454.14	187,289,492.70	200,152,921.41	192,697,033.06
预付款项	24,631,329.08	14,792,247.91	12,678,581.04	8,409,398.83
应收利息			-	-
应收股利			-	-
其他应收款	22,274,057.60	15,198,139.30	21,270,491.40	7,362,932.56
存货	129,083,658.43	97,407,020.71	110,139,987.00	88,792,700.56
一年内到期的非流动资产	1,991.41	-	-	-
其他流动资产			-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>1,023,230,474.00</b>	<b>888,136,204.12</b>	<b>887,034,038.89</b>	<b>863,526,686.16</b>
非流动资产：			-	-
可供出售金融资产			-	-
持有至到期投资			-	-
长期应收款			-	-
长期股权投资	5,172,561.32	5,054,035.65	5,025,453.02	4,850,614.64
投资性房地产			12,909,405.10	13,179,204.08
固定资产	267,198,343.65	276,647,297.42	261,728,894.55	256,240,505.49
在建工程	294,759.89	2,463,140.64	7,783,534.38	13,943,163.84
无形资产	11,283,900.70	11,823,042.19	11,924,704.74	12,558,247.84
开发支出	32,510,716.31	23,024,806.87	19,481,540.12	11,689,257.72
商誉			-	-
长期待摊费用	1,106,313.46	1,417,802.93	1,488,324.01	1,800,087.76
递延所得税资产	6,347,427.07	4,439,353.34	3,494,965.63	2,844,377.76
其他非流动资产			-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>323,914,022.40</b>	<b>324,869,479.04</b>	<b>323,836,821.55</b>	<b>317,105,459.13</b>

<b>资产总计</b>	<b>1,347,144,496.40</b>	<b>1,213,005,683.16</b>	<b>1,210,870,860.44</b>	<b>1,180,632,145.29</b>
<b>负债及所有者权益</b>	<b>2011年9月30日</b>	<b>2010年12月31日</b>	<b>2010年10月31日</b>	<b>2009年12月31日</b>
流动负债：				
短期借款	-	21,497,608.70	10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债			-	-
应付票据	112,198,736.25	92,575,331.20	83,234,365.82	60,437,440.05
应付账款	98,708,983.65	57,388,753.73	83,812,146.43	60,255,111.32
预收款项	1,421,625.09	666,993.98	1,110,827.38	1,978,120.03
应付职工薪酬	11,214,957.34	13,442,605.93	12,913,728.03	12,743,620.03
应交税费	9,097,617.71	2,965,934.89	7,822,415.51	18,840,483.73
应付利息			-	-
应付股利			-	93,000,000.00
其他应付款	12,074,040.25	4,419,203.03	3,459,202.95	2,930,813.27
一年内到期的非流动负债	920,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,180,000.00
其他流动负债			-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>245,635,960.29</b>	<b>194,006,431.46</b>	<b>203,402,686.12</b>	<b>261,365,588.43</b>
非流动负债：			-	-
长期借款			-	-
应付债券			-	-
长期应付款			-	-
专项应付款	40,390,000.00	40,006,000.00	40,006,000.00	34,540,000.00
预计负债			-	-
递延所得税负债			-	-
其他非流动负债	12,233,087.69	13,480,801.25	13,758,070.93	11,531,055.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>52,623,087.69</b>	<b>53,486,801.25</b>	<b>53,764,070.93</b>	<b>46,071,055.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>298,259,047.98</b>	<b>247,493,232.71</b>	<b>257,166,757.05</b>	<b>307,436,643.43</b>
所有者权益：			-	-
股本	240,994,321.00	240,994,321.00	240,994,321.00	240,994,321.00
资本公积	90,584,114.61	90,584,114.61	90,584,114.61	90,584,114.61

盈余公积	77,475,614.56	77,475,614.56	73,503,985.97	73,503,985.97
未分配利润	625,895,750.44	543,149,631.79	535,544,047.88	454,007,170.42
<b>归属于母公司 所有者权益合计</b>	<b>1,034,949,800.61</b>	<b>952,203,681.96</b>	<b>940,626,469.46</b>	<b>859,089,592.00</b>
少数股东权益	13,935,647.81	13,308,768.49	13,077,633.93	14,105,909.86
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,048,885,448.42</b>	<b>965,512,450.45</b>	<b>953,704,103.39</b>	<b>873,195,501.86</b>
<b>负债及所有者权益合计</b>	<b>1,347,144,496.40</b>	<b>1,213,005,683.16</b>	<b>1,210,870,860.44</b>	<b>1,180,632,145.29</b>

## 2、备考合并利润表

单位：元

项目	2011年1-9月	2010年度	2010年1-10月	2009年度
一、营业收入	486,052,457.20	692,979,356.77	576,582,597.41	738,963,519.66
减：营业成本	333,436,090.08	493,109,954.38	410,287,501.02	499,362,965.66
营业税金及附加	2,984,281.24	3,570,569.77	2,831,333.45	6,101,660.69
销售费用	9,568,642.99	14,554,189.66	12,002,999.97	10,999,538.51
管理费用	31,815,125.24	46,453,995.73	38,154,011.47	63,359,287.57
财务费用	-4,478,541.51	-654,384.05	-1,183,595.83	-2,779,036.38
资产减值损失	-1,440,213.21	5,671,361.74	106,172.12	-353,951.85
加：公允价值变动收益			-	-
投资收益	118,525.67	-84,288.45	-112,871.07	-468,834.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	118,525.67	-27,130.22	-	-
<b>二、营业利润</b>	<b>114,285,598.04</b>	<b>130,189,381.09</b>	<b>114,271,304.14</b>	<b>161,804,221.33</b>
加：营业外收入	1,367,714.10	3,292,122.56	1,622,511.33	5,074,956.60
减：营业外支出	213,656.61	3,309,458.37	571,468.96	237,867.57
其中：非流动资产处置损失	69,998.77	2,736,670.11	35,233.20	139,204.13
<b>三、利润总额</b>	<b>115,439,655.53</b>	<b>130,172,045.28</b>	<b>115,322,346.51</b>	<b>166,641,310.36</b>
减：所得税费用	17,216,657.56	20,736,363.37	17,695,011.65	30,496,103.23
<b>四、净利润</b>	<b>98,222,997.97</b>	<b>109,435,681.91</b>	<b>97,627,334.86</b>	<b>136,145,207.13</b>
归属于母公司所有者的净利润	97,596,118.65	107,964,089.96	96,386,877.46	135,182,369.74
少数股东损益	626,879.32	1,471,591.95	1,240,457.40	962,837.39

### 三、标的资产盈利预测审核报告

#### (一) 同方微电子盈利预测报告的编制基础

同方微电子的盈利预测报告是在遵循《盈利预测编制说明》中“二、盈利预测基本假设”所列主要假设，考虑国家宏观政策的影响，分析了同方微电子面临的市场环境、未来发展前景及其他有关资料，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，经过分析研究而编制的。编制盈利预测时采用的会计政策及会计估计方法遵循了国家现行的法律、法规、企业会计准则的规定，在各重要方面均与同方微电子实际采用的会计政策及会计估计一致。

#### (二) 同方微电子盈利预测报告的审核情况

兴华事务所审核了同方微电子编制的 2010 年度的盈利预测报告，并出具了 (2010) 京会兴核字第 1-52 号审核报告。其审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号——预测性财务信息的审核》。其审核意见如下：

“根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照盈利预测编制基础的规定进行了列报。”

#### (三) 同方微电子盈利预测编制的基本假设

- 1、预测期内同方微电子所遵循的国家现行政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；
- 2、预测期内同方微电子所遵循的税收政策不发生重大变化；
- 3、预测期内同方微电子适用的金融机构贷款利率以及外汇市场汇率不发生重大变化；
- 4、预测期内全球金融危机对实体经济的影响日趋减弱；
- 5、预测期内同方微电子所从事的行业及市场状况不发生重大变化；
- 6、预测期内同方微电子组织结构、合并报表的合并范围不发生重大变化；
- 7、预测期内同方微电子经营所需的原材料、能源、劳务能够取得且价格不

发生重大变化；

8、预测期内同方微电子制定的生产计划、销售计划、投资计划、融资计划等能够顺利执行；

9、预测期内其他不可抗力因素及不可预见因素对同方微电子不存在重大不利影响。

#### (四) 同方微电子盈利预测表

单位：元

项 目	2009 年度实际数	2010 年 1-10 月实际	2010 年 11-12 月预测	2010 年合计	2011 年预测数
<b>一、营业收入</b>	<b>450,056,812.89</b>	<b>277,249,865.23</b>	<b>66,425,861.62</b>	<b>343,675,726.85</b>	<b>419,285,920.84</b>
减：营业成本	278,735,593.94	185,289,409.85	45,583,853.79	230,873,263.64	295,145,543.06
税金及附加	4,865,493.39	1,661,758.67	500,851.01	2,162,609.68	2,212,386.43
营业费用	5,443,385.68	4,394,941.70	795,058.30	5,190,000.00	5,619,408.99
管理费用	44,249,356.54	19,995,704.05	7,098,950.43	27,094,654.48	30,965,160.32
财务费用	-4,515,675.38	-4,153,792.32	12,626.00	-4,141,166.32	85,918.39
资产减值损失	-1,571,875.94	7,439.82	-	7,439.82	-
加：公允价值变动收益	-	-	-	-	-
投资收益	-	230,551.23	-	230,551.23	-
<b>二、营业利润</b>	<b>122,850,534.66</b>	<b>70,284,954.69</b>	<b>12,434,522.09</b>	<b>82,719,476.78</b>	<b>85,257,503.65</b>
加：营业外收入	2,000,000.00	-	-	-	-
减：营业外支出	64,443.45	35,233.20	-	35,233.20	-
<b>三、利润总额</b>	<b>124,786,091.21</b>	<b>70,249,721.49</b>	<b>12,434,522.09</b>	<b>82,684,243.58</b>	<b>85,257,503.65</b>
所得税	23,697,110.36	10,018,818.08	2,383,818.46	12,402,636.54	12,788,625.55
<b>四、净利润</b>	<b>101,088,980.85</b>	<b>60,230,903.41</b>	<b>10,050,703.63</b>	<b>70,281,607.04</b>	<b>72,468,878.10</b>
归属于母公司所有者的净利润	101,088,980.85	60,230,903.41	10,050,703.63	70,281,607.04	72,468,878.10

## 四、上市公司备考合并盈利预测审核报告

### （一）上市公司备考合并盈利预测的编制基础

备考盈利预测以经兴华事务所有限公司审计的 2009年度和2010年1至10月份本公司和同方微电子的实际经营业绩为基础，结合本公司和同方微电子 2010年-2012年度的生产计划、销售计划、投资计划、融资计划及其他相关资料，并遵循谨慎性原则编制了晶源电子2010年-2011年度备考盈利预测报告（（2010）京会兴核字第1-53号）。编制该盈利预测报告所依据的主要会计政策和会计估计均与本公司的主要会计政策和会计估计相一致。

### （二）上市公司备考合并盈利预测报告的审核情况

兴华事务所审核了晶源电子编制的2010年-2011年度的备考合并盈利预测报告，其审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》，审核意见如下：

“根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照盈利预测编制基础的规定进行了列报”

### （三）上市公司备考合并盈利预测的基本假设

1、本公司所遵循的国家现行政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；

2、本公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；

3、本公司在盈利预测期间，公司生产经营涉及的国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变；

4、本公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；

5、预测期内本公司组织结构、资本结构、合并报表的合并范围不发生重大变化；

6、本公司计划经营项目及投资项目能如期实现或完成；

- 7、本公司制定的生产计划、销售计划、投资计划、融资计划等能够顺利执行；
- 8、本公司主要提供的服务、管理、销售等业务的市场无重大变化；
- 9、本公司生产所需的能源、原材料供应以及价格无重大不利变化；
- 10、本公司对管理人员、销售人员已进行合理配置，高层管理人员无舞弊、违法行为而造成重大不利影响；
- 11、预测期内其他不可抗力因素及不可预见因素对本公司不存在重大不利影响。

#### (四) 上市公司备考合并盈利预测表

单位：元

项目	2009 年度实际数	2010 年 1-10 月实际	2010 年 11-12 月预测	2010 年合计	2011 年预测数
一、营业收入	<b>738,963,519.66</b>	<b>576,582,597.41</b>	<b>99,290,402.89</b>	<b>675,873,000.30</b>	<b>764,975,635.09</b>
减：营业成本	499,362,965.66	410,287,501.02	71,597,527.06	481,885,028.08	559,652,161.31
营业税金及附加	6,101,660.69	2,831,333.45	992,262.60	3,823,596.05	4,113,679.86
营业费用	10,999,538.51	12,002,999.97	1,491,931.87	13,494,931.84	15,298,720.99
管理费用	63,359,287.57	38,154,011.47	10,533,465.78	48,687,477.25	54,472,060.89
财务费用	-2,779,036.38	-1,183,595.83	2,025,388.61	841,792.78	13,385,652.64
资产减值损失	-353,951.85	106,172.12	-	106,172.12	-
加：公允价值变动收益	-	-	-	-	-
投资收益	-468,834.13	-112,871.07	-	-112,871.07	-
二、营业利润	<b>161,804,221.33</b>	<b>114,271,304.14</b>	<b>12,649,826.97</b>	<b>126,921,131.11</b>	<b>118,053,359.40</b>
加：营业外收入	5,074,956.60	1,622,511.33	-	1,622,511.33	-
减：营业外支出	237,867.57	571,468.96	-	571,468.96	-
三、利润总额	<b>166,641,310.36</b>	<b>115,322,346.51</b>	<b>12,649,826.97</b>	<b>127,972,173.48</b>	<b>118,053,359.40</b>
所得税	30,496,103.23	17,695,011.65	2,416,114.19	20,111,125.84	17,708,003.91
四、净利润	<b>136,145,207.13</b>	<b>97,627,334.86</b>	<b>10,233,712.78</b>	<b>107,861,047.64</b>	<b>100,345,355.49</b>

## 第十一节 同业竞争和关联交易

### 一、本次交易对同业竞争的影响

#### (一) 本次交易前的同业竞争情况

本次交易前，公司的控股股东为同方股份，间接控股股东为清华控股，实际控制人为教育部。

本次交易前，公司的主营业务为压电石英晶体元器件的开发、生产和销售，主要产品为石英晶体谐振器和石英晶体振荡器。

同方股份主营业务可以概括为“两大产业、十一大领域”，即主要集中在信息和能源环境两大产业，其中，信息产业涉及计算机系统、数字城市、物联网应用、微电子与核心元器件、安防系统、多媒体、数字电视系统、军工、知识网络等九大领域；能源环境产业涉及建筑节能、半导体与照明两大领域。本次交易前，公司与控股股东同方股份之间不存在同业竞争。同方股份控股子公司情况见“第三节 交易对方的基本情况 二、交易对方之一：同方股份有限公司（六）下属企业名录”。

公司的间接控股股东清华控股所控制的公司主要分属信息技术产业、能源环保产业、生命科技产业、科技服务及相关产业四大产业领域，公司与间接控股股东清华控股之间不存在同业竞争。截至2011年9月30日，清华控股控股子公司情况如下表：

#### (1) 信息技术产业类

序号	企业名称	注册资本 (万元)	主营业务	持股比例
1	同方股份有限公司	99,385.06	信息技术业；环境工程设计、咨询，工业废水、生活污水环境保护设施运营；高新技术开发转让；物业管理等	23.88%
2	紫光股份有限公司	20,608.00	电子工程施工；综合布线工程；承接通信、监控、收费综合系统工程的施工；承包工程施工；设备安装3级；环境理体系咨询	31.62%
3	北京华环电子股份有限公司	5,242.95	通信技术设备的研发、生产、制造、销售	56.07%
4	比威网络技术有限公司	11,600.00	数据网络设备和网络安全设备的研究、开发、生产和销售	51.72%

5	北京清软英泰信息技术有限公司	600.00	经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务	51.00%
---	----------------	--------	---	--------

## (2) 能源环保产业

序号	企业名称	注册资本 (万元)	主营业务	持股比例
1	北京紫光泰和通环保技术有限公司	3,000.00	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;专业承包;污水资源化处理、废弃物生态化处理;开发生物工程	74.50%
2	浦华环保有限公司	22,145.00	项目投资与投资管理;生产销售桶装饮用水;销售桶装饮用纯净水、桶装矿泉水、瓶装矿泉水、饮料、医疗器械 III 类	35.77%
3	北京清华阳光能源开发有限公司	15,359.85	玻璃真空太阳集热管、热水器及热水系统真空薄膜产品、玻璃制品、太阳能装置零配件、仪器仪表制	31.60%
4	龙江环保集团股份有限公司	32,000.00	水务方面的投资、建设、运营,新技术开发、研制,新产品生产、销售(国家限制项目除外)	17.81%

## (3) 生命科技产业

序号	企业名称	注册资本 (万元)	主营业务	持股比例
1	诚志股份有限公司	29,703.24	生命科学、生物工程、医院投资管理、中西药、医药中间体、医疗器械、日用及专用化学品等产品的开发、生产、销售;技术开发、转让、咨询服务;物业管理;自产产品及相关技术进出口业务	40.11%
2	博奥生物有限公司	37,650.00	生物芯片相关技术的研究、开发和生产、销售	69.32%
3	紫光集团有限公司	34,000.00	资产管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;保险兼业代理;委托生产、经营经国家批准的片剂、硬胶囊、颗粒剂、口服液、软胶囊、保健食品。	52.35%

## (4) 科技服务及相关产业

序号	企业名称	注册资本 (万元)	主营业务	持股比例
1	启迪控股股份有限公司	54,432.00	投资管理;土地、基础设施建设、房地产的开发、销售商品房;技术开发、技术咨询、技术服务	59.90%
2	北京华控汇金投资管理有限公司	1,000.00	实业投资及管理、投资管理咨询服务	95.00%
3	清华大学建筑设计院有限公司	5,000	建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计;建筑智能化系统、公路行业(公路、交通)、水利行业(水库枢纽)工程设计;建筑、水电、水利工程咨询。	100%
4	北京清能创新	1,552.49	货物进出口,代理进出口,技术进出口	94.52%

序号	企业名称	注册资本 (万元)	主营业务	持股比例
	科技有限公司			
5	青岛华控合志实业有限公司	1,000.00	销售燃料油、日用百货、机电设备、电子产品及经济信息服务咨询；货物和技术的进出口	100.00%
6	北京清尚建筑装饰工程有限公司	4,000.00	建筑装饰装修工程专业承包；建筑装饰工程设计、展览设计；设计、安装、销售壁画、雕塑及艺术陈设品；广告设计、制作。	55.49%
7	辽宁省路桥建设集团有限公司	18,000.00	公路、桥梁总承包，公路、桥梁施工，市政工程建设	100.00%
8	北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	600.00	环境污染防治专项工程设计	100.00%
9	清华大学出版社有限公司	35,000.00	出版本校设置的学科、专业、课程所需教材；本校教学所需要的参考书、教学工具书；与本校主要专业方向相一致的学术专著、译著	100.00%
10	清华同方光盘电子出版社	500.00	出版科技、文化娱乐和社会教育方面的电子出版物	100.00%
11	河北华控弘屹科技有限公司	12,690.18	对河北清华科技园的开发、经营和管理；科技成果转化、推广、高科技项目的孵化；科技技术服务；创业投资管理	60.60%

## （二）本次交易对同业竞争影响

本次交易为公司非公开发行股份购买同方微电子 100% 股权。本次交易完成后，公司的控股股东、间接控股股东、实际控制人均未发生变化。

同方微电子主要从事智能卡、RFID 电子标签和信息安全等核心芯片的设计开发与销售。同方微电子的主营业务与同方股份、清华控股及其控制的关联方之间不存在同业竞争。

本次交易完成后，公司与控股股东同方股份的主营业务不存在同业竞争，与间接控股股东清华控股的主营业务不存在同业竞争。

## （三）关于避免同业竞争的措施

为了有效避免同业竞争，本次交易完成后的控股股东同方股份和间接控股股东清华控股作出书面承诺如下：

“1、本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司目前均未从事任何与晶源电子、同方微电子构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。

2、本公司及相关企业将来亦不直接或间接从事任何与晶源电子、同方微电子相同或类似的业务，不直接或间接从事、参与或进行与晶源电子、同方微电子的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动。”

综上所述，本次交易完成后，晶源电子与控股股东及其控制的企业不存在同业竞争。晶源电子的控股股东同方股份和间接控股股东清华控股出具了关于避免同业竞争的承诺函，该等避免同业竞争的措施或承诺函有利于本次交易完成后上市公司避免同业竞争。

## 二、本次交易对关联交易的影响

### （一）本次交易前公司关联方情况

#### 1、截至本报告书出具日，本次交易前公司存在控制关系的关联方

公司名称	与本公司关系	经济性质或类型	注册地址	注册资本(万元)	主要经营范围	法定代表人
同方股份	控股股东【注1】	股份公司	北京市	99,385.06	信息技术业；环境工程设计、咨询，工业废水、生活污水环境保护设施运营；高新技术开发转让；物业管理等	荣泳霖
晶源科技	原控股股东【注2】	有限责任公司	河北省玉田县	1,008.00	电子元件的开发、生产、销售；精密机械的开发、制造、销售。	孟令富
清华控股	间接控股股东	有限责任	北京市	200,000.00	信息技术产业、能源环境产业、生命科学及制药产业、科技服务等。	荣泳霖

注1：2009年6月21日，同方股份与公司原控股股东晶源科技签署了《发行股份购买资产协议》，同方股份向晶源科技发行股份购买晶源科技持有的晶源电子3,375万股股份，占晶源电子总股本的25.0%。2010年3月30日，中国证监会核准该方案。2010年6月28日，同方股份与晶源科技完成了股份转让及过户登记手续，同方股份持有公司25.0%的股权，成为公司第一大股东。公司控股股东由晶源科技变更为同方股份。

注2：晶源科技于2011年6月7日注销清算，根据《唐山晶源科技有限公司清算报告》中的剩余财产分配方案，晶源科技注销后，晶源科技持有的晶源电子13,901,362股股份（占公

司总股份的10.30%)由晶源科技现有股东进行分配。

## 2、截至本报告出具日，本次交易前与公司不存在控制关系的关联方

产业类别	企业名称	注册资本(万元)	与本公司关系
信息产业	同方威视技术股份有限公司	15,000.00	同受控股股东控制
	北京同方微电子有限公司	3,160.00	同受控股股东控制
	北京同方创新投资有限公司	18,000.00	同受控股股东控制
	同方工业有限公司	40,000.00	同受控股股东控制
	山东同方鲁颖电子有限公司	8,000.00	同受控股股东控制
	同方锐安科技有限公司	6,000.00	同受控股股东控制
	北京同方软件股份有限公司	5,000.00	同受控股股东控制
	同方光盘股份有限公司	8,000.00	同受控股股东控制
	北京同方光盘股份有限公司	1,800.00	同受控股股东控制
	中国学术期刊(光盘版)电子杂志社	100.00	同受控股股东控制
	沈阳同方多媒体科技有限公司	31,800.00	同受控股股东控制
	深圳市同方多媒体科技有限公司	30,000.00	同受控股股东控制
	北京同方凌讯科技有限公司	20,000.00	同受控股股东控制
	北京同方吉兆科技有限公司	7,000.00	同受控股股东控制
	北京中录同方文化传播有限公司	5,000.00	同受控股股东控制
	同方健康科技(北京)有限公司	4,144.00	同受控股股东控制
	同方鼎欣信息技术有限公司	6,250.00	同受控股股东控制
	郑州同方神火科技有限公司	2,000.00	同受控股股东控制
	同方国际信息技术有限公司	美元 800.00	同受控股股东控制
	Resuccess Investments Ltd.	美元 2,000.01	同受控股股东控制
Technovator Int Private Ltd.	美元 908.00	同受控股股东控制	
THTF U.S.A. Inc.	美元 249.00	同受控股股东控制	
TongFang Asia Pacific (R&D Center) Pte Ltd.	美元 300.00	同受控股股东控制	
九江佳华压电晶体材料有限公司	850.00	本公司联营企业	
能源环境产业	泰豪科技股份有限公司	45,532.57	同受控股股东控制
	南通同方半导体有限公司	67,200.00	同受控股股东控制
	同方炭素科技有限公司	5,000.00	同受控股股东控制
	淮安同方水务有限公司	11,000.00	同受控股股东控制
	惠州市同方水务有限公司	3,600.00	同受控股股东控制
	同方光电科技有限公司	8,000.00	同受控股股东控制
	同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	4,000.00	同受控股股东控制
	同方光电(香港)有限公司	美元 2,000.00	同受控股股东控制
	清芯光电有限公司	美元 1,000.00	同受控股股东控制
科技园及其他	北京同方房地产开发有限公司	5,000.00	同受控股股东控制
	北京同方物业管理有限公司	950.00	同受控股股东控制
	无锡同方创新科技园有限公司	10,000.00	同受控股股东控制
	同方鞍山科技园有限公司	3,000.00	同受控股股东控制
	沈阳同方科技园有限公司	13,000.00	同受控股股东控制
	南通同方科技园有限公司	20,000.00	同受控股股东控制

## （二）本次交易前，公司在报告期内的关联交易

### 1、关联方交易

根据兴华事务所出具的（2009）京会兴审字第6-148号审计报告、（2010）京会兴审字第1-42号审计报告和（2011）京会兴审字第1-007号审计报告，本次交易前，公司的关联交易交易情况如下：

#### （1）关联担保

2008年度，公司向中国农业银行唐山分行借入短期借款1,000,000.00美元，借款期限为2008年4月7日至2009年4月7日。公司原控股股东晶源科技为该笔借款提供连带责任保证担保。目前，该笔贷款已到期，晶源科技的担保已经解除。

#### （2）关联借款

2008年度，公司付给联营公司九江佳华压电晶体材料有限公司（以下简称“九江佳华”）往来款50.00万元。2009年度，公司付给联营公司九江佳华往来款50.00万元。上述往来款主要是晶源电子作为九江佳华的联营公司，根据相关合作协议向其支付的运营流动资金，协议约定九江佳华取得盈利后优先偿还该往来款。

除上述关联交易外，交易前公司不存在其他关联交易。

### 2、关联方往来余额

单位：万元

项目	关联方名称	2011. 9. 30	2010. 12. 31	2009. 12. 31	2008. 12. 31
其它应收款	九江佳华压电晶体材料有限公司	100.00	100.00	-	-

## （三）本次交易完成后，公司的关联方变化情况

本次交易完成后，同方微电子从同方股份的子公司变更为晶源电子的全资子公司，同方微电子与本公司的关系由“同受控股股东控制”变为“全资子公司”。交易前后，公司的主要关联方未发生变化。

## （四）本次交易后对上市公司关联交易影响

本次交易完成后，上市公司与关联方之间的经营性关联交易有所增加。根据兴华事务所出具的同方微电子三年一期的审计报告（（2010）京会兴审字第1-149

号和（2011）京会兴审字第1-130号）和晶源电子两年一期备考财务报告报告的审计报告（（2010）京会兴审字第1-150号和（2011）京会兴审字第1-129号），报告期内，主要关联交易的情况如下：

## 1、本次交易后关联交易及关联往来的情况

### （1）本次交易增加的关联方交易

#### ①购买商品、接受劳务等关联交易

单位：万元

关联企业	2011年1-9月		2010年度		2009年度	
	金额	占年度同类交易百分比	金额	占年度同类交易百分比	金额	占年度同类交易百分比
同方股份有限公司	-	-	-	-	75.00	0.44%
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75.00</b>	<b>0.44%</b>

#### ②销售商品、提供劳务等关联交易

单位：万元

关联企业	2011年1-9月		2010年度		2009年度	
	金额	占年度同类交易百分比	金额	占年度同类交易百分比	金额	占年度同类交易百分比
同方股份有限公司	6.84	0.01%	202.16	0.59%	553.23	0.75%
同方锐安科技有限公司	114.90	0.24%	22.50	0.07%	205.32	0.28%
<b>合计</b>	<b>121.74</b>	<b>0.25%</b>	<b>224.66</b>	<b>0.65%</b>	<b>758.55</b>	<b>1.03%</b>

#### ③关联担保

报告期内，同方股份为同方微电子银行承兑汇票提供了担保。。截至本报告书出具日，同方股份对同方微电子的担保余额为 73,218,706.67 元，明细如下：

贷款银行	银行承兑汇票金额	承兑票据期限	保证期间	是否履行完毕
交行北京林萃路支行	6,570,335.64	2011.8.24-2012.2.24	2011.8.24-2012.2.24	否
交行北京林萃路支行	9,000,000.00	2011.8.24-2012.2.24	2011.8.24-2012.2.24	否
交行北京林萃路支行	2,466,449.60	2011.9.22-2012.3.22	2011.9.22-2012.3.22	否
交行北京林萃路支行	9,000,000.00	2011.9.22-2012.3.22	2011.9.22-2012.3.22	否

交行北京林萃路支行	9,000,000.00	2011.9.22-2012.3.22	2011.9.22-2012.3.22	否
交行北京林萃路支行	9,000,000.00	2011.10.27-2012.04.24	2011.10.27-2012.4.24	否
交行北京林萃路支行	9,000,000.00	2011.10.27-2012.04.24	2011.10.27-2012.4.24	否
交行北京林萃路支行	3,742,574.43	2011.10.27-2012.04.24	2011.10.27-2012.4.24	否
交行北京林萃路支行	9,000,000.00	2011.11.16-2012.05.16	2011.11.16-2012.5.16	否
交行北京林萃路支行	6,439,347.00	2011.11.16-2012.05.16	2011.11.16-2012.0.16	否
<b>合计</b>	<b>73,218,706.67</b>			

报告期内，同方微电子没有为任何关联方提供担保的情况。

本次交易增加的关联交易，占上市公司同类交易的比重较小。所有关联交易均按照市场价格，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

## (2) 本次交易增加的关联往来余额

单位：万元

项目名称	关联方	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
应收款项	同方锐安科技有限公司	135.67	23.73	190.18	-
应收款项	同方股份有限公司	8.44	0.44	-	-
预收款项	同方股份有限公司		-	-	42.31
应付股利	同方股份有限公司		-	7,998.00	7,998.00
应付股利	陆致成		-	651.00	651.00
应付股利	赵维健		-	651.00	651.00
<b>合计</b>		<b>144.11</b>	<b>24.17</b>	<b>9,490.18</b>	<b>9,342.31</b>

本次交易完成后，公司没有增加任何非经营性关联交易及关联方往来余额。截至2011年9月30日，应收关联交易余额合计144.11万元，均为经营性关联交易余额。

## (五) 本次交易构成关联交易

本次交易对方包括上市公司控股股东同方股份及关联自然人，因此本次非公开发行股份购买资产构成关联交易，公司在召开董事会、股东大会审议相关议案时，将提请关联方回避表决。本次交易符合关联交易的公允性原则，履行了合法

程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

## （六）规范关联交易的措施

本次交易完成后，公司将尽可能的减少与控股股东及其关联企业之间的关联交易，对于必要的关联交易，公司已制定了相关措施。为充分保护上市公司的利益，公司控股股东同方股份和间接控股股东清华控股做出规范关联交易的承诺：

（1）尽量避免或减少本公司及其所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与晶源电子及其子公司之间发生关联交易。

（2）不利用股东地位及影响谋求晶源电子及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；

（3）不利用股东地位及影响谋求与晶源电子及其子公司达成交易的优先权利；

（4）将以市场公允价格与晶源电子及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害晶源电子及其子公司利益的行为；

（5）就本公司及其下属子公司与晶源电子及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促上市公司履行合法决策程序，按照《上市规则》和上市公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。

同时，公司已制定了关联交易相关管理办法，对关联交易的内容及应履行的程序、关联交易基本原则、关联交易定价原则、审批权限及其信息披露等进行了明确规定；在相关事项涉及关联交易时，公司将严格执行关联股东和关联董事回避制度；

上述措施将能够有效保证公司关联交易的公开、公平、公正。

## 第十二节 本次交易对公司治理机制的影响

本次交易前，本公司严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》等有关法律法规以及中国证监会的要求规范运作，建立了完善的法人治理结构和独立运营的经营机制。

本次交易完成后，公司将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求进一步完善公司治理结构。

### 一、公司拟采取的完善公司治理结构的措施

本次交易完成后，同方股份持有的本公司股权比例将从25%增加至51.83%，处于绝对控股地位。为了更加完善公司治理结构，公司拟采取的措施主要包括以下几个方面：

#### 1、控股股东与上市公司

本次交易完成后，公司将积极督促控股股东严格依法行使股东的权利，切实履行对本公司及其他股东的诚信义务，除依法行使股东权利以外，不直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动，不利用其控股地位谋取额外的利益，以维护广大中小股东的合法权益。

#### 2、股东与股东大会

本次交易完成后，公司将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定履行股东大会职能，确保所有股东，尤其是中小股东享有法律、行政法规和《公司章程》规定的平等权利，在合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例，切实保障股东的知情权和参与权。本公司将完善《关联交易决策制度》，严格规范本公司与关联人之间的关联交易行为，切实维护中小股东的利益。

#### 3、董事与董事会

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在规范公司运作、维护中小股东的合法权益、提高公司决策的科学性等方面的积极作用。独立董事的选聘、独立董事工作制度的建立和执行将严格遵守国家有关法律、法规、规章以及《公

公司章程》的有关规定。

#### 4、专家及专业委员会

为提高公司的决策水平和决策效率，完善公司的治理结构，促使公司健康、稳定、持续的发展，使专家在公司决策体系中充分发挥作用。公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会；公司董事会可以根据需要适时设立其他委员会。专门委员会成员全部由董事组成，提名、薪酬与考核、审计委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会专门委员会职责按照法律、行政法规、部门规章及公司的有关规定执行。

#### 5、监事与监事会

本次交易完成后，公司将继续严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，为监事正常履行职责提供必要的协助，保障监事会对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督的权利，维护公司及股东的合法权益。

## 二、控股股东对上市公司的承诺

为了更好的维护上市公司利益和中小股东权益，公司控股股东同方股份和间接控股股东清华控股出具承诺：

### “一、保证晶源电子的人员独立

1、保证晶源电子的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在晶源电子工作、并在晶源电子领取薪酬，不在承诺人及承诺人除晶源电子外的全资附属企业或控股子公司担任除董事、监事以外的职务。

2、保证晶源电子的人事关系、劳动关系独立于承诺人。

3、保证承诺人推荐出任晶源电子董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，承诺人不干预晶源电子董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。

### 二、保证晶源电子的财务独立

1、保证晶源电子及控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。

2、保证晶源电子及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预晶源电子的资金使用。

3、保证晶源电子及其控制的子公司独立在银行开户，不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户。

4、保证晶源电子及控制的子公司依法独立纳税。

### 三、保证晶源电子的机构独立

1、保证晶源电子及其控制的子公司(包括但不限于)依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与承诺人的机构完全分开；晶源电子及其控制的子公司(包括但不限于)与承诺人及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。

2、保证晶源电子及其控制的子公司(包括但不限于)独立自主地运作，承诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。

### 四、保证晶源电子的资产独立、完整

1、保证晶源电子及其控制的子公司具有完整的经营性资产。

2、保证不违规占用晶源电子的资金、资产及其他资源。

### 五、保证晶源电子的业务独立

1、保证晶源电子在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖承诺人。

2、保证承诺人及其控制的其他关联人避免与晶源电子及控制的子公司发生同业竞争。

3、保证严格控制关联交易事项，尽量减少晶源电子及控制的子公司(包括但不限于)与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照晶源电子的公司章程、有关法律法规和《深圳证券交

易所股票上市规则(2008年修订)》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,及时进行有关信息披露。

4、保证不通过单独或一致行动的途径,以依法行使股东权利以外的任何方式,干预晶源电子的重大决策事项,影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。”

## 第十三节 其他对上市公司的影响

### 一、资金占用和关联担保

#### (一) 控股股东或其他关联方资产、资金占用情况

##### 1、本次交易前的关联方资金占用情况

根据兴华事务所出具的《关于唐山晶源裕丰电子股份有限公司控股股东及其它关联方占用资金情况的专项说明》((2011)京会兴核字第 1-010 号)。2010 年度晶源电子的控股股东、实际控制人及其附属企业, 以及其他关联方不存在对晶源电子的非经营性资金占用。

根据兴华事务所出具的《关于唐山晶源裕丰电子股份有限公司募集资金 2009 年度使用情况专项报告的鉴证报告》((2010)京会兴核字第 1-15 号)。2009 年度晶源电子的控股股东<sup>[注]</sup>、实际控制人及其附属企业, 以及其他关联方不存在对晶源电子的非经营性资金占用。

根据兴华事务所出具的《关于唐山晶源裕丰电子股份有限公司募集资金 2008 年度使用情况专项报告的鉴证报告》((2009)京会兴核字第 6-66 号), 2008 年度晶源电子的控股股东<sup>[注]</sup>、实际控制人及其附属企业, 以及其他关联方不存在对晶源电子的非经营性资金占用。

注: 2008 年度、2009 年度, 公司的控股股东为原控股股东晶源科技。2009 年 6 月 21 日, 同方股份与晶源科技签署了《发行股份购买资产协议》, 同方股份向晶源科技发行 1,688 万股股份, 购买晶源科技持有的晶源电子 3,375 万股股份, 占晶源电子总股本的 25.0%。2010 年 3 月 30 日, 中国证监会核准该方案。2010 年 6 月 28 日, 同方股份与晶源科技完成了股份转让及过户登记手续, 公司控股股东由晶源科技变更为同方股份, 实际控制人由自然人阎永江先生变更为教育部。

##### 2、本次交易后的关联方资金占用情况

本次交易完成后, 公司的控股股东仍为同方股份, 间接控股股东仍为清华控股。根据兴华事务所出具的上市公司最近两年一期备考财务报告的审计报告 ((2010)京会兴审字第 1-150 号和 (2011)京会兴审字第 1-129 号), 截至到 2011 年 9 月 30 日, 晶源电子的控股股东、实际控制人及其关联方不存在对晶源

电子的非经营性资金占用。

## （二）上市公司为控股股东及其关联方提供担保情况

本次交易前，上市公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。本次交易完成后，上市公司的控股股东、实际控制人及主要关联方没有发生变化，上市公司仍不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

## 二、本次交易对上市公司负债结构的影响

根据晶源电子经审计的财务报表及经审计的备考财务报表，本次交易前后晶源电子的负债结构如下：

单位：万元

项目	重组前	备考重组后
	2011年9月30日	2011年9月30日（备考）
资产总额	51,471.05	134,714.45
负债总额	5,481.08	29,825.90
合并报表资产负债率	10.65%	22.14%

本次交易完成前后，2011年9月30日公司的资产负债率分别为10.65%、22.14%。增加负债主要为同方微电子经营性债务。同方微电子本身没有银行短期借款和长期借款，具有良好的财务状况及融资能力，公司不存在因本次交易大量增加负债的情形。

## 三、连续停牌前公司股票价格的波动情况

公司自2010年9月20日起停牌。在2010年8月23日—2010年9月17日（本次重大资产重组信息公布前20个交易日）期间，晶源电子的股价从13.50元/股上涨到13.96元/股，上涨幅度为3.41%；深圳成指从11,090.46点上涨到11,208.25点，上涨幅度为1.06%；中小板指从5,809.47点上涨到6,209.30点，上涨幅度为6.88%。电子行业指数（证监会行业划分标准）从946.67点上涨到986.63点，上涨幅度为4.22%。

剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅不超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露

及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条相关标准。

#### 四、对相关人员进行股票买卖情况的自查

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则——第26号上市公司重大资产重组申请文件》（证监会公告【2008】13号）以及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）的要求，公司对本次交易相关内幕信息知情人及其直系亲属是否利用该消息进行内幕交易进行了自查，并由相关内幕信息知情人出具了自查报告。

2010年11月7日，公司召开首次董事会，审议通过本次交易预案。公司确定的核查期间为本次重组预案董事会决议前6个月至本次重组报告书公告之日止。公司确定的核查范围包括：本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属；交易对方同方股份、清晶微科技的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属；自然人交易对方及其直系亲属；交易标的同方微电子、同方微电子的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属；本次交易的各中介机构、各中介机构的经办人员及其直系亲属。

根据中国登记结算有限责任公司深圳分公司提供的交易查询结果，核查范围内人员在核查期间买卖本公司股票情况如下：

1、上市公司晶源电子、晶源电子的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属自查期间交易晶源电子流通股的情况

（1）根据自查报告及证券登记结算公司查询结果，晶源电子董事潘晋的配偶邵敏在本次晶源电子停牌日前六个月至本次重组报告书公告之日有买卖晶源电子的行为，具体为：2010年3月31日买入5,000股晶源电子股票，2010年8月16日卖出5,000股晶源电子股票，目前没有持有晶源电子股份。

邵敏买卖晶源电子股票的行为系在未知悉本次交易的情况下做出，不构成内幕交易。

潘晋于2010年10月13日被晶源电子第三届董事会提名为公司第四届董事会非独立董事候选人，并于2010年10月29日经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。在晶源电子本次重组停牌前，潘晋未担任晶源电子董事、监事及

高级管理人员，未获知晶源电子本次资产重组事宜任何信息。晶源电子董事潘晋已于2010年11月1日出具声明：本人未向其配偶邵敏提供任何关于晶源电子本次重组的任何信息。

潘晋配偶邵敏已于2010年11月1日出具书面承诺：其上述股票买卖行为系依据对证券市场的判断和对晶源电子投资价值的认可而购买，事先未获知任何关于晶源电子本次重组的任何信息。

邵敏上述买卖晶源电子股票行为未获得收益。

(2) 除此之外，晶源电子、晶源电子的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次晶源电子停牌日前六个月至本次重组报告书公告之日无交易晶源电子流通股的行为。

2、交易对方同方股份、同方股份的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属自查期间交易晶源电子流通股的情况

(1) 根据自查报告及证券登记结算公司查询结果，同方股份在本次晶源电子停牌日前六个月至本次重组报告书公告之日有买入晶源电子股票的行为，具体为：2010年6月28日买入33,750,000股晶源电子股票，目前持有晶源电子股票的数量仍为33,750,000股。

同方股份买入晶源电子股票是因为：2009年6月21日，同方股份与公司原第一大股东晶源科技签署了《发行股份购买资产协议》，同方股份向晶源科技发行1,688万股股份，购买晶源科技持有的晶源电子3,375万股股份，占晶源电子总股本的25%。2010年3月30日，中国证监会核准该方案。2010年6月28日，同方股份与晶源科技完成了股份转让及过户登记手续。

自查期间，同方股份买入晶源电子股票的行为是同方股份向晶源科技发行股份购买晶源科技持有晶源电子股份之交易的必经程序，该行为不构成内幕交易。

(2) 根据自查报告及证券登记结算公司查询结果，同方股份的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次晶源电子停牌日前六个月至本次重组报告书公告之日无交易晶源电子流通股的行为。

3、交易对方清晶微科技、清晶微科技的董事、监事、高级管理人员及其直

系亲属自查期间交易晶源电子流通股的情况

根据自查报告及证券登记结算公司查询结果，清晶微科技、清晶微科技的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次晶源电子停牌日前六个月至本次重组报告书公告之日无交易晶源电子流通股的行为。

4、交易对方赵维健、葛元庆、吴行军、段立、孟红霞、宋翌、丁义民、李刚及其直系亲属自查期间交易晶源电子流通股的情况

根据自查报告及证券登记结算公司查询结果，赵维健、葛元庆、吴行军、段立、孟红霞、宋翌、丁义民、李刚及其直系亲属在本次晶源电子停牌日前六个月至本次重组报告书公告之日无交易晶源电子流通股的行为。

5、交易标的同方微电子及同方微电子的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属自查期间交易晶源电子流通股的情况

根据自查报告及证券登记结算公司查询结果，同方微电子、同方微电子的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次晶源电子停牌日前六个月至本次重组报告书公告之日无交易晶源电子流通股的行为。

6、本次相关中介机构、经办人员及其直系亲属自查期间交易晶源电子流通股的情况

根据自查报告及证券登记结算公司查询结果，本次交易相关中介机构、中介机构的经办人员及其直系亲属在本次晶源电子停牌日前六个月至本次重组报告书公告之日无交易晶源电子流通股的行为。

本次交易的法律顾问中咨律师认为：基于以上自查报告、中国证券登记结算有限责任公司的查询结果、各公司的说明、相关人员对买卖股票的说明及声明等，该等交易不涉嫌内幕交易，对本次重大资产重组不构成法律障碍。

## 五、对相关人员买卖同方股份股票情况的自查

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则——第26号上市公司重大资产重组申请文件》（证监会公告【2008】13号）以及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）的要求，公司对本次交易相关内幕信息知情人及其直系亲属是否利用该消息买卖同方股份股

票进行了核查。

2010年9月20日，公司股票因本次重大资产重组停牌。公司确定的核查期间为晶源电子股票停牌前6个月至本次重组报告书公告之日止。公司确定的核查范围包括：本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属；交易对方同方股份、清晶微科技的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属；清晶微科技的股东及其直系亲属；自然人交易对方及其直系亲属；交易标的同方微电子、同方微电子的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属；交易对方同方股份的控股股东清华控股有限公司的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属；本次交易的各中介机构、各中介机构的经办人员及其直系亲属。

根据中国登记结算有限责任公司上海分公司提供的交易查询结果，核查范围内人员在核查期间买卖同方股份股票情况如下：

1、上市公司晶源电子、晶源电子的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属自查期间交易同方股份股票的情况

(1) 根据证券登记结算公司查询结果，晶源电子董事潘晋的配偶邵敏在核查期间有买卖同方股份股票的行为，具体为：

姓名	身份	日期	交易价格 (元/股)	交易数量 (股)	交易类型	目前持股数量 (股)
邵敏	晶源电子董事潘晋之配偶	2010.08.18	24.87	14000	卖出	无
		2010.08.18	24.86	1000	卖出	

潘晋于2010年10月13日被晶源电子第三届董事会提名为公司第四届董事会非独立董事候选人，并于2010年10月29日经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。在晶源电子本次重组停牌前，潘晋未担任晶源电子董事、监事及高级管理人员，未获知本次资产重组事宜任何信息。晶源电子董事潘晋已于2011年3月2日出具声明：本人未向配偶邵敏提供任何关于晶源电子本次重组的任何信息。

潘晋配偶邵敏已于2011年3月1日出具书面承诺：其上述股票买卖行为是根据自身的判断所进行的投资行为，事先未获知关于晶源电子本次重组的任何信息。

晶源电子出具说明：潘晋于 2010 年 10 月 11 日被公司第三届董事会提名为公司第四届董事会非独立董事候选人，并于 2010 年 10 月 29 日经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。在公司本次重组停牌前，潘晋未担任公司董事、监事及高级管理人员，未获知公司本次资产重组事宜任何信息。本公司参与上述事宜的具体执行人员已经根据本公司的规定对本次非公开发行股份购买资产事宜的信息始终严格保密，未向包括潘晋、邵敏在内非相关人员提供任何内幕信息或者买卖同方股份股票的建议。

邵敏买卖同方股份股票的行为系在未知悉本次交易的情况下做出，不构成内幕交易。

(2) 除此之外，晶源电子、晶源电子的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在核查期间无交易同方股份股票的行为。

2、交易对方同方股份、同方股份的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属自查期间交易同方股份股票的情况

(1) 根据证券登记结算公司查询结果，同方股份监事刘刚的配偶韩冰、同方股份副总裁薛霖及其父亲薛福兴、同方股份副总裁王明亮的配偶罗海玲在核查期间有买卖同方股份股票的行为，具体为：

姓名	身份	日期	交易价格 (元/股)	交易数量 (股)	交易类型	目前持股 数量(股)
韩冰	同方股份监事刘刚之配偶	2010.05.07	26.25	11400	卖出	无
		2010.10.19	25.38	1700	卖出	
薛霖	同方股份副总裁	2010.04.12	24.70	3000	卖出	截至 2011 年 1 月 6 日持有同方股份股票 5000 股
		2010.04.20	27.88	2600	卖出	
		2010.05.05	26.50	2000	卖出	
		2010.05.06	28.30	3000	卖出	
薛福兴	同方股份副总裁薛霖之父	2010.04.15	25.40	10	卖出	无
罗海玲	同方股份副总裁王明亮之配偶	2010.03.17	19.53	1000	买入	无
		2010.03.23	20.47	1200	买入	
		2010.03.23	20.45	1500	买入	

	2010.04.02	21.37	1000	买入
	2010.04.02	21.29	1000	买入
	2010.04.12	24.75	5700	卖出
	2010.04.15	25.97	200	买入
	2010. 04.15	25.78	2000	买入
	2010. 04.15	25.97	2800	买入
	2010. 04.15	26.05	5000	卖出
	2010. 04.16	26.88	2000	买入
	2010. 04.16	26.92	1500	买入
	2010. 04.16	26.90	1500	买入
	2010. 04.19	26.23	5000	卖出
	2010. 05.06	28.88	5000	卖出
	2010. 05.06	28.71	5000	卖出
	2010. 05.14	28.71	700	买入
	2010. 05.18	28.71	700	卖出

①刘刚现担任同方股份第五届监事会监事，晶源电子于2010年11月7日召开本次重组首次董事会，刘刚在晶源电子本次重组首次董事会召开前没有参与本次重组的任何实质性工作并获知任何信息。刘刚已于2011年2月27日出具声明：本人未向配偶韩冰提供关于本次交易的任何信息。

刘刚配偶韩冰已于2011年2月27日出具书面承诺：其上述股票买卖行为是根据自身的判断所进行的投资行为，事先未获知关于晶源电子本次重组的任何信息。

韩冰买卖同方股份股票的行为系在未知悉本次交易的情况下做出，不构成内幕交易。

②薛霖于2010年5月12日起担任同方股份副总裁，在晶源电子本次重组停牌前，没有参与本次重组的任何实质性工作并获知任何内幕信息。薛霖已于2011年3月2日出具声明：其上述股票买卖行为是根据自身的判断所进行的投资行为，事先未获知关于晶源电子本次重组的任何信息。本人未向父亲薛福兴提供任何关于本次交易的任何信息。

薛霖的父亲薛福兴已于 2011 年 3 月 2 日出具书面承诺：其上述股票买卖行为是根据自身的判断所进行的投资行为，事先未获知关于本次交易的任何信息。

根据相关说明及查询结果，薛霖、薛福兴进行最后一笔股票交易时薛霖尚未任职同方股份副总裁。薛霖、薛福兴买卖同方股份股票的行为系在未知悉本次交易的情况下做出，不构成内幕交易。

③王明亮于 2010 年 5 月 12 日起担任同方股份副总裁，在晶源电子本次重组停牌前，没有参与本次重组的任何实质性工作并获知任何内幕信息。王明亮已于 2011 年 2 月 28 日出具声明：本人未向配偶罗海玲提供关于本次交易的任何信息。

王明亮配偶罗海玲已于 2011 年 2 月 28 日出具书面承诺：其上述股票买卖行为是根据自身的判断所进行的投资行为，事先未获知关于晶源电子本次重组的任何信息。

根据相关说明及查询结果，罗海玲买卖同方股份股票的行为系在未知悉本次交易的情况下做出，不构成内幕交易。

同方股份出具说明：薛霖、王明亮于 2010 年 5 月 12 日起任本公司副总裁，刘刚、薛霖、王明亮在晶源电子本次重组预案董事会决议公告之前，没有参与上述事宜的任何实质性工作并获知任何内幕信息。本公司参与本次晶源电子重组事宜的具体执行人员已经根据本公司的规定对相关信息始终严格保密，未向包括但不限于刘刚、韩冰、王明亮、罗海玲、薛霖、薛福兴在内的非相关人员提供任何内幕信息或者买卖本公司股票的建议。

(2) 除此之外，同方股份、同方股份的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在核查期间无交易同方股份股票的行为。

3、交易对方清晶微科技、清晶微科技的股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属自查期间交易同方股份股票的情况

(1) 根据证券登记结算公司查询结果，清晶微科技股东黄钧本人以及股东陈冈的父亲陈大元、陈冈的配偶张萌在本次晶源电子停牌日前六个月至本次重组报告书公告之日有买卖同方股份的行为。

姓名	身份	日期	交易价格 (元/股)	交易数量 (股)	交易类型	目前持股 数量(股)
----	----	----	---------------	-------------	------	---------------

黄钧	清晶微科技之股东	2010.03.25	20.65	300	卖出	截至2011年1月6日持有同方股份股票600股
		2010.04.12	24.08	200	卖出	
		2010.04.19	26.49	600	买入	
		2010.04.20	27.53	300	卖出	
		2010.04.28	27.98	300	买入	
		2010.04.29	27.55	400	卖出	
		2010.04.30	27.40	200	买入	
		2010.05.04	27.09	200	卖出	
		2010.05.06	28.23	200	卖出	
		2010.06.30	20.98	200	买入	
		2010.07.02	20.11	200	买入	
		2010.09.14	25.00	200	卖出	
		2010.09.16	23.01	200	买入	
		2010.09.29	23.19	100	买入	
2010.10.12	23.36	100	买入			
陈大元	清晶微科技股东陈冈之父	2010.03.25	20.86	4000	卖出	无
张萌	清晶微科技股东陈冈之配偶	2010.06.08	26.11	100	买入	无
		2010.06.10	27.01	100	卖出	
		2010.06.11	26.89	100	买入	
		2010.06.11	26.82	100	买入	
		2010.08.16	25.04	100	买入	
		2010.08.26	22.71	100	买入	
		2010.08.31	22.87	200	买入	
		2010.10.15	24.88	600	卖出	

清晶微科技于2010年10月15日成立，黄钧、陈冈为清晶微科技小股东，分别拥有该公司0.42%、0.42%股权。在清晶微科技成立之前，黄钧、陈冈没有参与本次重组的任何实质性工作并获知任何信息。黄钧、陈大元、张萌买卖股票的时间均早于清晶微科技成立日期。

①黄钧已于2011年2月25日出具声明：其作为清晶微科技的股东，在清晶

微科技成立之前，没有参与本次交易事宜的任何实质性工作并获知任何信息，其上述股票买卖行为是根据自身的判断所进行的投资行为。

黄钧买卖同方股份股票的行为系在未知悉本次交易的情况下做出，不构成内幕交易。

②陈冈已于 2011 年 2 月 25 日出具声明：其作为清晶微科技的股东，在清晶微科技成立之前，没有参与本次交易事宜的任何实质性工作并获知任何信息，也从未向张萌、陈大元违规透露有关上述事宜的任何内幕信息或者提供任何买卖同方股份股票的建议。

陈冈之父陈大元、之配偶张萌已于 2011 年 2 月 25 日分别出具书面承诺：其上述股票买卖行为是根据自身的判断所进行的投资行为，事先未获知关于本次交易的任何信息。

陈大元、张萌买卖同方股份股票的行为系在未知悉本次交易的情况下做出，不构成内幕交易。

清晶微科技出具声明：黄钧、陈冈为本公司小股东，拥有本公司 0.42% 股权。在本公司成立之前，黄钧、陈冈没有参与上述事宜的任何实质性工作并获知任何信息。本公司参与上述事宜的具体执行人员已经根据本公司的规定对相关信息始终严格保密，未向包括黄钧、陈冈、张萌、陈大元在内非相关人员提供任何内幕信息或者买卖同方股份股票的建议。

(2) 除此之外，清晶微科技、清晶微科技的股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在核查期间无交易同方股份股票的行为。

4、交易对方赵维健、葛元庆、吴行军、段立、孟红霞、宋翌、丁义民、李刚及其直系亲属自查期间交易同方股份股票的情况

根据证券登记结算公司查询结果，赵维健、葛元庆、吴行军、段立、孟红霞、宋翌、丁义民、李刚及其直系亲属在核查期间无交易同方股份股票的行为。

5、交易标的同方微电子及同方微电子的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属自查期间交易同方股份股票的情况

根据证券登记结算公司查询结果，同方微电子、同方微电子的董事、监事、

高级管理人员及其直系亲属在核查期间无交易同方股份股票的行为。

6、交易对方同方股份的控股股东清华控股有限公司的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属自查期间交易同方股份股票的情况

(1) 根据证券登记结算公司查询结果，清华控股董事龙大伟的配偶曹兰在核查期间有买卖同方股份股票的行为，具体为：

姓名	身份	日期	交易价格 (元/股)	交易数量 (股)	交易类型	目前持股数量 (股)
曹兰	清华控股董事龙大伟之配偶	2010.04.19	26.35	49500	买入	无
		2010.04.19	26.34	500	买入	
		2010.04.20	27.48	4800	买入	
		2010.04.20	27.50	15600	买入	
		2010.04.20	27.52	17500	买入	
		2010.04.20	27.55	200	买入	
		2010.04.20	27.58	30000	买入	
		2010.04.20	27.60	300	买入	
		2010.04.20	27.68	4700	买入	
		2010.05.04	27.60	3100	卖出	
		2010.05.04	27.95	108356	卖出	
		2010.05.04	27.96	10544	卖出	
		2010.05.04	27.97	1100	卖出	

龙大伟先生在晶源电子本次重组停牌前，未担任清华控股的董事、监事及高级管理人员，没有参与本次重组的任何实质性工作，未知悉或者探知任何有关本次重组的内幕信息。

龙大伟已于 2011 年 3 月 2 日出具声明：本人未向张萌、陈大元违规透露有关上述事宜的任何内幕信息或者提供任何买卖同方股份股票的建议。

龙大伟配偶曹兰已于 2011 年 3 月 2 日出具书面承诺：其上述股票买卖行为是根据自身的判断所进行的投资行为，事先未获知关于本次交易的任何信息。

清华控股出具说明：龙大伟先生为本公司下属控股子公司诚志股份有限公司

董事、总裁，2010年7月21日，清华大学经营资产管理委员会第51次会议召开，同意龙大伟任清华控股第三届董事会董事。在晶源电子本次重组预案董事会决议公告之前，他没有参与上述事宜的任何实质性工作并获知任何内幕信息。本公司参与上述事宜的有关人员对相关信息始终严格保密，未向包括龙大伟、曹兰在内的非相关人员提供任何内幕信息或者买卖同方股份股票的建议。

根据清华控股的说明及查询结果，龙大伟的配偶曹兰进行最后一笔股票交易时龙大伟尚未任职清华控股的董事。

曹兰买卖同方股份股票的行为系在未知悉本次交易的情况下做出，不构成内幕交易。

(2) 除此之外，清华控股的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在核查期间无交易同方股份股票的行为。

7、本次相关中介机构、经办人员及其直系亲属自查期间交易同方股份股票的情况

根据证券登记结算公司查询结果，本次交易相关中介机构、中介机构的经办人员及其直系亲属在核查期间无交易同方股份股票的行为。

本次交易的法律顾问中咨律师认为：基于以上自查报告、中国证券登记结算有限责任公司的查询结果、各公司的说明、相关人员对买卖股票的说明及声明等，该等交易不涉嫌内幕交易，对本次重大资产重组不构成法律障碍。

因此，上述股票的买卖行为不会损害上市公司及其全体股东的利益，对晶源电子本次重大资产重组也不构成不利影响。

## **六、其他影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息**

公司严格按照相关法律法规的要求，及时、全面、完整的对本次交易相关信息进行了披露，无其他应披露而未披露的能够影响股东及其他投资者做出合理判断的有关本次交易的信息。

## 第十四节 风险因素

### 一、新技术研发风险

同方微电子为了保持技术领先优势，必须尽可能准确地预测相关芯片技术的发展方向、技术产业化及市场化的发展趋势，并进行相应的研发投入。同方微电子制定了完善的技术研发管理制度和风险控制流程，所有研发项目都必须经过前期调研和论证，履行严格的决策程序后方可实施。但由于对未来市场的预测存在不确定性，如果同方微电子对相关芯片技术和市场发展趋势判断失误，或新技术产业化存在重大不确定性，将可能让同方微电子面临风险。

### 二、对核心技术人员依赖的风险

同方微电子拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员。这是同方微电子技术持续领先、产品不断创新的主要因素之一。为了吸引和留住核心技术人才，同方微电子制定了行业内具有竞争力的薪酬政策和职业发展规划体系；并通过中高层管理人员和核心技术人员持股，增强相关人员对公司的归属感。随着行业的发展，企业间人才竞争的日趋激烈，人才流动可能增加，同方微电子仍存在核心技术人才流失的风险。

### 三、业务模式风险

同方微电子采用 Fabless 运营模式，有效降低了运营成本，提高了资金使用效益。但由于 Fabless 运营模式中，同方微电子本身不具备芯片制造能力，芯片制造、封装和测试必须依托晶圆代工厂商和封装测试厂商。为保证产品供应环节的的稳定，同方微电子已与多家有实力的晶圆代工厂商和封装测试厂商建立长期稳定的合作关系。但在集成电路生产旺季，可能会存在晶圆代工厂商和封装测试厂商产能饱和，不能保证公司产品及时供应的风险。

### 四、主要客户集中的风险

同方微电子2008年、2009年、2010年、2011年1-9月份向前五名客户销售涉及金额合计分别为37,304.98万元、43,175.04万元、31,821.70万元、24,504.73万元，占同期销售总金额的比例分别为94.04%、95.94%、92.43%、91.42%。同方微电

子存在客户相对集中的风险，可能会因为某一单个客户的变动，影响同方微电子的经营业绩。

2008年、2009年、2010年、2011年1-9月份同方微电子向公安部第一研究所的销售占同期销售总金额的比例分别为70.09%、65.99%、41.97%、50.34%，销售的内容为国家二代身份证芯片。销售占比比较高的主要原因在于同方微电子在成立之初就承担了国家第二代居民身份证专用芯片模块开发和生产供应任务，是公安部指定的四家二代身份证芯片供应商之一。公安部每年根据二代身份证换发情况，给四家供应商下达芯片生产指标，由公安部第一研究所负责统一采购。同时，在成立之初，公司的产品线相对单一，二代身份证芯片在销售收入中所占比重比较高。随着第二代居民身份证大规模换证进入尾声，第二代居民身份证芯片供应进入平稳期，以及公司产品线的丰富，SIM卡业务的迅猛发展，同方微电子与公安部第一研究所的销售占比在报告期内持续下降，由70.09%下降到50.34%。

## 五、主要供应商集中的风险

同方微电子2008年、2009年、2010年、2011年1-9月份向前五名供应商采购金额合计分别为25,879.54万元、15,613.96万元、21,454.04万元、17,390.91万元，占同期采购总金额的比例分别为98.64%、96.88%、97.40%、94.86%，采购比例比较集中。报告期内，上海华虹NEC电子有限公司是公司最大的供应商，2008年、2009年、2010年、2011年1-9月份同方微电子向上海华虹NEC电子有限公司的采购金额占当期采购总额的比例分别为68.68%、59.35%、63.32%、70.09%。公司对其采购内容为晶圆。上海华虹NEC电子有限公司是全球领先的晶圆代工厂商，双方业已建立起长期稳定的良好合作关系，签署了战略合作协议。相对于其它可供选择的代工厂商，在公司部分的芯片产品中，上海华虹NEC电子有限公司的工艺和技术可更有效提升公司产品的成功率和稳定性。公司与上海华虹NEC电子有限公司的交易价格与业界平均水平相当，价格公允，双方为平等的合作关系，对主要供应商不存在重大依赖。

公司对供应商价格确定有完备、严格的决策程序，以“品质优先”、“货比三家”策略为基础，在保证产品质量的前提下，以“成本导向定价”方法为主。同时考虑，同等质量和价格条件下，交付周期最短者优先；同等上述条件下，技术

支持服务较好者优先。

## 六、管理风险

本次交易完成后，公司的资产和业务规模将出现大幅增长。尽管公司已建立规范的管理体系，经营状况良好，但随着公司规模迅速的扩大，技术创新要求将加快，组织结构和管理体系需要向更有效率的方向发展，公司经营决策和风险控制难度将增加。如公司的组织管理体系和人力资源不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，公司的生产经营和业绩提升将受到一定影响。

## 七、大股东控制风险

目前公司的控股股东同方股份持有公司 25%的股份，本次重组完成后，预计同方股份持有的公司股份比例将增加至 51.83%，处于绝对控股地位。同方股份可能通过公司董事会或通过行使股东表决权等方式对公司的人事、经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司其他股东的利益。

同方股份承诺，保证在本次重组完成后，将按照中国证监会规范性文件的要求，做到与晶源电子在资产、业务、机构、人员、财务方面完全分开，切实保障晶源电子在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立运作。

## 八、股市风险

股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩，还受到宏观经济周期、利率、资金供求关系等因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。因此，股票交易是一种风险较大的投资活动，投资者对此应有充分准备。公司本次交易需要有关部门审批，且审批时间存在不确定性，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

## 第十五节 独立董事、财务顾问和法律顾问对本次交易的结论性意见

### 一、独立董事意见

公司独立董事一致认为：

1、公司第四届董事会第四次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次非公开发行股份购买资产暨关联交易事项相关议案时履行了法定程序。

2、本次非公开发行股份购买资产构成关联交易，关联董事在表决过程中依法进行了回避，也没有代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。

3、公司聘请的评估机构具有证券从业资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估机构具有充分的独立性。

4、公司本次非公开发行股份购买资产暨关联交易涉及评估报告的评估假设前提能按照国家有关法规与规定进行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；评估目的与评估方法相关，评估方法合理。

5、公司本次交易标的资产的最终交易价格以评估机构出具评估报告的评估值为参考依据，并经公司与交易对方协商确定，交易价格合理、公允，不会损害中小投资者利益。

6、本次交易有利于实现公司战略目标，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况。清华控股有限公司、同方股份有限公司已就避免同业竞争、减少和规范关联交易的措施、保证上市公司独立性和完善公司治理结构等方面出具了相关承诺函；这些行为都符合全体股东的现实及长远利益。

7、本次关联交易是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益。

8、本次非公开发行股份购买资产暨关联交易尚需获得公司股东大会审议批准和中国证监会核准。

综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。

## 二、律师法律意见

本公司聘请北京市中咨律师事务所作为本次交易的法律顾问，北京市中咨律师事务所出具的法律意见书认为：

“上市公司具有本次交易的主体资格；同方股份、清晶微科技和赵维健等八位自然人具有本次交易主体资格以及上市公司本次发行股票对象的主体资格；现阶段已履行的相关批准程序合法有效；签署的相关协议条款符合法律、法规的规定；所涉主要资产权属清晰；本次重大资产重组事项已按照规定阶段履行了法定的信息披露和报告义务，不存在应披露而未披露的合同、协议或安排；上市公司本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《重组问题的规定》等法律、法规和规范性文件及《唐山晶源裕丰电子股份有限公司章程》的有关规定；上市公司本次发行股票购买资产、同方股份及其一致行动人申请豁免要约收购义务尚需取得中国证监会的核准。”

## 三、独立财务顾问意见

本公司聘请西南证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问。西南证券股份有限公司出具的独立财务顾问报告认为：

“本次交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，按相关法律、法规的规定履行了相应的程序，进行了必要的信息披露。本次交易已经晶源电子第四届董事会第四次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过，独立董事为本次关联交易事项出具了独立意见。本次交易所涉及的拟购买资产，已经过具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估公司的审计和评估。本次交易拟购买资产的价格是以评估值为参考，经交易双方协商确定的，体现了交易价格的客观、公允。本次交易有利于实现上市公司战略目标，打造电子元器件领域完整的

产业链；有利于改善上市公司的财务状况，提高上市公司的盈利能力与可持续发展能力。本次交易充分考虑到了对中小股东利益的保护，切实、可行。对本次交易可能存在的风险，晶源电子已经作了充分详实的披露，有助于全体股东和投资者对本次交易的客观评判。”

## 第十六节 相关中介机构

### 一、独立财务顾问

名称：西南证券股份有限公司  
通讯地址：北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 A 座四层  
法定代表人：王宜四  
电话：010-88092288  
传真：010-88091826  
联系人：汪子文、葛晓云、董建华

### 二、法律顾问

名称：北京市中咨律师事务所  
地址：北京市西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 6-8 层  
负责人：贾军  
电话：010-66091188  
传真：010-66091616  
联系人：贾军、杨利

### 三、审计机构

名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司  
地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层  
法定代表人：王全洲  
电话：010-82250666  
传真：010-82250851  
联系人：王全洲、杨轶辉

### 四、资产评估机构

名称：中发国际资产评估有限公司  
地址：北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 31 层 3102 室  
法定代表人：陈思

电话： 010-88576650  
传真： 010-88576645  
联系人： 高虎、秦宇

## 第十七节 董事及相关中介机构的声明

- 一、公司全体董事声明
  - 二、同方股份有限公司声明
  - 三、北京清晶微科技有限公司声明
  - 四、八位自然人声明
  - 五、审计机构声明
  - 六、评估机构声明
  - 七、法律顾问声明
  - 八、独立财务顾问声明
- 以上声明均附后。

## 一、公司全体董事声明

本公司全体董事承诺本报告书及本次非公开发行股份购买资产暨关联交易之申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

陆致成：\_\_\_\_\_ 赵维健：\_\_\_\_\_ 孙岷：\_\_\_\_\_

潘晋：\_\_\_\_\_ 段立：\_\_\_\_\_ 阎立群：\_\_\_\_\_

王震：\_\_\_\_\_ 崔树军：\_\_\_\_\_ 陈新：\_\_\_\_\_

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

年 月 日

## 二、同方股份有限公司声明

本公司承诺《唐山晶源裕丰电子股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》中由同方股份有限公司提供的相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

荣泳霖

同方股份有限公司

年 月 日

### 三、北京清晶微科技有限公司声明

本公司承诺《唐山晶源裕丰电子股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》中由北京清晶微科技有限公司提供的相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

陆致成

北京清晶微科技有限公司

年 月 日

#### 四、八位自然人声明

本人承诺《唐山晶源裕丰电子股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》中由本人提供的相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

赵维健：\_\_\_\_\_ 葛元庆：\_\_\_\_\_ 吴行军：\_\_\_\_\_

段立：\_\_\_\_\_ 孟红霞：\_\_\_\_\_ 宋翌：\_\_\_\_\_

丁义民：\_\_\_\_\_ 李刚：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 五、 审计机构声明

本公司保证唐山晶源裕丰电子股份有限公司在《唐山晶源裕丰电子股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》中引用本公司出具的审计报告、盈利预测审核报告中的相关内容已经本公司审阅，确认《唐山晶源裕丰电子股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定 代 表 人： \_\_\_\_\_  
王全洲

经 办 注 册 会 计 师： \_\_\_\_\_  
王全洲

经 办 注 册 会 计 师： \_\_\_\_\_  
杨轶辉

北京兴华会计师事务所有限责任公司

年 月 日

## 六、资产评估机构声明

本公司保证唐山晶源裕丰电子股份有限公司在《唐山晶源裕丰电子股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》中引用本公司出具的《资产评估报告书》中的相关内容已经本公司审阅，确认《唐山晶源裕丰电子股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人： \_\_\_\_\_  
陈思

经办资产评估师： \_\_\_\_\_  
高虎

经办资产评估师： \_\_\_\_\_  
秦宇

中发国际资产评估有限公司

年 月 日

## 七、法律顾问声明

本所保证唐山晶源裕丰电子股份有限公司在《唐山晶源裕丰电子股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》中引用本所出具的《法律意见书》的相关内容已经本所审阅，确认《唐山晶源裕丰电子股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人：\_\_\_\_\_

贾军

经办律师：\_\_\_\_\_

贾军

经办律师：\_\_\_\_\_

杨利

、

北京市中咨律师事务所

年 月 日

## 八、独立财务顾问声明

本公司保证唐山晶源裕丰电子股份有限公司在《唐山晶源裕丰电子股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》中引用本公司出具的《独立财务顾问报告》的相关内容已经本公司审阅，确认《唐山晶源裕丰电子股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定 代 表 人：\_\_\_\_\_

王宜四

西南证券股份有限公司

2012年 月 日

## 第十八节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、晶源电子关于本次非公开发行股份购买资产暨关联交易的董事会决议；
- 2、晶源电子关于本次非公开发行股份购买资产暨关联交易的监事会决议；
- 3、晶源电子独立董事关于本次交易的独立董事意见；
- 4、晶源电子关于本次非公开发行股份购买资产暨关联交易的临时股东大会决议；
- 5、同方股份关于本次交易的临时股东大会决议；
- 6、清晶微科技关于本次交易的临时股东大会决议；
- 7、晶源电子与交易对方签订的《非公开发行股票购买资产协议》、《非公开发行股票购买资产补充协议》及《利润补偿协议》；
- 8、兴华事务所出具的同方微电子最近三年一期财务报告及审计报告；
- 9、兴华事务所出具的晶源电子最近两年一期备考财务报告及审计报告；
- 10、兴华事务所出具的同方微电子最近一年一期盈利预测报告及审核报告；
- 11、兴华事务所出具的晶源电子最近一年一期备考盈利预测报告及审核报告；
- 12、中发评估出具的关于同方微电子100%股权的资产评估报告（中发评报字【2010】第083号和中发评报字【2011】第103号）；
- 13、中咨律师出具的关于本次交易的法律意见书；
- 14、西南证券出具的关于本次交易的独立财务顾问报告。

### 二、备查地点

投资者可在本报告书刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午9:30-11:30，下午2:00-5:00，于下列地点查阅上述文件。

- 1、唐山晶源裕丰电子股份有限公司

办公地址：河北省玉田县无终西街 3129 号

董事会秘书：杜林虎

证券事务代表：董玉洁

联系电话：0315-6198181

传真：0315-6198179

## 2、西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

联系地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座四层

电话：010-88092288

传真：010-88091826

联系人：汪子文、葛晓云

## 3、指定信息披露报刊：中国证券报

## 4、指定信息披露网址：<http://www.cninfo.com.cn>

（此页无正文，为《唐山晶源裕丰电子股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》之签字盖章专用页）

法定代表人： \_\_\_\_\_

陆致成

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

年 月 日